분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인

면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성전자주식회사

대 표 이 사 : 권 오 현

본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
(전 화) 031-200-1114
(홈페이지) http://www.samsung.com/sec

작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 남 궁 범
(전 화) 031-277-7218

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ——— 1

I. 회사의 개요 ——— 2

1. 회사의 개요 ——— 2

2. 회사의 연혁 ——— 28

3. 자본금 변동사항 ——— 35

4. 주식의 총수 등 ——— 36

5. 의결권 현황 ——— 41

6. 배당에 관한 사항 등 ——— 42

II. 사업의 내용 ——— 43

III. 재무에 관한 사항 ——— 99

1. 요약재무정보 ——— 99

2. 연결재무제표 ——— 102

3. 연결재무제표 주석 ——— 109

4. 재무제표 ——— 198

5. 재무제표 주석 ——— 205

6. 기타 재무에 관한 사항 ——— 275

IV. 감사인의 감사의견 등 ——— 302

V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ——— 304

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ——— 305

1. 이사회에 관한 사항 ——— 305

2. 감사제도에 관한 사항 ——— 314

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ——— 316

VII. 주주에 관한 사항 ——— 317

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ——— 323

1. 임원 및 직원의 현황 ——— 323

2. 임원의 보수 등 ——— 351

IX. 계열회사 등에 관한 사항 ——— 353

X. 이해관계자와의 거래내용 ——— 385

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ——— 389

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2017. 11. 14

삼성전자 주식회사

대표이사 : 권 오 현 (서명)

신고업무 담당임원 : 노 희 찬 (서명)

대표이사 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며,
1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.
당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를
삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
전화번호 : 031-200-1114
홈페이지 : http://www.samsung.com/sec

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 CE(Consumer Electronics), IM(Information technology & Mobile communications), DS(Device Solutions) 3개의 부문과 전장부품사업 등을 영위하는 Harman부문(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속회사)으로 나누어 독립 경영을 하고 있습니다.

각 부문별 제품은 아래와 같습니다.

부문	제품
CE	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의료기기 등
IM	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS	DRAM, NAND Flash, 모바일AP, TFT-LCD, OLED 등
Harman	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산・판매법인, Harman 산하 종속회사 등 278개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

[CE 부문]

CE 부문은 혁신적인 기술, 독특한 디자인, 편의성과 가치를 겸비한 제품을 통해 디지털시대 소비자들의 현재 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 미래의 수요를 예측하여 새로운 상품을 지속적으로 선보임으로써 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있습니다.

TV는 CE 사업 분야의 핵심 제품으로 2016년까지 11년째 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. LCD, LED TV 등 제품의 하드웨어 경쟁우위는 물론, Smart TV 분야에서도 독보적인 우위를 점하며 소프트웨어 산업으로의 전환을 선도하고 있습니다. 앞으로도 신기술의 개척 및 끊임없는 혁신을 통해 시장 지배력을 계속 확대할 계획입니다.

[IM 부문]

IM 부문은 모바일 컨버전스를 넘어 Soft Driven Company로의 패러다임 전환을 주도하고 있습니다. 또한, Premium 브랜드 '갤럭시(GALAXY)'를 필두로 소비자에게 가장 친화적이고 혁신적인 제품으로 모바일 라이프스타일을 선도하고 있습니다.

HHP의 경우 스마트폰 사업 강화 등 시장의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 최근에는 HHP가 MP3, 카메라, PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하는 등

단순 특화 영역을 뛰어넘어 스마트폰과 태블릿 등으로 발전하면서 끊임없이 신규수요를 창출하고 있습니다.
당사는 스마트폰 등 다양하고 차별화된 HHP 제품과 더불어 차세대 통신 기술의 개발과 표준화 사업을 주도하는 Long Term Evolution(LTE) 등 글로벌 통신 산업을 이끌고 있습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 정보를 저장하고 기억하는 메모리와 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 생산/판매하는 System LSI 등의 반도체 사업과 액정화면 표시 장치인 Display Panel을 생산/판매하는 Display 사업으로 구성되어 있으며, DRAM 등 정보 저장 용량의 획기적인 개선 및 모바일 제품의 두뇌에 해당하는 AP제품 성능 향상을 통한 완성품의 신수요 창출을 통하여 완제품 시장을 선도할 수 있는 역량을 지속적으로 확대/강화하고 있습니다.

반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등 초미세 공정 기술을 적용하여 경쟁사 대비 차별성 있는 제품의 생산과 원가 경쟁력을 지속적으로 확보하여 전세계 메모리 시장의 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.
System LSI는 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며 당사는 지속적으로 추진해온 선행 공정 개발로 AP, CIS 등의 제품 차별화 및 경쟁력 제고로 시장 지배력을 확대시켜 나갈 것입니다.
Foundry는 업계 최초로 2016년 4분기에 10나노 제품을 공급하는 등 시장을 주도하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

OLED는 Flexible 제품에 대한 시장 수요에 적기 대응 가능한 시스템을 구축하는 한편, 경쟁사와의 지속적인 기술 차별화를 진행하여 시장을 선도하고 있습니다.
또한, TFT-LCD는 고화질, 초대형, Quantum Dot, Frameless 등 고부가 제품의 판매를 확대하고, 수율 및 원가를 지속적으로 개선하여 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

[Harman 부문]

Harman 부문은 커넥티드카 시스템, 오디오/비디오 제품, 프로페셔널솔루션 및 커넥티드 서비스 사업분야에서 전세계 자동차 제조사, 소비자 및 기업을

대상고객으로 커넥티드 제품과 솔루션을 디자인하고 개발하는 등
전장 부품 시장을 선도하고 있습니다.
Harman 부문은 주요시장에서 널리 알려진 브랜드들과 다양한 제품군을
보유하고 있으며, 자체적인 개발 또는 지속적인 전략적 인수들을 통해
각 사업분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2017년 3분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 4개 회사(삼성액티브자산운용, 삼성헤지자산운용, 하만인터내셔널코리아, 레드벤드소프트웨어코리아)가 증가하여 62개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(2017.09.30. 현재)

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
상장사	16	삼성물산㈜	1101110015762
		삼성전자㈜	1301110006246
		삼성에스디아이㈜	1101110394174
		삼성전기㈜	1301110001626
		삼성화재해상보험㈜	1101110005078
		삼성중공업㈜	1101110168595
		삼성생명보험㈜	1101110005953
		㈜멀티캠퍼스	1101111960792
		삼성증권㈜	1101110335649
		삼성에스디에스㈜	1101110398556
		삼성카드㈜	1101110346901
		삼성엔지니어링㈜	1101110240509
		㈜에스원	1101110221939
		㈜제일기획	1101110139017
		㈜호텔신라	1101110145519
		삼성바이오로직스㈜	1201110566317
		㈜서울레이크사이드	1101110504070
		㈜삼우종합건축사사무소	1101115494151
		㈜씨브이네트	1101111931686
		삼성바이오에피스㈜	1201110601501
		삼성디스플레이㈜	1345110187812
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140000991
		에스유머티리얼스㈜	1648110061337
		스테코㈜	1647110003490
		세메스㈜	1615110011795
		삼성전자서비스㈜	1301110049139

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
비상장사	46	삼성전자판매㈜	1801110210300
		삼성전자로지텍㈜	1301110046797
		수원삼성축구단㈜	1358110160126
		삼성메디슨㈜	1346110001036
		삼성화재애니카손해사정㈜	1101111595680
		삼성화재서비스손해사정㈜	1101111237703
		㈜삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		대정해상풍력발전(주)	2201110095315
		삼성선물㈜	1101110894520
		삼성자산운용㈜	1701110139833
		㈜생보부동산신탁	1101111617434
		삼성생명서비스손해사정㈜	1101111855414
		삼성에스알에이자산운용㈜	1101115004322
		㈜삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
		에스디플렉스㈜	1760110039005
		제일패션리테일㈜	1101114736934
		네추럴나인(주)	1101114940171
		삼성웰스토리㈜	1101115282077
		에스프린팅솔루션㈜	1358110303346
		㈜시큐아이	1101111912503
		에스티엠㈜	2301110176840
		에스코어㈜	1101113681031
		오픈핸즈㈜	1311110266146
		㈜미라콤아이앤씨	1101111617533
		삼성카드고객서비스㈜	1101115291656
		㈜휴먼티에스에스	1101114272706
		에스원씨알엠㈜	1358110190199
		신라스테이㈜	1101115433927
		에이치디씨신라면세점㈜	1101115722916
		㈜삼성경제연구소	1101110766670
		㈜삼성라이온즈	1701110015786
		삼성벤처투자㈜	1101111785538
		삼성액티브자산운용㈜	1101116277382
		삼성헤지자산운용㈜	1101116277390
		㈜하만인터내셔널코리아	1101113145673
		레드벤드소프트웨어코리아 ㈜	1101113613315

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
計	62		

☞ 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속기업 개황

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의
연결대상 종속기업은 2017년 3분기말 현재 278개사입니다.
전년말 대비 118개 기업이 증가하고, 9개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부
Samsung Electronics America, Inc.	1978.07	Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA	전자제품 판매	21,810,491	의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	O
NexusDX, Inc.	2009.07	6759 Mesa Ridge Road Suite 100 San Diego, CA 92121	의료기기	7,912	상동	X
NeuroLogica Corp.	2004.02	14 Electronics Ave. Danvers, MA 01923 USA	의료기기	199,830	상동	O
Dacor Holdings, Inc.	1998.12	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	Holding Company	27,553	상동	X
Dacor	1965.03	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	가전제품 생산 및 판매	28,992	상동	X
Dacor Canada Co.	2001.06	Summit Place 6th floor 1601 Lower Water St. Halifax, Nova Scotia, B3J 3P6 Canada	가전제품 판매	46	상동	X
EverythingDacor.com, Inc.	2006.06	1440 Bridge Gate Drive Diamond Bar, CA 91765	가전제품 판매	166	상동	X
Distinctive Appliances of California, Inc.	2014.06	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	가전제품 판매	211	상동	X
Samsung HVAC America, LLC (舊Quietside LLC)	2001.07	3001 Northern Cross Blvd. #861 Fort Worth TX 76137 USA	에어컨공조 판매	42,556	상동	X
SmartThings, Inc.	2012.04	456 University Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94301	스마트홈기기 판매	219,398	상동	O
Samsung Oak Holdings, Inc.	2016.06	3655 N. First St. San Jose, CA 95134	Holding Company	171,546	상동	O
Joyent, Inc.	2005.03	655 Montgomery Street, Suite 1600, San Francisco, CA 94111	클라우드서비스	240,548	상동	O
Samsung Pay, Inc.	2006.03	8 New England Executive Park #220, Burlington, MA, USA	모바일 결제 개발 및 서비스	318,244	상동	O
Stellus Technologies, Inc.	2015.11	3500 South Dupont Highway, Dover, DE 19901	반도체 시스템 생산 및 판매	6,475	상동	X
Prismview, LLC	2007.10	1651 N 1000 W, Logan, Utah 84321	LED 디스플레이 생산 및 판매	62,453	상동	X
Samsung Semiconductor, Inc.	1983.07	North First St. San Jose, CA, USA	반도체/DP 판매	7,804,698	상동	O
Samsung Electronics Canada, Inc.	1980.07	2050 Derry Road West, Mississauga, ON, Canada	전자제품 판매	728,783	상동	O
PrinterOn Inc.	2000.04	221 McIntyre Drive Kitchener, Ontario, Canada	프린팅솔루션 판매	5,914	상동	X
PrinterOn America Corporation	1986.04	11041 Saratoga Drive Orland Park IL USA	프린팅솔루션 판매	502	상동	X
AdGear Technologies Inc.	2010.08	481 Viger West, Suite 300, Montreal, QC, Canada, H2Z 1G6	디지털광고 플랫폼	6,120	상동	X
Viv Labs, Inc.	2012.09	10 Almaden Boulevard Suite 560, San Jose, CA 95113, USA	인공지능 서비스	265,895	상동	O
NewNet Communication Technologies (Canada), Inc.	2009.07	26 Union Street, Suite 305, Bedford, Nova Scotia, Canada B4A 2B5	문자메시지 개발	819	상동	X
RT SV CO-INVEST, LP	2014.02	260 East Brown Street, Suite 380 Birmingham, MI 48009, USA	벤처기업 투자	13,622	상동	X
Samsung Research America, Inc	1988.10	665 Clyde Avenue Mountain View CA, USA 94043	R&D	629,484	상동	O

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Samsung Next LLC	2016.08	665 Clyde Avenue Mountain View CA, USA 94043	Holding Company	60,441	상동	X
Samsung Next Fund LLC	2016.08	665 Clyde Avenue Mountain View CA, USA 94043	신기술사업자, 벤처기업 투자	60,566	상동	X
Samsung International, Inc.	1983.10	9335 Airway Rd. Suite 105 San Diego, CA, USA 92154	CTV/모니터 생산	51,309	상동	X
Samsung Mexicana S.A. de C.V	1988.03	Parque Ind. El Florido Seguna Seccion Tijuna B.C. Mexico	전자제품 생산	917,188	상동	O
Samsung Austin Semiconductor LLC.	1996.02	12100 Samsung Blvd. Austin, Texas USA 78754	반도체 생산	4,940,748	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	1995.07	Col. Chapultepec Morales, Del Miguel Hidalgo D.F, Mexico	전자제품 판매	1,136,282	상동	O
SEMES America, Inc.	1998.10	78754 9701 Dessau Rd. #305 Austin Texas, USA	반도체 장비	1,090	상동	X
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	2012.12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro, Sta. Rosa Jauregui C.P 76220 Queretaro Queretaro, Mexico	전자제품 생산	497,064	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	1995.05	9800 NW 41st Street Suite 200, Miami, FL, USA 33178	전자제품 판매	247,467	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	1989.04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	370,058	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A.	2010.05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas Venezuela	마케팅 및 서비스	1,361	상동	X
Samsung Electronica Colombia S.A.	1997.03	Carrera 7 #114-43 Oficina 606 Bogota Colombia	전자제품 판매	410,668	상동	O
Samsung Electronics Panama. S.A.	2012.07	Torre de Las Americas, TorreC, Piso 23, Panama City Panama	컨설팅	1,572	상동	X
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	1995.01	Avenida das Nacoes Unidas, 12901-8 andar - Torre Oeste Brooklin Novo Sao Paulo SP Brazil	전자제품 생산 및 판매	5,200,799	상동	O
Simpress Comercio, Locacao e Servicos S.A.	2005.02	Rua Ricardo Cavatton, 227 - Lapa de Baixo CEP 05038-110 - Sao Paulo - SP - Brazil	프린팅솔루션 판매	148,581	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A.	1996.06	Bouchard 7107 Piso Ciudad de Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	60,558	상동	X
Samsung Electronics Chile Limitada	2002.12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	438,074	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C.	2010.04	Ricardo Rivera Navarrete 501, 9th floor, Avenue, Peru	전자제품 판매	280,653	상동	O
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	2017.08	284 Mawsons way, SC 29108	가전제품 생산	0	상동	X
Kngine, Inc.	2011.05	665 Clyde Avenue, Mountain View, CA 94043 USA	소프트웨어 개발	446	상동	X
AMX Holding Corporation	1982.04	3000 Research Drive Richardson, TX 75082	Holding Company	0	상동	X
AMX LLC	2006.01	3000 Research Drive Richardson, TX 75082	Holding Company	495,948	상동	O
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981.06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan 48377	오디오제품 생산, 판매, R&D	4,043,677	상동	O
Harman Connected Services Inc.	2002.02	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043	Connected Service Provider	92,836	상동	O
Harman Connected Services Engineering Corp.	2002.02	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043	Connected Service Provider	19,555	상동	X
Harman Connected Services Holding Corp.	2002.02	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043	Connected Service Provider	858,333	상동	O
Harman Connected Services South America S.R.L.	2015.04	Tucuman 1, 4th Floor, City of Buenos Aires	Connected Service Provider	325	상동	X
Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes Ltda.	2005.04	AV. Torquato Tapajos No. 10993 KM10 Taruma, City of Manaus, State of Amazonas BR	오디오제품 생산, 판매	67,945	상동	X
Harman de Mexico S. de R.L. de C.V.	1988.01	2290 Ave Delas Torres Cd. Juarez, Chih 32575 MX	오디오제품 생산	90,368	상동	O
Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	1973.03	City of Nova Santa Rita, Tabai-Canos Highway BR B R 386, KM 435	오디오제품 판매, R&D	189,579	상동	O

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Harman Financial Group, LLC	2014.06	400 Atlantic Street, 15th Floor Stamford, CT 06901	Management Company	0	상동	X
Harman International Industries Canada Ltd.	2005.12	301, 1321 Blanshard Street Victoria BC V8W 0B6	오디오제품 판매	0	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980.01	400 Atlantic Street, 15th Floor Stamford, CT 06901	Holding Company	7,651,766	상동	O
Harman International Mexico S de RL de CV	2014.11	2290 Ave Delas Torres Cd. Juarez, Chih 32575 MX	오디오제품 판매	16,687	상동	X
Harman Investment Group, LLC	2015.12	400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901	Financing Company	559,299	상동	O
Harman KG Holding, LLC	2009.03	400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901	Holding Company	0	상동	X
Harman Professional, Inc.	1994.08	8500 Balboa Blvd. Northridge, CA	오디오제품 판매, R&D	839,019	상동	O
Red Bend Software Inc.	2001.03	400-1 Totten Pond Road , Suite 130 Waltham, MA 02451	소프트웨어 디자인	31,293	상동	X
S1NN USA, Inc.	2011.02	1227 Prospect Street, Suite 200 La Jolla, CA 92037	R&D	371	상동	X
Southern Vision Systems, Inc	2003.04	360B Quality Circle Suite 200 Huntsville, AL 35806	영상 감지 장치 개발	29,572	상동	X
Triple Play Integration LLC	2013.11	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043	Connected Service Provider	6,327	상동	X
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014.12	Elian Fiduciary Services Limited, 89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands	벤처기업 투자	29,229	상동	X
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	2017.09	23 Lime Tree Bay Avenue, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	벤처기업 투자	0	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd.	1995.07	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	1,520,376	상동	O
Samsung Electronics(London) Ltd.	1999.01	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	Holding Company	6,503	상동	X
Samsung Electronics Holding GmbH	1982.02	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6, Schwalbach, Germany	Holding Company	532,697	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH	1987.12	Koelner Str. 12, 65760 Eschborn, Germany	반도체/DP 판매	708,694	상동	O
Samsung Electronics GmbH	1984.12	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6, Schwalbach, Germany	전자제품 판매	1,621,827	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A.	1989.01	Parque Empresarial Omega Edificio C Avenida de, Barajas, Espanol	전자제품 판매	794,238	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S	1988.01	1 Rue Fructidor 93400 Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,207,985	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	1989.10	H-1037 Budapest, Szepvolgyi ut 35-37, Hungary	전자제품 생산 및 판매	1,743,979	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	2010.01	V Parku 14, Praha, Czech Republic 14800	전자제품 판매	160,497	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A.	1991.04	Via Carlo Donat Cattin 5, Cernusco sul Naviglio, 20073 Milan Italy	전자제품 판매	901,906	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	1991.05	Olof Palmestraat 10, 2616LR Delft, The Netherlands	물류	2,887,230	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V.	1995.07	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, The Netherlands	전자제품 판매	1,319,479	상동	O
Samsung Display Slovakia s.r.o.	2007.03	919 42 Voderady 401 Voderady Slovakia	DP 임가공	147,955	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC	2007.09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VI, Nord City Tower Voluntari Ilfov Romania	전자제품 판매	201,775	상동	O
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	1996.04	ul.Marynarska 15 Warszawa Poland	전자제품 판매	526,135	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa S.A.	1982.09	Lagoas Parque, Edificio 5B Piso 0 2740-298 Porto Salvo - Portugal	전자제품 판매	157,324	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	1992.03	Kanal Vagen 10A, 194 27, Upplands Vasby, Sweden	전자제품 판매	961,566	상동	O
Samsung Semiconductor Europe Limited	1997.04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체/DP 판매	94,095	상동	O

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Samsung Electronics Austria GmbH	2002.01	Praterstraß e 31 1020 Vienna Austria	전자제품 판매	303,737	상동	O
Samsung Electronics Switzerland GmbH	2013.05	CH-8055 Binzallee 4, Samsung Electronics Zurich ZH, Switzerland	전자제품 판매	160,434	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o	2002.06	Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia	CTV/모니터 생산	2,053,467	상동	O
Samsung Electronics Baltics SIA	2001.10	Duntes iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	111,574	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	2008.10	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, The Netherlands	Holding Company	8,643,308	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	2010.02	ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland	가전제품 생산	336,490	상동	O
Samsung Electronics Greece S.A.	2010.04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232 Athens Greece	전자제품 판매	89,948	상동	O
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	2017.04	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, The Netherlands	에어컨공조 판매	0	상동	X
Samsung Nanoradio Design Center	2004.02	Torshamnsgatan 39 164 40 Kista Sweden	R&D	24,330	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS	2012.09	c/o Novi Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø st, Denmark	R&D	21,170	상동	X
Samsung France Research Center SARL	2012.10	Les 2 Arcs, Bat.B, etage 4, 1800 Route des cretes, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France	R&D	15,729	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited	2012.09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, UK, CB4 0ZT	R&D	115,546	상동	O
PrinterOn Europe Limited	2013.11	Wesley Gate Queens Road Reading Berkshire RG14AP, United Kingdom	프린팅솔루션 판매	59	상동	X
Joyent Ltd.	2014.04	31-37 Church Street, Reigate, Surrey, RH2 0AD	클라우드서비스	1,615	상동	X
Samsung Electronics Overseas B.V.	1997.01	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, The Netherlands	전자제품 판매	126,485	상동	O
Innoetics E.P.E.	2006.04	Artemidos 6, Athens 151 25 Greece	소프트웨어 개발	102	상동	X
Aditi Technologies Europe GmbH	2013.03	Friedrichstrasse 90, 10117 Berlin, Germany	오디오제품 판매 등	0	상동	X
AKG Acoustics GmbH	1940.01	Lemboeckgasse 21-25 P.O. Box 158 A-1230 Vienna, Austria	오디오제품 생산, 판매	378,592	상동	O
AMX GmbH	2008.03	Behrstrasse 100, D-73240 Wendlingen, Germany	오디오제품 판매	9,556	상동	X
AMX UK Limited	1993.03	Roland Court _ Huntington Road York Y03 9PW United Kindom	오디오제품 판매	9,945	상동	X
ARCAM Ltd	2004.07	The West Wing Stirling House, Waterbeach, Cambridge CB25 9PB	Holding Company	5,862	상동	X
A&R Cambridge Ltd	1993.12	The West Wing Stirling House, Waterbeach, Cambridge CB25 9PB	오디오제품 판매	6,616	상동	X
Duran Audio B.V.	1987.08	Koxkampseweg 10, 5301KK Zaltbommel The Netherlands	오디오제품 판매, R&D	565,015	상동	O
Duran Audio Iberia Espana S.L.	2012.11	Calle Castillo De Fuensaldana, Portal 4, 2º Piso, Puerta 229 - 28232 Las Rozas de Madrid	오디오제품 판매	0	상동	X
Endeleo Limited	2003.05	Auster Road, Clifton Moor York, YO30 4GD UK	오디오제품 판매, R&D	0	상동	X
Harman Automotive UK Limited	2012.10	6th Floor, Salisbury House London Wall London England EC2M 5QQ	오디오제품 생산	725,859	상동	O
Harman Becker Automotive Systems GmbH	2012.06	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307 GM	오디오제품 생산, 판매, R&D	1,175,168	상동	O
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	2005.12	Via Turati 18, Milano, 20121 IT	오디오제품 판매	754	상동	X
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	1997.12	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fasor 19-HU	오디오제품 생산, R&D	1,461,389	상동	O
Harman Belgium SA	1994.12	Bosdellestraat 120 Sterrebeek, 1933 BE	오디오제품 판매	565	상동	X

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Harman Connected Services AB.	1984.10	Hallenborgs Gata 13 Malmo SW 211 19	Connected Service Provider	42,059	상동	X
Harman Connected Services Finland OY	1983.05	Teknikantie 12 Espoo FI 02150	Connected Service Provider	1,141	상동	X
Harman Connected Services GmbH	2005.12	Neumeyerstrasse 50 Nurnberg, GM DE-90411	Connected Service Provider	50,070	상동	X
Harman Connected Services Limited	1992.12	137 Barlow Moor Road Didsbury Manchester UK M20 2PW	Connected Service Provider	5,329	상동	X
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007.06	Ul Kasprzaka 6 Lodz PL 91-803	Connected Service Provider	2,622	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008.09	3000 Cathedral Hill Guildfold, Surrey UK GU7YP	Connected Service Provider	24,711	상동	X
Harman Consumer Division Nordic A/S	1991.01	Hejreskovvej 18A Kvistgaard, DK-3460 DA	오디오제품 판매	21,110	상동	X
Harman Consumer Finland OY	2002.07	Koysikuja 1 Vantaa, 01640 FI	오디오제품 판매	2	상동	X
Harman Consumer Nederland B.V.	1995.12	Wilgenweg 8B, AM Groot-Ammers, 2964 NL	오디오제품 판매	36,295	상동	X
Harman Deutschland GmbH	1998.03	Hunderstrabe 1 Heilbronn, 74080 GM	오디오제품 판매	0	상동	X
Harman Finance International GP S.a.r.l	2015.04	6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duche de Luxembourg	Holding Company	0	상동	X
Harman France SNC	1995.07	2 Route De Tours Chateau De Loir, FR 72500	오디오제품 판매	153,505	상동	O
Harman Holding Gmbh & Co. KG	2012.03	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307 GM	Management Company	1,046,654	상동	O
Harman Hungary Financing Ltd.	2012.06	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fasor 19-HU	Financing Company	538,830	상동	O
Harman Inc. & Co. KG	2012.03	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307 GM	Holding Company	16	상동	X
Harman International Estonia OU	2015.05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, 11317	R&D	166	상동	X
Harman International Industries Limited	1980.03	6th Floor, Salisbury House London Wall London England EC2M 5QQ	오디오제품 판매 등	529,173	상동	O
Harman International Romania SRL	2014.12	Piata Montreal no. 10, Bldg WTC, En 1st Flr, Office 138, Buchartest RO	R&D	130	상동	X
Harman Finance International SCA	2015.04	6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duche de Luxembourg	Financing Company	459,415	상동	O
Harman International s.r.o	2015.02	Pobe n 394/12, Karl n, 186 00 Pra	오디오제품 생산	186	상동	X
Harman International SNC	1995.07	2 Route De Tours Chateau De Loir, FR 72500	오디오제품 판매	4,403	상동	X
Harman Management GmbH	2002.05	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307 GM	Holding Company	6	상동	X
Harman Professional Kft	2014.12	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fasor 19-HU	오디오제품 생산, R&D	90,250	상동	O
Inspiration Matters Limited	2002.06	Auster Road, Clifton Moor York, YO30 4GD UK	오디오제품 판매, R&D	0	상동	X
Knight Image Limited	1989.06	Auster Road, Clifton Moor York, YO30 4GD UK	오디오제품 판매, R&D	0	상동	X
Martin Manufacturing (UK) Ltd	1985.05	Belvoir Way, Fairfield Industrial Est, Louth LN11 0LQ	오디오제품 생산	4,322	상동	X
Harman Professional Denmark ApS	1987.07	Olof Palmes Alle 18 DK-8200 Aarhus N	오디오제품 판매, R&D	221,325	상동	O
Harman Professional France SAS	1989.09	1, rue du Gevaudan, 91090 Lisses	오디오제품 판매	641	상동	X
Harman Professional Germany GmbH	1999.12	Robert-Bosch-Straß e 2 85716 Unterschleiß heim Germany	오디오제품 판매	952	상동	X
R&D International BVBA	1989.12	3400 Landen, Industriezone Roosveld 9A	오디오제품 생산	1,593	상동	X
Red Bend Software Ltd.	2004.08	27 Little Marlow Road Marlow, Bucks SL7 1HA UK	소프트웨어 디자인	8,836	상동	X
Red Bend Software SAS France	2002.10	14 Place Georges Pompidou Montigny Le Bretonne, 78180 FR	소프트웨어 디자인	26,110	상동	X

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Studer Professional Audio GmbH	2003.12	Althardstrasse 30, Regensdorf Switzerland, CH 8105	오디오제품 판매, R&D	17,130	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC	2006.10	Bolshoi Gnezdnikovsky per., 1, bldg.2 Moscow Russia	전자제품 판매	981,971	상동	O
Samsung Electronics Ukraine Company LLC	2008.09	75A, Zhylianska Str Kiev, Ukraine	전자제품 판매	112,569	상동	O
Samsung R&D Institute Rus LLC	2011.11	127018 Office 1401, building 1, 12, Dvintsev Street, Moscow Russia	R&D	15,344	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	2008.09	Naurizbay batyr st. Almaty Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	71,570	상동	X
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	2014.10	1065 Bridge Plaza Biz Centre, 6 Bakikhanov str, 12th Fl Baku Azerbaijan	마케팅	1,968	상동	X
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	2007.07	Kaluga region, Borovsk district, Koryakovo village, Pe rviy Severniy Drive,1, Russia	CTV 생산	902,533	상동	O
Harman Connected Services OOO	1998.11	23 Rodionova St. Nizhny Novgorod Russia 603093	Connected Service Provider	16,742	상동	X
Harman RUS CIS LLC	2011.08	Presnenskaya Emb, 10, Block C Moscow, 123317 RS	오디오제품 판매	27,790	상동	X
Samsung Electronics West Africa	2010.03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	67,349	상동	X
Samsung Electronics East Africa	2011.12	27577 00506, Milford Suites, 4th Floor, Pa Nairobi, Kenya	마케팅	37,782	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	1995.05	R/A-5, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE	전자제품 판매	873,034	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E	2012.07	62815 Piece No. 98,Engineering Sector, Kom Abu Ra di, Industrial Zone, AlWastaCity, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	610,030	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd.	2012.09	60972 1st Fl, Holland Building Europark Yakum Israel	마케팅	8,054	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	2012.09	1053 2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'ann ecy Les Berges du Lac 1053 Tunis, Tunisia	마케팅	3,163	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	2012.11	No.4 1st Fl. Park Lane Tower 172 Turfail Road Lahore Cantt, Lahore Pakistan	마케팅	2,581	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	1994.06	Medscheme Office Park, Phase 110 Muswell Road, S outh Bryanston, Johannesburg South Africa	전자제품 판매	491,077	상동	O
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	2014.07	35 UMKHOMAZI DR, LA MERCY, KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA, 4399	CTV/모니터 생산	59,970	상동	X
Samsung Electronics Turkey	1984.12	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 판매	630,056	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	2007.10	10 Oholiav Street, Ramat Gan 52522, Israel	R&D	43,985	상동	X
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	2009.07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St. P.O 962372, Amman 11196 , Jordan	전자제품 판매	306,299	상동	O
Samsung Electronics Maghreb Arab	2009.11	Lot N° 9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf 20190 , Ain Chock Hay Hassani Casablanca Morocco	전자제품 판매	180,605	상동	O
Broadsense Ltd.	2007.03	32 Habarzel St., Tel Aviv	서비스	0	상동	X
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	2002.01	3rd Fl Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Lous MP	Holding Company	0	상동	X
Harman Connected Services Morocco	2014.01	TECHNOPARK, ROUTE NOUACEUR, ANGLE R CASABLANCA, MO CT 1029 MO	Connected Service Provider	2,333	상동	X
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	2009.10	IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, MP	Holding Company	55,181	상동	X
iOnRoad Ltd	2011.08	Bialik St. 155, 8th Floor Ramat Gan, 52520 IS	R&D	0	상동	X
iOnRoad Technologies Ltd	2012.01	Bialik St. 155, 8th Floor Ramat Gan, 52520 IS	R&D	7,078	상동	X
Red Bend Ltd.	1998.02	8 Hangar St. Neve Ne-Eman HID Hasharson, IS 45240	오디오제품 생산	277,567	상동	O
TowerSec Ltd.	2008.04	6 Hamada Street, Herzlia, Israel 4673340	R&D	93,304	상동	O

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Samsung Japan Corporation	1975.12	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	661,483	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	1992.08	2-7,Sugasawa-cho,Tsurumi-ku,Yokohama,230-0027, Japan	R&D	156,447	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	2008.09	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	538,719	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	1995.03	Tuanku Jaafar Industrial Park, 71450 Seremban. Negeri Sembilan. Malaysia	전자제품 생산	212,535	상동	O
Samsung Medison India Private Ltd.	2009.01	H-79, Basement, Kalkaji, New dehli, India 110019	의료기기	5	상동	X
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	1989.09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park 42000 Port Klang Selangor, Malaysia	가전제품 생산	136,334	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	1995.01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam	전자제품 판매	217,496	상동	O
Samsung Asia Private Ltd.	2006.07	3 Church Street #26-01 Samsung Hub, Singapore	전자제품 판매	5,528,472	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd.	1995.08	Copia Corporate Suites, Plot no 9, Jasola District Center, New Delhi, India	전자제품 생산 및 판매	4,563,407	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	2005.05	Bagmane Tech. Park Bangalore India	R&D	190,083	상동	O
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	1987.11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127 Australia	전자제품 판매	431,774	상동	O
Samsung Electronics New Zealand Limited	2013.09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand	전자제품 판매	77,356	상동	O
PT Samsung Electronics Indonesia	1991.08	Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	1,204,467	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia	2003.03	Prudential Tower 23rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 79 Jakarta 129-10 Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	2,052	상동	X
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	1988.10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand	전자제품 생산 및 판매	2,079,865	상동	O
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	2016.09	3rd Floor Kolao Tower 2, 23 Singha Rd Vientiane Capital LAO PDR	마케팅	355	상동	X
Samsung Electronics Philippines Corporation	1996.03	8th Floor HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City Taguig 1634 Philippines	전자제품 판매	228,183	상동	O
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	2014.07	Yenphong I I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh Province Vietnam	DP 생산	3,165,239	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	2003.05	Suite E-09-01, Level 9, East Wing, The ICON ,No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak , 55000 Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	313,299	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh	2010.08	Bangladesh, Dhaka, Gulshan Avenue, Gualshan-1, Bangladesh	R&D	8,290	상동	X
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	2008.03	Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh Province, Vietnam	전자제품 생산	9,134,023	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	2013.03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen Province, Vietnam	통신제품 생산	7,646,828	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd,.	2015.02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	1,814,566	상동	O
AMX Products And Solutions Private Limited	2008.02	Evorna Business Park, Old Madras Road Bangalore, Karnataka 560049	오디오제품 판매	0	상동	X
Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	1994.07	224/16 Ramana Maharishi Road Bangalore, India 560-080	Connected Service Provider	82,663	상동	O
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	2002.04	13 Magrath Road Bangalore, India 560025	Connected Service Provider	346,732	상동	O
Harman Connected Services Japan Co. Ltd.	2009.12	1-2-3 Kaigan Minato-Ku Tokyo Japan	Connected Service Provider	275	상동	X

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Harman International (India) Private Limited	2009.01	Unit No. 301, 3rd Fl., Campus 3D Ecospace, Out Ring Road, Bangalore, Karnat, IN	오디오제품 판매, R&D	226,154	상동	O
Harman International Industries PTY, Ltd.	2014.12	Unit 3, 6 Gilda Court, Mulgrave, Victoria, Australia 3170	Holding Company	7,354	상동	X
Harman International Japan Co. Ltd.	1991.06	4F Kohtokudoh Bldg, 5-7-7 Ueno Taito-ku, Tokyo 110-0005 JA	오디오제품 판매, R&D	69,027	상동	X
Harman International Singapore Pte. Ltd.	1993.12	51 Goldhill Plaza, #09-09 Singapore, 308900 SN	오디오제품 판매	5,176	상동	X
Harman Malaysia Sdn. Bhd.	2008.07	Suite 1008, 10th Floor Wisma Lim Foo Yong, 86 Jalan Raha Chulan, Kuala Lumpur 50200 MY	오디오제품 판매	0	상동	X
Harman Professional Singapore Pte. Ltd	2007.08	13 International Business Park Labone Building #609932	오디오제품 판매	8,397	상동	X
INSP India Software Development Pvt. Ltd.	2007.06	C-4 BLOCK, WING A, MANYATA EMBASSY RACHENAHALLI VILLAGE BANGALORE, 560045 IN	소프트웨어 개발 및 공급	0	상동	X
Martin Professional Pte. Ltd.	1995.06	68 KALLANG PUDDING ROAD #06-02 SYH LOGISTICS BUILDING SINGAPORE (349327)	오디오제품 판매	4,202	상동	X
Red Bend Software KK	2005.11	12th Floor, Yurakucho Itocia 2-7-1 Yurakucho, Chiyoda-KU Tokyo 100-0006	소프트웨어 디자인	3,277	상동	X
Studer Japan, Ltd.	1982.12	3-2-1 Uehara, Shibuya-KU Tokyo, 151-0064 JA	Holding Company	5,381	상동	X
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	2001.11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, Guangdong, China	DP 생산	1,584,504	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	2004.06	NO.25,Mip Fourth Road,Xi qing District, Tianjin, China	DP 생산	1,128,400	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	1988.09	33/f., Central Plaza, 18 Harbour Road, Hong Kong	전자제품 판매	1,256,625	상동	O
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	1995.04	No.501, SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	604,198	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	1995.04	No.501, SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	379,356	상동	O
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	1996.03	Beijing, China No.118, Jian Guo Lu, Chao Yang District 2208-13/ China Merchants Tower	전자제품 판매	13,632,938	상동	O
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	2010.01	A3 Building, No.185 Kexue Avenue, Science City, Luogang District, Guangzhou, China	R&D	58,274	상동	X
Samsung Tianjin Mobile Development Center	2010.08	No.14 weiliu Rd.Micro-Electronic Industrial Park Xiqing Dist. Tianjin, China	R&D	31,391	상동	X
Samsung R&D Institute China-Shenzhen	2013.03	12th Floor, EVOC Technology Building, No. 31 Gaoxi n Central Avenue 4th,Nanshan District, Shenzhen 518057, China	R&D	12,187	상동	X
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	1994.12	Suzhou Industrial Park Suzhou No.15, JinJiHu Road, China	반도체 임가공	866,173	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013.07	#1301 - #1302, Unit 6, Building No.1, Yicuiyuan 3nd t own(North), Jinye 2nd Road Gaoxin District, Xi'an City, Shanxi Province, China	반도체 장비	899	상동	X
Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	1993.03	Samsung Road Hi-Tech IDZ, Weihai, China	프린터 생산	917,909	상동	O
Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	1992.12	256,6th Road ,Zhongkai Chenjiang Town Huizhou 516029 Guangdong China	전자제품 생산	6,174,579	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	1993.04	#12, no 4 Big Street, Dong Ting Road Teda, Tianjin, China	CTV/모니터 생산	831,374	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	1994.11	10F,No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan, R.O.C	전자제품 판매	1,857,017	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center	2000.09	china beijing Chaoyang District, xiaguangli, No. 9, Zhongdian fazhan Building,12/F	R&D	74,740	상동	X
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	2001.03	No.9 WeiWu Rd.Micro Electronic Industrial Park Xiqing Dist, Tianjin, China	통신제품 생산	1,354,396	상동	O

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd	2001.10	P.R.C. Shenzhen, 46F,New World Center, 6009 Yitian Road, Futian District, China	반도체/DP 판매	5,862,409	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	2002.09	NO.198,Fangzhou Road, Suzhou Industrial park, Jiangsu province, China	전자제품 생산	923,116	상동	O
Samsung Suzhou Module Co., Ltd.	2002.09	NO.318 Fang Zhou Road,Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	DP 임가공	734,785	상동	O
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	2011.07	NO.337 Fengli Street,IP,Suzhou, China	DP 생산	2,499,917	상동	O
Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	2002.02	Samsung Kejian Plant,No.2 songping St.,North Area of Hi-tech Park, Nanshan, Shenzhen,PRC., China	통신제품 생산	147,439	상동	O
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	2003.04	No.15, Jinjihu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	26,219	상동	X
Samsung Electronics China R&D Center	2004.05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu Province, China	R&D	41,552	상동	X
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	2012.09	A12F, City Gate, 1 Jinye Rd., Xi'an, China	반도체 생산	9,749,448	상동	O
Samsung SemiConductor Xian	2016.04	8F Customs Clearance Center , No.5 Tonghai First Road, Changan District, Xian City, China	반도체/DP 판매	318,010	상동	O
Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	2005.01	2/F, B-Building, No.2, LiZeZhongYuan 2 Road, ChaoYang District, Beijing, China	서비스	151,158	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	2009.05	300385 China Tianjin No 1. Weisan Rd., Miero-Electronic Industrial Park., Xiqing Dist.	LED 생산	391,711	상동	O
Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	1994.02	No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic Industrial Park Jingang Road Tianjin China	카메라/캠코더 생산	87,314	상동	O
Harman (China) Technologies Co. Ltd.	2011.03	No. 9 Bao Quan Road, Dandong City, Liaoning Province, China	오디오제품 생산	83,641	상동	O
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co. Ltd.	2013.03	Room 2013, 20F, Modern Logistics No. 88 Modern Avenue, Suzhou I, CH	오디오제품 판매	23,244	상동	X
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co. Ltd	2006.09	Unit D Block 21, 428 Xinglong St. Suzhou, Jiangsu, 215122 CH	오디오제품 생산, R&D	309,662	상동	O
Harman Commercial (Shanghai) Co. Ltd.	2010.10	Chong Hing, Suite 3004 Shanghai, 200003 CH	오디오제품 판매	2,784	상동	X
Harman Connected Services (Beijing) Solutions Co. Ltd.	2007.03	Room 602 Jing Guang Business Center Hujialou, Chaoyang, Beijing CH 100020	Connected Service Provider	361	상동	X
Harman Connected Services (Chengdu) Solutions Co. Ltd.	2007.08	Floor 6 Building B3 No. 801, Tianfu Road Chengdu, Sichuan CH 610041	Connected Service Provider	11,286	상동	X
Harman Connected Services Taiwan Inc.	2005.08	Room 714 7F-10 No 152 Song Jiang Road Taipei City, TW	Connected Service Provider	39	상동	X
Harman Holding Limited	2007.07	31/F Edinburgh Tower 15 Queen's Road Central Hong Kong, HK	오디오제품 판매	129,821	상동	O
Harman International (China) Holdings Co. Ltd	2009.06	Chong Hing, Suite 3004 Shanghai, 200003 CH	오디오제품 판매, R&D	279,049	상동	O
Harman Automotive Infotech (Dalian) Co., Ltd	2013.12	Room 206, 901-7 Huangpu Road, Dalian High-tech Industrial Zone, Dalian City, Liaoning Province, CH	소프트웨어 개발 및 공급	998	상동	X
Harman Technology (Shenzhen) Co. Ltd.	2004.07	3rd Floor, Shu Guang Building #12 Technology South Road, Shenzhen, 518057	오디오제품 판매, R&D	9,032	상동	X
Martin Trading Zhuhai Ltd.	2012.08	Yuecai Building, Room 10, Floor 26th, Jida District, Zhuhai City, 519000 Guangdong Province, P.R.China	오디오제품 판매	19	상동	X
삼성디스플레이㈜	2012.04	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95	DP 생산 및 판매	43,305,405	상동	O
에스유머티리얼스(주)	2011.08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	DP 부품 생산	28,558	상동	X
스테코(주)	1995.06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20	반도체 부품 생산	112,968	상동	O
세메스(주)	1993.01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77(모시리)	반도체/FPD 제조 장비	889,089	상동	O
삼성전자서비스(주)	1998.10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290(원천동)	전자제품 수리서비스	295,007	상동	O

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
삼성전자판매(주)	1996.07	경기도 성남시 분당구 황새울로 340	전자제품 판매	597,695	상동	O
삼성전자로지텍(주)	1998.04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129	종합물류대행	143,800	상동	O
삼성메디슨(주)	1985.07	서울특별시 강남구 테헤란로108길 42 삼성메디슨 빌딩 (대치동)	의료기기	303,561	상동	O
에스프린팅솔루션㈜	2016.11	경기도 수원시 영통구 삼성로 129	프린팅솔루션 판매	573,390	상동	O
미래로시스템	1994.01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120	반도체 S/W	17,254	상동	X
SVIC 20호 신기술투자조합	2011.03	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	24,852	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	99,815	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	143,315	상동	O
SVIC 23호 신기술투자조합	2012.10	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	32,075	상동	X
SVIC 26호 신기술투자조합	2014.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	169,961	상동	O
SVIC 27호 신기술투자조합	2014.09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	15,131	상동	X
SVIC 28호 신기술투자조합	2015.02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	175,205	상동	O
SVIC 29호 신기술투자조합	2015.04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	28,317	상동	X
SVIC 32호 신기술투자조합	2016.08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	39,936	상동	X
SVIC 33호 신기술투자조합	2016.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	5,008	상동	X
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017.03	서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	0	상동	X
㈜하만인터내셔널코리아	2005.01	서울특별시 강남구 강남대로 298, 5층(역삼동, 푸르덴셜타워)	소프트웨어 개발 및 공급 등	15,220	상동	X
레드벤드소프트웨어코리아㈜	2007.02	서울특별시 강남구 선릉로90길 36(대치동, 미소빌딩6층)	소프트웨어 개발 및 공급	320	상동	X

※ 주요종속 기업여부 판단기준 : 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상

※ 주요사업에 대한 상세 내역은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하십시오.

※ 당기 중 Martin Professional ApS 사명이 Harman Professional Denmark ApS로,
Martin Professional France SAS 사명이 Harman Professional France SAS로,
Quietside LLC 사명이 Samsung HVAC America, LLC로,
Martin Professional GmbH 사명이 Harman Professional Germany GmbH로,
Harman Neusoft Automotive Infotech (Dalian) Co. Ltd 사명이
Harman Automotive Infotech (Dalian) Co., Ltd로 변경되었습니다.

(종속기업의 변동)

구분	미주	유럽/중아/CIS	아시아	중국	국내	합계	증가	감소
제44기 (2012년말)	30	61	23	32	20	166개사		
제45기 (2013년말)	25	55	22	33	18	153개사	[미주 : 2개사] NeuroLogica Corp., Intellectual Keystone Technology LLC. [유럽/중아/CIS : 1개사] Samsung Electronics Switzerland GmbH [아시아 : 2개사] Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. Samsung Electronics New Zealand Limited [중국 : 3개사] Samsung Network R&D Center China-Shenzhen, Samsung R&D Institute China-Xian, SEMES (XIAN) Co., Ltd.	[국내 : 2개사] 세크론(주), (주)지이에스 [미주 : 7개사] Newton Sub. Corp., mSpot, Inc., Deltapoint Cardiac Diagnostics, Inc., Samsung Medison America, Inc., Intellectual Keystone Technology LLC., Samsung Medison Brasil Ltda., Samsung Electronics Corporativo, SA de CV [유럽/중아/CIS : 7개사] Samsung Telecoms (UK) Ltd., Samsung LCD Netherlands R&D Center B.V, Samsung LCD Netherlands R&D Center (UK)Limited, General RF Modules AB, Samsung Medison France S.A.S., Samsung Opto-Electronics GmbH, Samsung Medison Italia S.r.l. [아시아 : 3개사] Samsung Electronic Philippines Manufacturing Corp., Batino Realty Corporation, TNP Small/Medium Size & Venture Enterprises Growth Promotion Investment Limited Partnership(TSUNAMI) [중국 : 2개사] Samsung LCD Netherlands R&D Center (HK)Limited, Medison (shanghai) Co., Ltd.
제46기 (2014년말)	30	56	22	32	18	158개사	[국내 : 2개사] SVIC 26호 신기술투자조합, SVIC 27호 신기술투자조합 [미주 : 6개사] RT SV CO-INVEST, LP, Samsung HVAC America, LLC(舊Quietside LLC), SmartThings, Inc., PrinterOn Inc., PrinterOn America Corporation, 1397011 Ontario Ltd. [유럽/중아/CIS : 3개사] PrinterOn Europe Limited, Samsung Electronics South Africa Production(pty) Ltd., Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd. [아시아 : 1개사] Samsung Display Bac Ninh	[국내 : 2개사] 삼성전자축구단(주), 월드사이버게임즈(주) [미주 : 1개사] 1397011 Ontario Ltd. [유럽 : 2개사] Samsung Medison Europe B.V., Nanogen Recognomics GmbH [아시아 : 1개사] Medison Medical Systems India Private Ltd. [중국 : 1개사] Medison Medical Equipment Shanghai Co., Ltd.
제47기 (2015년말)	33	55	24	30	17	159개사	[국내 : 2개사] SVIC 28호 신기술투자조합, SVIC 29호 신기술투자조합 [미주 : 6개사] Simpress Comercio, Locacao e Servicos S.A., Samsung Pay, Inc.(舊LoopPay, Inc.), Prismview, LLC(舊YESCO Electronics LLC), Paymate Global, Inc., Stellus Technologies Beijing Integrated Circuit Industry International Fund [아시아 : 2개사] Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd., Future Technology & Service	[국내 : 3개사] 레이, 하이파이오니어 사모특별자산투자신탁 1호, SVIC 6호 신기술투자조합 [미주 : 3개사] Samsung Telecommunications America, Paymate Global, Nvelo [중국 : 2개사] Samsung Electronics Hainan Fiberoptics, Samsung Medison Shanghai Medical Instrument [유럽 : 1개사] Nanoradio Hellas

구분	미주	유럽/중아/CIS	아시아	중국	국내	합계	증가	감소
제48기 (2016년말)	44	53	23	29	20	169개사	[국내 : 4개사] SVIC 32호 신기술투자조합, SVIC 33호 신기술투자조합, 미래로시스템, 에스프린팅솔루션 [미주 : 13개사] Samsung Oak Holdings, Inc., Joyent, Inc., Joyent Canada, Inc., AdGear Technologies Inc., Samsung Next LLC, Samsung Next Fund LLC, Dacor Holdings, Inc., Dacor, Dacor Canada Co., EverythingDacor.com, Inc., Distinctive Appliances of California, Inc., Viv Labs, Inc., NewNet Communication Technologies (Canada), Inc. [유럽 : 1개사] Joyent Ltd. [아시아 : 1개사] Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd [중국 : 1개사] Samsung SemiConductor Xian	[국내 : 1개사] SVIC 14호 신기술투자조합 [미주 : 2개사] Grandis, Inc., Joyent Canada, Inc. [유럽/CIS : 3개사] Samsung Russia Service Centre, SonoAce Deutschland GmbH, Samsung Electronics Kazakhstan LLP [아시아 : 2개사] Samsung Telecommunications Malaysia, Future Technology & Service, [중국 : 2개사] Samsung R&D Institute China-Xian, Samsung Electronics Shanghai Telecommunication Co., Ltd.
제49기 3분기 (2017년 9월말)	67	110	37	41	23	278개사	[국내 : 3개사] 반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁 ㈜하만인터내셔널코리아 레드벤드소프트웨어코리아㈜ [미주 : 25개사] Samsung Electronics Home Appliances America, LLC Kngine, Inc. AMX Holding Corporation AMX LLC Harman Becker Automotive Systems, Inc. Harman Connected Services Inc. Harman Connected Services Engineering Corp. Harman Connected Services Holding Corp. Harman Connected Services South America S.R.L. Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes Ltda. Harman de Mexico S. de R.L. de C.V. Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda. Harman Financial Group, LLC Harman International Industries Canada Ltd. Harman International Industries, Inc. Harman International Mexico S de RL de CV Harman Investment Group, LLC Harman KG Holding, LLC Harman Professional, Inc. Red Bend Software Inc. S1NN USA, Inc. Southern Vision Systems, Inc TowerSec Inc. Triple Play Integration LLC China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership [유럽/CIS/중아 : 62개사] Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Aditi Technologies Europe GmbH AKG Acoustics GmbH AMX GmbH AMX UK Limited Duran Audio B.V. Duran Audio Iberia Espana S.L.	[미주 : 2개사] Samsung Receivables Corporation TowerSec Inc. [유럽/CIS : 5개사] Samsung Electronics Rus LLC Samsung Electronics Ukraine LLC Surfkitchen Limited AMX LLC (Russia) Martin Professional Ltd. [아시아 : 2개사] VFX Systems PTY Ltd. I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD.

구분	미주	유럽/중아/CIS	아시아	중국	국내	합계	증가	감소
							Endeleo Limited Harman Automotive UK Limited Harman Becker Automotive Systems GmbH Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Belgium SA Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Finland OY Harman Connected Services GmbH Harman Connected Services Limited Harman Connected Services Poland Sp.zoo Harman Connected Services UK Ltd. Harman Consumer Division Nordic A/S Harman Consumer Finland OY Harman Consumer Nederland B.V. Harman Deutschland GmbH Harman Finance International GP S.a.r.l Harman France SNC Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman Hungary Financing Ltd. Harman Inc. & Co. KG Harman International Estonia OU Harman International Industries Limited Harman International Romania SRL Harman Finance International SCA Harman International s.r.o Harman International SNC Harman Management GmbH Harman Professional Kft Inspiration Matters Limited Knight Image Limited Martin Manufacturing (UK) Ltd Harman Professional Denmark ApS Harman Professional France SAS Harman Professional Germany GmbH Martin Professional Ltd. R&D International BVBA Red Bend Software Ltd. Red Bend Software SAS France Studer Professional Audio GmbH Surfkitchen Limited AMX LLC (Russia) Harman Connected Services OOO Harman RUS CIS LLC Broadsense Ltd. Global Symphony Technology Group Private Ltd. Harman Connected Services Morocco Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. iOnRoad Ltd iOnRoad Technologies Ltd Red Bend Ltd. TowerSec Ltd. Innoetics E.P.E. ARCAM Ltd A&R Cambridge Ltd [아시아 : 16개사] AMX Products And Solutions Private Limited Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. Harman Connected Services Japan Co. Ltd.	

구분	미주	유럽/중아/CIS	아시아	중국	국내	합계	증가	감소
							Harman International (India) Private Limited Harman International Industries PTY, Ltd. Harman International Japan Co. Ltd. Harman International Singapore Pte. Ltd. Harman Malaysia Sdn. Bhd. Harman Professional Singapore Pte. Ltd I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD. INSP India Software Development Pvt. Ltd. Martin Professional Pte. Ltd. Red Bend Software KK Studer Japan, Ltd. VFX Systems PTY Ltd. [중국 : 12개사] Harman (China) Technologies Co. Ltd. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co. Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co. Ltd Harman Commercial (Shanghai) Co. Ltd. Harman Connected Services (Beijing) Solutions Co. Ltd. Harman Connected Services (Chengdu) Solutions Co. Ltd. Harman Connected Services Taiwan Inc. Harman Holding Limited Harman International (China) Holdings Co. Ltd Harman Automotive Infotech (Dalian) Co., Ltd Harman Technology (Shenzhen) Co. Ltd. Martin Trading Zhuhai Ltd.	

- 당기 중 종속기업 변동내용

구분	자회사	사유
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	당기 중 신설
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	당기 중 신설
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	당기 중 신설
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	당기 중 신설
	㈜하만인터내셔널코리아	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	레드벤드소프트웨어코리아㈜	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Kngine, Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	AMX Holding Corporation	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	AMX LLC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Engineering Corp.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Holding Corp.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services South America S.R.L.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes Ltda.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman de Mexico S. de R.L. de C.V.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Financial Group, LLC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Industries Canada Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Industries, Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Mexico S de RL de CV	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Investment Group, LLC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman KG Holding, LLC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Professional, Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Red Bend Software Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	S1NN USA, Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Southern Vision Systems, Inc	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	TowerSec Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Triple Play Integration LLC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Aditi Technologies Europe GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	AKG Acoustics GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	AMX GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	AMX UK Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Duran Audio B.V.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Duran Audio Iberia Espana S.L.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Endeleo Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Automotive UK Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입

구분	자회사	사유
신규 연결	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Belgium SA	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services AB.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Finland OY	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services UK Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Consumer Division Nordic A/S	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Consumer Finland OY	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Consumer Nederland B.V.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Deutschland GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Finance International GP S.a.r.l	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman France SNC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Holding Gmbh & Co. KG	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Hungary Financing Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Inc. & Co. KG	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Estonia OU	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Industries Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Romania SRL	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Finance International SCA	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International s.r.o	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International SNC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Management GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Professional Kft	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Inspiration Matters Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Knight Image Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Martin Manufacturing (UK) Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Professional Denmark ApS	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Professional France SAS	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Professional Germany GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Martin Professional Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	R&D International BVBA	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Red Bend Software Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Red Bend Software SAS France	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Studer Professional Audio GmbH	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Surfkitchen Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	AMX LLC (Russia)	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services OOO	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman RUS CIS LLC	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입

구분	자회사	사유
	Broadsense Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Morocco	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	iOnRoad Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	iOnRoad Technologies Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Red Bend Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	TowerSec Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Innoetics E.P.E.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	ARCAM Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	A&R Cambridge Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	AMX Products And Solutions Private Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Japan Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International (India) Private Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Industries PTY, Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Japan Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International Singapore Pte. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Professional Singapore Pte. Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	INSP India Software Development Pvt. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Martin Professional Pte. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Red Bend Software KK	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Studer Japan, Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	VFX Systems PTY Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman (China) Technologies Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co. Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Commercial (Shanghai) Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services (Beijing) Solutions Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services (Chengdu) Solutions Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Connected Services Taiwan Inc.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Holding Limited	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman International (China) Holdings Co. Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Automotive Infotech (Dalian) Co., Ltd	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Harman Technology (Shenzhen) Co. Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Martin Trading Zhuhai Ltd.	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Samsung Receivables Corporation	청산
	Samsung Electronics Rus LLC	합병(합병존속회사 : SRR)

구분	자회사	사유
연결 제외	Samsung Electronics Ukraine LLC	청산
	TowerSec Inc.	합병(합병존속회사 : Harman International Industries, Inc.)
	Surfkitchen Limited	청산
	AMX LLC (Russia)	청산
	Martin Professional Ltd.	청산
	VFX Systems PTY Ltd.	청산
	I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD.	청산

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 무디스(Moody's) 및 S&P로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다.
2017년 3분기말 현재 무디스(Moody's)의 당사 평가등급은 A1,
투자전망은 긍정적(Positive)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-,
투자전망은 안정적(Stable)입니다.

평가일	평가대상 유가증권	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가 등급범위)	비고
'14.08	회사채	A+	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'14.10	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가
'15.05	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가
'15.09	회사채	A+	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'16.07	회사채	A+	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'16.08	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가
'17.07	회사채	AA-	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'17.08	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가

2. 회사의 연혁

2012.01.19	에스엘시디 주식회사에 대한 Sony(50.0%) 지분 인수
2012.04.01	LCD사업부문 분할(삼성디스플레이 주식회사 설립)
2012.04.01	삼성엘이디 주식회사 흡수합병
2012.04.10	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 10억불 규모 회사채 발행
2012.07.01	종속기업인 삼성디스플레이의 삼성모바일디스플레이 및 에스엘시디 흡수합병
2012.09.01	종속기업인 삼성메디슨의 프로소닉 흡수합병
2012.12.01	에쓰이에이치에프코리아 주식회사 흡수합병
2013.01.01	종속기업인 세메스의 세크론 및 지이에스 흡수합병
2013.01.28	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 NeuroLogica사(100%) 지분 인수
2014.01.15	종속기업인 삼성디스플레이의 삼성코닝정밀소재 주식 매각 및 Corning Incorporated사 전환우선주 취득
2014.08.18	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 SmartThings사(100%) 지분 인수
2015.01.01	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 STA(Samsung Telecommunications America LLC) 흡수합병
2015.02.23	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 LoopPay사(100%) 지분 인수
2016.01.28	삼성카드(주) 지분(37.5%) 매각
2016.06.24	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Joyent사(100%) 지분 인수
2016.09.07	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Dacor사(100%) 지분 인수
2016.10.07	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Viv Labs사(100%) 지분 인수
2016.11.01	프린팅솔루션사업부 분할(에스프린팅솔루션 주식회사 설립)
2017.03.10	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Harman International Industries, Inc.사(100%) 지분 인수

※ 본사 소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) 입니다

(경영진의 중요한 변동)
당사는 2012년 3월 16일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(최지성, 이윤우, 윤주화)중 이윤우 사내이사는 퇴임하고, 최지성, 윤주화 사내이사가 재선임되었으며, 권오현 사내이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 사외이사 임기만료자 3인(윤동민, 이재웅, 박오수)중 이재웅, 박오수 사외이사는 퇴임하고, 윤동민 사외이사가 재선임 되었으며, 김한중, 이병기 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2012년 6월 8일 최지성 대표이사에서 권오현 대표이사로 변경되었습니다.

2013년 2월 7일 윤동민 사외이사가 퇴임하였으며
2013년 3월 14일 최지성, 윤주화 사내이사가 사임하였습니다.
2013년 3월 15일 주주총회를 통해 윤부근, 신종균, 이상훈 사내이사가
신규 선임되었으며, 사외이사 임기만료자인 이인호 사외이사가 재선임되고
송광수, 김은미 사외이사가 신규 선임되었습니다.
2013년 3월 15일 윤부근, 신종균 사내이사가 대표이사로 신규선임되어
대표이사가 3인(권오현, 윤부근, 신종균)으로 변경되었습니다.

2015년 3월 13일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 권오현 사내이사가 재선임 되었으며, 사외이사 임기만료자 2인(김한중, 이병기)이 재선임되었습니다.

2016년 3월 11일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(윤부근, 신종균, 이상훈)이 재선임되었습니다. 또한 사외이사 임기만료자 3인(이인호, 송광수, 김은미) 중 김은미 사외이사는 퇴임하고, 이인호, 송광수 사외이사가 재선임 되었으며, 박재완 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2016년 10월 27일 임시 주주총회를 통해 이재용 사내이사가 신규 선임되었으며 이상훈 사내이사가 사임하였습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(권오현, 윤부근, 신종균, 이재용), 사외이사 5인(이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 박재완)으로 구성되어 있습니다.

(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)

당사는 2012년 4월 삼성엘이디 주식회사 흡수합병으로 LED사업부를 신설하였으며, 2012년 5월 DS부문 산하 일본 지역총괄을 신설하였습니다.
2012년 12월 조직개편을 통해 CE사업부문과 IM사업부문을 각각 부문으로 승격하고, IT솔루션사업부를 프린팅솔루션과 컴퓨터로 분리하여 프린팅솔루션 사업부는 CE부문 소속으로 변경하였으며, 컴퓨터 사업은 IM부문의 무선사업부로 통합하였습니다. 또한 의료기기사업팀은 CE부문 소속의 사업부로 승격되었습니다.

또한, 2013년 12월 디지털이미징사업부를 무선사업부 산하로 통합하였으며, 2015년 12월 LED사업부를 LED사업팀으로 조직개편 하였습니다.

2016년 11월 프린팅솔루션사업부를 에스프린팅솔루션 주식회사로 분사하였습니다.

2017년 6월 System LSI사업부를 Foundry 사업부와 System LSI사업부로 분리하였습니다.

[2012년 4월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD)	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2012년 5월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2012년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
		IM부문 (무선, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2013년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크, 디지털이미징)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2015년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2016년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2017년 6월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, Foundry, DP)
	-	Harman부문
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액:5,000원)이며 2017년 3분기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 우선주)의 수는 각각 129,768,494주와 18,418,580주입니다 (소각주식수 제외). 당사는 2017년 3분기말 현재까지 보통주 25,840,843주와 우선주 5,474,847주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다.
2017년 3분기말 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 9,452,305주, 우선주 1,727,485주를 제외한 보통주 120,316,189주, 우선주 16,691,095주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		400,000,000	100,000,000	500,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		155,609,337	23,893,427	179,502,764	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		25,840,843	5,474,847	31,315,690	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	25,840,843	5,474,847	31,315,690	자사주소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		129,768,494	18,418,580	148,187,074	-
Ⅴ. 자기주식수		9,452,305	1,727,485	11,179,790	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		120,316,189	16,691,095	137,007,284	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.
이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식

당사는 2017년 중 주주환원의 목적으로 보통주 2,381,462주, 우선주 592,639주를 각각 취득하였으며, 보통주 10,910,843주, 우선주 2,094,847주를 소각하였습니다. 2017년 3분기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 9,452,305주, 우선주 1,727,485주입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	17,981,686	2,381,462	-	10,910,843	9,452,305	-
			우선주	3,229,693	592,639	-	2,094,847	1,727,485	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	17,981,686	2,381,462	-	10,910,843	9,452,305	-
			우선주	3,229,693	592,639	-	2,094,847	1,727,485	-
	신탁계약에의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	17,981,686	2,381,462	-	10,910,843	9,452,305	-
			우선주	3,229,693	592,639	-	2,094,847	1,727,485	-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 기명식 보통주식외 비누적적 무의결권 기명식 우선주식이 있습니다.
동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있으며, 당3분기말 현재 발행주식수는 18,418,580주입니다.

[우선주식 발행현황] (단위 : 원)

발행일자			1989년 08월 25일(최초 발행일)	
주당 액면가액			5,000	
발행총액(액면가기준) / 발행주식수			119,467백만원	23,893,427주
현재 잔액/ 현재주식수			92,093백만원	18,418,580주
주식의 내용	이익배당에 관한 사항		액면금액 기준 보통주식보다 1%의 금전배당을 추가로 받음	
	잔여재산분배에 관한 사항		-	
	상환에 관한 사항	상환조건	-	
		상환방법	-	
		상환기간	-	
		주당 상환가액	-	
		1년 이내 상환 예정인 경우	-	
	전환에 관한 사항	전환조건	-	
		전환청구기간	-	
		전환으로 발행할 주식의 종류	-	
		전환으로 발행할 주식수	-	
	의결권에 관한 사항		의결권 없음	
기타 투자 판단에 참고할 사항			-	

※ 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 92,093백만원으로 납입자본금(119,467백만원)과 상이합니다.

[발행일자별 내역]

일 자	사 유	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액(원)	액면가액 합계(원)	주 당 발행가액(원)	발행가액 합계(원)
1989.08.25	유상증자	우선주식	3,400,000	5,000	17,000,000,000	28,800	97,920,000,000
1989.08.25	무상증자	우선주식	340,000	5,000	1,700,000,000	5,000	1,700,000,000
1990.10.29	전환권 행사	우선주식	371,620	5,000	1,858,100,000	29,600	10,999,952,000
1991.03.19	전환권 행사	우선주식	40,898	5,000	204,490,000	29,341	1,199,988,218
1991.03.30	전환권 행사	우선주식	5,112	5,000	25,560,000	29,341	149,991,192

일 자	사 유	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액(원)	액면가액 합계(원)	주 당 발행가액(원)	발행가액 합계(원)
1991.04.08	전환권 행사	우선주식	1,704	5,000	8,520,000	29,341	49,997,064
1991.05.17	DR 발행	우선주식	1,907,671	5,000	9,538,355,000	37,973	72,439,990,883
1991.07.24	전환권 행사	우선주식	34,081	5,000	170,405,000	29,341	999,970,621
1991.07.30	전환권 행사	우선주식	20,449	5,000	102,245,000	29,341	599,994,109
1991.07.31	전환권 행사	우선주식	64,754	5,000	323,770,000	29,341	1,899,947,114
1991.08.30	전환권 행사	우선주식	214,716	5,000	1,073,580,000	29,341	6,299,982,156
1991.09.30	전환권 행사	우선주식	20,448	5,000	102,240,000	29,341	599,964,768
1993.06.17	DR 발행	우선주식	2,542,372	5,000	12,711,860,000	47,312	120,284,704,064
1993.10.29	전환권 행사	우선주식	105,999	5,000	529,995,000	28,302	2,999,983,698
1993.11.12	DR 발행	우선주식	2,158,273	5,000	10,791,365,000	55,975	120,809,331,175
1993.11.29	전환권 행사	우선주식	58,295	5,000	291,475,000	28,302	1,649,865,090
1993.11.30	전환권 행사	우선주식	19,079	5,000	95,395,000	28,302	539,973,858
1994.04.06	DR 발행	우선주식	1,086,956	5,000	5,434,780,000	74,502	80,980,395,912
1994.06.03	전환권 행사	우선주식	16,027	5,000	80,135,000	25,809	413,640,843
1994.06.06	전환권 행사	우선주식	9,072	5,000	45,360,000	25,809	234,139,248
1994.06.13	전환권 행사	우선주식	17,236	5,000	86,180,000	25,809	444,843,924
1994.06.22	전환권 행사	우선주식	1,209	5,000	6,045,000	25,809	31,203,081
1994.06.27	전환권 행사	우선주식	16,632	5,000	83,160,000	25,809	429,255,288
1994.06.28	전환권 행사	우선주식	54,131	5,000	270,655,000	25,809	1,397,066,979
1994.06.29	전환권 행사	우선주식	292,127	5,000	1,460,635,000	25,809	7,539,505,743
1994.06.30	전환권 행사	우선주식	52,922	5,000	264,610,000	25,809	1,365,863,898
1994.07.01	전환권 행사	우선주식	232,854	5,000	1,164,270,000	25,809	6,009,728,886
1994.07.04	전환권 행사	우선주식	116,426	5,000	582,130,000	25,809	3,004,838,634
1994.07.05	전환권 행사	우선주식	188,401	5,000	942,005,000	25,809	4,862,441,409
1994.07.06	전환권 행사	우선주식	686,164	5,000	3,430,820,000	25,809	17,709,206,676
1994.07.07	전환권 행사	우선주식	270,349	5,000	1,351,745,000	25,809	6,977,437,341
1994.07.08	전환권 행사	우선주식	977,068	5,000	4,885,340,000	25,809	25,217,148,012
1994.07.12	전환권 행사	우선주식	6,048	5,000	30,240,000	25,809	156,092,832
1994.07.19	전환권 행사	우선주식	68,040	5,000	340,200,000	25,809	1,756,044,360
1994.07.20	전환권 행사	우선주식	4,232	5,000	21,160,000	25,809	109,223,688
1994.08.12	전환권 행사	우선주식	944	5,000	4,720,000	25,502	24,073,888
1995.03.13	무상증자	우선주식	3,028,525	5,000	15,142,625,000	5,000	15,142,625,000
1996.03.13	무상증자	우선주식	5,462,593	5,000	27,312,965,000	5,000	27,312,965,000
2003.04.14	이익소각	우선주식	-470,000	5,000	-2,350,000,000	-	-
2004.01.15	이익소각	우선주식	-330,000	5,000	-1,650,000,000	-	-
2004.05.04	이익소각	우선주식	-260,000	5,000	-1,300,000,000	-	-
2016.01.15	이익소각	우선주식	-1,240,000	5,000	-6,200,000,000	-	-
2016.04.20	이익소각	우선주식	-530,000	5,000	-2,650,000,000	-	-
2016.07.19	이익소각	우선주식	-320,000	5,000	-1,600,000,000	-	-

일 자	사 유	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액(원)	액면가액 합계(원)	주 당 발행가액(원)	발행가액 합계(원)
2016.09.28	이익소각	우선주식	-230,000	5,000	-1,150,000,000	-	-
2017.04.12	이익소각	우선주식	-255,000	5,000	-1,275,000,000	-	-
2017.05.02	이익소각	우선주식	-1,614,847	5,000	-8,074,235,000	-	-
2017.07.24	이익소각	우선주식	-225,000	5,000	-1,125,000,000	-	-
우선주식 계			**18,418,580**		**92,092,900,000**		**642,261,376,652**

5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 129,768,494주이며 정관상 발행할 주식 총수(5억주)의 26.0%에 해당됩니다. 보통주 외에 18,418,580주의 우선주가 있습니다.
이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 9,452,305주 및 발행된 우선주는 의결권이 없으며,기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(12,506,577주)을 제외할 경우, 의결권 행사 가능 주식수는 107,809,612주입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	129,768,494	-
	우선주	18,418,580	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	9,452,305	상법 상 자기주식
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	18,418,580	우선주인 자기주식 1,727,485주 포함
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	12,479,184	· 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제한 [삼성생명 10,622,814주, 삼성화재 1,856,370주]
	보통주	27,393	· 보험업법에 의한 제한 [삼성생명 특별계정 일부]
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F=A-B-C-D+E)	보통주	107,809,612	-
	우선주	-	-

※ "기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한"된 주식 中, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 제한 주식수 12,479,184주(삼성생명 고유계정 10,622,814주, 삼성화재 1,856,370주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사 가능

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제49기 3분기	제48기	제47기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		29,328,245	22,415,655	18,694,628
(별도)당기순이익(백만원)		18,794,866	11,579,749	12,238,469
(연결)주당순이익(원)		211,936	157,967	126,305
현금배당금총액(백만원)		2,896,772	3,991,892	3,068,737
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		9.9	17.8	16.4
현금배당수익률(%)	보통주	0.8	1.6	1.6
	우선주	1.0	2.0	1.9
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	21,000	28,500	21,000
	우선주	21,000	28,550	21,050
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 49기 3월 분기배당금은 972,373백만원(주당 7,000원), 6월 분기배당금은 965,348백만원(주당 7,000원), 9월 분기배당금은 959,051백만원(주당 7,000원)입니다.
※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
※ 기본주당이익 산출근거는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '3. 연결재무제표 주석' 중 주당이익 항목을 참조하십시오.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산・판매법인, Harman 산하 종속회사 등 278개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업군별로 보면 Set 사업에서는 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등을 생산/판매하는 CE 부문과 스마트폰 등 HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산/판매하는 IM 부문이 있습니다. 부품사업에서는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산/판매하고있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC, 모바일용 등의 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산/판매하고 있는 DP 사업의 DS 부문으로 구성되어 있습니다.
또한 2017년 상반기 중 신규로 인수한 Harman 부문에서 Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등을 생산/판매하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문		주요 제품
CE 부문		TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의료기기 등
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS 부문	반도체 사업부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
	DP 사업부문	TFT-LCD, OLED 등
Harman 부문		Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

지역별로 보면 국내에는 CE, IM 부문 및 반도체 사업을 총괄하는 본사와 23개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다.

본사는 수원사업장(CE 부문 및 R&D 센터 등)과 구미사업장(IM 부문), 기흥사업장(반도체 사업), 화성사업장(반도체 사업), 평택사업장(반도체 사업), 광주사업장(생활가전 사업) 등으로 구성이 되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매, 제품의 서비스를 담당하는 삼성전자서비스 및 제품의 운송을 담당하는 삼성전자로지텍 등 총 23개의 비상장 종속기업으로 구성되어 있습니다.

해외는 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등지에서 생산, 판매, 연구활동을 담당하는 255개의 해외 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주는 TV, HHP 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(뉴저지, 미국), TV 생산을 담당하는 SAMEX(티후아나, 멕시코), 반도체 제조를 담당하는 SAS(오스틴, 미국) 및 Harman 등을 포함하여 총 67개의 생산, 판매 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽은 영국내 Set제품 판매를 담당하는 SEUK(영국)와 SEF(프랑스), SEG(독일), SEI(이탈리아) 등의 판매법인이 있으며, 유럽내 TV 생산을 담당하는 SESK (슬로바키아), SEH(헝가리) 및 냉장고 등 가전생산을 담당하는 SEPM(폴란드) 등의 생산법인 등을 포함하여 총 80개의 법인이 운영되고 있습니다.

아시아는 SAPL(싱가폴)을 중심으로 SEAU(호주), SEPCO(필리핀), SME (말레이시아) 등 판매법인 및 HHP 생산법인 SEV・SEVT(베트남), TV 등 생산법인 SEHC(베트남), TV・HHP 등 복합 생산법인 SIEL(인도) 등을 포함하여 총 37개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국은 중국내 Set 제품 판매를 담당하는 SCIC(북경), SEHK(홍콩) 등의 판매법인과 Set 제품의 생산, 반도체 및 DP의 임가공을 담당하는 천진지역, 소주지역 등의 생산법인(TSTC, SSEC, SESS 등)을 포함하여 총 41개의 법인이 운영되고 있습니다.

아프리카, 중동, CIS에서는 생산, 판매 등을 담당하는 30개 법인이 운영되고 있습니다.

[CE 부문]

(산업의 특성 등)

TV산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산/판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV 사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송 확산(영/미 1998년~)을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, FPTV는 화질, 디자인 등 제품 성능 향상과 지속적인 Set가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존 CRT 시장을 빠르게 대체하였습니다.
또한, 2010년 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스(OTT, OVER-THE-TOP) 업체들의 부상과 스마트기기에 대한 사용자들의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 2013년에는 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV, 2014년에는 새로운 Form Factor인 Curved TV가 출시되었으며 2015년에는 퀀텀닷TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하였습니다.

2016년 전체 TV 수요는 전년비 약 1.5% 하락한 2억 2,270만대로, 시장內 99% 이상을 점유하고 있는 LCD TV(LED TV 포함)가 전년비 1.3% 하락한 2억 2,150만대, OLED 70만대, CRT 약 50만대 등 이었으며, 2017년도 전체 TV 수요는 전년과 유사한 2억 2,190만대 수준으로 예상됩니다. LCD-TV가 2억 2천만대로 99% 이상의 비중을 지속 이어 나갈 것으로 보이며. OLED 수요는 138만대로 전년대비 성장이 예상되나 비중은 0.6%로 전망하고 있습니다.

또한 시장의 고해상도 대형화면에 대한 Needs도 지속 증가하여, UHD TV는 전년비 40% 이상 증가한 80백만대로 TV수요 중 비중이 35% 이상이 될 전망이며, 60"이상 초대형 TV도 전년비 30% 이상 성장한 약 16백만대로 예상됩니다. 지역별로는 선진시장보다는 성장시장 중심으로 수요가 증가할 것으로 보이며, 아시아와 중남미 중심으로 2~5% 성장하며 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건 등)

TV시장의 Mega Trend인 대형화/고화질화가 Device간, 업체간 경쟁 격화에 따라 더욱 빠른 속도로 진행되고 있으며, 이에 제품력, 브랜드파워를 앞세운 Major 업체의 강세가 지속되고 있습니다. 또한 고화질 및 슬림 제품에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 친환경 소재인 LED BLU(Back Light Unit)를 적용하여 TV의 밝기와 명암비를 높이고 소비전력을 낮춘 LED TV가 시장의 Main Stream으로 자리 잡고 있습니다.

한편 TV에서 인터넷 정보를 얻으려는 Needs가 증가할 것이라는 전망에 따라,
다양한 App을 이용 가능한 스마트 TV 출시(2010년), 소비자의 사용편의 혁신을 위한 음성/제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction) 도입(2012년), 사용자의 사용이력을 기반으로 한 방송 프로그램 추천 시스템 도입(2013년), 비디오 시청 경험 극대화를 위한 사용성 혁신, 다양한 컨텐츠 확보, 플랫폼 성능 강화 등(2014년)을 추진하였습니다. 아울러 시청자가 컨텐츠를 구매하는 생태계 변화에 맞춰, TV에서 다양한 컨텐츠를 쉽게 사용할 수 있도록 스마트 UX 혁신을 이뤄냈습니다(2015년).
또한, 2016년 스마트TV는 연결된 주변기기를 자동으로 인식할 뿐만 아니라 하나의 리모컨으로 인식된 주변기기를 컨트롤하고, TV 시청 경험을 방해 받지 않고 다양한 소스를 한 화면에서 이용할 수 있도록 하였습니다.

2017년에는 모바일 기기를 통해 쉽게 스마트 허브를 이용하고 TV를 제어할 수 있으며, 모바일 기기에 저장된 콘텐츠를 대형 스크린의 압도적인 화질로 언제든지 볼 수 있어 기존의 TV만을 사용하는 경험보다 통합적이고 일관적인 경험을 제공할 것입니다. 또한 지능형 음성인식 기능을 이용하여 볼륨, 채널 이동 그리고 화면 모드 변경까지 사용자가 원하는 TV 제어 기능을 더욱 쉽게 활용할 수 있을 것입니다.

<CE 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2017년 3분기	2016년	2015년
TV	20.0%	21.6%	21.0%

※ 2015년, 2016년 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료(수량기준)이며,
2017년 3분기 시장점유율은 당사추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2006년이후 2016년까지 11년 연속으로 TV 전체, FPTV, LCD TV 세계 1위 등 Triple Crown을 지속 달성하였습니다. 특히 2009년에는 세계 최초로 LED TV(LED BLU, 초슬림/초경량화, 친환경)라는 신규 category를 창출하였고 2010년 1분기에 세계 최초로 3D TV/BDP/안경/BD Title을 동시에 제공하는 3D Total Solution 출시하며, 압도적 경쟁력 우위로 3D TV시장을 선점하였습니다. 이에 더하여 2010년에 세계 최초 TV용 App Store 'Samsung Apps'를 런칭한 이후 2011년에는 다양한 스마트 서비스를 지속 추가하여 "스마트 TV = SAMSUNG"이라는 이미지를 확립하였습니다. 또한 2012년 당사는 음성/제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction)을 활용한 컨텐츠 개발을 통해 온 가족이 이용할 수 있는 서비스를 강화하였고, 2013년에는 기존 대비 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV를 출시하였습니다. 2014년에는 신규 Form factor인 Curved TV 출시, 2015년은 나노입자의 퀀텀닷 SUHD TV의 최초 출시를 통해 Premium 시장을 주도하며 리더십을 유지하였고, 2016년은 2세대 퀀텀닷, HDR 1000 기술로 화질의 디테일을 한층 끌어 올렸습니다.

2017년에 당사는 QLED TV로 신규 카테고리 창출을 통해 어떤 밝기 영역에서나 정확한 컬러를 표현할 수 있는 컬러 볼륨 100%를 구현하고, 최고 2000 nit 밝기까지 제공, 더 이상의 화질 논쟁은 필요 없는 궁극의 화질을 제공할 것입니다. 뿐만 아니라, 당사는 그 동안 사용자의 Pain point였던, TV 와 주변 기기 연결시 수많은 케이블로 인한 복잡함과 각각의 기기 마다 리모컨이 필요 했던 것을 투명한 옵티컬 케이블 하나로 연결된 선처리, 하나의 리모컨으로 셋탑박스, 게임콘솔 등 모든 연결 기기를 제어할 수 있는 기술을 구현 하였습니다. 이로써 한 차원 다른 TV 출시를 통해, 당사는 업계 리더로서 새로운 TV 개념을 시장에 제안하고자 합니다.

이러한 소비자의 Lifestyle 과 일체화된 미래 TV에 대한 또 다른 고민의 일환으로, '더 프레임(The Frame)TV'는 주거환경의 어떤 공간에도 어울리는 '스크린 에브리웨어(Screen Everywhere)' 비전을 추구할 예정입니다. 당사는 TV 업계 리더로서, 소비자에게 진정한 TV의 가치를 전달하기 위해 지속적 변화와 혁신적인 제품을 출시하도록 하겠습니다.

[IM 부문]

(산업의 특성 등)

휴대폰 보급률은 2016년 76% 수준에서 2017년은 78%에 이를 것으로 전망됩니다. (2016.12월 Strategy Analytics)

휴대폰 산업은 1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식을 거쳐, WCDMA와 같은 3세대 이동통신이 보편화 되었으며, 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌 확산되고 있습니다. 차기 5세대 이동통신 서비스도 상용화를 준비 중에 있습니다. 또한, 스마트폰 중심으로의 시장 변화에 따라 고성능 AP, AMOLED Display, 고화질 카메라, 센서, 방수・방진과 같은 Hardware 뿐만 아니라 Application, UX, Mobile Payment, AI 등의 Software와 서비스 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰 시장규모는 2016년 14.9억대에서 2017년에는 약 7% 성장하여 15.9억대 수준이 예상됩니다. 태블릿 시장규모는 2016년 2억대에서 2017년 1.9억대 수준으로 전년比 약 5%의 역성장이 전망됩니다.

(출처 : Strategy Analytics - 스마트폰 2017.9월, 태블릿 2017.9월)

<IM 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2017년 3분기	2016년	2015년
HHP	20.0%	19.2%	20.7%

※ 2015년, 2016년, 2017년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장점유율 자료(수량기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 모바일 시장에서 사업위상을 더욱 강화하는 차원에서 제품력 뿐만 아니라 서비스, B2B 등 미래 성장을 위해 경쟁력을 높이는 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 스마트폰은 Premium에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 라인업을 바탕으로 글로벌 1위 위상을 지속하고 있습니다. 앞으로도 Flexible Display와 같은 새로운 Form Factor 및 차별화된 디자인/UX로 Premium 시장 리더십을 더욱 확고히 하고,

보급형 시장도 적극적으로 대응하여 시장 지배력을 높여 나가겠습니다.
그리고 Gear S3, Gear VR과 같은 웨어러블 및 단말 사용성과 편의성을 더욱 높여주는 Accessory 제품으로 고객의 다양한 요구에 적극적으로 대응하겠습니다.

제품에 더불어 당사 고유의 차별화 서비스인 Samsung Pay와 같은 Mobile Payment 분야와 Intelligence, IoT, Cloud, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자도 지속하고, 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하여, 글로벌 위상을 더욱 높여 가도록 하겠습니다.

또한, 혁신은 지속 추구하되 고객안전을 최우선으로 고려하여 제품의 품질과 안전성 강화를 통해 시장과 고객의 신뢰를 더욱 높일 수 있도록 하겠습니다.

[DS 부문]

- 반도체 사업부문

(산업의 특성 등)
반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리 반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write)있는 램(RAM)제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM)제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, Server 등의 중앙처리장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트웍, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 향 AP제품과 이미지 센서, 기타 주문형 반도체 등을 공급하고 있습니다.

반도체 시장은 스마트폰 시장의 성장율 저하 및 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감소로 성장율 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장이 창출되어 향후 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 수요 기반 또한 다변화되어 수급의 변동은 과거 대비 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

DRAM은 공급초과 상황에서 모바일 분야 및 서버용 신제품 수요 증가 및 공급 업체의 선단공정 확대 지연 등으로 인해 차츰 공급부족 상황으로 전환 되었습니다. 타 공급 업체의 선단공정 안정화가 늦어지고 있고, 고성능 고신뢰성 제품 개발이 지연되고 있어 당사로의 수요 집중은 계속될 전망입니다. NAND는 SSD 채용 확대, 신규 모바일 기기의 NAND 탑재량 증가 등으로 수요가 지속 증가하고 있으나, 공급 업계의 Planar NAND 추가 공정 개발의 한계 및 경쟁사의 Vertical NAND 확산이 지연되고 있어 Chip 공급 부족이 지속될 전망입니다.

<반도체 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2017년 3분기	2016년	2015년
DRAM	45.8%	48.0%	45.3%

※ 2015년, 2016년 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장 점유율 자료(금액기준)를 활용하였으며, 2017년 3분기 시장점유율은 당사추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2016년 4분기 10나노급 DRAM을 세계최초로 출시 하였으며, 경쟁사 대비 1년 이상 앞선 경쟁력을 확보하고 있습니다. 더불어, AI/슈퍼컴퓨터에 구현되는 고성능 고대역폭 메모리(HBM2) 공급을 본격적으로 확대하고 있습니다. NAND의 경우 Planar 타입과 Vertical 타입을 동시에 양산하는 등 고객이 원하는 모든 제품을 적기 대응하고 있습니다. 특히, 경쟁사 대비 앞선 기술력을 확보한 Vertical NAND 는 4세대 적층 제품을 본격 양산하고 있으며, 이를 고성능 SSD에 탑재하여 프리미엄 시장에 적극 진입하는 한편, 2017년 3분기중 포터블 SSD T5를 글로벌 런칭하며 포터블 SSD 시장 확대에 나섰습니다. 또한, 세계최초로 자동차용 eUFS를 양산하여 자동차용 메모리 시장을 주도하여 프리미엄 메모리 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

2017년은 메모리 반도체 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 선단 공정을 기반으로 한 차별화 제품 확대 및 다양한 제품 라인업을 이용한 응용처별 최적 대응을 통해 메모리1위 업체로서 시장을 선도해 나갈 것입니다.

또한 System LSI 시장은 모바일 중심의 성장에서 Automotive, IoT로 시장의 다각화 중으로 신규 제품군의 시장 확대로 성장세가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 선단 공정 조기 개발 및 차별화 기술 적용 제품의 선 출시로 성장을 이어 나갈 것입니다. AP 모뎀 통합칩은 경쟁사보다 앞서 선단공정을 도입하여 프리미엄부터 중저가 시장까지 적극 대응하고 있습니다.

아울러 Foundry 시장에서는 앞선 선단공정 기술을 바탕으로 대형 Fabless 업체와 협력 중입니다. 당사는 업계 최초로 2016년 4분기 10나노 제품 공급을 시작하였으며, 7나노 공정 또한 적기 개발하여 시장을 주도하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

- DP 사업부문

(산업의 특성 등)

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점은 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 차별화 요소로 작용하여 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 OLED의 채용이 빠르게 늘어나고 있습니다. 더불어 TV 및 투명디스플레이를 포함한 대형 시장으로 영역이 확대되고 있습니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.

OLED와 TFT-LCD 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 일반적으로 이러한 장치산업은 경기변동에 민감하여, 수요가 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있습니다. 이처럼 생산이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격이 상승할 수 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

디스플레이 패널의 주요 생산업체는 대부분 아시아 지역에 위치하고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

한국 : 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등
일본 : Sharp, Japan Display 등
대만 : AU Optronics, Innolux 등
중국 : BOE, CSOT, Tianma, CEC Panda 등

당사는 앞선 기술력을 바탕으로 대형 TFT-LCD 시장을 선도해 왔을 뿐만 아니라, 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다.

2017년은 중소형 OLED 패널의 경우, Rigid 제품과 LTPS LCD간의 경쟁이 심화되고 있으나, 플렉서블 제품 중심으로 주요 스마트폰 고객사들의 OLED 패널 채용은 지속적으로 증가하고 있습니다.

한편 대형 LCD 패널은, 고객사의 재고 조정 및 패널 업계의 공급 확대로 수급불균형이 지속될 Risk가 있으나, 고해상도 및 초대형 TV 등 프리미엄 TV 시장의 성장 또한 계속될 것으로 전망되고 있습니다.

<DP 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2017년 3분기	2016년	2015년
디스플레이 패널	15.3%	17.1%	21.1%

※ 2015년, 2016년, 2017년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료(대형패널-금액기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 지속적인 수율 향상 및 원가 절감, 거래선과의 협업체계 강화 등을 통하여 높은 수준의 가동률을 유지하고 사업 경쟁력을 견고히 하고 있습니다.

3분기 중소형 OLED 패널사업은 주요 고객의 Flagship 신제품 출시에 따라 플렉서블 제품을 중심으로 매출이 증가하였으며, 앞으로도 지속적인 공급 확대를 통해 성장을 추진할 예정입니다.

대형 LCD 패널 사업은 주요 고객의 재고 조정에 따른 수급 불균형의 영향으로 패널 판가가 하락하였으며, 중국 업체의 Capa 확대 지속과 업체간 경쟁 심화로 향후 시장 내 불확실성이 증가할 우려가 있습니다.
이에 당사는 수율 및 원가 개선 활동을 강화하고, 초대형/UHD/Quantum Dot/ Frameless 등 고부가 제품 및 차별화 제품의 판매 확대를 추진하여 수익성을 제고할 계획입니다.

[Harman 부문]

(산업의 특성 등)

2017년에는 전장부품 사업과 연관성이 높은 자동차 Global 생산량이 약 1% 증가 예상되어 현재 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. (출처 : LMC Automotive Global Production, 2017.8월)

최근 수년간 자동차 산업 내에서 Connectivity와 엔터테인먼트에 대한 수요는 증가해 왔습니다. 자동차 제조사들이 자율주행 자동차와 공유 모빌리티를 두 축으로 기술 발전의 선두에 서는 것을 지향하면서 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

프로페셔널/소비자 오디오 산업(커넥티드 홈, 헤드폰, 스마트 오디오 等) 중 소비자 오디오는 2020년까지 매년 약 6% 성장할 것으로 전망되며, 프로페셔널 오디오는 동기에 연간 약 2% 성장이 전망됩니다. (출처 : Futuresource, 2017.5월)

커넥티드 홈과 스마트 오디오에서의 기술혁신 결과로 산업의 수요가 크게 증가해왔으며, 세계적인 성장 기조 속에 이 분야의 기술이 지속적으로 발전함에 따라 이러한 수요증가 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건 등)

자동차와 프로페셔널/소비자 오디오 시장은 경쟁이 매우 심한 가운데 급속하게 발전하고 있습니다.

커넥티드카 분야에는 자동차 제조사들과 협력하는 여러 회사들(Bosch, Alpine, Continental, Delphi, Mitsubishi, Panasonic 等)이 있습니다. 시장은 지속적으로 커넥티드카 영역에서 자동차 제조사들에게 자율주행 등 가장 앞선 기술을 지속적으로 요구하고 있어 이 분야는 현재 Major업체들과 신규업체들간 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다.

카오디오시스템 분야도 주요 업체들(Bose, Pioneer, Panasonic)간 경쟁이 매우 치열합니다. 미래에도 이 분야의 지속적인 기술 발전이 예상되며 여러 카오디오업체들은 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 이

사업분야 또한 향후에도 지속적으로 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

프로페셔널/소비자오디오 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도업체들(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 等)이 있습니다. 특히, 커넥티드 홈과 스마트 스피커 제품은 시장 포화상태로, 새로운 업체들과 기존 업체들간 경쟁 상황이 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

<Harman 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2017년 3분기	2016년	2015년
Headunits	18.3%	18.2%	18.3%

※ 2015년, 2016년, 2017년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 자료를 활용한 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 전장부품 및 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서 뛰어난 성과를 이어 나가는 데 집중하고 있으며, 이를 달성하기 위해 혁신, 전략적 인수합병, 그리고 널리 알려진 브랜드들을 통해 지속적으로 성장해 나갈 것입니다.
당사의 Harman 부문은 전장부품시장에서 선도업체의 위상을 유지하고 있습니다. 대량판매 시장에서부터 고급특화시장에 걸쳐 차량들에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드들을 활용하는 한편, Harman 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카오디오와 Connectivity 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사들과의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다.
추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차시장에서의 성공요인들은 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 Harman 브랜드들은 일상적인 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야들에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객들을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니

다. 이러한 노력들을 통해 당사가 사업을 영위하는 전장부품 등의 산업분야에서 선도 업체로서의 역할을 유지할 수 있을 것입니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원, %)

부문		구 분	제49기 3분기		제48기		제47기	
			금액	비중	금액	비중	금액	비중
CE 부문		총매출액	74,591,090	18.1%	104,870,428	21.8%	115,378,019	23.4%
		내부매출액	42,200,903	17.7%	59,767,666	21.3%	70,576,753	24.2%
		순매출액	32,390,187	18.7%	45,102,762	22.3%	44,801,266	22.3%
		영업이익	1,142,673	3.0%	2,712,148	9.3%	1,448,568	5.5%
		총자산	50,794,057	11.1%	47,202,301	12.0%	42,540,738	11.9%
IM 부문		총매출액	172,584,132	42.0%	211,523,973	43.9%	222,023,600	45.0%
		내부매출액	91,383,243	38.4%	111,221,861	39.7%	118,469,345	40.5%
		순매출액	81,200,889	46.8%	100,302,112	49.7%	103,554,255	51.6%
		영업이익	9,412,022	24.4%	10,807,569	37.0%	10,142,022	38.4%
		총자산	116,956,914	25.5%	111,574,049	30.5%	98,463,323	27.4%
DS 부문	반도체	총매출액	101,116,514	24.6%	99,527,926	20.6%	90,600,806	18.4%
		내부매출액	47,974,854	20.2%	48,370,924	17.3%	43,014,054	14.7%
		순매출액	53,141,660	30.6%	51,157,002	25.3%	47,586,752	23.7%
		영업이익	24,307,704	63.1%	13,595,004	46.5%	12,787,297	48.4%
		총자산	124,570,484	27.1%	102,251,069	28.0%	98,989,253	27.6%
	DP	총매출액	48,818,569	11.9%	55,884,739	11.6%	55,120,243	11.2%
		내부매출액	25,536,589	10.7%	28,956,095	10.3%	27,633,382	9.4%
		순매출액	23,281,980	13.4%	26,928,644	13.3%	27,486,861	13.7%
		영업이익	3,985,508	10.4%	2,226,626	7.6%	2,295,367	8.7%
		총자산	68,098,786	14.8%	57,240,065	15.6%	50,147,263	14.0%
	계	총매출액	153,567,934	37.3%	159,473,455	33.1%	149,974,731	30.4%
		내부매출액	77,451,858	32.6%	81,325,252	29.0%	74,948,617	25.6%
		순매출액	76,116,076	43.8%	78,148,203	38.7%	75,026,114	37.4%
		영업이익	28,127,074	73.1%	15,850,986	54.2%	14,887,262	56.4%
		총자산	218,558,836	47.6%	183,951,625	50.3%	174,264,841	48.5%
Harman 부문		총매출액	6,247,783	1.5%	-	-	-	-
		내부매출액	1,468,988	0.6%	-	-	-	-
		순매출액	4,778,795	2.8%	-	-	-	-
		영업이익	△4,180	0.0%	-	-	-	-
		총자산	15,743,072	3.4%	-	-	-	-

※ 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]
※ CE부문은 프린팅솔루션 사업부를 제외하여 재작성하였습니다.
※ Harman 부문은 인수일 이후의 실적입니다.
※ 3분기 9개월 기준 금액입니다.

2017년(제49기) 3분기 매출은 순매출액 기준 173조 5,970억원입니다.
CE 부문이 32조 3,902억원(18.7%), IM 부문이 81조 2,009억원(46.8%)이며,
반도체 사업부문이 53조 1,417억원(30.6%), DP 사업부문이 23조 2,820억원(13.4%)

등 DS 부문이 약 43.8% 수준입니다. Harman 부문은 4조 7,788억원(2.8%)입니다.
2017년(제49기) 3분기 영업이익은 38조 4,981억원입니다.
CE 부문의 영업이익은 1조 1,427억원으로 전체이익의 3.0%, IM 부문이 9조 4,120억원으로 전체이익의 24.4%를 차지하며, DS 부문은 전체이익의 73.1%인 28조 1,271억원을 달성하였습니다. Harman 부문의 영업이익은 전체이익의 △0.01%인 △42억원입니다.

□ 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용

1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 컴퓨터 등 완제품과
반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산, 판매하고 있습니다.
아울러 Harman을 통해 인포테인먼트, 텔레메틱스 등을 생산, 판매하고 있습니다.
2017년 3분기 당사 제품별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

부문		주요 제품	순매출액	비중
CE 부문		TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의료기기 등	323,902	18.7%
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	812,009	46.8%
DS 부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	531,417	30.6%
	DP 사업	TFT-LCD, OLED 등	232,820	13.4%
	부문 계		761,161	43.8%
Harman 부문		인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커, 헤드폰 등	47,788	2.8%
기타		-	△208,890	△12.0%
전체 계			1,735,970	100%

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) [△는 부(-)의 값임]
※ Harman 부문은 인수일 이후의 실적입니다.
※ 3분기 9개월 기준 금액입니다.

2017년 3분기 매출은 CE 부문이 32조 3,902억원으로 전체 순매출액의 18.7%,
IM 부문이 81조 2,009억원으로 46.8%를 차지하며,
DS 부문이 76조 1,161억원으로 43.8%를 구성하고 있습니다.
Harman 부문은 4조 7,788억원으로 전체의 2.8%입니다.
☞ 세부 제품별 매출은 5. 매출 항목을 참조하십시오

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2017년 3분기 TV의 평균판매가격은 2016년 대비 9.5% 상승하였으며, HHP는 전년 대비 4.5% 상승하였습니다. 또한 메모리 평균판매가격은 2016년 대비 25% 상승하였으며, 디스플레이 패널 평균판매가격도 2016년 대비 10.3% 상승하였습니다.
Headunits의 평균판매가격은 2016년 대비 4.3% 하락하였습니다.

3. 주요 원재료

(단위 : 억원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처
CE	원재료	디스플레이 패널	화상신호기	45,351	27.7%	AUO, BOE 등
	원재료	기타		118,304	72.3%	
	부문 계			163,655	100.0%	
IM	원재료	Base Band Chip	CPU	24,948	8.9%	Qualcomm 등
	원재료	Camera Module	휴대폰용 카메라	30,660	10.9%	삼성전기 등
	원재료	모바일용 디스플레이 패널	화상신호기	23,562	8.4%	일진디스플레이 등
	원재료	기타		200,974	71.7%	
	부문 계			280,144	100.0%	
DS	원재료	Window	강화유리	14,718	8.6%	Biel 등
	원재료	POL	편광판	14,231	8.3%	동우화인켐, Nitto 등
	원재료	Glass	디스플레이용 유리기판	8,421	4.9%	코닝정밀소재 등
	원재료	기타		134,660	78.2%	
	부문 계			172,030	100.0%	
Harman	원재료	메모리	자동차용 제품	2,148	20.0%	Avnet, Microchip 등
	원재료	시스템온칩	자동차용 제품	2,069	19.3%	NVIDIA, Renesas 등
	원재료	기타		6,521	60.7%	
	Harman 계			10,738	100.0%	
기타				7,174		
총계				633,741		

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.
※ 주요 매입처중 삼성전기는 삼성계열 소속회사입니다.
※ Harman 부문은 인수일 이후의 실적입니다.
※ 3분기 9개월 기준 금액입니다.

당사의 주요 원재료는 CE 부문의 경우 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 모듈이며, IM 부문은 Camera Module, Base Band Chip 및 모바일용 디스플레이 패널 등 입니다. 또한, DS 부문의 경우 Window, POL, Glass 등이 주요 원재료 입니다.
TV 및 모니터에 사용되는 대형 디스플레이 패널은 AUO, BOE 등에서 공급받고 있으며, Camera Module은 삼성전기 등에서, Base Band Chip은 Qualcomm 등에서, 모바일용 디스플레이 패널은 일진디스플레이 등으로부터 공급받고 있습니다. 또한, 동우화인켐, 코닝정밀소재 등으로부터 POL, Glass를 공급받아 디스플레이 패널을 제조하고 있습니다.
Harman 부문의 주요 원재료는 자동차용 메모리, 시스템온칩 등이 있으며, 메모리는 Avnet, Microchip 등에서, 시스템온칩은 NVIDIA, Renesas 등에서 공급받고 있습니다.

- 주요 원재료 가격 변동 추이

CE 부문의 주요 원재료인 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 가격은 2016년 대비 약 6% 하락하였습니다. IM 부문의 모바일용 디스플레이 패널 가격은 2016년대비 약 8% 하락하였으며, Base Band Chip의 경우 2016년 대비 약 38% 가격이 상승하였습니다. DS부문의 원재료 중 강화유리용 Window 가격은 전년대비 약 6% 하락하였으며, 디스플레이 패널 원재료 중 Glass 가격은 전년 대비 약 10% 하락하였습니다 Harman 부문의 원재료 중 메모리 가격은 2016년 대비 약 7%, 시스템온칩 가격은 약 4% 하락하였습니다.

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제49기 3분기 ('17.1.1~9.30)	제48기 ('16.1.1~12.31)	제47기 ('15.1.1~12.31)
		수량	수량	수량
CE	TV	32,774	52,308	50,450
IM	HHP	311,000	447,200	497,050
DS	메모리	373,534,000	415,026,000	268,630,000
	DP	6,488	10,028	9,459
Harman	Headunits	3,952	-	-

※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.
※ Harman 부문은 인수일 이후의 기준입니다.
※ 3분기 9개월 기준 금액입니다.

CE 및 IM 부문의 주요 품목별 생산능력은 평균 라인수× 시간당 평균생산실적× 일평균가동시간× 가동일수로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1GB 환산기준으로 환산생산실적(패키지 OUT기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있고, DP의 경우 라인별 생산가능한 제품의 총면적을 8세대 Glass (2200× 2500mm) 로 환산하고 있습니다.
Harman 부문의 Headunits 생산능력은 각 거래선/제품별 생산셀(조립, 테스트)수× 각 생산셀별 시간당 평균생산능력× 1일 평균 생산시간× 생산일수로 산출하였습니다

(생산실적)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제49기 3분기 ('17.1.1~9.30)	제48기 ('16.1.1~12.31)	제47기 ('15.1.1~12.31)
		수량	수량	수량
CE	TV	28,600	47,428	45,821
IM	HHP	301,017	389,838	423,058
DS	메모리	373,534,000	415,026,000	268,630,000
	DP	5,813	8,307	8,284
Harman	Headunits	3,130	-	-

※ 생산실적은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.
※ Harman 부문은 인수일 이후의 실적입니다.
※ 3분기 9개월 기준 금액입니다.

2017년 3분기 CE 부문의 TV 생산실적은 28,600천대이고 한국(수원), 중국, 멕시코, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. IM 부문의 HHP 생산실적은 301,017천대이며 한국(구미), 중국, 베트남, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 373,534백만개(1GB 환산기준)이며, 한국(기흥, 화성) 및 중국에서 생산하고 있습니다. DP 생산실적은 5,813천개이며, 한국(천안, 아산), 중국 등 지역에서 생산 중입니다. Harman 부문의 생산실적은 3,130천개 입니다.

(가동률)

(단위 : 천대)

부문	품 목	제49기 3분기 생산능력 대수	제49기 3분기 실제 생산대수	가동률
CE	TV	32,774	28,600	87.3%
IM	HHP	311,000	301,017	96.8%

당사 CE 및 IM 부문의 2017년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV가 87.3%, HHP가 96.8%입니다.

(단위 : 시간)

부문	품 목	제49기 3분기 가동가능 시간	제49기 3분기 실제 가동시간	가동률
DS	메모리	52,416	52,416	100.0%
	DP	52,516	48,978	93.3%

DS부문의 메모리와 DP는 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 휴일을 포함하여 2017년 3분기 누적 가동일은 총 273일입니다. 273일× 생산라인수× 24시간으로 실제가동시간을 산출하여 가동률을 계산하였습니다.

(단위 : 천대)

부문	품 목	제49기 3분기 생산능력 대수	제49기 3분기 실제 생산대수	가동률
Harman	Headunits	3,952	3,130	79.2%

Harman부문의 2017년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 79.2%입니다.

나. 생산설비 및 투자현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 기흥, 온양, 광주 등 국내사업장 및 북미, 구주, 중국 등 해외 CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, Harman 산하 종속회사 등에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길11 (서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33 (우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1 (반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114 (여염리)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302 (임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107 (오선동)
해외 (CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	미국, 뉴저지
	구주 총괄	영국, 런던
	중국 총괄	중국, 북경
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가폴
	서남아 총괄	인도, 뉴델리
	CIS 총괄	러시아, 모스크바
	중동 총괄	아랍에미리트, 두바이
	아프리카 총괄	남아프리카공화국, 요하네스버그
	중남미 총괄	브라질, 상파울로
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	미국, 산호세
	구주 총괄	독일, 에쉬본
	중국 총괄	중국, 상해
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가폴
	일본 총괄	일본, 동경
Harman	미국 HQ	미국, Stamford

※ Harman 부문의 Connected Car 사업은 미국(Novi) 등, Lifestyle Audio 사업은 독일(Garching) 등, Professional Solution 사업은 미국(Northridge) 등, Connected Service 사업은 미국(Mt. View) 등에서 영위하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2017년 3분기말 현재 장부가액은 109조 61억원으로 전년말 대비 17조 5,331억원 증가하였습니다.
2017년 3분기 신규취득은 32조 8,747억원이며, 감가상각비는 14조 8,863억원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기초	기초장부가액	7,869,679	24,375,826	38,302,055	18,773,986	2,151,495	91,473,041
	취득원가	7,869,679	36,474,462	155,285,378	18,773,986	6,769,149	225,172,654
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(12,098,636)	(116,983,323)	-	(4,617,654)	(133,699,613)
증감	일반취득 및 자본적지출	1,571,648	5,785,310	27,110,846	(2,567,862)	974,804	32,874,746
	사업결합으로 인한 취득(*)	13,643	184,845	419,927	90,958	149,425	858,798
	감가상각	-	(1,343,387)	(12,863,161)	-	(679,795)	(14,886,343)
	처분/폐기	(19,026)	(11,723)	(57,511)	(77)	(65,621)	(153,958)
	손상	-	-	(294)	-	282	(11)
	매각예정자산으로 대체	-	238	2,199	(860)	(2,114)	(536)
	기타(*)	(7,686)	(450,251)	(194,874)	(390,538)	(116,297)	(1,159,646)
기말	기말장부가액	9,428,258	28,540,858	52,719,188	15,905,608	2,412,180	109,006,091
	취득원가	9,428,258	41,886,585	177,087,850	15,905,608	7,350,944	251,659,245
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(13,345,727)	(124,368,662)	-	(4,938,764)	(142,653,154)

※ 사업결합으로 인한 취득은 당분기 중 당사의 종속기업 Samsung Electronics America가 Harman과 그 종속기업의 지분 100%를 인수함에 따른 증가액을 포함하고 있습니다 [()는 부(-)의 값임]
※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.
※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

(2) 시설투자현황

당사는 2017년 3분기중 반도체와 DP사업부문의 라인 성능 개선 등 시설투자에 32.9조를 사용하였습니다. 2017년 연간 투자계획은 약 46.2조원으로 전년 대비 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.

[부문별 시설투자금액] (단위 : 억원)

사업부문	구 분	투자기간	대 상 자 산	제49기 3분기 투자액	비 고
반도체	신/증설, 보완 등	'17.1~'17.9	건물/설비	196,505	
DP	신/증설, 보완 등	'17.1~'17.9	건물/설비	113,062	
기 타	기타	'17.1~'17.9	건물/설비	19,180	
합 계				328,747	

5. 매출

가. 매출실적

2017년 매출은 173조 5,970억으로 전년 동기 대비 16.9% 증가하였습니다.
부문별로 보면 전년 동기 대비 CE 부문이 1.6% 증가, IM 부문이 5.9% 증가,
DS 부문이 36.2% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문		매출유형	품 목		제49기 3분기 (2017.1.1~9.30)	제48기 (2016년)	제47기 (2015년)
CE 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의료기기 등	계	323,902	451,028	448,013
IM 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	계	812,009	1,003,021	1,035,543
DS 부문	반도체 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	계	531,417	511,570	475,868
	DP 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	TFT-LCD, OLED 등	계	232,820	269,286	274,869
	부문 계				761,161	781,482	750,261
Harman 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커, 헤드폰 등	계	47,788	-	-
기 타		기타매출	-	계	△208,890	△216,864	△227,282
합 계					1,735,970	2,018,667	2,006,535

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준) [Δ 는 부(-)의 값임]
※ CE부문은 프린팅솔루션 사업부를 제외하여 재작성하였습니다.

- 주요제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제49기 3분기 ('17.1.1~9.30)	제48기 ('16.1.1~12.31)	제47기 ('15.1.1~12.31)
영상기기	191,510	287,241	292,194
무선	785,927	977,494	1,005,117
MEMORY	423,647	378,594	342,917
DP	232,820	269,286	274,869

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

- 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제49기 3분기 ('17.1.1~9.30)	제48기 (2016년)	제47기 (2015년)
제상품	1,711,317	2,006,326	1,988,452
용역 및 기타매출	24,653	12,341	18,083
계	1,735,970	2,018,667	2,006,535

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

- 주요지역별 매출현황 (별도기준)

(단위 : 억원)

구 분	제49기 3분기 ('17.1.1~9.30)	제48기 (2016년)	제47기 (2015년)
국내	128,598	140,656	145,908
미주	362,776	426,448	425,042
유럽	137,126	170,850	173,583
아시아 및 아프리카	245,740	281,021	291,473
중국	323,596	320,497	316,044
계	1,197,836	1,339,472	1,352,050

나. 판매경로

□ 국 내

<table>
<tr><th>판매자</th><th colspan="3">판매경로</th><th>소비자</th></tr>
<tr><td rowspan="5">생산자
(공장)</td><td colspan="3">대리점</td><td rowspan="5">소비자</td></tr>
<tr><td colspan="3">유통업체(양판점,할인점,백화점,홈쇼핑,인터넷)</td></tr>
<tr><td>대리점</td><td colspan="2">계열점</td></tr>
<tr><td colspan="3">통신사업자(SKT, KT, LG유플러스)</td></tr>
<tr><td colspan="3">직접판매</td></tr>
</table>

□ 해 외

<table>
<tr><th>판매자</th><th colspan="5">판매경로</th><th>소비자</th></tr>
<tr><td rowspan="8">생산법인</td><td rowspan="4">판매법인</td><td colspan="4">Retailer</td><td rowspan="8">소비자</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dealer</td><td colspan="2">Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td colspan="2">Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="4">통신사업자, Automotive OEM</td></tr>
<tr><td rowspan="3">물류법인</td><td rowspan="3">판매법인</td><td colspan="3">Retailer</td></tr>
<tr><td>Dealer</td><td colspan="2">Retailer</td></tr>
<tr><td>Distributor</td><td>Dealer</td><td>Retailer</td></tr>
<tr><td colspan="5">직접판매</td></tr>
</table>

□ 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	25%	24%	44%	7%

※ Global 기준입니다.

다. 판매방법 및 조건

□ 국 내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	- 약정여신수금(현금,30일여신) (담보 100%내 여신적용)	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점,할인점, 백화점,홈쇼핑,인터넷	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
특직판	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

□ 해 외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점,할인점,백화점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래선 직판 영업	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

○ 스마트 제품 등 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화

○ 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공

○ 고객/시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2017년 3분기 당사의 주요 매출처는 Apple, AT&T, Deutsche Telekom, Sprint, Verizon 등 입니다.(알파벳순)

당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 11% 수준입니다.

6. 수주상황

2017년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 또한 당사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

한편, 당사는 해외 주요 권역별로(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아) 지역금융센터를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 당사는 환율변동으로 인한 현금흐름의 불확실성과 손익변동을 최소화하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 당사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

당사는 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 31,157백만원 및 23,622백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정・관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 당사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 줄이는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 당사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

당사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	85,887,328	69,211,291
자 본	210,691,251	192,963,033
부채비율	40.8%	35.9%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	30,788,226	(*1)	32,111,442	(*1)
단기금융상품	41,280,668	(*1)	52,432,411	(*1)
단기매도가능금융자산	3,964,250	3,964,250	3,638,460	3,638,460
매출채권	30,351,245	(*1)	24,279,211	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	8,066,146	6,885,713	6,804,276	5,826,507
기타(*4)	6,244,101	1,273,750	3,459,863	919,071
소 계	120,694,636		122,725,663	
금융부채				
매입채무	11,367,405	(*1)	6,485,039	(*1)
단기차입금	15,329,338	(*1)	12,746,789	(*1)
미지급금(*3)	12,034,295	335,640	10,225,271	(*1)
유동성장기부채	17,659	(*1)	1,232,817	(*1)
사채	1,015,061	1,029,997	58,542	76,129
장기차입금	2,199,998	2,209,618	1,244,238	1,225,455
장기미지급금	1,683,082	1,663,015	3,009,659	3,022,821
기타(*4)	9,851,631	138,216	11,942,469	74,697
소 계	53,498,469		46,944,824	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 1,180,433백만원(전기: 977,769백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 11,698,655백만원(전기: 10,225,271백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*4) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 금융자산 4,929,761백만원(전기: 2,452,118백만원) 및 금융부채 9,713,415백만원(전기: 11,867,772백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,964,250	-	3,964,250
장기매도가능금융자산	3,115,711	-	3,770,002	6,885,713
기타	-	1,273,750	-	1,273,750
(2) 부 채				
미지급금	-	-	335,640	335,640
사채	-	1,029,997	-	1,029,997
장기차입금	-	2,209,618	-	2,209,618
장기미지급금	-	1,663,015	-	1,663,015
기타	-	102,157	36,059	138,216

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,638,460	-	3,638,460
장기매도가능금융자산	2,362,235	-	3,464,272	5,826,507
기타	-	919,071	-	919,071
(2) 부 채				
사채	-	76,129	-	76,129
장기차입금	-	1,225,455	-	1,225,455
장기미지급금	-	2,680,119	342,702	3,022,821
기타	-	74,697	-	74,697

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

・Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격

・Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)

・Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

당사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

1) 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
장기매도가능금융자산				
말타니	16,270	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.45%~9.45%(8.45%)
삼성벤처투자	7,515	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	21.31%~23.31%(22.31%)
Corning Incorporated 전환우선주	3,746,217	삼항모형	위험 할인율	5.27%~7.27%(6.27%)
			가격 변동성	26.9%~32.9%(29.9%)
미지급금				
조건부금융부채	335,640	현금흐름할인모형	할인율	3.81%~4.65%(4.23%)
기타				
조건부금융부채	29,484	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	10.50%
			무위험할인율	0.97%
			자산변동성	34.54%
			신용스프레드	2.12%
조건부금융부채	5,332	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	17.57%
			무위험할인율	0.86%
			영업레버리지율	60.00%
			매출총이익할인율	6.68%
조건부금융부채	1,243	확률가중모형	가중평균자본비용	8.60%
			신용위험	2.12%

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초잔액	3,464,272	3,488,344
매입	-	91,584
매도 등	-	(85,169)
당기손익으로 인식된 손익	-	(6,528)
기타포괄손익으로 인식된 손익	305,730	478,104
기타	-	1,534
분기말	3,770,002	3,967,869

(단위: 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	342,702	312,738
결제 등	(2,669)	-
당기손익으로 인식된 손익	(7,062)	(5,118)
사업결합으로 인한 취득	39,083	-
기타	(355)	-
분기말	371,699	307,620

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
장기매도가능금융자산(*1)	-	175,464	-	(162,648)
미지급금(*2)	824	824	(826)	(826)
계	824	176,288	(826)	(163,474)

(*1) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.
(*2) 미지급금은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사 및 종속회사는 Corning Incorporated의 전환우선주를 보유하고 있으며,
2017년 3분기말 현재 전환우선주의 가치는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실
전환우선주	2,434,320	3,746,217	1,311,897	-

※ 공정가치는 삼항 모형을 이용, 평가이익은 자본(기타자본항목)에 반영하였습니다.

환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사의 해외법인은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다.
또한, 해외법인은 위험회피목적으로 1년 미만 만기 통화선도를 은행을 통하여 매수 또는 매도합니다.

2017년 3분기말 현재, USD/EUR/JPY 등 총 37개 통화에 대하여 2,592건의 통화선도거래를 체결중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	101,814	78,198	65,736	61,673
계	101,814	78,198	65,736	61,673

9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
에릭슨	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
구글	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 / 영구
	목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이센스 계약(향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
시스코	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
글로벌 파운드리즈	계약 유형	공정 기술 라이센스 계약
	체결시기 및 기간	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
	기타 주요내용	-
인터디지털	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
Sharp	계약 유형	상호 특허 사용계약
	체결시기 및 기간	2015.01.01
	목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
마이크로소프트	계약 유형	분쟁종료 합의
	체결시기 및 기간	-
	목적 및 내용	로열티 지급에 관한 분쟁 종료 목적
	기타 주요내용	-
노키아	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2016.07.12
	목적 및 내용	특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-

계약 상대방	항 목	내 용
HP	계약 유형	사업 매각
	체결시기 및 기간	2016.09.12
	목적 및 내용	핵심역량 강화를 통한 사업고도화
	기타 주요내용	계약금액 : USD 10.5억

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 창조적이고 혁신적인 제품을 준비하고 있으며 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원)

과 목		제49기 3분기	제48기	제47기
연구개발비용 계		12,229,963	14,792,343	14,848,754
회계처리	개발비 자산화(무형자산)	(307,775)	(680,962)	(1,143,059)
	연구개발비(비용)	11,922,188	14,111,381	13,705,695
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100]		7.0%	7.3%	7.4%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. [()는 부(-)의 값임]

2017년 3분기 당사의 연구개발비용은 12조 2,300억원이며, 자산화된 3,078억원을 제외한 11조 9,222억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

나. 연구개발 조직 및 운영

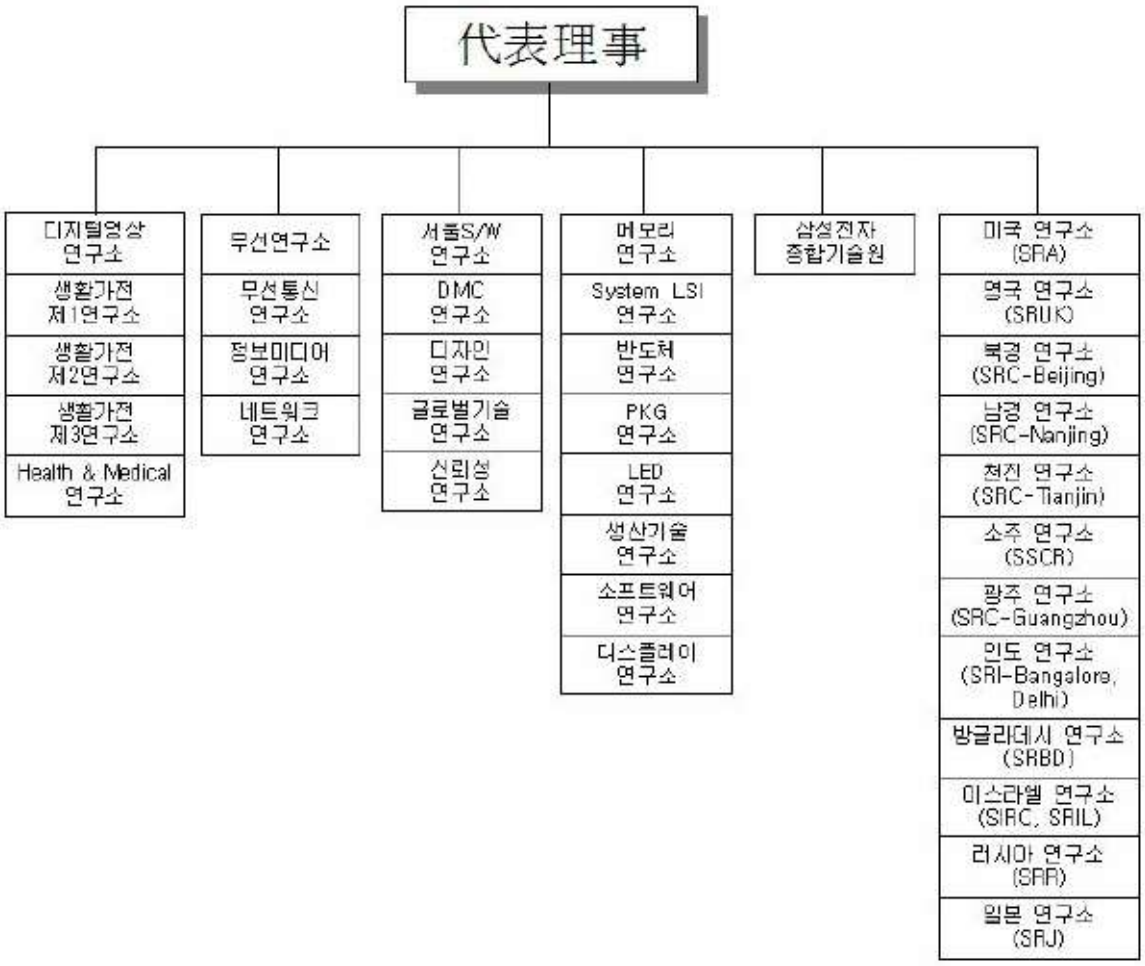
□ 국내

당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 무한탐구를 실현하며 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

□ 해외

미국(SRA), 영국(SRUK), 러시아(SRR), 이스라엘(SRIL,SIRC), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 일본(SRJ), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Tianjin, SRC-Guangzhou) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품개발 및 기초기술연구 등의 연구활동을 수행중입니다.



연구개발조직도

※ 연구개발 조직도는 2017년 3분기말 기준입니다.

※ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 I. 회사의 개요 중 사. 연결대상 종속기업 개황을 참조하시기 바랍니다.

다. 연구개발실적

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
스마트카드 신제품 개발	□ 플래시 메모리 내장 (e-flash) NFC 출시 - 업계 유일 45나노 e-플래시 로직 공정 사용, 90나노 제품 대비 집적도 및 전력효율 개선 - 최소 안테나 솔루션 지원으로 제품 소형화 - 업계 최초 NFC칩을 통해 모바일 POS 구현 ※ POS (Point of Sales) : 판매시점 정보관리 시스템	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.1월 □ 명칭 : S3FWRN5
고해상도 저소비전력 Tablet 제품 기술	□ 고해상도 Tablet 패널 양산 □ 투과율향상에 의한 Tablet 제품의 저소비전력 달성 및 생산 수율 향상	□ 지역: 글로벌 □ 출시: '14.2월
Server향 20나노 4GB DDR3 D램 양산	□ 세계 최초 초미세 20나노 4GB DDR3 D램 양산 - 독자개발 '고집적/초고속/저전력' 기술 적용 - 25나노 대비 생산성 30% 이상 향상 □ 20나노 4GB D램으로 PC 및 서버 풀라인업 출시예정 - 향후 모바일까지 全라인업 출시로 경쟁력 강화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.2월 □ 명칭 : 4GB DDR3 D램
ISOCELL 이미지센서 신제품 개발	□ 1600만화소 ISOCELL 이미지센서 신제품 출시 - 어두운 공간에서도 선명한 이미지 획득 - 업계 최초 1600만화소/ 초당 30pfs 촬영可 - 16:9 종횡비 FullHD 해상도 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.3월 □ 명칭 : S5K2P2
HMP 솔루션 적용 모바일 AP 신제품 개발	□ Exynos 5 Octa (5422) 신제품 출시 - HMP 솔루션 적용으로 고성능/저전력 코어 8개 조합 및 활용하여 전력효율 강화 - WQHD 및 WQXGA 초고해상도 지원 - 절전모드 자동전환 및 모바일 영상 압축 기술 사용으로 저전력 특성 강화 □ Exynos 5 Hexa (5250) 신제품 출시 - HMP 솔루션 적용으로 고성능/저전력 코어 6개 조합 및 활용하여 전력효율 강화 - WQXGA 초고해상도 지원	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.1월/3월 □ 명칭 : Exynos5250/ Exynos5422
UHD TV HU9000	□ 완벽한 몰입감을 주는 Ultimate Curved UHD TV - 인체공학적 Curved LED Panel 채용 □ 경쟁사 대비 확고한 차별화 가치 제시 - Multi-Link Screen 추가한 Smart Hub 기능 - 유일한 Evolutionary UHD TV □ Premium 디자인 - Ergonomic Curved Design 채용 - Immersive Viewing Experience를 통한 최상의 Premium 이미지 선점	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.3월 □ 인치 : 55"/65"
PC향 2세대 V-NAND기반 1TB SSD 양산	□ 세계 최초 2세대 3D V낸드기반 1TB SSD 양산 - 2세대 V낸드로 '3차원 메모리 대중화시대'열어 - 작년 서버시장 창출에 이어 PC시장 본격 공략 □ 고신뢰성,고성능,저전력 V낸드 SSD 라인업 출시 - 기존 SSD 보다 수명 2배 확대 및 20% 절전 - 7월부터 전세계 53개국에 'V낸드 SSD' 런칭	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.5월 □ 명칭 : 1TB V-NAND SSD
ISOCELL 이미지센서 신제품 개발	□ 1300만화소 적층형 ISOCELL 이미지센서 개발 - 적층형 구조로 칩 크기 감소, 회로영역 증가 - 스마트WDR 기능 탑재로 인한 노출 다양화는 역광에서의 색 재현성 개선	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.6월 □ 명칭 : S5K3M2

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
모바일 AP 신제품 개발	□ Exynos 5 Octa (5430) 신제품 출시 – 20나노 저전력 HKMG공정 적용, 전력 효율 향상 – HMP 솔루션 적용으로 성능향상 및 저전력 코어 필요에 따라 개별적으로 동작 – 절전모드 자동전환 및 모바일 영상 압축 기술 사용으로 저전력 특성 강화 – WQHD 및 WQXGA 초고해상도 지원	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.6월 □ 명칭 : Exynos 5430
UHD TV (UN105S9WAF)	□ Product Concept – Wide Curved(21:9) 105" UHD TV – 초대형 105" Curved UHD TV 세계 최초 도입을 통한 시장 리더십 확고화 필요 □ 사양 및 효과 – SDC(社) 4200R 105" Wide Curved Panel 채용 – Golf-AP/MP Platform 적용 – 궁극의 몰입감 및 현장감 있는 시청 환경 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.7월 □ 인치 : 105"
LFD QMD	□ Premium UHD Line Up 도입 – 고해상도 UHD급 LFD 라인업 도입 운영 – SE13U Platform 적용 – LFD Usage 대응을 위한 사양 적용 – TV HU7K 디자인 공용화를 통한 추가 투자비 절감 □ 주요 기능 – Full HD 4분할 화면 지원 (2/3/4/ 다양한 Format의 화면 분할 시나리오) – DP 1.2 및 SBB 적용 가능	□ 지역: 글로벌 □ 출시 : '14.8월 □ 인치 : 85"
PC/서버향 32단 3비트 3D V-NAND 양산	□ 세계 최초 3비트(bit) 3D V낸드기반 1TB SSD 양산 – 3비트 V낸드로 'V낸드 SSD 대중화시대' 열어 – 생산성 50% 향상된 V낸드로 표준형SSD 시장 공략 □ 고신뢰성· 고성능· 저전력 V낸드 SSD 라인업 강화 – 기존 2.5” 에 이어 mSATA 및 M.2 SSD 라인업출시 – 12월부터 전세계 53개국에 '850 EVO SSD' 런칭	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.10월 □ 명칭 : 128Gb 3bit 3D V-NAND (850 EVO SSD)
Bendable TV Nov (UN78S9BAF)	□ 세계 최초 Bendable UHD TV – 당사 Tech Leadership 확보 □ Design – Timeless Gallery Design 채용 – TV가 꺼지는 순간, 하나의 미학적인 오브제	□ 지역 : 국내 □ 출시 : '14.11월 □ 인치 : 78"
Mobile향 20나노 8Gb LPDDR4 D램 양산	□ 세계 최초 초미세 20나노8Gb LPDDR4 D램 양산 – 독자개발 '고집적/초고속/고용량' 솔루션 적용 – 세계 최초 4GB 시장 창출 및 선점 □ 20나노 D램 라인업 확대로 D램 시장 증가세 견인 – 향후 차세대 라인업(8/6/4Gb) 확대로 시장선점	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '14.12월 □ 명칭 : 8Gb LPDDR4 D램
모바일 AP 신제품 출시	□ 업계 최초 14나노 핀펫 공정 기반 모바일 AP – 14나노 공정은 20나노 공정 比 20% 성능 향상, 35% 소비전력 감소, 30% 생산성 개선	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.1월 □ 명칭 : Exynos 7 Octa
NFC 신제품 출시	□ RF 성능 향상된 4세대 NFC 솔루션 – 3세대 제품 比 카드모드 2배, 리더모드 20% ↑ □ 스마트폰 환경에서 모바일 POS 구현 지원 □ 45나노 임베디드 플래시 공정 적용 – 고객의 제품 개발 및 인증기간 단축	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.1월 □ 명칭 : S3FWRN5P
Mobile向 10나노급	□ 세계 최초 차세대 모바일용 메모리 128GB UFS 양산 – 메모리카드의 12배, eMMC의 2.7배 성능 향상	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.2월

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
128GB UFS 양산	- 세계 최초 128GB UFS 시장 창출 및 선점 □ 고용량 메모리 시장 확대로 Premium시장 성장 주도 - 기존보다 2배 고용량 라인업(128/64/32GB) 출시	□ 명칭 : 128GB UFS (내장 메모리 카드)
SUHD TV 출시	□ Curved SUHD TV : 궁극의 몰입감 제공 ※ S : 압도적인(Spectacular), 스마트(Smart), 세련된(Stylish), 최고의(Superb) □Design : Chamfer Design (Real Metal)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.3월 □ 인치: 65"/78"/88"
PC向 10나노급 NAND기반 512GB M.2 NVMe SSD양산	□ 세계 최초 차세대 PC용 512GB M.2 NVMe SSD 양산 - SATA SSD보다 4배 빠른 읽기성능 2,260MB/s 구현 - 세계 최초 모바일워크스테이션, 슬림PC 시장 선점 □ 초고속 고용량 SSD 시장 확대로 Premium시장 주도 - 향후 V낸드기반 라인업출시로 PC시장 본격 공략	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.4월 □ 명칭 : 512GB M.2 NVMe SSD (SM951 SSD)
HAV(WAA) WAM5500/ZA	□ Ambient Audio 차별화된 음질 및 감성적 디자인으로 신규 카테고리 제안 (Blending, conventional 디자인) - Wireless Audio 360 및 Ring Radiator Tech 통한 동일한 음질제공 - TV/AV제품 호환성을 통한 Multiroom Audio 사용성 확대 - Analog Wheel을 적용하여 감성적인 사용경험 제공 - Voice AUI를 적용을 통한 설정정보를 이해하기 쉬움 - OLED를 적용하여 Visual 경험 제공	□ 지역 : 미주 □ 출시 : '15.8월
CMOS 이미지센서 신제품 출시	□ 업계 최초 1.0um 1600만 화소 모바일 이미지센서 - 아이소셀 기술로 1.12um 화소와 동등 화질 구현 - 높이 5mm 이하 카메라 모듈 실현을 가능케 해 모바일 기기 디자인 슬림화 지원 - 1.12um화소 센서 대비 모듈 높이 20% 감소	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.7월 □ 명칭 : S5K3P3
SSD向 3세대(48단) 256Gb 3D V-NAND 양산	□ 세계 최초 3세대(48단) 256Gb 3D V낸드 양산 - 128Gb 낸드보다 집적도 2배 높인 256Gb 본격양산 - PC, 엔터프라이즈서버, 데이터센터 SSD시장 선점 □ 초고속 SSD 라인업 확대로 '테라SSD 대중화' 주도 - 3세대 V낸드기반 라인업 확대로 시장 본격 공략	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.8월 □ 명칭 : 256Gb 3D V낸드 (3세대 48단)
Mobile向 20나노 D램기반 12Gb LPDDR4 모바일 D램양산	□ 세계 최초 차세대 모바일용 12Gb LPDDR4 D램 양산 - PC D램보다 2배 빠른 4,266Mbps 속도 최초 구현 - 모바일에서 PC, 가전, 자동차시장까지 시장 선점 □ 초고속 D램 시장 선점으로 Premium D램시장 주도 - 향후 6GB 라인업 출시로 차세대 D램시장 본격공략	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.9월 □ 명칭 : 12Gb LPDDR4 모바일 D램 (20나노D램)
LFD OHD	□ Product Concept - Outdoor Signage의 Digital화 가속에 따른 시장 Needs 충족 - 기존 46" → 46"/55" 로 사이즈 다변화 - 1,500nit에서 2,500nit의 밝기 개선 및 고온 대응 신규패널 적용 □ 제품사양 - 별도 Power Box 형태의 Outdoor Kit 제품 - 사용온도 -30 ~ 50도 (Fan 및 Heating Film 적용)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.10월 □ 인치 : 46"/55"
서버向 20나노 D램기반 128GB 3D TSV DDR4 RDIMM양산	□ 세계 최초 차세대 서버용 128GB 3D TSV RDIMM양산 - 3차원 TSV기술로 속도 2배, 소비전력량 50%절감 - 서버 D램 모듈(RDIMM/LRDIMM)의 용량 한계 돌파 □ 차세대 라인업 출시로 Premium D램시장 성장주도 - 향후 TSV LRDIMM에 이어 HBM2출시로 신시장창출	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.11월 □ 명칭 : 128GB 3D TSV DDR4 RDIMM (20나노D램)
CAC 시스템에어컨 AC9000K	□ 제품 특성 - 세계최초 Bladeless 360 카세트 개발 - 원형 기류로 냉방 사각지대 최소화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.12월

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
	- 쾌적면적 비율 44→83% - Cold Draft Free(냉기류 체감온도차 7.9→0.2℃)	
DVM 시스템에어컨 AM7500K	□ 제품 특성 - 동일 Size 업계 최대 용량 - Compact Size & 설치/서비스 개선(업계 최저 폭 940mm) - 업계 최고효율 (중국 12HP IPLV 17% ↑)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.12월
바이오 프로세서 통합칩 양산	□ 업계 최초 바이오 프로세서 통합칩 양산 - AEF 外 MCU, DSP, eFlash, PMIC 내장으로 신호의 채집에서 처리까지 원칩으로 구현 - 5개 AFE 탑재해 칩 하나로 5개 신호 측정 (BIA(체지방), PPG(심박수), ECG(심전도), 피부온도, GSR(스트레스 레벨))	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '15.12월 □ 명칭 : S3FBP5A
HPC向 20나노 D램기반 4GB HBM2 D램 양산	□ 세계 최초 차세대 HPC용 4GB HBM2 D램 양산 - 시스템속도 3.6배 향상, 보드탑재 면적 97% 절감 - 기존 대비 37배 고집적 TSV기술로 속도한계 돌파 □ 8GB HBM2 출시로 Premium 메모리 시장 성장 주도 - 그래픽, HPC에 이어 네트워크 시장도 지속 선점	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.1월 □ 명칭 : 4GB HBM2 D램 (20나노D램)
LFD DCE	□ 사양 및 효과 - DBE 모델의 기구, 패널 공용하여 Slim 대응과 NT14 플랫폼 적용으로 Light한 MagicInfo-E 솔루션 제공 - Slim Design: Bezel 9.5mm, Depth 49.9mm - MagicInfo E 솔루션을 통한 USB Contents Player 기능 제공 - RJ45/RS232C 등 Control 기능 강화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.1월 □ 인치 :32/40/48/55"
LM TC2	□ 사양 및 효과 - CPU 사양 Upgrade를 통해 경쟁력 제고 ※ 1.0GHZ Dual Core → 2.2GHz Dual Core - 64bit WES7 도입으로 OS 선택폭 넓힘 - USB 단자 추가(Serial Port → USB x 2) ※ 기존 Serial Port는 USB to Serial 어댑터로 대체	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.1월 □ 인치 : 22"/24"
DVM 시스템에어컨 AM9100K	□ 제품 특성 - 고효율 Inverter Chiller 시장 진입 - 효율(구주) : EER : 3.4 / ESEER : 5.7 (경쟁사 대비 40%↑) - 설치면적 : 1.38㎡(경쟁사 대비 39%↓) - 운전범위 : -25 ~ 48 ℃ (경쟁사-15 ~ 43℃)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.1월
모바일向 3세대(48단) V낸드기반 256GB UFS양산	□ 세계 최초 차세대 스마트폰용 256GB UFS 양산 - uSD카드 대비 9배, SSD대비 2배 고성능 구현 - 스마트폰용 초고속・초대용량・초소형 솔루션 제공 □ 256Gb UFS 시장 본격 확대로 메모리 사업역량 강화 - 내장 스토리지 시장에서 UFS 고성장세 지속 견인	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.2월 □ 명칭 : 256GB UFS (3세대(48단) 256Gb V낸드)
서버向 3세대(48단) V낸드기반 15.36TB SAS SSD양산	□ 세계 최초 차세대 서버용 15.36TB SAS SSD 양산 - 256Gb V낸드 탑재로 세계 최초 15.36TB SSD 제공 - 단일 Form Factor 저장장치 중 역대 최대 용량 구현 □ 고용량 라인업 지속 확대로 SAS시장 본격 공략 - 데이터센터에 이어 엔터프라이즈 시장도 대폭확대	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.2월 □ 명칭 : 15.36TB SAS SSD (3세대(48단) 256Gb V낸드)
PC/서버向 10나노급(1x) 8Gb DDR4 D램 양산	□ 세계 최초 차세대 10나노급 8Gb DDR4 D램 양산 - 20나노대비 생산성/속도 30%이상향상, 약20%절전 - 독자 개발 '3대 혁신 기술'로 미세화 한계 돌파 □ 초고용량 D램 라인업 확대로 시장 성장세 주도 - PC, 서버에 이어 모바일 시장까지 지속 선점	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.2월 □ 명칭 : 8Gb DDR4 D램 (10나노급D램)

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
LM CF59	□ 사양 및 효과 - 회로 : 1 D-Sub/1HDMI/1DP 의 Triple Interface 제공 - 기구 : 3면 Bezeless 적용을 통한 세련된 디자인과 Multi-Display의 Seamless한 usage 제공 - 패널 : 1800R 곡률 적용 ('15년 4000R)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.2월 □ 인치 : 27"
FDR 냉장고 RF9500KF	□ 제품 특성 - IOT시대에 새로운 사용경험 제안으로 스마트가전시장 선도 및 신규 수요 창출 - 21.5" LCD 적용 - Smart Things, Sticki Shopping 등 가족간 커뮤니케이션, 스마트 홈 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.2월
엑시노스8 옥타	□ 14나노 2세대 공정 기반 Premium 모바일 SOC - 성능과 절전효과 더욱 강화 - 독자 개발 커스텀 CPU 코어 기술 적용 - 최고 사양 LTE 모뎀 내장한 첫 Premium 통합칩	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 명칭 : S5E8990
엑시노스7	□ 업계 최초 14나노 기반 보급형 모바일 SOC - 14나노 파생공정 적용 - 기존 동일 성능의 28nm공정 제품 대비 전력효율 30% 개선	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 명칭 : S5E7870
모바일 이미지센서	□ 듀얼 픽셀 1,200만 화소 모바일 이미지센서 - 모든 화소에서 고속으로 위상차 검출기능 구현 - 어두운 환경에서도 빠르고 정확한 자동초점 기능 - 삼성 아이소셀 기술 적용으로 성능 극대화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 명칭 : S5K2L1
LFD OHE	□ 사양 및 효과 - 기존 Outdoor 사양 유지 - 110℃ TN Panel로 Outdoor Usage 대응 - Quad-Core SoC 내장으로 PC-Less 솔루션 제공 - 자동 조도센서를 통한 최적의 밝기 유지, 전력 소모 최적화 및 제품 수명 극대화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 인치 : 24"
LM CF39	□ 사양 및 효과 - 16:9 세계 최고 곡률의 1800R 적용 - 라운드 형태의 Stand Base 및 Simple Single Hinge 적용을 통한 세련된 디자인 - 후면은 심플하고 감각적인 디자인 적용을 통해 최대 곡률의 느낌을 반영	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 인치 : 24"/27"
SUHD TV (KS9000)	□ Curved SUHD TV □ Design : Dignity, Bezel-less, Screw-less, Axis Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : Jazz-M, Tizen OS - 화질 : UHD 120Hz, Curved, QD, Local Dimming - 기능 : Live와 OTT 통합 Home을 통해 TV 시청 컨텐츠 /서비스로의 접근성 제고 및 시청 경험 강화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 인치 : 49"/55"/65"
SUHD TV (KS7500/KS7000)	□ Curved SUHD TV □ Design : Triumph, Bezel-less, Screw-less, Branch Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : Jazz-M, Tizen OS - 화질 : UHD 120Hz, Curved, QD, Local Dimming - 기능 : Live와 OTT 통합 Home을 통해 TV 시청 컨텐츠 /서비스로의 접근성 제고 및 시청 경험 강화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 인치 : 43"/49"/55"/65"
UHD TV (KU6500/KU6400)	□ UHD Curved TV □ Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
	□ 사양 및 효과 – Platform(H/W,S/W) : JAZZ-L, Tizen OS – 화질 : Wide Color Gamut – 기능 및 사용성 : Live와 OTT 통합 Home을 통해 TV 시청 컨텐츠/서비스로의 접근성 제고 및 시청 경험 강화	□ 인치 : 40"/43"/49"/55"/65"
UHD TV (KU6000)	□ UHD Flat TV □ Design : Minimalism 디자인, V-Shape 스탠드 □ 사양 및 효과 – Platform(H/W,S/W) : JAZZ-L, Tizen OS – 화질 : UHD Upscaling, Auto Contrast Enhancer, PurColor 等 – 기능 및 사용성 : 신규 Smart TV 적용을 통해 컨텐츠/서비스로 접근성 제고 및 시청 경험 강화	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.3월 □ 인치 : 40"/43"/50"/55"/60"/65"
FHD TV (K5100) (K4100)	□ FHD Flat TV □ Design : Louvre Design, Semi Edge Slim □ 사양 및 효과 – Platform(H/W,S/W) : XL1,NT14L,NT16L(Non-Smart) – 화질 : 다양한 컨텐츠 시청에 최적화된 FHD화질 – 기능 및 사용성 : Sport mode, USB 2.0	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.4월 □ 인치 : 32"/40"/43"/49"/55"
HD-TV (HE690)	□ Product Concept – Market Segment별 특화 제품 및 솔루션 제공을 통한 시장 공략 – Premium Smart TV, 4~5성급 호텔 대상 □ 사양 및 효과 – HMS, SINC, REACH, H.Browser, Bluetooth Music Player, Ethernet Bridge(32" ↑), Swivel Stand	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.8월 □ 인치 : 22"/24"/28"/32"/40"/49"/55"
엑시노스7 쿼드	□ 커넥티비티 통합 모바일 SOC – 28나노 前 세대 제품 比 성능 70%, 전력효율 30% 향상 – 모뎀, 커넥티비티, PMIC 등 주요 기능 통합해 칩셋면적 20% 축소	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.8월 □ 명칭 : S5E7570
식기세척기 (DW9900M)	□ 제품 특성 – 2세대 WaterWall – Zone booster 기능강화 – WiFi 앱 적용 및 Rack 기능 차별화 – Sump & New Filter System – Hidden control, Touch Type display	□ 지역 : 북미 □ 출시 : '16.12월
RAC 가정용에어컨 (AR5500M)	□ 제품 특성 – 친환경(Low-GWP) R32 냉매 도입을 통한 시장 환경 변화 대응 – S-Inv 제품 도입으로 Inv 제품 경쟁력 강화 – N-PFC 적용, R32 8극 압축기 적용	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '16.12월
엑시노스9	□ 10나노 핀펫 공정 기반 Premium AP – 최첨단 10나노 공정 적용, 저전력 고성능 구현 – 기가비트급 LTE 통신 지원 모뎀 통합칩 – 2세대 커스텀 CPU 및 차세대 GPU등 최고수준 성능 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.1분기
UHD TV (MU7000)	□ Flat UHD TV □ Design : Slim Unibody, Real 360, Bezel-less, Screw-less, Branch Stand □ 사양 및 효과 – Platform(H/W,S/W) : Kant-M, Tizen OS – 화질 : UHD 120Hz, Flat, Local Dimming – 기능 : One Connect mini로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.2월 □ 인치 : 49"/55"/65"
UHD TV	□ UHD Curved TV	□ 지역 : 글로벌

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
(MU6500)	□ Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design Y-Shape Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 출시 : '17.3월 □ 인치 : 49"/55"/65"
UHD TV (MU6400)	□ UHD Flat TV □ Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design Y-Shape Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.3월 □ 인치 : 40/49/55/65"
UHD TV (MU6300 /MU6100)	□ UHD Curved TV □ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.3월 □ 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/ 65"/75"
QLED TV (Q8C)	□ Curved QLED TV □ Design : 4면bezel-less, Simple Edge, Metal Back Stainless Silver stand(Type-U) Slim Wall Mount □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : Kant-M, Tizen OS - Concept: 4면 Bezel-less 디자인 QLED TV - 화질: 최고수준의 밝기, 풍부하고 정확한 컬러, 블랙화질 및 시야각 개선 - 기능: Optical Cable 과 One Connect로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시: '17.4월 □ 인치 : 75"
UHD TV (MU6100)	□ UHD Flat TV □ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile)을 적용하여 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.4월 □ 인치 : 49"/55"/58"/75"
UHD TV (LS003)	□ Lifestyle TV □ Design : Frame Edge Design, Zero Gap WMT □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look - 기능 : Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection, Replaceable Deco Frame	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.5월 □ 인치 : 55"/65"
엑시노스i (T200)	□ IoT 전용 SOC - 28나노 HKMG 공정 적용, 멀티코어 탑재 - 암호화/복호화 기능, 물리적 복제 방지 기능 등 보안 기능 강화 - 와이파이 얼라이언스 인증, IoT 프로토콜 표준 'IoTvity' 지원	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.5월 □ 명칭 : S5JT200

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
UHD TV (MU6303)	□ 실속형 UHD Curved TV □ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공 - MU6300 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.7월 □ 인치 : 49"/55"/65"
UHD TV (MU6103)	□ 실속형 UHD Flat TV □ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand □ 사양 및 효과 - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공 - MU6100 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.7월 □ 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/ 65"/75"
HD-TV HF690	□ Product Concept - Market Segment별 특화 제품 및 솔루션 제공 - 3~4성급 대상 지역 별 Premium Smart HF590/690 도입 - KANT-M(Tizen3.0)적용 도입 □ 사양 및 효과 - Panel : 기존 M5500 동일 사양 : 32"/43"/49"/55" 도입 - 회로 Platform : Kant-M(Tizen3.0) 적용 ※ SMPS : M5500 SMPS 공용설계 ※ HDMIx3,USBx2,RJ12,LAN,Opt,Comp/AV,RJP,BathSPK,LAN OUT - 기구 Design : M5500 시리즈 공용 설계 ※ Swivel Stand/Box : 16년 호텔 690동일 사양	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.8월 □ 인치 : 32"/43"/49"/55"
LFD QMH	□ Product Concept - Premium UHD Line Up 도입 ※ 고해상도 UHD급 Signage 라인업 도입 운영 ※ SoC 적용을 통한 Signage 솔루션 제공 ('16년 QMF 比 주요 개선 Point) - UHD 라인업 Size 경쟁력 확대 ※ 다양한 사이즈의 Full Line-up 구축을 통한 시장의 고해상도 Needs 대응 - Non-Glare 및 24/7 사용 대응, 16년 QMF 동일 ※ LFD Usage 대응을 위한 사양 적용 □ 사양 및 효과 - Platform : Orsay → Tizen 3.0 도입, DTS, DIVX 삭제 - 회로 : FHD/UHD 모델 플랫폼 통합 : Kant-M SoC 적용 ※ 성능/기능 개선 : SE13U(Scaler) → Kant-M(SoC) - 패널 : 24/7, V-PID 및 Non-Glare 적용 (Haze 25%)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.8월 □ 인치 : 49"/55"/65"
청소기 (VS8000ML)	□ 제품 특성 - 세계 최고 흡입력 POWERStick 청소기 - Suction Power 150W, 40분 - Flex Body, 듀얼 드럼 브러시 - EzClean Dustbin & Brush - Hygienic Soluction: HEPA Filter적용	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '17.8월 □ 명칭 : 파워스틱

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권관련

당사는 R&D활동의 지적 재산화에도 집중하여 2016년 14조 8천억원의 R&D 투자를 통해 국내특허 5,629건 출원, 해외특허 15,193건을 출원하였으며, 미국에서 5,683건의 특허를 취득하였습니다. 2017년 3분기에는 R&D 투자 12조 2천억원을 통해 미국에서 4,824건의 특허를 취득하였습니다.

< 국가별 등록 건수(2017년 3분기말 기준, 누적)> (단위 : 件)

국가	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가
건수	28,742	48,670	21,696	11,771	7,421	10,057

당사는 1984년 최초로 미국 특허를 등록시킨 이래 현재 세계적으로 총 128,357건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 누적 건수 기준으로 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

< 연도별 특허등록 건수> (단위 : 件)

특허등록	'17.3Q	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년	'11년	'10년
한국	2,154	3,462	3,002	3,985	2,775	2,024	1,616	1,620
미국	4,824	5,683	5,220	5,085	4,802	5,194	4,991	4,653

이들은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사 기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 新기술 관련 선행 특허 확보를 통해 향후 신규사업 진출 시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 구글 ('14년 1월 체결, 영구), 노키아('16. 7월), WD사('16.12월, 2024년까지 공유) 등과의 특허 크로스 라이센스 체결을 통해, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 특허뿐 아니라 스마트폰, LED TV 등에 적용된 당사 고유의 디자인을 보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여 2017년 3분기에는 미국에서 848건의 디자인 특허를 취득하였습니다.

나. 환경관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다.
(녹색기술 인증관련 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 10. 녹색경영 부분을 참고하십시오.)

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 "협력회사 에코파트너 인증" 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원사용 절감, 에너지 절약, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 "에코디자인 평가" 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생되는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 "폐제품 회수・재활용 시스템"을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기전자 제품 관련 국내외 환경법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수・재활용법 (例, EU WEEE Directive)
2. 유해물질사용 제한 (例, EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (例, EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지 시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동규제법, 환경영향평가법 등
2. 온실가스 배출 관리 : 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 저탄소 녹색성장 기본법 등
3. 기타 사업장환경관리법 : 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률, 악취방지법, 토양환경보전법 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 '저탄소 녹색성장기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2016년	2015년	2014년
온실가스(단위 : tCO2e)	6,885,300	6,729,419	6,775,019
에너지(단위 : TJ)	107,740	111,166	101,386

※ 대상 : 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등
※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
※ 삼성디스플레이 분사(2012년)로 인해 DP사업이 제외된 기준입니다.

당사는 2015년부터 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 따라 온실가스 배출권 거래제 적용 대상업체에 해당합니다.

(녹색기술 인증관련 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 10. 녹색경영 부분을 참고하십시오.)

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제49기	제48기	제47기
	2017년 9월말	2016년 12월말	2015년 12월말
[유동자산]	145,322,337	141,429,704	124,814,725
· 현금및현금성자산	30,788,226	32,111,442	22,636,744
· 단기금융상품	41,280,668	52,432,411	44,228,800
· 단기매도가능금융자산	3,964,250	3,638,460	4,627,530
· 매출채권	30,351,245	24,279,211	25,168,026
· 재고자산	27,032,501	18,353,503	18,811,794
· 기타	11,905,447	10,614,677	9,341,831
[비유동자산]	151,256,242	120,744,620	117,364,796
· 장기매도가능금융자산	8,066,146	6,804,276	8,332,480
· 관계기업 및 공동기업 투자	5,914,258	5,837,884	5,276,348
· 유형자산	109,006,091	91,473,041	86,477,110
· 무형자산	15,376,169	5,344,020	5,396,311
· 기타	12,893,578	11,285,399	11,882,547
자산총계	296,578,579	262,174,324	242,179,521
[유동부채]	66,172,585	54,704,095	50,502,909
[비유동부채]	19,714,743	14,507,196	12,616,807
부채총계	85,887,328	69,211,291	63,119,716
[지배기업 소유주지분]	203,504,410	186,424,328	172,876,767
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	206,773,005	193,086,317	185,132,014
· 기타	△8,570,002	△11,963,396	△17,556,654
[비지배지분]	7,186,841	6,538,705	6,183,038
자본총계	210,691,251	192,963,033	179,059,805
	2017년 1월~9월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월
매출액	173,596,964	201,866,745	200,653,482
영업이익	38,498,067	29,240,672	26,413,442
연결총당기순이익	29,931,616	22,726,092	19,060,144

구 분	제49기	제48기	제47기
지배기업 소유주지분	29,328,245	22,415,655	18,694,628
비지배지분	603,371	310,437	365,516
기본주당순이익(단위 : 원)	211,936	157,967	126,305
희석주당순이익(단위 : 원)	211,936	157,967	126,303
연결에 포함된 회사수	279개	170개	160개

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [Δ 는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제47기~제48기 연결감사보고서 및 제49기 3분기 연결검토보고서 주석사항을 참조하십시오.

나.요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제49기	제48기	제47기
	2017년 9월말	2016년 12월말	2015년 12월말
[유동자산]	65,782,329	69,981,128	67,002,055
・현금및현금성자산	2,955,954	3,778,371	3,062,960
・단기금융상품	20,110,259	30,170,656	27,763,589
・단기매도가능금융자산	-	-	3,021,210
・매출채권	30,265,906	23,514,012	20,251,464
・재고자산	6,600,153	5,981,634	6,578,112
・기타	5,850,057	6,536,455	6,324,720
[비유동자산]	123,027,161	104,821,831	101,967,575
・장기매도가능금융자산	1,070,598	913,989	3,205,283
・종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	55,688,643	48,743,079	44,107,398
・유형자산	58,493,282	47,228,830	45,148,629
・무형자산	2,688,016	2,891,844	3,407,229
・기타	5,086,622	5,044,089	6,099,036
자산총계	188,809,490	174,802,959	168,969,630
[유동부채]	42,071,538	34,076,122	29,630,488
[비유동부채]	2,454,577	3,180,075	2,910,887
부채총계	44,526,115	37,256,197	32,541,375
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	143,900,883	140,747,574	143,629,177
[기타]	△4,918,915	△8,502,219	△12,502,329
자본총계	144,283,375	137,546,762	136,428,255
종속・관계・공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2017년 1월~9월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월
매출액	119,783,624	133,947,204	135,205,045
영업이익	23,597,608	13,647,436	13,398,215
당기순이익	18,794,866	11,579,749	12,238,469
기본주당순이익(단위 : 원)	135,812	81,602	82,682
희석주당순이익(단위 : 원)	135,812	81,602	82,680

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도 기준) [Δ 는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제47기~제48기 감사보고서 및 제49기 3분기 검토보고서 주석사항을 참조하십시오.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 48 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기말	제 48 기말
자산		
유동자산	145,322,337	141,429,704
현금및현금성자산	30,788,226	32,111,442
단기금융상품	41,280,668	52,432,411
단기매도가능금융자산	3,964,250	3,638,460
매출채권	30,351,245	24,279,211
미수금	3,551,281	3,521,197
선급금	1,960,054	1,439,938
선급비용	4,155,405	3,502,083
재고자산	27,032,501	18,353,503
기타유동자산	1,318,309	1,315,653
매각예정분류자산	920,398	835,806
비유동자산	151,256,242	120,744,620
장기매도가능금융자산	8,066,146	6,804,276
관계기업 및 공동기업 투자	5,914,258	5,837,884
유형자산	109,006,091	91,473,041
무형자산	15,376,169	5,344,020
장기선급비용	3,381,655	3,834,831
순확정급여자산	120,688	557,091
이연법인세자산	5,026,790	5,321,450
기타비유동자산	4,364,445	1,572,027
자산총계	296,578,579	262,174,324
부채		
유동부채	66,172,585	54,704,095
매입채무	11,367,405	6,485,039
단기차입금	15,329,338	12,746,789
미지급금	13,755,728	11,525,910
선수금	1,360,407	1,358,878
예수금	680,210	685,028
미지급비용	9,983,738	12,527,300

	제 49 기 3분기말	제 48 기말
미지급법인세	5,446,061	2,837,353
유동성장기부채	17,659	1,232,817
충당부채	7,386,454	4,597,417
기타유동부채	401,522	351,176
매각예정분류부채	444,063	356,388
비유동부채	19,714,743	14,507,196
사채	1,015,061	58,542
장기차입금	2,199,998	1,244,238
장기미지급금	1,999,578	3,317,054
순확정급여부채	594,158	173,656
이연법인세부채	10,353,456	7,293,514
장기충당부채	635,329	358,126
기타비유동부채	2,917,163	2,062,066
부채총계	85,887,328	69,211,291
자본		
지배기업 소유주지분	203,504,410	186,424,328
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	206,773,005	193,086,317
기타자본항목	(8,525,520)	(11,934,586)
매각예정분류기타자본항목	(44,482)	(28,810)
비지배지분	7,186,841	6,538,705
자본총계	210,691,251	192,963,033
자본과부채총계	296,578,579	262,174,324

연결 손익계산서

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기		제 48 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	62,048,901	173,596,964	47,815,633	148,535,005
매출원가	33,004,119	93,559,545	29,411,256	89,394,232
매출총이익	29,044,782	80,037,419	18,404,377	59,140,773
판매비와관리비	14,511,623	41,539,352	13,204,288	39,120,922
영업이익(손실)	14,533,159	38,498,067	5,200,089	20,019,851
기타수익	375,774	1,036,412	1,083,572	2,061,889
기타비용	278,122	778,761	545,721	1,399,810
지분법이익	80,423	122,114	4,975	18,398
금융수익	2,610,849	6,435,175	2,303,768	7,369,760
금융비용	2,407,343	5,821,426	2,075,981	6,904,942
법인세비용차감전순이익(손실)	14,914,740	39,491,581	5,970,702	21,165,146
법인세비용	3,721,329	9,559,965	1,432,847	5,527,095
계속영업이익(손실)	11,193,411	29,931,616	4,537,855	15,638,051
당기순이익(손실)	11,193,411	29,931,616	4,537,855	15,638,051
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,039,771	29,328,245	4,408,790	15,498,474
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	153,640	603,371	129,065	139,577
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위:원)	80,349	211,936	31,303	108,728
희석주당이익(손실) (단위:원)	80,349	211,936	31,303	108,728

연결 포괄손익계산서

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기		제 48 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	11,193,411	29,931,616	4,537,855	15,638,051
기타포괄손익	1,868,097	(95,516)	(4,340,477)	(4,383,548)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(21,063)	(79,222)	(1,528)	(49,940)
순확정급여부채 재측정요소	(20,587)	(77,438)	(38,987)	(86,032)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(476)	(1,784)	37,459	36,092
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,889,160	(16,294)	(4,338,949)	(4,333,608)
매도가능금융자산평가손익	279,139	784,445	(456,032)	(426,117)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	9,364	23,594	(37,909)	(172,758)
해외사업장환산외환차이	1,604,341	(775,954)	(3,845,008)	(3,734,733)
파생상품평가손익	(3,684)	(48,379)		
총포괄손익	13,061,508	29,836,100	197,378	11,254,503
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	12,918,043	29,184,789	132,268	11,158,654
비지배지분	143,465	651,311	65,110	95,849

연결 자본변동표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

		자본							
		지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
		자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류 기타자본항목	지배기업 소유주 지분 합계		
2016.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	185,132,014	(17,580,451)	23,797	172,876,767	6,183,038	179,059,805
자본의 변동	포괄손익								
	당기순이익			15,498,474			15,498,474	139,577	15,638,051
	매도가능금융자산평가				(459,570)	(23,797)	(483,367)	57,250	(426,117)
	관계기업 및 공동기업의 기타 포괄손익에 대한 지분				(136,489)		(136,489)	(177)	(136,666)
	해외사업장환산외환차이				(3,633,935)		(3,633,935)	(100,798)	(3,734,733)
	순확정급여부채 재측정요소				(86,029)		(86,029)	(3)	(86,032)
	파생상품평가								
	매각예정 분류				19,094	(19,094)			
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래								
	배당			(3,061,360)			(3,061,360)	(23,326)	(3,084,686)
	연결실체내 자본거래 등				(37)		(37)	11,522	11,485
	연결실체의 변동							(444)	(444)
	자기주식의 취득				(7,707,938)		(7,707,938)		(7,707,938)
	자기주식의 처분								
	자기주식의 소각			(11,399,991)	11,399,991				
	주식선택권								
	기타				3,573		3,573	81	3,654
2016.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	186,169,137	(18,181,791)	(19,094)	173,269,659	6,266,720	179,536,379
2017.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	193,086,317	(11,934,586)	(28,810)	186,424,328	6,538,705	192,963,033
자본의 변동	포괄손익								
	당기순이익			29,328,245			29,328,245	603,371	29,931,616
	매도가능금융자산평가				740,601		740,601	43,844	784,445
	관계기업 및 공동기업의 기타 포괄손익에 대한 지분				22,809		22,809	(999)	21,810
	해외사업장환산외환차이				(781,072)		(781,072)	5,118	(775,954)
	순확정급여부채 재측정요소				(77,415)		(77,415)	(23)	(77,438)
	파생상품평가				(48,379)		(48,379)		(48,379)
	매각예정 분류				15,672	(15,672)			
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래								
	배당			(5,788,072)			(5,788,072)	(19,867)	(5,807,939)
	연결실체내 자본거래 등				(630)		(630)	16,842	16,212
	연결실체의 변동							267	267
	자기주식의 취득				(6,317,621)		(6,317,621)		(6,317,621)
	자기주식의 처분								
	자기주식의 소각			(9,853,485)	9,853,485				
	주식선택권								
	기타				1,616		1,616	(417)	1,199
2017.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	206,773,005	(8,525,520)	(44,482)	203,504,410	7,186,841	210,691,251

연결 현금흐름표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기	제 48 기 3분기
영업활동 현금흐름	40,470,495	36,399,732
영업에서 창출된 현금흐름	44,949,562	40,564,770
당기순이익	29,931,616	15,638,051
조정	26,755,486	23,357,626
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(11,737,540)	1,569,093
이자의 수취	1,314,082	1,108,228
이자의 지급	(421,908)	(333,030)
배당금 수입	145,706	225,880
법인세 납부액	(5,516,947)	(5,166,116)
투자활동 현금흐름	(31,057,350)	(22,357,866)
단기금융상품의 순감소(증가)	11,124,497	(10,225,788)
단기매도가능금융자산의 처분		3,010,003
매도가능금융자산의 취득	(144,767)	(2,345,122)
장기금융상품의 처분	49,326	789,860
장기금융상품의 취득	(780,287)	(941,503)
장기매도가능금융자산의 처분	177,804	1,642,930
장기매도가능금융자산의 취득	(218,976)	(636,970)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	356,608	1,537,457
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(19,510)	(70,998)
유형자산의 처분	137,230	160,876
유형자산의 취득	(32,355,245)	(14,143,682)
무형자산의 처분	945	537
무형자산의 취득	(595,846)	(811,181)
사업결합으로 인한 현금유출액	(8,673,260)	(372,872)
기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	(115,869)	48,587
재무활동 현금흐름	(10,444,988)	(10,260,428)
단기차입금의 순증가(감소)	1,823,920	(41,969)
자기주식의 취득	(6,317,621)	(7,707,938)
사채 및 장기차입금의 차입	976,842	603,177
사채 및 장기차입금의 상환	(1,139,177)	(51,949)
배당금 지급	(5,806,602)	(3,074,182)

	제 49 기 3분기	제 48 기 3분기
비지배지분의 증감	17,650	12,433
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,031,843)	3,781,438
외화환산으로 인한 현금의 변동	(291,373)	(1,150,613)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,323,216)	2,630,825
기초 현금및현금성자산	32,111,442	22,636,744
기말 현금및현금성자산	30,788,226	25,267,569

3. 연결재무제표 주석

제 49 기 분기 : 2017년 9월 30일 현재
제 48 기 : 2016년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항 :

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문과 Harman부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, Foundry, System LSI 등의 반도체 사업과 LCD 및 OLED 패널 등의 디스플레이(DP) 사업으로 구성되어 있습니다. Harman부문은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이 및 Samsung Electronics America 등 278개의 종속기업(주석 1. 나 참조)을 연결대상으로 하고, 삼성전기 등 40개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
국내	삼성디스플레이	디스플레이 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스	디스플레이 부품 생산	50.0
	스테코	반도체 부품생산	70.0
	세메스	반도체/FPD제조장비 생산	91.5
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자판매	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨	의료기기	68.5
	SVIC 20호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 23호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	미래로시스템	반도체 공정불량 및 품질관리 소프트웨어 개발 및 공급	81.0
	에스프린팅솔루션	프린팅솔루션 사업	100.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.0
	레드벤드소프트웨어코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Electronics America(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	Kngine	소프트웨어 개발	100.0
	NeuroLogica	의료기기	100.0
	Samsung Semiconductor(SSI)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Research America(SRA)	R&D	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 판매	99.9
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM)	전자제품 생산	99.9
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	RT SV CO-INVEST(RT-SV)	벤처기업 투자	99.9
	Samsung HVAC(구 Quietside)	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings	스마트홈기기 판매	100.0
	PrinterOn	프린팅솔루션 판매	100.0
	PrinterOn America	프린팅솔루션 판매	100.0
	Simpress	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Pay	모바일 결제 개발 및 서비스	100.0
	Prismview	LED 디스플레이 생산 및 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund (Beijing Fund)	벤처기업 투자	61.4
	Stellus Technologies	반도체 시스템 생산 및 판매	100.0
	Samsung Oak Holdings(SHI)	Holding Company	100.0
	AdGear Technologies	디지털광고 플랫폼	100.0
	Joyent	클라우드 서비스	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Next	Holding Company	100.0
	Samsung Next Fund	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Dacor Holdings	Holding Company	100.0
	Dacor	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada	가전제품 판매	100.0
	EverythingDacor.com	가전제품 판매	100.0
	Distinctive Appliances of California	가전제품 판매	100.0
	Viv Labs	인공지능관련 신기술 연구	100.0
	NewNet Communication Technologies (Canada)	RCS (Rich Communication Service)	100.0
	AMX Holding Corporation	Holding Company	100.0
	AMX LLC	Holding Company	100.0
	Harman Becker Automotive Systems	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services Engineering	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Holding	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services South America	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico S. de R.L.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	Holding Company	100.0
	Harman International Mexico S de RL de CV	오디오제품 판매	100.0
	Harman Investment Group, LLC	Financing Company	100.0
	Harman KG Holding, LLC	Holding Company	100.0
	Harman Professional	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software	소프트웨어 디자인	100.0
	S1NN USA	R&D	100.0
	Southern Vision Systems	영상 감지 장치 개발	100.0
	Triple Play Integration	Connected Service Provider	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America(SEHA)	가전제품 생산	100.0
	China Materialia	벤처기업 투자	98.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia(SDSK)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics(London) Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Denmark Research Center(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung France Research Center(SFRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre(SCSC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH(SESG)	전자제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	PrinterOn Europe	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Electronics Caucasus(SECC)	마케팅	100.0
	Joyent(UK)	클라우드 서비스	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
	Aditi Technologies Europe	오디오제품 판매 등	100.0
	AKG Acoustics	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX (Germany)	오디오제품 판매	100.0
	AMX UK	오디오제품 판매	100.0
	Duran Audio B.V.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Duran Audio Iberia Espana	오디오제품 판매	100.0
	Endeleo	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive UK	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems (Germany)	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Finland OY	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services (Germany)	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Division Nordic A/S	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Finland OY	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	Holding Company	100.0
	Harman Finance International SCA	Financing Company	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	Holding Company	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	Harman International Industries (UK)	오디오제품 판매 등	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman International SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Management	Holding Company	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Inspiration Matters	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Knight Image	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Martin Manufacturing (UK)	오디오제품 생산	100.0
	Harman Professional Denmark ApS(구 Martin Professional ApS)	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Professional France SAS(구 Martin Professional France)	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Germany GmbH(구 Martin Professional GmbH)	오디오제품 판매	100.0
	R&D International	오디오제품 생산	100.0
	Red Bend Software (UK)	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS France	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Innoetics E.P.E.	소프트웨어 개발	100.0
	ARCAM	Holding Company	100.0
	A&R Cambridge	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production(SSAP)	TV/모니터 생산	100.0
	Broadsense	서비스	100.0
	Global Symphony Technology Group	Holding Company	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius	Holding Company	100.0
	iOnRoad	R&D	100.0
	iOnRoad Technologies	R&D	100.0
	Red Bend	오디오제품 생산	100.0
	TowerSec (Israel)	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore(SRI-B)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Bangladesh(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	통신제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics New Zealand(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam(SDV)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Laos Samsung Electronics Sole(LSE)	마케팅	100.0
	AMX Products and Solutions Private	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services India	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Technologies	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY	Holding Company	100.0
	Harman International Singapore	오디오제품 판매	100.0
	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Singapore Pte.	오디오제품 판매	100.0
	INSP India Software Development Pvt.	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	Martin Professional Pte.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아 (중국제외)	Harman Connected Services Japan	Connected Service Provider	100.0
	Harman International Japan	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software KK	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Japan	Holding Company	100.0
중국	Samsung Display Dongguan(SDD)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin(SDT)	디스플레이 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(STMC)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP)	프린터 생산	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.9
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	TV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(SESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module(SSM)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	디스플레이 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication (SSET)	통신제품 생산	95.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중국	Tianjin Samsung LED(TSLED)	LED 생산	100.0
	Tianjin Samsung Opto-Electronics(TSOE)	카메라/캠코더 생산	90.0
	SEMES (Xian)	반도체 장비	100.0
	Samsung Semiconductor Xian(SSCX)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Harman (China) Technologies	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai)	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Taiwan	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive Infotech (Dalian)(구 Harman Neusoft Automotive Infotech (Dalian))	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	Harman Technology (Shenzhen)	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Martin Trading Zhuhai	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services (Beijing) Solutions	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services (Chengdu) Solutions	Connected Service Provider	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기와 전기의 주요 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

기업명	당분기말		당분기			
	자산	부채	3 개 월		누 적	
			매출액	분기순이익(손실)	매출액	분기순이익(손실)
삼성디스플레이	48,491,241	10,639,042	7,261,121	622,567	20,173,103	2,642,465
Samsung Electronics America(SEA)	28,335,974	9,433,879	8,357,290	(5,218)	23,995,468	307,293
Harman과 그 종속기업(*)	15,743,072	6,112,067	2,086,611	(26,705)	4,778,802	(174)
Samsung (China) Investment(SCIC)	13,674,542	11,526,785	1,522,101	142,112	4,203,425	195,899
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	10,961,648	2,117,548	5,427,215	768,347	14,594,861	1,790,742
Samsung Semiconductor(SSI)	10,937,584	5,883,685	8,316,809	19,349	20,521,935	56,290
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	10,868,100	2,940,745	7,316,692	791,186	21,824,215	2,713,677
Samsung Display Vietnam(SDV)	9,997,910	9,554,939	4,598,457	210,221	10,236,161	689,613
Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	9,599,854	7,249,939	-	2,588	-	16,467
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	9,348,540	3,082,782	1,243,016	423,033	3,320,052	934,502
Samsung India Electronics(SIEL)	7,144,593	4,236,641	2,778,124	233,650	8,529,829	636,008
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	7,134,527	1,620,797	3,946,570	182,654	10,427,697	459,891
Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	6,118,821	1,545,272	1,819,544	411,072	5,236,894	990,575
Samsung Asia Private(SAPL)	6,020,159	789,289	499,369	20,541	1,436,450	520,938
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	5,330,791	4,345,432	5,675,015	55,166	17,590,283	162,922
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	5,267,396	569,447	912,648	35,607	2,590,710	89,810
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	2,607,463	2,257,790	3,786,317	23,091	10,210,444	214,972
Samsung Suzhou LCD(SSL)	2,344,044	1,130,780	452,401	19,963	1,333,251	92,601
Samsung Electronics Slovakia(SESK)	2,341,718	524,224	759,034	30,294	2,352,969	91,901
Thai Samsung Electronics(TSE)	2,333,174	491,010	1,201,853	68,720	3,524,268	100,761
Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	1,992,603	1,568,221	1,109,529	87,383	2,883,624	193,372
Samsung International(SII)	1,937,998	1,264,802	1,680,475	87,318	4,375,226	164,019
Samsung Electronics GmbH(SEG)	1,852,036	1,862,379	1,561,719	(35,216)	4,726,018	(14,685)
Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,844,425	1,498,270	1,141,487	31,121	3,341,831	26,512
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	1,703,566	1,105,337	1,253,634	20,605	3,502,058	147,813

(*) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위: 백만원)

기업명	전기말		전분기			
	자산	부채	3 개 월		누 적	
			매출액	분기순이익(손실)	매출액	분기순이익(손실)
삼성디스플레이	43,305,405	8,361,256	6,414,151	673,820	17,835,088	674,392
Samsung Electronics America(SEA)	21,810,492	9,496,649	7,766,088	(136,460)	25,436,935	(109,068)
Samsung (China) Investment(SCIC)	13,632,938	11,672,755	2,054,118	(70,040)	7,355,547	18,498
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	9,749,448	4,564,793	1,142,365	443,747	3,246,258	1,088,226
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	9,134,023	1,258,948	3,860,960	(146,487)	14,523,801	1,239,415
Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	8,643,308	6,661,092	-	324,671	-	346,862
Samsung Semiconductor(SSI)	7,804,698	3,746,687	5,314,807	6,255	14,336,301	17,423
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	7,646,828	2,179,023	6,106,956	679,282	17,111,850	2,078,399
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	6,174,579	1,106,633	2,166,777	(363,541)	9,200,702	104,392
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	5,862,409	5,166,385	5,201,842	52,086	14,140,965	127,506
Samsung Asia Private(SAPL)	5,528,472	592,320	341,848	(5,213)	1,094,505	505,107
Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	5,200,799	1,510,972	1,510,287	301,265	4,389,671	653,723
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	4,940,748	1,293,458	729,271	23,050	2,816,143	83,752
Samsung India Electronics(SIEL)	4,563,407	2,256,194	2,160,168	228,108	6,626,652	677,503
Samsung Display Vietnam(SDV)	3,165,239	3,437,791	1,525,101	(22,053)	3,749,833	(55,615)
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	2,887,230	2,779,296	2,831,375	(7,039)	9,464,001	534,611
Samsung Suzhou LCD(SSL)	2,499,917	1,376,439	463,937	18,399	1,004,650	(68,178)
Thai Samsung Electronics(TSE)	2,079,865	364,518	969,584	31,281	3,164,274	140,161
Samsung Electronics Slovakia(SESK)	2,053,467	440,402	756,621	15,104	2,412,604	71,238
Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,857,017	1,540,478	897,876	2,356	2,546,328	636
Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	1,814,566	1,572,982	715,814	101,870	1,314,590	140,657
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,743,979	633,975	511,257	13,334	1,704,176	90,631
Samsung Electronics GmbH(SEG)	1,621,827	1,618,305	1,419,834	47,173	4,680,212	64,620
Samsung Display Dongguan(SDD)	1,584,504	518,511	1,285,994	62,370	3,847,981	140,526
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	1,526,879	1,103,579	1,019,851	17,343	3,446,116	95,101

라. 연결대상범위의 변동

(1) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	사유
미주	Samsung Receivables(SRC)	청산
미주	TowerSec	합병(*1)
유럽/CIS	Samsung Electronics Rus(SER)	합병(*2)
유럽/CIS	Samsung Electronics Ukraine(SEU)	청산
유럽/CIS	AMX LLC (Russia)	청산
유럽/CIS	Surfkitchen	청산
유럽/CIS	Martin Professional	청산
아시아	I.P.S.G. International Product Solution Group PTY.	청산
아시아	VFX Systems PTY	청산

(*1) 연결회사의 종속기업 Harman International Industries, Inc.은 2017년 5월 종속기업 TowerSec을 흡수합병하였습니다.

(*2) 연결회사의 종속기업 Samsung R&D Institute Rus(SRR)는 2017년 1월 종속기업 Samsung Electronics Rus(SER)를 흡수합병하였습니다.

(2) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에 포함되는 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	사유
국내	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	출자
	하만인터내셔널코리아	인수
	레드벤드소프트웨어코리아	인수
미주	Kngine	인수
	AMX Holding Corporation	인수
	AMX LLC	인수
	Harman Becker Automotive Systems	인수
	Harman Connected Services Engineering	인수
	Harman Connected Services Holding	인수
	Harman Connected Services	인수
	Harman Connected Services South America	인수
	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes	인수
	Harman de Mexico S. de R.L.	인수
	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes.	인수
	Harman Financial Group	인수
	Harman International Industries Canada	인수
	Harman International Industries, Inc.	인수
	Harman International Mexico S de RL de CV	인수
	Harman Investment Group, LLC	인수
	Harman KG Holding, LLC	인수
	Harman Professional	인수
	Red Bend Software	인수
	S1NN USA	인수
	Southern Vision Systems	인수
	TowerSec	인수
	Triple Play Integration	인수
	Samsung Electronics Home Appliances America(SEHA)	설립
	China Materialia	설립

지역	기업명	사유
유럽/CIS	AMX LLC (Russia)	인수
	Harman Connected Services OOO	인수
	Harman RUS CIS LLC	인수
	Aditi Technologies Europe	인수
	AKG Acoustics	인수
	AMX (Germany)	인수
	AMX UK	인수
	Duran Audio B.V.	인수
	Duran Audio Iberia Espana	인수
	Endeleo	인수
	Harman Automotive UK	인수
	Harman Becker Automotive Systems (Germany)	인수
	Harman Becker Automotive Systems Italy	인수
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	인수
	Harman Belgium	인수
	Harman Connected Services AB.	인수
	Harman Connected Services Finland OY	인수
	Harman Connected Services (Germany)	인수
	Harman Connected Services	인수
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	인수
	Harman Connected Services UK	인수
	Harman Consumer Division Nordic A/S	인수
	Harman Consumer Finland OY	인수
	Harman Consumer Nederland B.V.	인수
	Harman Deutschland	인수
	Harman Finance International GP S.a.r.l	인수
	Harman Finance International SCA	인수
	Harman France SNC	인수
	Harman Holding & Co. KG	인수

지역	기업명	사유
유럽/CIS	Harman Hungary Financing	인수
	Harman Inc. & Co. KG	인수
	Harman International Estonia OU	인수
	Harman International Industries (UK)	인수
	Harman International Romania SRL	인수
	Harman International s.r.o	인수
	Harman International SNC	인수
	Harman Management	인수
	Harman Professional Kft	인수
	Inspiration Matters	인수
	Knight Image	인수
	Martin Manufacturing (UK)	인수
	Harman Professional Denmark ApS(구 Martin Professional ApS)	인수
	Harman Professional France SAS(구 Martin Professional France)	인수
	Harman Professional Germany GmbH(구 Martin Professional GmbH)	인수
	Martin Professional	인수
	R&D International	인수
	Red Bend Software (UK)	인수
	Red Bend Software SAS France	인수
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	설립
	Studer Professional Audio	인수
	Surfkitchen	인수
	Innoetics E.P.E.	인수
	ARCAM	인수
	A&R Cambridge	인수

지역	기업명	사유
중동 및 아프리카	Broadsense	인수
	Global Symphony Technology Group	인수
	Harman Connected Services Morocco	인수
	Harman Industries Holdings Mauritius	인수
	iOnRoad	인수
	iOnRoad Technologies	인수
	Red Bend	인수
	TowerSec (Israel)	인수
아시아 (중국제외)	AMX Products and Solutions Private	인수
	Harman Connected Services India	인수
	Harman Connected Services Technologies	인수
	Harman International (India) Private	인수
	Harman International Industries PTY	인수
	Harman International Singapore	인수
	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	인수
	Harman Professional Singapore Pte.	인수
	I.P.S.G. International Product Solution Group PTY.	인수
	INSP India Software Development Pvt.	인수
	Martin Professional Pte.	인수
	VFX Systems PTY	인수
	Harman Connected Services Japan	인수
	Harman International Japan	인수
	Red Bend Software KK	인수
	Studer Japan	인수

지역	기업명	사유
중국	Harman (China) Technologies	인수
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems	인수
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)	인수
	Harman Commercial (Shanghai)	인수
	Harman Connected Services Taiwan	인수
	Harman Holding	인수
	Harman International (China) Holdings	인수
	Harman Automotive Infotech (Dalian)(구 Harman Neusoft Automotive Infotech (Dalian))	인수
	Harman Technology (Shenzhen)	인수
	Martin Trading Zhuhai	인수
	Harman Connected Services (Beijing) Solutions	인수
	Harman Connected Services (Chengdu) Solutions	인수

2. 중요한 회계처리방침 :

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2017년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2017년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제・개정 기준서

연결회사는 2017년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 개정
재무활동에서 생기는 부채 변동을 현금흐름에서 생기는 변동과 비현금거래로 인한 변동 등으로 구분하여 공시하도록 하였습니다. 기업회계기준서 제1007호의 개정에 따른 공시내용은 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 적용될 예정입니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결회사가 조기 적용하지 아니한 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급・선수취 대가' 제정
제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 부채, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 또한, 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정합니다. 동 해석서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 해석서의 제정으로 인해 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정
2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체할 예정입니다. 연결회사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류, 측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.

기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다.

기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 연결회사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다.

연결회사는 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2017년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2017년 재무제표에 미치는 잠재적인 영향을 예비 평가하였으며, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 것으로 예상되는 영향은 다음과 같습니다. 연결회사는 향후 추가적인 정보에 기초하여 보다 구체적인 재무영향을 분석할 예정이고, 예비영향평가 결과는 향후 연결회사가 이용할 수 있는 추가 정보 등에 따라 변경될 수 있습니다.

① 금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 연결회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

계약상 현금흐름 특성/사업모형	원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우
계약상 현금흐름 수취 목적	상각후원가 측정 (*1)	당기손익-공정가치 측정 (*2)
계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적	기타포괄손익-공정가치 측정 (*1)	
매도 목적, 기타	당기손익-공정가치 측정	

(*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)
(*2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

기업회계기준서 제1109호에서 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치 측정 대상으로 분류하기 위한 요건이 현행 기업회계기준서 제1039호의 요건보다 엄격하므로, 기업회계기준서 제1109호 도입 시 당기손익-공정가치 측정 대상 금융자산의 비중이 증가하여 당기손익의 변동성이 확대될 수 있습니다.

연결회사는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 108,550,509백만원, 매도가능금융자산 12,030,396백만원을 보유하고 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하는 채무상품만 상각후원가로 측정할 수 있습니다. 연결회사는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 108,550,509백만원을 상각후원가로 측정하고 있습니다.

예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 2017년 9월 30일 현재 위 금융자산에 적용할 경우, 대부분 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하므로 상각후원가로 측정되는 항목으로 분류되어 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단합니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취 및 매도를 목적으로 하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 연결회사는 2017년 9월 30일 현재 매도가능금융자산으로 분류된 채무상품 4,069,625백만원을 보유하고 있습니다.

예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 2017년 9월 30일 현재 위 매도가능금융자산으로 분류된 채무상품에 적용할 경우, 대부분이 상각후원가로 측정되는 금융자산으로 분류될 것으로 예상합니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품은 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있고, 동 포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환(recycling)되지 않습니다. 연결회사의 2017년 9월 30일 현재 매도가능금융자산으로 분류된 지분상품은 7,960,771백만원이고, 당분기 중 매도가능지분상품 관련 미실현평가손익 5,965백만원이 당기손익으로 재순환되었습니다.

예비영향평가 결과에 따르면 연결회사는 매도가능지분상품 중 대부분을 차지하는 장기 투자 목적의 지분상품을 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 계획을 갖고 있어, 기업회계기준서 제1109호를 적용하더라도 해당 금융자산이 재무제표에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단합니다. 다만 2017년 9월 30일 기준 해당 지분상품과 관련된 후속적으로 당기손익으로 재순환 되지 않을 기타포괄손익-공정가치의 잔액은 2,121,562백만원입니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따른 현금흐름이 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성되지 않거나 매매가 주된 목적인 채무상품과 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하지 않은 지분상품은 당기손익-공정가치로 측정합니다. 2017년 9월 30일 현재 당기손익인식금융자산으로 분류된 채무상품과 지분상품은 없습니다.

② 금융부채의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호에 따르면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.

현행 기업회계기준서 제1039호에서 모두 당기손익으로 인식했던 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 일부가 기타포괄손익으로 표시되므로 금융부채의 평가 관련 당기손익이 감소할 수 있습니다.

연결회사는 2017년 9월 30일 현재 금융부채 53,498,469백만원 중 432,720백만원을 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정하였습니다.

예비영향평가 결과에 따르면 2017년 9월 30일 현재 당기손익인식 금융부채는 대부분 만기가 짧고 금융부채의 신용위험 변동이 미미하여, 기업회계기준서 제1109호를 적용하더라도 해당 금융부채가 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단합니다.

③ 손상: 금융자산과 계약자산

현행 기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하지만, 새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있어 현행 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형에 비하여 신용손실을 조기에 인식할 수 있습니다.

구 분 (*1)		손실충당금
Stage 1	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우 (*2)	12개월 기대신용손실: 보고기간종료일 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실
Stage 2	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우	전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실
Stage 3	신용이 손상된 경우	

(*1) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용범위에 포함되는 거래에서 생기는 매출채권이나 계약자산의 경우 유의적인 금융요소가 없다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정해야 하고, 유의적인 금융요소가 있다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음. 리스채권도 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음
(*2) 보고기간종료일 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음

기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

연결회사는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 109,234,670백만원, 매도가능금융자산으로 분류되어 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 4,069,625백만원을 보유하고 있고, 이들 자산에 대하여 손실충당금 684,161백만원을 설정하고 있습니다.

④ 위험회피회계

새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 현행 기업회계기준서 제1039호에서 정한 위험회피회계의 체계(mechanics of hedge accounting: 공정가치위험회피, 현금흐름위험회피, 해외사업장순투자위험회피)를 유지하지만, 복잡하고 규정중심적인 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 요구사항을 기업의 위험관리활동에 중점을 둔 원칙중심적인 방식으로 변경했습니다. 위험회피대상항목과 위험회피수단을 확대하였고, 높은 위험회피효과가 있는지에 대한 평가 및 계량적인 판단기준(80~125%)을 없애는 등 위험회피회계 적용요건을 완화하였습니다.

기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계를 적용할 경우, 현행 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 적용요건을 충족하지 못하는 일부 거래에 대해서도 위험회피회계를 적용할 수 있게 되어 당기손익의 변동성이 축소될 수 있습니다.

위험회피회계에 대한 경과규정에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용할 때 현행 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 관련 규정을 계속해서 적용할 것을 회계정책으로 선택할 수 있습니다.

연결회사는 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용할 때 동 기준서의 위험회피회계 요구사항을 적용할지 현행 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 관련 규정을 계속해서 적용할지 아직 결정하지 않았지만, 기업회계기준서 제1109호의 위험회피회계를 적용한다고 가정하여 예비영향평가를 하였습니다. 연결회사는 재고자산 매입거래 등의 현금흐름 변동 위험에 대한 위험회피회계를 적용하고 있으며, 대부분이 기

업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 적용요건 중 높은 위험회피효과(80~125%)의 소급적 발생 요건을 충족하고 있으므로 동 기준서 적용시 유의적인 영향이 존재하지 않을 것으로 예상합니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 제정
2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체할 예정입니다.

연결회사는 기업회계기준서 제1115호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하되, 이 기준서의 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 이익잉여금(또는 적절하다면 다른 자본요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식하고, 해당 경과규정에 따라 최초 적용일에 완료되지 않은 계약에만 이 기준서를 소급하여 적용할 예정입니다.

현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

연결회사는 기업회계기준서 제1115호 도입 준비를 위하여 2017년 9월 30일 현재 회계 부서 소속직원과 외부자문사인 회계법인으로 구성되고 필요 시 전산 등 실무 부서의 도움을 받는 TF팀을 운영하고 있습니다. 연결회사는 현재 상황 및 입수 가능한 정보를 기초로 수익 구조를 분석하여 기업회계기준서 제1115호의 도입에 따른 재무영향을 구체적으로 분석 중에 있으며, 도입 추진 계획과 진행상황을 경영진에게 주기적으로 보고하고 있습니다. 연결회사는 재무제표에 미치는 재무적 영향을 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도 재무제표 주석에 공시할 예정입니다.

연결회사는 2017년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 기업회계기준서 제1115호 적용 시 2017년 연결재무제표에 미치는 잠재적인 영향을 예비 평가하였고, 그 결과는 다음과 같습니다. 예비영향평가 결과는 향후 연결회사가 이용할 수 있는 추가 정보 등에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 수행의무의 식별

연결회사의 IM(Information technology & Mobile communications)부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있습니다. 연결회사는 네트워크 통신 시스템 등을 제작 및 설치하여 고객에게 제공하고 있으며, 2017 회계연도 중 관련 수익이 총 수익에서 차지하는 비중은 크지 않습니다. 기업회계기준서 제1115호 적용 시 고객과의 네트워크 통신 시스템 제작 등의 통합 계약에서 (1) 제품 판매, (2) 설치용역, (3) 유지보수 등과 같이 기술지원으로 각각 구별되는 수행의무를 식별합니다. 각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지에 따라 연결실체의 수익인식 시점이 변경될 수 있습니다.

연결회사는 수행의무의 분리에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면, 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 연결회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

2) 변동대가

연결회사는 제품 및 상품 판매시 반품을 허용하기 때문에 고객에게서 받은 대가가 변동될 수 있습니다.

기업회계기준서 제1115호 적용시 연결회사는 받을 권리를 갖게 될 대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 기댓값 방법을 사용하여 변동 대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 기업이 받았거나 받을 대가 중에서 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채로 계상합니다.

연결회사는 변동대가 규정에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면, 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 연결회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

3) 거래가격의 배분

연결회사는 기업회계기준서 제1115호 적용 시 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 연결회사는 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법'을 사용하며, 예외적으로 일부 거래에 대해서는 예상원가를 예측하고 적절한 이윤을 더하는 '예상원가 이윤 가산 접근법'을 사용할 예정입니다.

연결회사는 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분함에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면, 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 연결회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

4) 보증

연결회사는 고객과 제품 판매계약 체결 당시 소비자보호법에서 요구하는 법정 보증기간이 경과한 후에도 제품의 품질에 대한 보증을 제공하는데, 고객에게는 추가 보증을 별도로 구매할 수 있는 선택권이 있으므로 기업회계기준서 제1115호에 따라 그 보증은 구별되는 용역입니다.

연결회사는 고객에게 약속한 보증을 별도의 수행의무로 회계처리하고, 그 수행의무에 거래가격의 일부를 배분할 예정이나, 보증의무 구별에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 연결회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

5) 라이선싱 : 사용권

연결회사는 고객과의 계약에 따라 보유 특허권 라이선스를 제공하고 있습니다.

기업회계기준서 제1115호 적용 시 라이선스 계약은 라이선스를 부여한 시점에 존재하는 지적재산을 사용할 권리에 해당하는데, 이는 라이선스를 이전하는 시점에 고객이 라이선스의 사용을 지시할 수 있고 라이선스에서 생기는 나머지 효익의 대부분을 획득할 수 있음을 의미합니다. 연결회사는 특허권 라이선스 수익과 관련한 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 연결회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제・개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉, 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 :

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	-	30,788,226	-	-	30,788,226
단기금융상품	-	41,280,668	-	-	41,280,668
단기매도가능금융자산	-	-	3,964,250	-	3,964,250
매출채권	-	30,351,245	-	-	30,351,245
장기매도가능금융자산	-	-	8,066,146	-	8,066,146
기타	56,799	6,130,370	-	56,932	6,244,101
계	56,799	108,550,509	12,030,396	56,932	120,694,636

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	-	11,367,405	-	11,367,405
단기차입금	-	1,711,656	13,617,682	15,329,338
미지급금	335,640	11,698,655	-	12,034,295
유동성장기부채	-	17,659	-	17,659
사채	-	1,015,061	-	1,015,061
장기차입금	-	2,199,998	-	2,199,998
장기미지급금	-	1,683,082	-	1,683,082
기타	97,080	9,713,414	41,137	9,851,631
계	432,720	39,406,930	13,658,819	53,498,469

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	계
현금및현금성자산	-	32,111,442	-	32,111,442
단기금융상품	-	52,432,411	-	52,432,411
단기매도가능금융자산	-	-	3,638,460	3,638,460
매출채권	-	24,279,211	-	24,279,211
장기매도가능금융자산	-	-	6,804,276	6,804,276
기타	63,208	3,396,655	-	3,459,863
계	63,208	112,219,719	10,442,736	122,725,663

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	-	6,485,039	-	6,485,039
단기차입금	-	1,817,021	10,929,768	12,746,789
미지급금	-	10,225,271	-	10,225,271
유동성장기부채	-	1,232,817	-	1,232,817
사채	-	58,542	-	58,542
장기차입금	-	1,244,238	-	1,244,238
장기미지급금	342,702	2,666,957	-	3,009,659
기타	74,697	11,867,772	-	11,942,469
계	417,399	35,597,657	10,929,768	46,944,824

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 등을 포함하고 있습니다.

4. 장기매도가능금융자산 :

가. 보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식	3,115,711	2,362,235
지분증권 - 비상장주식	4,845,060	4,337,328
채무증권(*)	105,375	104,713
계	8,066,146	6,804,276

(*) 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액입니다.

나. 보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기 업 명	당분기말				전기말
	보유주식수(주)	지분율(%)(*1)	취득원가	장부가액 (시장가치)	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	65,930,982	16.9	473,727	738,427	609,862
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	116,675	96,527
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	6,221	6,732
에스에프에이(*2)	3,644,000	10.2	38,262	150,679	117,519
원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	26,599	23,714
원익아이피에스	3,701,872	9.0	32,428	126,234	96,989
ASML	6,297,787	1.4	363,012	1,225,504	851,395
Wacom	8,398,400	5.0	62,013	44,913	26,647
BYD	52,264,808	1.9	528,665	615,235	449,872
기타			54,792	65,224	82,978
계			1,598,001	3,115,711	2,362,235

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 당분기 중 에스에프에이는 무상증자를 실시하여, 연결회사의 보유주식수가 증가하였습니다.

취득원가는 회수가능액이 취득원가에 미달하여 인식한 매도가능금융자산 손상차손을 차감하지 아니한 금액입니다. 손상차손 금액을 제외한 취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산 평가손익)으로 계상하고 있습니다.

5. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금(*)	장부가액	평가전금액	평가충당금(*)	장부가액
제품 및 상품	9,377,377	(1,237,855)	8,139,522	7,982,850	(2,077,511)	5,905,339
반제품 및 재공품	7,289,992	(319,793)	6,970,199	5,334,607	(317,223)	5,017,384
원재료 및 저장품	11,718,995	(1,013,319)	10,705,676	7,526,608	(1,032,442)	6,494,166
미착품	1,217,104	-	1,217,104	936,614	-	936,614
계	29,603,468	(2,570,967)	27,032,501	21,780,679	(3,427,176)	18,353,503

(*) 연결회사는 생산 및 판매 중단한 재고자산을 순실현가치로 평가하고 원가와의 차이를 평가충당금으로 반영하였습니다.

6. 관계기업 및 공동기업 투자 :

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	5,837,884	5,276,348
취득	19,510	70,998
처분(*1)	(52,834)	(1,341,108)
이익 중 지분해당액	122,114	18,398
기타변동액(*2)	(12,416)	(302,963)
분기말장부가액	5,914,258	3,721,673

(*1) 연결회사는 전분기 중 삼성카드 지분 전부를 매각하였습니다.

(*2) 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장
삼성전기	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국
삼성에스디에스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합/관리업 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국
삼성바이오로직스	신사업 투자	31.5	한국
삼성SDI(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국
제일기획	광고 대행업	25.2	한국

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장
삼성코닝어드밴스드글라스	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성전기	359,237	1,019,838	1,019,968	359,237	993,031	997,022
삼성에스디에스	147,963	1,227,440	1,252,700	147,963	1,161,197	1,185,703
삼성바이오로직스	443,193	1,256,906	1,260,718	443,193	1,285,706	1,289,351
삼성SDI	1,242,605	2,223,555	1,212,583	1,242,605	2,131,718	1,232,986
제일기획	506,162	245,392	544,172	506,162	192,594	517,885
기타	590,842	215,378	385,363	642,536	182,279	390,438
계	3,290,002	6,188,509	5,675,504	3,341,696	5,946,525	5,613,385

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성코닝어드밴스드글라스	215,000	171,331	171,310	215,000	169,521	169,485
기타	259,994	68,408	67,444	259,977	59,342	55,014
계	474,994	239,739	238,754	474,977	228,863	224,499

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 지분법평가 내역

(1) 당분기

(단위: 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기	997,022	20,114	11,678	(8,846)	1,019,968
삼성에스디에스	1,185,703	85,087	(4,987)	(13,103)	1,252,700
삼성바이오로직스	1,289,351	(27,287)	(1,345)	(1)	1,260,718
삼성SDI	1,232,986	(10,559)	3,619	(13,463)	1,212,583
제일기획	517,885	26,586	8,412	(8,711)	544,172
삼성코닝어드밴스드글라스	169,485	1,826	-	(1)	171,310
기타	445,452	26,347	5,600	(24,592)	452,807
계	5,837,884	122,114	22,977	(68,717)	5,914,258

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성카드	1,338,679	-	-	(1,338,679)	-
삼성전기	994,489	7,250	1,840	(8,847)	994,732
삼성에스디에스	1,060,396	78,908	(13,968)	(8,736)	1,116,600
삼성바이오로직스	1,310,202	(49,068)	(2,762)	(253,282)	1,005,090
삼성코닝어드밴스드글라스	188,371	(14,531)	(50)	-	173,790
기타	384,211	(4,161)	(7,254)	58,665	431,461
계	5,276,348	18,398	(22,194)	(1,550,879)	3,721,673

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보

(1) 주요 관계기업의 요약 재무정보 및 관계기업으로부터의 배당금수입은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	삼성전기	삼성에스디에스	삼성바이오로직스	삼성SDI	제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(당분기말) :					
유동자산	2,774,957	5,090,374	616,779	3,715,119	1,877,536
비유동자산	5,410,587	2,162,404	6,491,520	11,885,217	294,222
유동부채	3,052,251	1,372,453	2,175,062	2,772,767	1,242,089
비유동부채	674,897	288,091	942,075	1,569,698	64,965
비지배지분	98,876	156,275	-	213,630	8,828
요약 포괄손익계산서(당분기) :					
매출	5,121,485	6,832,584	298,318	4,467,095	2,376,059
계속영업손익(*)	107,397	375,363	(86,871)	419,668	95,969
기타포괄손익(*)	49,921	(22,085)	(4,346)	63,709	28,133
총포괄손익(*)	157,318	353,278	(91,217)	483,377	124,102
Ⅱ. 배당(당분기)					
배당금수입	8,847	13,104	-	13,463	8,711

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

2) 전기

(단위: 백만원)

구 분	삼성전기	삼성에스디에스	삼성바이오로직스	삼성SDI	제일기획
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말) :					
유동자산	2,812,409	4,548,448	1,461,425	3,958,266	1,794,812
비유동자산	4,850,220	2,293,556	6,071,580	10,942,046	356,619
유동부채	2,043,155	1,347,385	2,476,545	2,212,796	1,244,899
비유동부채	1,281,889	203,495	974,089	1,723,405	130,248
비지배지분	97,467	150,429	-	241,980	13,277
요약 포괄손익계산서(전분기) :					
매출	4,687,988	5,798,312	189,072	-	-
계속영업손익(*)	49,988	347,070	(119,842)	-	-
기타포괄손익(*)	7,863	(61,861)	(6,958)	-	-
총포괄손익(*)	57,851	285,209	(126,800)	-	-
Ⅱ. 배당(전분기)					
배당금수입	8,847	8,736	-	-	-

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업의 요약 재무정보 및 공동기업으로부터의 배당금수입은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스	
	당분기	전기
Ⅰ. 요약 재무정보		
요약 재무상태표 :		
유동자산	133,252	170,614
- 현금및현금성자산	36,906	16,021
비유동자산	252,748	209,881
유동부채	42,002	41,076
- 유동금융부채(*1)	22,188	14,779
비유동부채	1,337	377
요약 포괄손익계산서(*2) :		
매출	184,735	191,776
감가상각비 및 무형자산상각비	1,032	1,726
이자수익	597	1,096
법인세비용(수익)	218	(8,581)
계속영업손익(*3)	3,619	(29,097)
기타포괄손익(*3)	-	(100)
총포괄손익(*3)	3,619	(29,197)
Ⅱ. 배당		
배당금수입	-	-

(*1) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다.

(*2) 분기 9개월 기준 금액입니다.

(*3) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익(*)	20,479	5,868	(6,276)	2,115
기타포괄손익(*)	701	4,899	(2,531)	(2,646)
총포괄손익(*)	21,180	10,767	(8,807)	(531)

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기	17,693,084	1,804,695	898,809
삼성에스디에스	17,472,110	2,944,051	2,437,359
삼성바이오로직스	20,836,832	7,032,431	3,146,362
삼성SDI	13,462,673	2,672,341	1,467,431
제일기획	29,038,075	528,493	457,350

7. 유형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	91,473,041	86,477,110
일반취득 및 자본적지출	32,874,746	14,721,270
사업결합으로 인한 취득(*1)	858,798	6,694
감가상각	(14,886,343)	(14,658,625)
처분/폐기/손상/환입	(153,969)	(299,477)
기타(*2)	(1,160,182)	(2,373,188)
분기말순장부금액	109,006,091	83,873,784

(*1) 당분기 중 연결회사의 종속기업 Samsung Electronics America가 Harman과 그 종속기업의 지분 100%를 인수함에 따른 증가액을 포함하고 있습니다(주석 27 참조).
(*2) 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	13,292,501	13,201,737
판매비와관리비 등	1,593,842	1,456,888
계	14,886,343	14,658,625

8. 무형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	5,344,020	5,396,311
내부개발에 의한 취득	307,775	569,657
개별 취득	288,070	241,523
사업결합으로 인한 취득(*1)	10,017,528	359,825
상각	(1,155,447)	(1,021,168)
처분/폐기/손상/환입	(8,547)	(423,394)
기타(*2)	582,770	(34,521)
분기말장부금액	15,376,169	5,088,233

(*1) 당분기 중 연결회사의 종속기업 Samsung Electronics America가 Harman과 그 종속기업의 지분 100%를 인수함에 따른 증가액을 포함하고 있습니다(주석 27 참조).
(*2) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	698,209	692,611
판매비와관리비 등	457,238	328,557
계	1,155,447	1,021,168

9. 차입금 :

보고기간종료일 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
(1) 단기차입금				
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.1 ~ 10.9	13,617,682	10,929,768
무담보차입금	씨티은행 외	0.1 ~ 16.9	1,711,656	1,817,021
계			15,329,338	12,746,789
(2) 유동성장기차입금				
은행차입금	-	-	-	684
금융리스부채(*2)	CSSD 외	1.1 ~ 15.7	12,100	18,599
계			12,100	19,283
(3) 장기차입금				
은행차입금	씨티은행 외	LIBOR+0.4 ~ 19.8	2,136,505	1,179,111
금융리스부채(*2)	CSSD 외	1.1 ~ 15.7	63,493	65,127
계			2,199,998	1,244,238

(*1) 담보부 차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 리스자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채 :

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.2	2027.10.1	7.7	57,335 (US$50,000천)	66,468 (US$55,000천)
US$ denominated Unsecured Bonds(*2)	2012.4.10	2017.4.10	-	-	1,208,500 (US$1,000,000천)
US$ denominated Debenture Bonds(*3)	2015.5.6	2025.5.15	4.2	458,680 (US$400,000천)	-
EURO€ denominated Debenture Bonds(*4)	2015.5.20	2022.5.27	2.0	472,805 (EUR€ 350,000천)	-
1년이내 만기도래분(유동성사채)				(5,734)	(1,214,543)
사채할인발행차금				(1,566)	(1,883)
사채할증발행차금				33,541	-
계				1,015,061	58,542

(*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*2) 종속기업 Samsung Electronics America에서 발행한 것으로 당분기 중 일시상환되었습니다.

(*3) 종속기업 Harman International Industries에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며, 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*4) 종속기업 Harman Finance International SCA에서 발행하였고, 7년 만기 일시상환되며, 이자는 1년마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산) :

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)와 관련하여 연결재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	7,799,383	7,167,929
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	280,826	110,885
소계	8,080,209	7,278,814
사외적립자산의 공정가치	(7,606,739)	(7,662,249)
순확정급여부채(자산) 계	473,470	(383,435)

나. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	663,880	809,458
순이자원가(수익)	(9,277)	8,380
기타	2,621	(1,856)
계	657,224	815,982

다. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	265,815	353,071
판매비와관리비 등	391,409	462,911
계	657,224	815,982

12. 충당부채 :

당분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여충당부채 (라)	기타충당부채 (마),(바)	계
기초	1,747,857	1,588,037	716,252	-	903,397	4,955,543
순전입액	1,545,608	730,405	418,357	3,318,749	124,078	6,137,197
사용액	(1,461,739)	(185,444)	(504,018)	(409,645)	(764,230)	(3,325,076)
기타(*)	254,261	(38,595)	1,051	39,934	(2,532)	254,119
당분기말	2,085,987	2,094,403	631,642	2,949,038	260,713	8,021,783

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액과 사업결합으로 인한 전입 및 매각예정으로 인한 재분류를 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여년도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

바. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 연결회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만톤)

2017년	수 량
무상할당 배출권	1,225
배출량 추정치	1,291

(2) 당분기 중 배출권 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금 액
기초	15,067
취득	5,626
매각	(5,934)
당분기말	14,759

(3) 당분기 중 배출부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금 액
기초	12,692
순전입액	(2,855)
당분기말	9,837

13. 우발부채와 약정사항 :

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

내 역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증(*)	51,383	56,752

(*) 직원용 임대주택 제공과 관련 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 제공한 채무보증 약정 한도액입니다.

상기 지급보증 이외에 연결회사는 향후 부담가능성 등을 고려하여 메디캐피탈을 위해 다임기업투자 등에 제공한 지급보증 전액(2,264백만원)을 금융보증채무로 설정하고 있습니다.

나. 소송 등

(1) 보고기간종료일 현재 Apple사와의 특허관련 소송이 미국에서 진행중입니다. 해당 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 연결회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 연결회사 제품 판매금지주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 평결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 연결회사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리

신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 연결회사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다.

연결회사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 연결회사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 연결회사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 연결회사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 연결회사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다. 2016년 12월 6일 대법원은 회사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월 7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다.

또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 연결회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 평결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 연결회사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소심법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 18일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 번복하여 Apple사의 기술

특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 번복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 연결회사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 당사 상고에 반대하는 법정조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 당사 상고를 기각하였습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

2014년 8월, 연결회사와 Apple사는 미국 외 지역에서의 소송을 취하한다는 합의에 이른 바 있으며, 보고기간종료일 현재 미국 외 모든 국가에서 소송 취하가 완료되었습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 TFT-LCD 판매에 대한 가격담합과 관련된 일부 해외구매자들로부터의 민사상 손해배상청구 등을 포함하여, 연결회사의 사업과 관련하여 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 기타 약정사항

삼성디스플레이는 2013년 10월 23일 Corning Incorporated 등과 포괄적 사업협력에 대한 기본계약을 체결하였습니다. 동 계약은 상호 간의 손실보전 조건을 포함하고 있어 향후 자원의 유입 또는 유출이 있을 수 있으며, 보고기간종료일 현재 지급이 예상되는 금액을 부채로 계상하였습니다.

14. 자본금 :

회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원) 이며, 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 129,768,494주와 18,418,580주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 740,935백만원(보통주 648,842백만원 및 우선주 92,093백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

15. 연결이익잉여금 :

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
임의적립금 등	139,295,154	143,007,192
연결미처분이익잉여금	67,477,851	50,079,125
계	206,773,005	193,086,317

나. 회사는 2017년 4월 27일, 7월 27일, 10월 31일 이사회결의에 의거 2017년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일을 배당기준일로 하여 분기배당을 지급하기로 하였으며, 당분기와 전분기의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분			당분기	전분기
1분기	배당받을 주식	보통주	121,840,851주	-
		우선주	17,069,534주	-
	배당률(액면가 기준)		140%	-
	배당금액	보통주	852,886	-
		우선주	119,487	-
		계	972,373	-
2분기	배당받을 주식	보통주	121,038,051주	123,958,561주
		우선주	16,868,834주	17,580,920주
	배당률(액면가 기준)		140%	20%
	배당금액	보통주	847,266	123,958
		우선주	118,082	17,581
		계	965,348	141,539
3분기	배당받을 주식	보통주	120,316,189주	-
		우선주	16,691,095주	-
	배당률(액면가 기준)		140%	-
	배당금액	보통주	842,213	-
		우선주	116,838	-
		계	959,051	-

16. 기타자본항목 :

가. 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(6,214,462)	(9,750,326)
매도가능금융자산평가손익	2,131,225	1,390,624
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	117,503	94,694
해외사업장환산외환차이	(3,670,175)	(2,902,076)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(886,245)	(811,529)
기타	(3,366)	44,027
계	(8,525,520)	(11,934,586)

나. 연결회사는 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	보통주	우선주	보통주	우선주
주식수	9,452,305	1,727,485	17,981,686	3,229,693
취득가액	5,553,475	660,987	8,871,509	878,817

17. 비용의 성격별 분류 :

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	(2,418,855)	(4,186,999)	338,419	768,880
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	21,509,283	58,907,132	17,754,561	54,447,511
급여	5,648,974	16,427,353	4,713,158	14,353,252
퇴직급여	244,320	721,416	304,034	894,128
감가상각비	5,270,583	14,886,343	4,707,030	14,658,625
무형자산상각비	383,537	1,155,447	334,926	1,021,168
복리후생비	922,622	2,871,547	825,460	2,661,516
지급수수료	1,944,076	5,703,997	1,922,886	6,219,721
기타비용	14,011,202	38,612,661	11,715,070	33,490,353
계(*)	47,515,742	135,098,897	42,615,544	128,515,154

(*) 연결손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

18. 판매비와관리비 :

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비				
급여	1,656,927	5,044,684	1,358,779	4,195,683
퇴직급여	64,963	191,063	79,065	217,997
지급수수료	1,944,076	5,703,997	1,922,886	6,219,721
감가상각비	241,305	691,613	192,427	581,378
무형자산상각비	107,488	282,772	53,654	166,239
광고선전비	1,360,249	3,722,742	1,128,409	3,441,004
판매촉진비	2,036,701	5,227,382	1,864,702	5,245,025
운반비	961,194	2,691,067	858,888	2,446,219
서비스비	701,240	2,268,165	1,149,586	2,707,095
기타판매비와관리비	1,255,649	3,793,679	1,089,474	3,328,925
소계	10,329,792	29,617,164	9,697,870	28,549,286
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	4,293,695	12,229,963	3,634,013	11,141,293
개발비 자산화	(111,864)	(307,775)	(127,595)	(569,657)
소계	4,181,831	11,922,188	3,506,418	10,571,636
계	14,511,623	41,539,352	13,204,288	39,120,922

19. 기타수익 및 기타비용 :

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익				
배당금수익	27,524	100,924	27,748	209,619
임대료수익	36,722	104,800	28,384	74,880
투자자산처분이익	17,376	131,873	749,884	1,137,183
유형자산처분이익	27,249	64,607	83,478	126,940
매각예정분류자산처분이익	-	-	-	69,924
기타	266,903	634,208	194,078	443,343
계	375,774	1,036,412	1,083,572	2,061,889
(2) 기타비용				
유형자산처분손실	25,444	90,504	40,489	85,489
기부금	68,491	208,205	164,416	339,809
무형자산손상차손	90	187	26,080	381,445
기타	184,097	479,865	314,736	593,067
계	278,122	778,761	545,721	1,399,810

20. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익				
이자수익	420,785	1,182,516	392,170	1,116,900
- 대여금및수취채권	420,439	1,181,532	391,346	1,088,137
- 매도가능금융자산	346	984	824	28,763
외환차이	1,975,746	4,690,871	1,787,645	5,669,389
파생상품관련이익	214,318	561,788	123,953	583,471
계	2,610,849	6,435,175	2,303,768	7,369,760
(2) 금융비용				
이자비용	161,386	470,592	148,305	432,708
- 상각후원가로 측정하는 금융부채	77,015	252,720	86,411	262,042
- 기타 금융부채	84,371	217,872	61,894	170,666
외환차이	1,993,815	4,672,032	1,797,803	5,875,953
파생상품관련손실	252,142	678,802	129,873	596,281
계	2,407,343	5,821,426	2,075,981	6,904,942

나. 연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

21. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 24.2%입니다.

22. 주당이익 :

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	11,039,771	29,328,245	4,408,790	15,498,474
분기순이익 중 보통주 해당분	9,694,653	25,753,240	3,864,240	13,584,284
÷가중평균유통보통주식수	120,657	121,514	123,447	124,939
기본 보통주 주당이익(단위:원)	80,349	211,936	31,303	108,728

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	11,039,771	29,328,245	4,408,790	15,498,474
분기순이익 중 우선주 해당분	1,345,118	3,575,005	544,550	1,914,190
÷가중평균유통우선주식수	16,776	16,989	17,459	17,829
기본 우선주 주당이익(단위:원)	80,181	210,433	31,190	107,363

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

23. 영업에서 창출된 현금흐름 :

당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

- 조정내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 법인세비용	9,559,965	5,527,095
2. 금융수익	(2,509,171)	(2,341,890)
3. 금융비용	1,883,994	1,587,210
4. 퇴직급여	721,416	894,128
5. 감가상각비	14,886,343	14,658,625
6. 무형자산상각비	1,155,447	1,021,168
7. 대손상각비 등	543,476	507,889
8. 지분법이익	(122,114)	(18,398)
9. 유형자산처분이익	(64,607)	(126,940)
10. 유형자산처분손실	90,504	85,489
11. 무형자산손상차손	187	381,445
12. 재고자산평가손실 등	1,145,018	2,789,947
13. 투자자산처분이익	(131,873)	(1,137,183)
14. 매각예정분류자산처분이익	-	(69,924)
15. 배당금수익	(100,924)	(209,619)
16. 기타	(302,175)	(191,416)
계	26,755,486	23,357,626

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 매출채권의 (증가)감소	(4,469,738)	1,466,212
2. 미수금의 (증가)감소	(224,170)	574,596
3. 선급금의 (증가)감소	(409,827)	116,432
4. 장단기선급비용의 감소(증가)	361,933	(714,042)
5. 재고자산의 증가	(8,940,606)	(3,318,236)
6. 매입채무의 증가	3,517,958	3,473,260
7. 장단기미지급금의 증가(감소)	262,412	(77,546)
8. 선수금의 증가(감소)	6,315	(220,481)
9. 예수금의 증가	527,843	195,742
10. 미지급비용의 감소	(3,052,284)	(990,256)
11. 충당부채의 증가	2,722,467	775,666
12. 퇴직금의 지급	(353,566)	(366,545)
13. 기타	(1,686,277)	654,291
계	(11,737,540)	1,569,093

24. 재무위험관리 :

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 또한 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

한편, 연결회사는 해외 주요 권역별로(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아) 지역 금융센터를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 연결회사는 환율변동으로 인한 현금흐름의 불확실성과 손익변동을 최소화하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

연결회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 31,157백만원 및 23,622백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정・관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

연결회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 연결회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 줄이는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

연결회사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	85,887,328	69,211,291
자 본	210,691,251	192,963,033
부채비율	40.8%	35.9%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	30,788,226	(*1)	32,111,442	(*1)
단기금융상품	41,280,668	(*1)	52,432,411	(*1)
단기매도가능금융자산	3,964,250	3,964,250	3,638,460	3,638,460
매출채권	30,351,245	(*1)	24,279,211	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	8,066,146	6,885,713	6,804,276	5,826,507
기타(*4)	6,244,101	1,273,750	3,459,863	919,071
소 계	120,694,636		122,725,663	
금융부채				
매입채무	11,367,405	(*1)	6,485,039	(*1)
단기차입금	15,329,338	(*1)	12,746,789	(*1)
미지급금(*3)	12,034,295	335,640	10,225,271	(*1)
유동성장기부채	17,659	(*1)	1,232,817	(*1)
사채	1,015,061	1,029,997	58,542	76,129
장기차입금	2,199,998	2,209,618	1,244,238	1,225,455
장기미지급금	1,683,082	1,663,015	3,009,659	3,022,821
기타(*4)	9,851,631	138,216	11,942,469	74,697
소 계	53,498,469		46,944,824	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 1,180,433백만원(전기: 977,769백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 11,698,655백만원(전기: 10,225,271백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*4) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 금융자산 4,929,761백만원(전기: 2,452,118백만원) 및 금융부채 9,713,415백만원(전기: 11,867,772백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,964,250	-	3,964,250
장기매도가능금융자산	3,115,711	-	3,770,002	6,885,713
기타	-	1,273,750	-	1,273,750
(2) 부 채				
미지급금	-	-	335,640	335,640
사채	-	1,029,997	-	1,029,997
장기차입금	-	2,209,618	-	2,209,618
장기미지급금	-	1,663,015	-	1,663,015
기타	-	102,157	36,059	138,216

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,638,460	-	3,638,460
장기매도가능금융자산	2,362,235	-	3,464,272	5,826,507
기타	-	919,071	-	919,071
(2) 부 채				
사채	-	76,129	-	76,129
장기차입금	-	1,225,455	-	1,225,455
장기미지급금	-	2,680,119	342,702	3,022,821
기타	-	74,697	-	74,697

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

・Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격

・Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)

・Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

연결회사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

1) 연결회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
장기매도가능금융자산				
말타니	16,270	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.45%~9.45%(8.45%)
삼성벤처투자	7,515	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	21.31%~23.31%(22.31%)
Corning Incorporated 전환우선주	3,746,217	삼항모형	위험 할인율	5.27%~7.27%(6.27%)
			가격 변동성	26.9%~32.9%(29.9%)
미지급금				
조건부금융부채	335,640	현금흐름할인모형	할인율	3.81%~4.65%(4.23%)
기타				
조건부금융부채	29,484	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	10.50%
			무위험할인율	0.97%
			자산변동성	34.54%
			신용스프레드	2.12%
조건부금융부채	5,332	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	17.57%
			무위험할인율	0.86%
			영업레버리지율	60.00%
			매출총이익할인율	6.68%
조건부금융부채	1,243	확률가중모형	가중평균자본비용	8.60%
			신용위험	2.12%

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초잔액	3,464,272	3,488,344
매입	-	91,584
매도 등	-	(85,169)
당기손익으로 인식된 손익	-	(6,528)
기타포괄손익으로 인식된 손익	305,730	478,104
기타	-	1,534
분기말	3,770,002	3,967,869

(단위: 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	342,702	312,738
결제 등	(2,669)	-
당기손익으로 인식된 손익	(7,062)	(5,118)
사업결합으로 인한 취득	39,083	-
기타	(355)	-
분기말	371,699	307,620

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
장기매도가능금융자산(*1)	-	175,464	-	(162,648)
미지급금(*2)	824	824	(826)	(826)
계	824	176,288	(826)	(163,474)

(*1) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.
(*2) 미지급금은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

25. 부문별 보고 :

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 CE, IM, 반도체, DP, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	CE	IM	DS			Harman	합계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP				
매출액	74,591,090	172,584,132	153,567,934	101,116,514	48,818,569	6,247,783	411,378,137	(237,781,173)	173,596,964
내부매출액	(42,200,903)	(91,383,243)	(77,451,858)	(47,974,854)	(25,536,589)	(1,468,988)	(237,781,173)	237,781,173	-
순매출액(*2)	32,390,187	81,200,889	76,116,076	53,141,660	23,281,980	4,778,795	173,596,964	-	173,596,964
감가상각비	452,275	960,529	13,070,012	9,382,684	3,550,219	127,169	14,886,343	-	14,886,343
무형자산상각비	47,402	115,940	720,124	617,148	91,493	119,444	1,155,447	-	1,155,447
영업이익	1,142,673	9,412,022	28,127,074	24,307,704	3,985,508	(4,180)	38,498,067	-	38,498,067

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(2) 당3분기

(단위: 백만원)

구 분	CE	IM	DS			Harman	합계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP				
매출액	26,451,353	59,832,241	56,921,998	38,112,202	17,525,341	2,709,036	147,464,827	(85,415,926)	62,048,901
내부매출액	(15,321,274)	(32,140,825)	(28,904,345)	(18,206,292)	(9,244,698)	(622,432)	(85,415,926)	85,415,926	-
순매출액(*2)	11,130,079	27,691,416	28,017,653	19,905,910	8,280,643	2,086,604	62,048,901	-	62,048,901
감가상각비	152,230	313,527	4,654,785	3,207,135	1,408,860	56,935	5,270,583	-	5,270,583
무형자산상각비	15,837	37,796	226,989	193,280	30,696	53,657	383,537	-	383,537
영업이익	443,634	3,289,905	10,846,687	9,962,704	968,588	(32,565)	14,533,159	-	14,533,159

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(3) 전분기

(단위: 백만원)

구 분	CE(*3)	IM	DS			계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP			
매출액	75,801,891	162,385,229	113,897,218	70,917,983	40,083,165	356,859,400	(208,324,395)	148,535,005
내부매출액	(43,906,440)	(85,691,134)	(58,006,466)	(34,618,802)	(20,574,124)	(208,324,395)	208,324,395	-
순매출액(*2)	31,895,451	76,694,095	55,890,752	36,299,181	19,509,041	148,535,005	-	148,535,005
감가상각비	402,899	979,040	12,953,820	9,521,077	3,266,462	14,658,625	-	14,658,625
무형자산상각비	45,155	130,220	693,415	581,828	99,202	1,021,168	-	1,021,168
영업이익	2,284,685	8,311,641	9,510,950	8,645,298	890,864	20,019,851	-	20,019,851

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(*3) 프린팅솔루션 사업부가 CE에서 기타로 보고부문의 구성이 변경되어, 해당 부문 정보를 재작성하였습니다.

(4) 전3분기

(단위: 백만원)

구 분	CE(*3)	IM	DS			계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP			
매출액	25,258,070	49,216,738	41,132,039	25,368,571	14,718,895	117,160,970	(69,345,337)	47,815,633
내부매출액	(14,475,237)	(26,681,445)	(20,844,942)	(12,218,522)	(7,661,485)	(69,345,337)	69,345,337	-
순매출액(*2)	10,782,833	22,535,293	20,287,097	13,150,049	7,057,410	47,815,633	-	47,815,633
감가상각비	133,968	324,318	4,146,758	3,060,043	1,031,564	4,707,030	-	4,707,030
무형자산상각비	14,068	45,776	224,325	188,083	32,099	334,926	-	334,926
영업이익	786,482	99,097	4,397,235	3,368,823	1,018,878	5,200,089	-	5,200,089

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(*3) 프린팅솔루션 사업부가 CE에서 기타로 보고부문의 구성이 변경되어, 해당 부문 정보를 재작성하였습니다.

나. 지역별 정보

당분기와 전분기의 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	20,003,910	58,189,893	31,970,019	34,298,140	29,135,002	-	173,596,964
비유동자산(*)	84,293,206	11,462,791	6,458,846	12,799,148	10,198,654	(622,272)	124,590,373

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 당3분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	7,690,359	21,550,326	11,206,535	11,732,865	9,868,816	-	62,048,901
비유동자산(*)	84,293,206	11,462,791	6,458,846	12,799,148	10,198,654	(622,272)	124,590,373

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(3) 전분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	15,193,101	49,653,606	27,940,791	29,935,212	25,812,295	-	148,535,005
비유동자산(*)	64,029,124	6,184,337	716,516	7,813,133	10,866,088	(444,022)	89,165,176

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(4) 전3분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	4,805,039	16,156,201	8,710,181	9,228,277	8,915,935	-	47,815,633
비유동자산(*)	64,029,124	6,184,337	716,516	7,813,133	10,866,088	(444,022)	89,165,176

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

26. 특수관계자와의 거래 :

가. 매출・매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	42,780	-	1,418,329	215,689
	삼성전기	36,097	-	1,627,909	302
	삼성SDI(*2)	49,204	-	749,487	38,605
	제일기획(*3)	11,563	-	531,035	667
	기타	362,439	-	6,458,820	114,773
	관계기업 및 공동기업 계	502,083	-	10,785,580	370,036
그 밖의 특수관계자	삼성물산	135,430	68	288,664	2,786,369
	기타	124,278	35	689,190	196,646
	그 밖의 특수관계자 계	259,708	103	977,854	2,983,015
기타(*4)	삼성엔지니어링	7,336	-	31,886	1,188,742
	에스원	35,258	-	267,145	59,373
	기타	51,198	3	171,477	365
	기타 계	93,792	3	470,508	1,248,480

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 전기 중 유통보통주식수 기준의 지분율이 상승하여 관계기업에 포함되었습니다

.

(*3) 전기 중 지분 취득으로 관계기업에 포함되었습니다.

(*4) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	33,026	-	1,145,182	108,365
	삼성전기	18,735	-	1,900,468	-
	기타	180,187	114	4,149,372	141,806
	관계기업 및 공동기업 계	231,948	114	7,195,022	250,171
그 밖의 특수관계자	삼성물산	25,668	74	186,690	1,682,977
	삼성SDI	45,100	-	826,227	22,188
	기타	120,174	90	893,700	255,397
	그 밖의 특수관계자 계	190,942	164	1,906,617	1,960,562
기타(*2)	삼성엔지니어링	12,566	-	16,046	1,479,275
	에스원	22,932	-	238,311	12,947
	기타	43,623	923	615,639	60
	기타 계	79,121	923	869,996	1,492,282

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 채권・채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권・채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	5,369	421,295
	삼성전기	4,081	195,886
	삼성SDI	87,793	106,629
	제일기획	323	392,355
	기타	136,443	874,986
	관계기업 및 공동기업 계	234,009	1,991,151
그 밖의 특수관계자	삼성물산	245,710	344,465
	기타	30,215	1,798,040
	그 밖의 특수관계자 계	275,925	2,142,505
기타(*2)	삼성엔지니어링	3,216	40,019
	에스원	7,319	56,400
	기타	1,133	24,766
	기타 계	11,668	121,185

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	5,709	362,062
	삼성전기	1,143	108,469
	삼성SDI	89,721	76,211
	제일기획	456	436,624
	기타	210,891	784,475
	관계기업 및 공동기업 계	307,920	1,767,841
그 밖의 특수관계자	삼성물산	231,089	435,505
	기타	31,752	1,932,924
	그 밖의 특수관계자 계	262,841	2,368,429
기타(*2)	삼성엔지니어링	10,664	115,726
	에스원	4,160	47,098
	기타	3,058	28,841
	기타 계	17,882	191,665

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당분기 중 관계기업 및 공동기업에 19,510백만원(전분기: 70,998백만원)을 추가로 출자하였으며, 출자원금 52,732백만원(전분기: 2,103백만원)을 회수하였습니다.

라. 연결회사가 당분기 중 특수관계자에게 지급결의한 배당금은 997,625백만원(전분기 : 505,296백만원)입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 중 지급결의한 배당금은 77,039백만원(전분기 : 38,983백만원)입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

마. 주요 경영진에 대한 보상

당분기 및 전분기 중 연결회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	14,376	7,277
퇴직급여	594	480
기타 장기급여	6,462	6,237

27. 사업결합 :

당분기 중 발생한 주요한 사업결합 거래는 다음과 같습니다.

연결회사의 종속기업 Samsung Electronics America는 신성장 분야인 전장사업을 본격화하고 오디오 사업을 강화하기 위해 2017년 3월 10일자로 Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업의 지분 100%를 인수하였습니다.

가. 피인수회사의 개요

피인수회사명	Harman International Industries, Inc. 외 109개 종속기업
본점소재지	Stamford, CT, USA
대표이사	Dinesh Paliwal
업종	오디오 및 비디오시스템 부품의 디자인, 개발, 제조 및 공급

나. 인수회계처리

(단위: 백만원)

구 분	금 액
Ⅰ. 이전대가	9,272,702
Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
현금및현금성자산	647,729
매출채권 및 기타채권	1,533,437
재고자산	1,068,865
유형자산	858,790
무형자산	5,564,309
기타자산	902,824
매입채무 및 기타채무	3,436,020
이연법인세부채	1,442,527
기타부채	873,637
총 식별가능한 순자산	4,823,770
Ⅲ. 영업권 (Ⅰ - Ⅱ)	4,448,932

Harman과 그 종속기업이 2017년 1월 1일부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 매출 및 당기순이익은 6,256,826백만원 및 4,098백만원이며, 연결대상 편입 이후 Harman과 그 종속기업으로부터 발생한 매출 및 당기순손실은 4,778,802백만원 및 174백만원입니다.

28. 매각예정분류(처분자산집단) :

가. 주요 사항

전기 중 연결회사의 경영진은 프린팅솔루션 사업부문을 HP Inc.에게 매각하기로 결정하였으며, 2017년 11월 1일 매각이 완료되었습니다.

나. 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구 분	금 액
매각예정분류자산	
매출채권	259,219
재고자산	323,009
기타유동자산	92,200
유형자산	85,405
무형자산	122,709
기타비유동자산	37,856
계	920,398
매각예정분류부채	
유동부채	349,617
비유동부채	94,446
계	444,063

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분	금 액
매각예정분류자산	
매출채권	182,738
재고자산	270,642
기타유동자산	115,037
유형자산	84,869
무형자산	124,571
기타비유동자산	57,949
계	835,806
매각예정분류부채	
유동부채	272,726
비유동부채	83,662
계	356,388

다. 매각예정으로 분류한 기타자본항목의 내역

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구 분	금 액
순확정급여부채 재측정요소	(2,699)
해외사업장환산외환차이	(41,783)
계	(44,482)

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분	금 액
순확정급여부채 재측정요소	-
해외사업장환산외환차이	(28,810)
계	(28,810)

29. 보고기간 후 사건 :

연결회사는 보고기간종료일 이후 2017년 7월 27일자 이사회 결의에 의거 2017년 7월 28일부터 2017년 10월 23일까지 자기주식(취득원가 2,019,078백만원) 총 83.8만주(보통주 67만주, 우선주 16.8만주)를 취득하였으며, 2017년 10월 중에 이익 소각의 방법으로 소각 완료하였습니다.

연결회사는 보고기간종료일 이후 2017년 10월 31일자 이사회 결의에 의거 자기주식 취득 및 소각을 결정하였습니다. 취득 예정 주식수는 총 89만주(보통주 71.2만주, 우선주 17.8만주)이며, 취득 종료 예상일은 2018년 1월 31일 입니다. 동 이사회 결의에 의거 취득한 자기주식을 소각할 예정입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 48 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기말	제 48 기말
자산		
유동자산	65,782,329	69,981,128
현금및현금성자산	2,955,954	3,778,371
단기금융상품	20,110,259	30,170,656
단기매도가능금융자산		
매출채권	30,265,906	23,514,012
미수금	1,251,655	2,319,782
선급금	1,214,660	814,300
선급비용	2,476,895	2,375,520
재고자산	6,600,153	5,981,634
기타유동자산	623,157	743,163
매각예정분류자산	283,690	283,690
비유동자산	123,027,161	104,821,831
장기매도가능금융자산	1,070,598	913,989
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	55,688,643	48,743,079
유형자산	58,493,282	47,228,830
무형자산	2,688,016	2,891,844
장기선급비용	3,009,582	3,507,399
순확정급여자산	120,688	557,091
이연법인세자산	69,065	110,239
기타비유동자산	1,887,287	869,360
자산총계	188,809,490	174,802,959
부채		
유동부채	42,071,538	34,076,122
매입채무	7,454,401	6,162,650
단기차입금	12,610,934	9,061,167
미지급금	8,911,763	7,635,740
선수금	171,085	200,445
예수금	386,174	389,528
미지급비용	3,492,646	6,284,646

	제 49 기 3분기말	제 48 기말
미지급법인세	4,378,336	2,055,829
유동성장기부채	5,559	5,854
충당부채	4,606,772	2,221,717
기타유동부채	53,868	58,546
비유동부채	2,454,577	3,180,075
사채	50,035	58,542
장기미지급금	1,852,541	2,808,460
이연법인세부채		
장기충당부채	551,832	312,467
기타비유동부채	169	606
부채총계	44,526,115	37,256,197
자본		
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	143,900,883	140,747,574
기타자본항목	(4,918,915)	(8,502,219)
자본총계	144,283,375	137,546,762
자본과부채총계	188,809,490	174,802,959

손익계산서

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기		제 48 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	43,074,291	119,783,624	32,583,623	98,635,822
매출원가	26,678,477	77,361,049	24,777,976	72,621,129
매출총이익	16,395,814	42,422,575	7,805,647	26,014,693
판매비와관리비	6,401,333	18,824,967	5,986,535	17,521,389
영업이익(손실)	9,994,481	23,597,608	1,819,112	8,493,304
기타수익	197,300	1,075,351	514,819	1,067,176
기타비용	149,857	415,035	197,833	774,040
금융수익	944,769	2,460,116	1,250,832	3,682,881
금융비용	951,330	2,445,228	1,237,124	3,624,348
법인세비용차감전순이익(손실)	10,035,363	24,272,812	2,149,806	8,844,973
법인세비용	2,257,988	5,477,946	467,294	1,933,596
계속영업이익(손실)	7,777,375	18,794,866	1,682,512	6,911,377
당기순이익(손실)	7,777,375	18,794,866	1,682,512	6,911,377
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위:원)	56,604	135,812	11,945	48,483
희석주당이익(손실) (단위:원)	56,604	135,812	11,945	48,483

포괄손익계산서

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기		제 48 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	7,777,375	18,794,866	1,682,512	6,911,377
기타포괄손익	(77,940)	47,440	(282,739)	(663,685)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(20,136)	(74,885)	(19,088)	(64,209)
순확정급여자산 재측정요소	(20,136)	(74,885)	(19,088)	(64,209)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(57,804)	122,325	(263,651)	(599,476)
매도가능금융자산평가손익	(57,804)	122,325	(263,651)	(599,476)
총포괄손익	7,699,435	18,842,306	1,399,773	6,247,692

자본변동표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

		자본					
		자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류 기타자본항목	자본 합계
2016.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	143,629,177	(12,526,126)	23,797	136,428,255
자본의 변동	포괄손익						
	당기순이익(손실)			6,911,377			6,911,377
	매도가능금융자산평가				(575,679)	(23,797)	(599,476)
	순확정급여자산 재측정요소				(64,209)		(64,209)
	매각예정분류						
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
	배당			(3,061,361)			(3,061,361)
	자기주식의 취득				(7,707,938)		(7,707,938)
	자기주식의 처분						
	자기주식의 소각			(11,399,991)	11,399,991		
	주식선택권						
	기타						
2016.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	136,079,202	(9,473,961)		131,906,648
2017.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	140,747,574	(8,502,219)		137,546,762
자본의 변동	포괄손익						
	당기순이익(손실)			18,794,866			18,794,866
	매도가능금융자산평가				122,325		122,325
	순확정급여자산 재측정요소				(74,885)		(74,885)
	매각예정분류						
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
	배당			(5,788,072)			(5,788,072)
	자기주식의 취득				(6,317,621)		(6,317,621)
	자기주식의 처분						
	자기주식의 소각			(9,853,485)	9,853,485		
	주식선택권						
	기타						
2017.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	143,900,883	(4,918,915)		144,283,375

현금흐름표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 49 기 3분기	제 48 기 3분기
영업활동 현금흐름	23,660,843	16,141,077
영업에서 창출된 현금흐름	25,941,877	17,395,930
당기순이익	18,794,866	6,911,377
조정	13,656,686	11,901,605
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,509,675)	(1,417,052)
이자의 수취	400,185	464,312
이자의 지급	(192,963)	(153,865)
배당금 수입	641,155	544,145
법인세 납부액	(3,129,411)	(2,109,445)
투자활동 현금흐름	(15,824,391)	(6,702,943)
단기금융상품의 순감소(증가)	10,060,397	(4,106,385)
단기매도가능금융자산의 처분		3,010,003
장기금융상품의 처분		700,000
장기금융상품의 취득	(500,000)	(900,000)
장기매도가능금융자산의 처분	91,949	681,139
장기매도가능금융자산의 취득	(58,498)	(28,900)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	505,768	1,674,442
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(7,267,741)	(771,680)
유형자산의 처분	179,568	224,599
유형자산의 취득	(18,301,773)	(6,467,870)
무형자산의 처분	456	
무형자산의 취득	(538,275)	(790,475)
기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	3,758	72,184
재무활동 현금흐름	(8,658,869)	(10,623,735)
단기차입금의 순증가(감소)	3,452,017	151,128
자기주식의 취득	(6,317,621)	(7,707,938)
사채의 상환	(6,043)	(5,860)
배당금 지급	(5,787,222)	(3,061,065)
외화환산으로 인한 현금의 변동		(856)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(822,417)	(1,186,457)
기초 현금및현금성자산	3,778,371	3,062,960
기말 현금및현금성자산	2,955,954	1,876,503

이익잉여금처분계산서

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목	제 48 기		제 47 기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		38,248		12,089,583
1. 전기이월이익잉여금	30		30	
2. 중간배당액 제48기 - 주당배당금(률) : 1,000원(20%) 제47기 - 주당배당금(률) : 1,000원(20%)	(141,540)		(148,916)	
3. 자기주식 소각	(11,399,991)		-	
4. 당기순이익	11,579,749		12,238,469	
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		3,812,135		-
1. 기업합리화적립금	3,812,135		-	
Ⅲ. 이익잉여금처분액		3,850,352		12,089,553
1. 기업합리화적립금	-		3,000,000	
2. 배당금 주당배당금(률) 제48기 - 보통주 : 27,500원(550%) 우선주 : 27,550원(551%) 제47기 - 보통주 : 20,000원(400%) 우선주 : 20,050원(401%)	3,850,352		2,919,821	
3. 연구및인력개발준비금	-		5,000,000	
4. 시설적립금	-		1,169,732	
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		31		30

5. 재무제표 주석

제 49 기 분기 : 2017년 9월 30일 현재

제 48 기 : 2016년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

1. 일반적 사항 :

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, Foundry, System LSI 등의 반도체 사업으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침 :

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2017년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2017년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제・개정 기준서

회사는 2017년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제・개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 개정
재무활동에서 생기는 부채 변동을 현금흐름에서 생기는 변동과 비현금거래로 인한 변동 등으로 구분하여 공시하도록 하였습니다. 기업회계기준서 제1007호의 개정에 따른 공시내용은 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성 시 적용될 예정입니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제・개정 기준서

2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제・개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급・선수취 대가' 제정
제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 부채, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 또한, 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정합니다. 동 해석서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용이 허용됩니다. 회사는 동 해석서의 제정으로 인해 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정
2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류, 측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.

기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다.

기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 회사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다.

회사는 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2017년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2017년 재무제표에 미치는 잠재적인 영향을 예비 평가하였으며, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 것으로 예상되는 영향은 다음과 같습니다. 회사는 향후 추가적인 정보에 기초하여 보다 구체적인 재무영향을 분석할 예정이고, 예비영향평가 결과는 향후 회사가 이용할 수 있는 추가 정보 등에 따라 변경될 수 있습니다.

① 금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

계약상 현금흐름 특성/사업모형	원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우
계약상 현금흐름 수취 목적	상각후원가 측정 (*1)	당기손익-공정가치 측정 (*2)
계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적	기타포괄손익-공정가치 측정 (*1)	
매도 목적, 기타	당기손익-공정가치 측정	

(*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

(*2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

기업회계기준서 제1109호에서 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치 측정 대상으로 분류하기 위한 요건이 현행 기업회계기준서 제1039호의 요건보다 엄격하므로, 기업회계기준서 제1109호 도입 시 당기손익-공정가치 측정 대상 금융자산의 비중이 증가하여 당기손익의 변동성이 확대될 수 있습니다.

회사는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 56,689,864백만원, 매도가능금융자산 1,070,598백만원을 보유하고 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하는 채무상품만 상각후원가로 측정할 수 있습니다. 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 56,689,864백만원을 상각후원가로 측정하고 있습니다.

예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 2017년 9월 30일 현재 위 금융자산에 적용할 경우, 대부분 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하므로 상각후원가로 측정되는 항목으로 분류되어 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단합니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취 및 매도를 목적으로 하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 회사는 2017년 9월 30일 현재 매도가능금융자산으로 분류된 채무상품 4,221백만원을 보유하고 있습니다.

예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 2017년 9월 30일 현재 위 매도가능금융자산으로 분류된 채무상품에 적용할 경우, 대부분이 당기손익-공정가치로 측정되는 금융자산으로 분류될 것으로 예상합니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품은 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있고, 동 포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환(recycling)되지 않습니다. 2017년 9월 30일 현재 매도가능금융자산으로 분류된 지분상품은 1,066,377백만원이고, 당분기 중 매도가능지분상품 관련 미실현평가손익이 당기손익으로 재순환된 금액은 없습니다.

예비영향평가 결과에 따르면 회사는 매도가능지분상품 중 대부분을 차지하는 장기투자 목적의 지분상품을 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 계획을 갖고 있어, 기업회계기준서 제1109호를 적용하더라도 해당 금융자산이 재무제표에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단합니다. 다만 2017년 9월 30일 기준 해당 지분상품과 관련된 후속적으로 당기손익으로 재순환 되지 않을 기타포괄손익-공정가치의 잔액은 321,974백만원입니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따른 현금흐름이 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성되지 않거나 매매가 주된 목적인 채무상품과 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하지 않은 지분상품은 당기손익-공정가치로 측정합니다. 2017년 9월 30일 현재 당기손익인식금융자산으로 분류된 채무상품과 지분상품은 없습니다.

② 금융부채의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호에 따르면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.

현행 기업회계기준서 제1039호에서 모두 당기손익으로 인식했던 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 일부가 기타포괄손익으로 표시되므로 금융부채의 평가 관련 당기손익이 감소할 수 있습니다.

2017년 9월 30일 현재 당기손익인식금융부채는 없습니다.

③ 손상: 금융자산과 계약자산

현행 기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하지만, 새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있어 현행 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형에 비하여 신용손실을 조기에 인식할 수 있습니다.

구 분 (*1)		손실충당금
Stage 1	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우 (*2)	12개월 기대신용손실: 보고기간 종료일 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실
Stage 2	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우	전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실
Stage 3	신용이 손상된 경우	

(*1) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용범위에 포함되는 거래에서 생기는 매출채권이나 계약자산의 경우 유의적인 금융요소가 없다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정해야 하고, 유의적인 금융요소가 있다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음. 리스채권도 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음
(*2) 보고기간종료일 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음

기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

회사는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 57,053,131백만원, 매도가능금융자산으로 분류되어 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 4,221백만원을 보유하고 있고, 이들 자산에 대하여 손실충당금 363,267백만원을 설정하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 제정
2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체할 예정입니다.

회사는 기업회계기준서 제1115호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하되, 이 기준서의 최초 적용 누적효과를 최초 적용일이 포함되는 회계연도의 이익잉여금(또는 적절하다면 다른 자본요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식하고, 해당 경과규정에 따라 최초 적용일에 완료되지 않은 계약에만 이 기준서를 소급하여 적용할 예정입니다.

현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

회사는 기업회계기준서 제1115호 도입 준비를 위하여 2017년 9월 30일 현재 회계부서 소속직원과 외부자문사인 회계법인으로 구성되고 필요 시 전산 등 실무 부서의 도움을 받는 TF팀을 운영하고 있습니다. 회사는 현재 상황 및 입수 가능한 정보를 기초로 수익 구조를 분석하여 기업회계기준서 제1115호의 도입에 따른 재무영향을 구체적으로 분석 중에 있으며, 도입 추진 계획과 진행상황을 경영진에게 주기적으로 보고하고 있습니다. 회사는 재무제표에 미치는 재무적 영향을 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도 재무제표 주석에 공시할 예정입니다.

2017년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 기업회계기준서 제1115호 적용 시 2017년 재무제표에 미치는 잠재적인 영향을 예비 평가하였고, 그 결과는 다음과 같습니다. 예비영향평가 결과는 향후 회사가 이용할 수 있는 추가 정보 등에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 수행의무의 식별

회사의 IM(Information technology & Mobile communications)부문은 휴대폰, 통신 시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있습니다. 회사는 네트워크 통신 시스템 등을 제작 및 설치하여 고객에게 제공하고 있으며, 2017 회계연도 중 관련 수익이 총 수익에서 차지하는 비중은 크지 않습니다. 기업회계기준서 제1115호 적용 시 고객과의 네트워크 통신 시스템 제작 등의 통합 계약에서 (1) 제품 판매, (2) 설치용역, (3) 유지보수 등과 같이 기술지원으로 각각 구별되는 수행의무를 식별합니다. 각각의 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지에 따라 수익인식 시점이 변경될 수 있습니다.

회사는 수행의무의 분리에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면, 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

2) 변동대가

회사는 제품 및 상품 판매시 반품을 허용하기 때문에 고객에게서 받은 대가가 변동될 수 있습니다.

기업회계기준서 제1115호 적용 시 회사는 받을 권리를 갖게 될 대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 기댓값 방법을 사용하여 변동 대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 기업이 받았거나 받을 대가 중에서 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채로 계상합니다.

회사는 변동대가 규정에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면, 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

3) 거래가격의 배분

회사는 기업회계기준서 제1115호 적용 시 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 회사는 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법'을 사용하며, 예외적으로 일부 거래에 대해서는 예상원가를 예측하고 적절한 이윤을 더하는 '예상원가 이윤 가산 접근법'을 사용할 예정입니다.

회사는 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분함에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면, 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

4) 보증

회사는 고객과 제품 판매계약 체결 당시 소비자보호법에서 요구하는 법정 보증기간이 경과한 후에도 제품의 품질에 대한 보증을 제공하는데, 고객에게는 추가 보증을 별도로 구매할 수 있는 선택권이 있으므로 기업회계기준서 제1115호에 따라 그 보증은 구별되는 용역입니다.

회사는 고객에게 약속한 보증을 별도의 수행의무로 회계처리하고, 그 수행의무에 거래가격의 일부를 배분할 예정이나, 보증의무 구별에 따른 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

5) 라이선싱 : 사용권

회사는 고객과의 계약에 따라 보유 특허권 라이선스를 제공하고 있습니다.

기업회계기준서 제1115호 적용 시 라이선스 계약은 라이선스를 부여한 시점에 존재하는 지적재산을 사용할 권리에 해당하는데, 이는 라이선스를 이전하는 시점에 고객이 라이선스의 사용을 지시할 수 있고 라이선스에서 생기는 나머지 효익의 대부분을 획득할 수 있음을 의미합니다. 회사는 특허권 라이선스 수익과 관련한 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비 영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

6) 라이선싱 : 접근권

회사는 회사의 브랜드를 고객에게 일정기간 사용하도록 라이선스하고, 라이선스에 대한 대가를 수령하고 있습니다. 회사는 브랜드 가치 향상을 위해 TV, 인터넷 포털 등 다양한 매체를 통하여 홍보활동을 합니다.

브랜드 라이선스 약속의 성격은 고객에게 라이선스 기간 동안 회사의 지적재산에 접근할 수 있도록 하는 것이므로 기업회계기준서 제1115호에 따르면 약속된 라이선스를 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무로 회계처리합니다. 회사는 라이선스 기간 기준으로 수행의무의 진행률을 측정하는 것이 바람직하다고 판단하고 있습니다.

회사는 브랜드 라이선스 수익과 관련한 재무적 영향을 구체적으로 분석 중 입니다. 다만, 예비영향평가 결과에 따르면 기업회계기준서 제1115호를 2017년 9월 30일 현재 적용할 경우 회사의 수익에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제・개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 :

보고기간종료일 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	계
현금및현금성자산	2,955,954	-	2,955,954
단기금융상품	20,110,259	-	20,110,259
매출채권	30,265,906	-	30,265,906
장기매도가능금융자산	-	1,070,598	1,070,598
기타	3,357,745	-	3,357,745
계	56,689,864	1,070,598	57,760,462

(단위: 백만원)

금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	7,454,401	-	7,454,401
단기차입금	-	12,610,934	12,610,934
미지급금	8,720,227	-	8,720,227
유동성장기부채	5,559	-	5,559
사채	50,035	-	50,035
장기미지급금	1,620,802	-	1,620,802
기타	3,193,014	-	3,193,014
계	21,044,038	12,610,934	33,654,972

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	계
현금및현금성자산	3,778,371	-	3,778,371
단기금융상품	30,170,656	-	30,170,656
매출채권	23,514,012	-	23,514,012
장기매도가능금융자산	-	913,989	913,989
기타	3,416,654	-	3,416,654
계	60,879,693	913,989	61,793,682

(단위: 백만원)

금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	6,162,650	-	6,162,650
단기차입금	-	9,061,167	9,061,167
미지급금	7,519,413	-	7,519,413
유동성장기부채	5,854	-	5,854
사채	58,542	-	58,542
장기미지급금	2,585,366	-	2,585,366
기타	6,037,993	-	6,037,993
계	22,369,818	9,061,167	31,430,985

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 등을 포함하고 있습니다.

4. 장기매도가능금융자산 :

가. 보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식	959,071	797,693
지분증권 - 비상장주식	107,306	112,075
채무증권(*)	4,221	4,221
계	1,070,598	913,989

(*) 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액입니다.

나. 보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기 업 명	당분기말				전기말
	보유주식수(주)	지분율(%)(*)	취득원가	장부가액 (시장가치)	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	65,930,982	16.9	473,727	738,427	609,862
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	116,675	96,527
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	6,221	6,732
에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	13,436	16,636
원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	13,299	11,857
원익아이피에스	1,850,936	4.5	16,214	63,117	48,495
케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	3,456	4,152
용평리조트	400,000	0.8	1,869	4,440	3,432
계			551,193	959,071	797,693

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

취득원가는 회수가능액이 취득원가에 미달하여 인식한 매도가능금융자산 손상차손을 차감하지 아니한 금액입니다. 손상차손 금액을 제외한 취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산 평가손익)으로 계상하고 있습니다.

5. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금(*)	장부가액	평가전금액	평가충당금(*)	장부가액
제품 및 상품	1,688,286	(477,850)	1,210,436	2,698,363	(1,053,757)	1,644,606
반제품 및 재공품	3,715,569	(154,385)	3,561,184	3,152,821	(188,311)	2,964,510
원재료 및 저장품	1,917,807	(392,674)	1,525,133	1,409,118	(398,894)	1,010,224
미착품	303,400	-	303,400	362,294	-	362,294
계	7,625,062	(1,024,909)	6,600,153	7,622,596	(1,640,962)	5,981,634

(*) 회사는 생산 및 판매 중단한 재고자산을 순실현가능가치로 평가하고 원가와의 차이를 평가충당금으로 반영하였습니다.

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 :

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	48,743,079	44,107,398
취득	7,267,741	771,680
처분(*1)	(229,165)	(1,544,673)
손상	(93,012)	(19,262)
기타변동액(*2)	-	(182,595)
분기말장부가액	55,688,643	43,132,548

(*1) 회사는 전분기 중 삼성카드 지분 전부를 매각하였습니다.

(*2) 전분기 중 삼성바이오로직스 지분 일부 및 Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP) 지분 전부가 매각예정분류 요건을 충족함에 따라 매각예정분류 자산으로 재분류되었습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다 (종속기업 현황은 주석 25 참조).

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장
삼성전기	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국
삼성에스디에스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합/관리업 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국
삼성바이오로직스	신사업 투자	31.5	한국
삼성SDI(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국
제일기획	광고 대행업	25.2	한국

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장
Toshiba Samsung Storage Technology Japan	전자제품 생산 및 공급	49.0	일본

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부가액	시장가치	장부가액
삼성전기	17,693,084	1,804,695	445,244	898,809	445,244
삼성에스디에스	17,472,110	2,944,051	560,827	2,437,359	560,827
삼성바이오로직스	20,836,832	7,032,431	443,193	3,146,362	443,193
삼성SDI	13,462,673	2,672,341	1,242,605	1,467,431	1,242,605
제일기획	29,038,075	528,493	491,599	457,350	491,599

7. 유형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부가액	47,228,830	45,148,629
일반취득 및 자본적지출	19,050,983	6,638,239
감가상각	(7,563,120)	(7,513,961)
처분/폐기/손상	(74,850)	(120,411)
기타	(148,561)	(108,650)
분기말순장부가액	58,493,282	44,043,846

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	6,670,286	6,659,260
판매비와관리비 등	892,834	854,701
계	7,563,120	7,513,961

8. 무형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	2,891,844	3,407,229
내부개발에 의한 취득	307,775	569,657
개별 취득	230,500	220,818
상각	(835,917)	(830,954)
처분/폐기/손상	(7,998)	(398,829)
기타	101,812	41,563
분기말장부가액	2,688,016	3,009,484

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	634,556	629,941
판매비와관리비 등	201,361	201,013
계	835,917	830,954

9. 차입금 :

보고기간종료일 현재 회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
담보부차입금	우리은행 외	0.1 ~ 10.9	12,610,934	9,061,167

상기 담보부 차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

10. 사채 :

보고기간종료일 현재 회사의 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US$ denominated Straight Bonds	1997.10.2	2027.10.1	7.7	57,335 (US$50,000천)	66,468 (US$55,000천)
1년이내 만기도래분(유동성사채)				(5,734)	(6,043)
사채할인발행차금				(1,566)	(1,883)
계				50,035	58,542

상기 사채는 10년 거치 20년 분할상환되며, 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여자산 :

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여자산과 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	6,066,241	5,687,413
기금이 적립되지 않는 확정급여채무의 현재가치	9,863	9,247
소 계	6,076,104	5,696,660
사외적립자산의 공정가치	(6,196,792)	(6,253,751)
순확정급여(자산) 계	(120,688)	(557,091)

나. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	492,065	609,826
순이자수익	(17,733)	(2,985)
계	474,332	606,841

다. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	178,621	238,940
판매비와관리비 등	295,711	367,901
계	474,332	606,841

12. 충당부채 :

당분기 중 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여충당부채 (라)	기타충당부채 (마)	계
기초	181,342	1,493,290	624,933	-	234,619	2,534,184
순전입액	204,743	727,797	398,048	2,552,481	186,414	4,069,483
사용액	(204,254)	(185,191)	(471,149)	(268,548)	(270,448)	(1,399,590)
기타(*)	-	(37,073)	-	-	(8,400)	(45,473)
당분기말	181,831	1,998,823	551,832	2,283,933	142,185	5,158,604

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 상기 금액의 지급시기는 협상경과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 임직원들 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 회사의 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만톤)

2017년	수 량
무상할당 배출권	750
배출량 추정치	821

(2) 당분기 중 회사의 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금 액
기초	18,626
취득	5,626
매각	(5,934)
사용	(3,559)
당분기말	14,759

(3) 당분기 중 회사의 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금 액
기초	12,692
순전입액	704
사용액	(3,559)
당분기말	9,837

13. 우발부채와 약정사항 :

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 백만US$)

내 역	금액	
	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증(*)	7,722	8,956
해외종속기업에 대한 채무보증 (한도 기준)	US$ 8,405 (원화환산액: ₩9,638,479)	US$ 9,434 (원화환산액: ₩11,401,171)
해외종속기업에 대한 채무보증 (실차입금 기준)	US$ 514 (원화환산액: ₩589,318)	US$ 1,618 (원화환산액: ₩1,954,777)

(*) 직원용 임대주택 제공과 관련 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 제공한 채무보증 약정 한도액입니다.

보고기간종료일 현재 회사가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(단위: 백만원)

해외종속기업	보증처	보증기간	금액	
			실차입금	지급보증금액
Samsung Japan(SJC)	Mizuho Bank 외	2018-05-31	37,192	1,016,668
Samsung Electronics Turkey(SETK)	BTMU 외	2018-06-13	241,566	676,553
Samsung Electronics South Africa(SSA)	Citibank 외	2018-06-13	4,030	384,145
Samsung Electronics Peru(SEPR)	BBVA 외	2018-06-13	57,778	206,406
Samsung Electronics Chile(SECH)	Citibank 외	2018-06-13	10,820	204,113
Samsung Electronica Columbia(SAMCOL)	Citibank 외	2018-06-13	66,635	178,885
Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	HSBC	2018-06-13	117,673	143,338
Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	SocGen 외	2017-12-16	1,735	126,137
Simpress	BNP	2017-11-08	51,889	68,802
기타			-	6,633,432
합계			589,318	9,638,479

나. 소송 등

(1) 보고기간종료일 현재 Apple사와의 특허관련 소송이 미국에서 진행중입니다. 해당 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 회사 제품 판매금지주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 평결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 회사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 회사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다.

회사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 회사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 회사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 회사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 회사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다. 2016년 12월 6일 대법원은 회사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월

7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다.

또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 평결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 회사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소심법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 18일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 번복하여 Apple사의 기술특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 번복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 회사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 회사 상고에 반대하는 법정조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 회사 상고를 기각하였습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

2014년 8월, 회사와 Apple사는 미국 외 지역에서의 소송을 취하한다는 합의에 이른 바 있으며, 보고기간종료일 현재 미국 외 모든 국가에서 소송 취하가 완료되었습니다.

(2) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 분할과 관련된 연대채무

회사와 삼성디스플레이 주식회사 등은 분할된 삼성디스플레이 주식회사 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

14. 자본금 :

회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원) 이며, 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 129,768,494주와 18,418,580주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 740,935백만원(보통주 648,842백만원 및 우선주 92,093백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

15. 이익잉여금 :

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	450,789	450,789
임의적립금 등	143,450,094	140,296,785
계	143,900,883	140,747,574

나. 회사는 2017년 4월 27일, 7월 27일, 10월 31일 이사회결의에 의거 2017년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일을 배당기준일로 하여 분기배당을 지급하기로 하였으며, 당분기 및 전분기의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분			당분기	전분기
1분기	배당받을 주식	보통주	121,840,851주	-
		우선주	17,069,534주	-
	배당률(액면가 기준)		140%	-
	배당금액	보통주	852,886	-
		우선주	119,487	-
		계	972,373	-
2분기	배당받을 주식	보통주	121,038,051주	123,958,561주
		우선주	16,868,834주	17,580,920주
	배당률(액면가 기준)		140%	20%
	배당금액	보통주	847,266	123,958
		우선주	118,082	17,581
		계	965,348	141,539
3분기	배당받을 주식	보통주	120,316,189주	-
		우선주	16,691,095주	-
	배당률(액면가 기준)		140%	-
	배당금액	보통주	842,213	-
		우선주	116,838	-
		계	959,051	-

16. 기타자본항목 :

가. 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(6,214,462)	(9,750,326)
매도가능금융자산평가손익	321,974	199,649
순확정급여자산 재측정요소	(786,835)	(711,950)
기타	1,760,408	1,760,408
계	(4,918,915)	(8,502,219)

나. 회사는 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	보통주	우선주	보통주	우선주
주식수	9,452,305	1,727,485	17,981,686	3,229,693
취득가액	5,553,475	660,987	8,871,509	878,817

17. 비용의 성격별 분류 :

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	(5,613)	(162,504)	1,076,606	782,488
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	19,597,729	57,416,416	17,921,104	53,916,764
급여	2,549,944	7,930,027	2,507,401	7,630,682
퇴직급여	158,424	475,199	202,530	607,564
감가상각비	2,606,570	7,563,120	2,492,622	7,513,961
무형자산상각비	263,231	835,917	272,702	830,954
복리후생비	374,499	1,177,562	340,866	1,109,615
지급수수료	965,008	2,653,682	921,393	2,554,768
기타비용	6,570,018	18,296,597	5,029,287	15,195,722
계(*)	33,079,810	96,186,016	30,764,511	90,142,518

(*) 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

18. 판매비와관리비 :

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비				
급여	487,985	1,694,558	450,039	1,432,526
퇴직급여	32,019	99,203	38,773	115,642
지급수수료	965,008	2,653,682	921,393	2,554,768
감가상각비	84,942	251,019	81,532	242,444
무형자산상각비	31,409	94,635	31,789	94,813
광고선전비	315,753	961,414	196,728	709,727
판매촉진비	401,512	999,564	345,373	959,735
운반비	149,476	424,391	140,293	397,880
서비스비	172,891	525,541	263,925	523,525
기타판매비와관리비	511,994	1,581,467	459,014	1,352,681
소계	3,152,989	9,285,474	2,928,859	8,383,741
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	3,360,208	9,847,268	3,185,271	9,707,305
개발비 자산화	(111,864)	(307,775)	(127,595)	(569,657)
소계	3,248,344	9,539,493	3,057,676	9,137,648
계	6,401,333	18,824,967	5,986,535	17,521,389

19. 기타수익 및 기타비용 :

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익				
배당금수익	93,947	736,395	45,429	200,483
임대료수익	38,894	112,545	28,712	73,859
투자자산처분이익	240	714	342,839	423,048
유형자산처분이익	25,150	107,611	24,998	117,024
매각예정분류자산처분이익	-	-	-	69,924
기타	39,069	118,086	72,841	182,838
계	197,300	1,075,351	514,819	1,067,176
(2) 기타비용				
유형자산처분손실	2,158	8,086	4,211	19,998
기부금	54,497	170,463	139,875	282,967
무형자산손상차손	-	-	2,106	357,537
기타	93,202	236,486	51,641	113,538
계	149,857	415,035	197,833	774,040

20. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익				
이자수익	111,351	342,433	132,293	431,850
- 대여금및수취채권	111,351	342,394	131,724	403,891
- 매도가능금융자산	-	39	569	27,959
외환차이	833,418	2,117,683	1,118,539	3,251,031
계	944,769	2,460,116	1,250,832	3,682,881
(2) 금융비용				
이자비용	96,334	273,774	79,723	246,054
- 상각후원가로 측정하는 금융부채	25,271	85,410	29,856	97,596
- 기타금융부채	71,063	188,364	49,867	148,458
외환차이	854,996	2,171,454	1,157,401	3,378,294
계	951,330	2,445,228	1,237,124	3,624,348

나. 회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

21. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 22.6%입니다.

22. 주당이익 :

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
분기순이익	7,777,375	18,794,866	1,682,512	6,911,377
분기순이익 중 보통주 해당분	6,829,703	16,503,104	1,474,580	6,057,450
÷ 가중평균유통보통주식수	120,657	121,514	123,447	124,939
기본 보통주 주당이익(단위:원)	56,604	135,812	11,945	48,483

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
분기순이익	7,777,375	18,794,866	1,682,512	6,911,377
분기순이익 중 우선주 해당분	947,672	2,291,762	207,932	853,927
÷ 가중평균유통우선주식수	16,776	16,989	17,459	17,829
기본 우선주 주당이익(단위:원)	56,490	134,899	11,910	47,895

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

23. 영업에서 창출된 현금흐름 :

당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름의 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

- 조정 내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 법인세비용	5,477,946	1,933,596
2. 금융수익	(749,529)	(885,936)
3. 금융비용	598,830	583,046
4. 퇴직급여	475,199	607,564
5. 감가상각비	7,563,120	7,513,961
6. 무형자산상각비	835,917	830,954
7. 대손상각비 등	232,613	165,479
8. 배당금수익	(736,395)	(200,483)
9. 유형자산처분이익	(107,611)	(117,024)
10. 유형자산처분손실	8,086	19,998
11. 무형자산손상차손	-	357,537
12. 재고자산평가손실 등	102,933	1,684,769
13. 투자자산처분이익	(714)	(423,048)
14. 매각예정분류자산처분이익	-	(69,924)
15. 기타	(43,709)	(98,884)
계	13,656,686	11,901,605

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 매출채권의 증가	(6,493,203)	(2,499,031)
2. 미수금의 감소	859,786	1,013,207
3. 선급금의 (증가)감소	(403,480)	165,890
4. 장단기선급비용의 감소(증가)	396,442	(640,286)
5. 재고자산의 증가	(701,242)	(931,761)
6. 매입채무의 증가	1,217,854	2,539,325
7. 장단기미지급금의 감소	(490,458)	(249,627)
8. 선수금의 (감소)증가	(29,360)	1,929
9. 예수금의 (감소)증가	(3,354)	58,832
10. 미지급비용의 감소	(2,907,614)	(1,320,302)
11. 충당부채의 증가	2,669,893	54,951
12. 퇴직금의 지급	(278,754)	(237,001)
13. 기타	(346,185)	626,822
계	(6,509,675)	(1,417,052)

24. 재무위험관리 :

회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

한편, 회사는 해외 주요 권역별로(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아) 지역금융센터를 운영하여, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 9,591백만원 및 7,977백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정・관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재경팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

회사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	44,526,115	37,256,197
자 본	144,283,375	137,546,762
부채비율	30.9%	27.1%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 회사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	2,955,954	(*1)	3,778,371	(*1)
단기금융상품	20,110,259	(*1)	30,170,656	(*1)
매출채권	30,265,906	(*1)	23,514,012	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	1,070,598	982,856	913,989	821,478
기타(*3)	3,357,745	381,745	3,416,654	361,226
소계	57,760,462		61,793,682	
금융부채				
매입채무	7,454,401	(*1)	6,162,650	(*1)
단기차입금	12,610,934	(*1)	9,061,167	(*1)
미지급금	8,720,227	(*1)	7,519,413	(*1)
유동성장기부채	5,559	(*1)	5,854	(*1)
사채	50,035	64,971	58,542	76,129
장기미지급금	1,620,802	1,600,927	2,585,366	2,587,619
기타	3,193,014	(*1)	6,037,993	(*1)
소계	33,654,972		31,430,985	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가하여 공정가치 공시에서 제외한 금액은 87,742백만원(전기말: 92,511백만원)입니다.

(*3) 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외한 금액은 2,945,510백만원(전기말: 3,004,318백만원)입니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
장기매도가능금융자산	959,071	-	23,785	982,856
기타	-	381,745	-	381,745
(2) 부 채				
사채	-	64,971	-	64,971
장기미지급금	-	1,600,927	-	1,600,927

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
장기매도가능금융자산	797,693	-	23,785	821,478
기타	-	361,226	-	361,226
(2) 부 채				
사채	-	76,129	-	76,129
장기미지급금	-	2,587,619	-	2,587,619

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

・Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격

・Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)

・Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

회사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

1) 회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
말타니	16,270	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.45%~9.45%(8.45%)
삼성벤처투자	7,515	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	21.31%~23.31%(22.31%)

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초잔액	23,785	88,213
매입	-	21,029
매도	-	(2,931)
기타	-	4,409
분기말잔액	23,785	110,720

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동에 따른 기타포괄손익효과(법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
장기매도가능금융자산(*)	-	5,127	-	(3,309)

(*) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

25. 특수관계자와의 거래 :

가. 지배, 종속관계

보고기간종료일 현재 회사의 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
국내	삼성디스플레이	디스플레이 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스	디스플레이 부품 생산	50.0
	스테코	반도체 부품생산	70.0
	세메스	반도체/FPD제조장비 생산	91.5
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자판매	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨	의료기기	68.5
	SVIC 20호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 23호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	미래로시스템	반도체 공정불량 및 품질관리 소프트웨어 개발 및 공급	81.0
	에스프린팅솔루션	프린팅솔루션 사업	100.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.0
	레드벤드소프트웨어코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Electronics America(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	Kngine	소프트웨어 개발	100.0
	NeuroLogica	의료기기	100.0
	Samsung Semiconductor(SSI)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Research America(SRA)	R&D	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 판매	99.9
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM)	전자제품 생산	99.9
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	RT SV CO-INVEST(RT-SV)	벤처기업 투자	99.9
	Samsung HVAC(구 Quietside)	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings	스마트홈기기 판매	100.0
	PrinterOn	프린팅솔루션 판매	100.0
	PrinterOn America	프린팅솔루션 판매	100.0
	Simpress	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Pay	모바일 결제 개발 및 서비스	100.0
	Prismview	LED 디스플레이 생산 및 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund (Beijing Fund)	벤처기업 투자	61.4
	Stellus Technologies	반도체 시스템 생산 및 판매	100.0
	Samsung Oak Holdings(SHI)	Holding Company	100.0
	AdGear Technologies	디지털광고 플랫폼	100.0
	Joyent	클라우드 서비스	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Next	Holding Company	100.0
	Samsung Next Fund	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Dacor Holdings	Holding Company	100.0
	Dacor	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada	가전제품 판매	100.0
	EverythingDacor.com	가전제품 판매	100.0
	Distinctive Appliances of California	가전제품 판매	100.0
	Viv Labs	인공지능관련 신기술 연구	100.0
	NewNet Communication Technologies (Canada)	RCS (Rich Communication Service)	100.0
	AMX Holding Corporation	Holding Company	100.0
	AMX LLC	Holding Company	100.0
	Harman Becker Automotive Systems	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services Engineering	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Holding	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services South America	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico S. de R.L.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	Holding Company	100.0
	Harman International Mexico S de RL de CV	오디오제품 판매	100.0
	Harman Investment Group, LLC	Financing Company	100.0
	Harman KG Holding, LLC	Holding Company	100.0
	Harman Professional	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software	소프트웨어 디자인	100.0
	S1NN USA	R&D	100.0
	Southern Vision Systems	영상 감지 장치 개발	100.0
	Triple Play Integration	Connected Service Provider	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America(SEHA)	가전제품 생산	100.0
	China Materialia	벤처기업 투자	98.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia(SDSK)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics(London) Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Denmark Research Center(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung France Research Center(SFRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre(SCSC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH(SESG)	전자제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	PrinterOn Europe	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Electronics Caucasus(SECC)	마케팅	100.0
	Joyent(UK)	클라우드 서비스	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
	Aditi Technologies Europe	오디오제품 판매 등	100.0
	AKG Acoustics	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX (Germany)	오디오제품 판매	100.0
	AMX UK	오디오제품 판매	100.0
	Duran Audio B.V.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Duran Audio Iberia Espana	오디오제품 판매	100.0
	Endeleo	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive UK	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems (Germany)	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Finland OY	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services (Germany)	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Division Nordic A/S	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Finland OY	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	Holding Company	100.0
	Harman Finance International SCA	Financing Company	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	Holding Company	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	Harman International Industries (UK)	오디오제품 판매 등	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman International SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Management	Holding Company	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Inspiration Matters	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Knight Image	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Martin Manufacturing (UK)	오디오제품 생산	100.0
	Harman Professional Denmark ApS(구 Martin Professional ApS)	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Professional France SAS(구 Martin Professional France)	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Germany GmbH(구 Martin Professional GmbH)	오디오제품 판매	100.0
	R&D International	오디오제품 생산	100.0
	Red Bend Software (UK)	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS France	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Innoetics E.P.E.	소프트웨어 개발	100.0
	ARCAM	Holding Company	100.0
	A&R Cambridge	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production(SSAP)	TV/모니터 생산	100.0
	Broadsense	서비스	100.0
	Global Symphony Technology Group	Holding Company	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius	Holding Company	100.0
	iOnRoad	R&D	100.0
	iOnRoad Technologies	R&D	100.0
	Red Bend	오디오제품 생산	100.0
	TowerSec (Israel)	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore(SRI-B)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Bangladesh(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	통신제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics New Zealand(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam(SDV)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Laos Samsung Electronics Sole(LSE)	마케팅	100.0
	AMX Products and Solutions Private	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services India	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Technologies	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY	Holding Company	100.0
	Harman International Singapore	오디오제품 판매	100.0
	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Singapore Pte.	오디오제품 판매	100.0
	INSP India Software Development Pvt.	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	Martin Professional Pte.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아 (중국제외)	Harman Connected Services Japan	Connected Service Provider	100.0
	Harman International Japan	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software KK	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Japan	Holding Company	100.0
중국	Samsung Display Dongguan(SDD)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin(SDT)	디스플레이 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(STMC)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP)	프린터 생산	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.9
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	TV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(SESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module(SSM)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	디스플레이 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication (SSET)	통신제품 생산	95.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중국	Tianjin Samsung LED(TSLED)	LED 생산	100.0
	Tianjin Samsung Opto-Electronics(TSOE)	카메라/캠코더 생산	90.0
	SEMES (Xian)	반도체 장비	100.0
	Samsung Semiconductor Xian(SSCX)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Harman (China) Technologies	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai)	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Taiwan	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive Infotech (Dalian)(구 Harman Neusoft Automotive Infotech (Dalian))	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	Harman Technology (Shenzhen)	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Martin Trading Zhuhai	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services (Beijing) Solutions	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services (Chengdu) Solutions	Connected Service Provider	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 매출・매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이	224,032	79	864,674	-
	Samsung Electronics America(SEA)	19,815,350	-	131,166	-
	Harman International Industries	-	-	5,950	-
	Samsung (China) Investment(SCIC)	213,661	-	5,179	-
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	2,582,854	1,262	7,273,172	1,210
	Samsung Semiconductor(SSI)	17,206,702	-	300,952	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	3,644,248	513	11,182,143	287
	Samsung Display Vietnam(SDV)	774,817	-	-	-
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	-	-	-	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	243,490	26,450	3,320,002	24,642
	Samsung India Electronics(SIEL)	2,705,951	-	142,255	-
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	1,487,018	19	7,883,003	261
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	953,503	203	9,299	-
	Samsung Asia Private(SAPL)	1,388,024	-	10,852	-
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	12,379,597	-	-	-
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	35	67,379	2,590,712	4,495
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	2,114,355	-	8,691	-
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	27,792	-	-	-
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	393,412	325	2,334	179
	Thai Samsung Electronics(TSE)	1,453,348	842	1,560,382	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	467,269	472	2,026,033	-
	Samsung International(SII)	863,032	128	4,249,840	-
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,583,489	-	19,050	-
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	2,565,989	-	885	-
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	234,861	-	46,833	433
	기타	30,973,519	11,539	12,243,497	9,903
	종속기업 계	105,296,348	109,211	53,876,904	41,410

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	38,946	-	1,282,621	180,978
	삼성전기	20,784	-	639,237	302
	삼성SDI(*2)	39,187	-	207,074	25,925
	제일기획(*3)	10,878	-	526,381	667
	기타	159,953	-	238,971	1,477
	관계기업 및 공동기업 계	269,748	-	2,894,284	209,349
그 밖의 특수관계자	삼성물산	107,063	68	181,332	1,861,855
	기타	103,341	35	280,639	48,487
	그 밖의 특수관계자 계	210,404	103	461,971	1,910,342
기타(*4)	삼성엔지니어링	7,160	-	30,105	695,882
	에스원	24,486	-	202,770	28,330
	기타	42,670	3	135,251	290
	기타 계	74,316	3	368,126	724,502

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 전기 중 유통보통주식수 기준의 지분율이 상승하여 관계기업에 포함되었습니다

.

(*3) 전기 중 지분 취득으로 관계기업에 포함되었습니다.

(*4) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이	309,918	-	959,580	6,649
	Samsung Electronics America(SEA)	20,621,118	-	126,369	-
	Samsung (China) Investment(SCIC)	401,191	-	6,125	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	177,830	71,886	3,235,963	3,195
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	2,210,210	2,389	7,578,018	44
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	630	-	-	-
	Samsung Semiconductor(SSI)	11,254,114	-	250,988	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	2,383,058	26,514	8,051,029	2,700
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	1,123,903	261	5,524,841	1,519
	Samsung Asia Private(SAPL)	1,037,721	-	4,533	-
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	683,978	29	4,782	-
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	8,940,871	-	-	-
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	40	5,927	2,816,143	3,745
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,634,081	684	128,151	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	2,579,190	-	7,631	-
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	20,286	-	-	-
	Samsung Display Vietnam(SDV)	394,642	-	-	-
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	308,045	27	1,227	-
	Thai Samsung Electronics(TSE)	1,521,208	171	1,237,658	-
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	278,751	63	2,557,100	421
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,452,783	-	22,231	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	271,096	29,616	824,486	-
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	113,968	2	3,142	108
	Samsung Display Dongguan(SDD)	217,259	-	-	-
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,661,349	-	637	-
	기타	25,669,130	7,628	14,538,701	1,330
	종속기업 계	86,266,370	145,197	47,879,335	19,711

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	26,492	-	1,006,280	83,553
	삼성전기	11,180	-	726,730	-
	기타	138,670	114	260,173	2,513
	관계기업 및 공동기업 계	176,342	114	1,993,183	86,066
그 밖의 특수관계자	삼성물산	24,289	74	145,486	1,256,037
	삼성SDI	34,282	-	217,061	10,361
	기타	102,144	90	235,558	31,200
	그 밖의 특수관계자 계	160,715	164	598,105	1,297,598
기타(*2)	삼성엔지니어링	12,405	-	14,645	488,424
	에스원	14,167	-	190,443	6,821
	기타	35,351	923	570,941	60
	기타 계	61,923	923	776,029	495,305

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별 회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 채권・채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권・채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이	14,886	109,964
	Samsung Electronics America(SEA)	5,447,256	114,426
	Harman International Industries	-	1,864
	Samsung (China) Investment(SCIC)	48,282	1,040
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	682,094	1,912,186
	Samsung Semiconductor(SSI)	5,246,481	49,692
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	877,451	1,176,471
	Samsung Display Vietnam(SDV)	141,436	-
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	600	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	49,053	453,840
	Samsung India Electronics(SIEL)	2,089,728	18,985
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	373,356	709,757
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	238,945	2,443
	Samsung Asia Private(SAPL)	164,105	30,698
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	3,120,521	-

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	14,220	323,154
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	649,462	1,346
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	6,750	-
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	155,115	172
	Thai Samsung Electronics(TSE)	186,149	193,973
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	73,069	287,817
	Samsung International(SII)	149,974	441,179
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	915,458	2,313
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	334,055	22,712
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	68,499	23,491
	기타	8,568,475	2,746,391
	종속기업 계(*2)	29,615,420	8,623,914
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	5,036	376,307
	삼성전기	1,495	109,426
	삼성SDI	87,739	47,826
	제일기획	23	389,413
	기타	34,815	60,842
	관계기업 및 공동기업 계	129,108	983,814
그 밖의 특수관계자	삼성물산	222,505	277,419
	기타	17,718	1,551,799
	그 밖의 특수관계자 계	240,223	1,829,218
기타(*3)	삼성엔지니어링	3,157	32,667
	에스원	2,827	33,802
	기타	378	23,470
	기타 계	6,362	89,939

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(*2) 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 대손충당금 296,154백만원을 계상하고 있으며, 당분기에 인식된 대손상각비는 72,792백만원입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이	26,017	105,445
	Samsung Electronics America(SEA)	4,200,871	430,475
	Samsung (China) Investment(SCIC)	50,354	1,006
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	51,611	320,006
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	381,759	1,902,614
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	1,447	36
	Samsung Semiconductor(SSI)	3,123,618	98,931
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	749,996	650,219
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	151,613	1,123,574
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	3,448,765	840
	Samsung Asia Private(SAPL)	54,231	12,350
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	162,997	1,445
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	37,391	298,150
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,056,157	14,177
	Samsung Display Vietnam(SDV)	40,894	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	1,284,610	2,283
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	4,855	-

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	Thai Samsung Electronics(TSE)	140,628	167,454
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	91,094	40
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	249,588	30,651
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	119,320	173,261
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	21,454	194
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	678,964	6,237
	Samsung Display Dongguan(SDD)	34,823	-
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	130,999	27,646
	기타	6,042,123	2,011,144
	종속기업 계(*2)	22,336,179	7,378,178
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	5,484	326,518
	삼성전기	642	52,589
	삼성SDI	89,491	27,005
	제일기획	36	433,914
	기타	80,716	82,520
	관계기업 및 공동기업 계	176,369	922,546
그 밖의 특수관계자	삼성물산	207,463	268,839
	기타	21,488	1,582,645
	그 밖의 특수관계자 계	228,951	1,851,484
기타(*3)	삼성엔지니어링	10,611	99,802
	에스원	2,949	35,153
	기타	1,924	23,095
	기타 계	15,484	158,050

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.

(*2) 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 대손충당금 223,362백만원을 계상하고 있으며, 전기에 인식된 대손상각비는 30,037백만원입니다.

(*3) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당분기 중 Samsung Electronics America 6,990,725백만원 등 총 7,267,741백만원(전분기: 756,875백만원)을 종속기업에 출자하였으며, 종속기업으로부터 출자원금 179,753백만원(전분기 87,188백만원)을 회수하였습니다. 당분기 중 관계기업 및 공동기업에 추가 출자한 내역은 없으며(전분기 : 14,804백만원), 관계기업 및 공동기업으로부터 출자원금 49,412백만원(전분기 2,102백만원)을 회수하였습니다.

마. 회사가 당분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 997,625백만원(전분기 : 505,296백만원)입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다. 또한, 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 중 지급 결의한 배당금은 77,039백만원(전분기 : 38,983백만원)입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

바. 주요 경영진에 대한 보상

당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	14,168	7,156
퇴직급여	594	480
기타 장기급여	6,462	6,237

사. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

26. 매각예정분류(처분자산집단) :

가. 주요 사항

(1) 프린팅솔루션 사업부 매각

전기 중 회사의 경영진은 프린팅솔루션 사업부문을 HP Inc.에게 매각하기로 결정하였으며, 2017년 11월 1일 매각이 완료되었습니다.

나. 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구 분	금 액
매각예정분류자산	
투자자산	283,690
계	283,690

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분	금 액
매각예정분류자산	
투자자산	283,690
계	283,690

다. 매각예정으로 분류한 기타자본항목의 내역

보고기간종료일 현재 매각예정으로 분류한 기타자본항목은 없습니다.

27. 보고기간 후 사건 :

회사는 보고기간종료일 이후 2017년 7월 27일자 이사회 결의에 의거 2017년 7월 28일부터 2017년 10월 23일까지 자기주식(취득원가 2,019,078백만원) 총 83.8만주(보통주 67만주, 우선주 16.8만주)를 취득하였으며, 2017년 10월 중에 이익 소각의 방법으로 소각 완료하였습니다.

회사는 보고기간종료일 이후 2017년 10월 31일자 이사회 결의에 의거 자기주식 취득 및 소각을 결정하였습니다. 취득 예정 주식수는 총 89만주(보통주 71.2만주, 우선주 17.8만주)이며, 취득 종료 예상일은 2018년 1월 31일 입니다. 동 이사회 결의에 의거 취득한 자기주식을 소각할 예정입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

- 해당사항 없음

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

- 최근 3사업연도내 본사 기준(별도 재무제표 기준) 주요한 합병 내역은 없으며, 종속기업의 주요한 사업결합 및 사업매각 등의 내용은 연결재무제표의 사업결합 주석과 매각예정분류(처분자산집단) 주석을 참조하시기 바랍니다.

- 분할 내역

[프린팅솔루션 사업부문 분할]

- 회사명 : 에스프린팅솔루션 주식회사
- 소재지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
- 대표이사 : 김기호
- 분할방법 : 물적분할(분할후 에스프린팅솔루션 주식회사 신설)
- 분할목적 : 프린팅솔루션 사업의 경쟁력 강화
- 분할승인 : 2016년 10월 27일(임시주주총회 결의)
- 분할기일 : 2016년 11월 1일

(단위 : 억원)

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도(17.3Q)	1차연도		2차연도(17.3Q)		
				실적	괴리율	실적	괴리율	
에스프린팅솔루션 주식회사	매출액	2,094	12,203	2,186	4.40%	12,195	△0.07%	
	영업이익	△29	561	△61	111.48%	577	2.85%	
	당기순이익	△67	554	△10	△84.72%	588	6.14%	

[△는 부(-)의 값임]

에스프린팅솔루션 주식회사 지분을 포함한 프린팅솔루션 사업부문 양도 거래가 2017년 11월 1일 종결되었습니다.

상기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

합병 등의 사후정보는 별도기준으로 작성되었습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

- 중요한 소송사건

1) Apple사

① 1차 소송

구 분	내 용
소제기일	2011년 4월 15일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 트레이드 드레스, 실용 특허, 디자인 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
진행현황	2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 당사 제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 평결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 당사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 당사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 당사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 당사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 당사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 당사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 당사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다. 2016년 12월 6일 대법원은 당사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월 7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다.
향후 소송일정	디자인 관련 재재판(2018년 5월)
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

② 2차 소송

구 분	내 용
소제기일	2012년 2월 8일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
진행현황	2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두 번째 소송과 관련해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 평결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 당사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 18일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 번복하여 Apple사의 기술특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 번복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 당사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 당사 상고에 반대하는 법정조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 당사 상고를 기각하였습니다.
향후 소송일정	향후분 로열티 관련 대응(2018년 1월, 1심 법원 심리)
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향은 향후분 로열티 관련 법원 판단이 남아 있으므로 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

2) TFT-LCD 판매 관련

① Iiyama社 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2014년 12월 19일
소송 당사자	원고 : Mouse Computer社, 유럽內 Iiyama 5개社 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	원고 신청에 의한 항소 진행 중
향후 일정 및 전망	2017년 12월 항소 구두변론 진행 예정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

② 영국 정부기관 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2015년 11월 4일
소송 당사자	원고 : 영국 42개 정부기관 피고 : 삼성전자 및 해외 판매 자회사
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대한 영국 정부기관 클레임
진행상황	소장 송달 완료
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

③ 이스라엘LCD 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2013년 11월 26일
소송 당사자	원고 : Hatzlacha 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

- 채무보증 내역

1) 국내채무보증

2017년 3분기말 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대한 채무보증 약정한도는 51,383백만원이며, 잔액은 33,302백만원입니다.

이외 메디캐피탈에 대하여 다임기업투자 등에 한도 2,264백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역 (잔액)				채무보증한도	이자율 (%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	SMBC 外	2018-06-13	1,000,000	0	1,000,000	0	1,423,000		2016-11-09
SEM (멕시코생판법인)	계열회사	Santander 外	2018-08-19	0	0	0	0	546,000		2016-11-09
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	83,585	0	25,475	58,110	156,000	7.89%	2016-12-17
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	HSBC 外	2018-06-13	0	0	0	0	769,000		2016-10-08
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	0	9,436	0	9,436	178,000	2.40%	2016-11-09
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 外	2018-06-13	68,739	0	18,353	50,386	180,000	2.80%	2016-11-09
SSA (남아공판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	34,327	0	30,813	3,514	335,000	8.25%	2016-11-09
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 外	2017-12-16	0	1,513	0	1,513	110,000	5.00%	2016-11-09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BTMU 外	2018-06-13	187,867	22,795	0	210,662	590,000	12.12%	2016-11-09
SECE (카자흐판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-07-19	0	0	0	0	93,739		2016-12-17
SEEG (이집트생산법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	50,000		2017-06-14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 外	2018-06-13	0	0	0	0	186,000		2016-11-09
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 外	2018-05-31	0	32,434	0	32,434	886,603	0.27%	2016-11-09
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 外	2018-06-13	0	0	0	0	175,000		2016-11-09
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	101,326	0	101,326	0	391,000		2016-11-09
SECA (캐나다판매법인)	계열회사	Nova Scotia	2017-10-10	0	0	0	0	12,062		2016-10-11
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	30,000		2016-12-17
SEEH (네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 外	2018-09-05	0	0	0	0	727,000		2016-11-01
SERK (러시아생산법인)	계열회사	BNP 外	2018-06-28	0	0	0	0	345,000		2016-11-09
SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	10,000		2016-12-17
SAPL (싱가폴법인)	계열회사	BOA 外	2018-06-13	0	0	0	0	411,000		2016-11-09
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	15,000		2016-11-09
SAVINA (베트남생산법인)	계열회사	SCB 外	2018-06-13	0	0	0	0	71,000		2016-11-09
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	30,000		2016-11-09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 外	2018-06-13	0	0	0	0	350,000		2016-11-09

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역 (잔액)				채무보증한도	이자율 (%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	110,000		2016-11-09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	5,000		2016-12-17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	1,000		2016-12-17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	10,282	0	10,282	0	30,000		2016-11-09
Simpress (브라질판매법인)	계열회사	BNP	2017-11-08	44,529	722	0	45,250	60,000	10.65%	2016-11-09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	2,000		2017-06-14
SEPM (폴란드판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	86,870	15,749	0	102,619	125,000	1.85%	2017-06-14
Adgear (캐나다판매법인)	계열회사	BOA	2017-11-08	0	0	0	0	2,000		2016-11-09
Harman Finance International SCA	계열회사	JP Morgan 外	2022-05-27	367,115	45,203	0	412,318	412,318	2.00%	2015-05-27
합 계				1,984,640	127,852	1,186,249	926,242	8,817,722		

※ 채무보증 내역 중 기초잔액 및 기말잔액이 없는 법인은 未포함
※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

- 추가적인 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제49기 3분기	매출채권	30,999,702	648,457	2.1%
	단기대여금	7,749	90	1.2%
	미수금	3,576,594	25,313	0.7%
	선급금	1,965,357	5,303	0.3%
	장기성매출채권	2,029,577	5,637	0.3%
	장기성미수금	210,810	353	0.2%
	장기성선급금	138,624	846	0.6%
	장기대여금	201,320	4,889	2.4%
	합 계	39,129,733	690,888	1.8%
제48기	매출채권	24,699,961	420,750	1.7%
	단기대여금	7,208	67	0.9%
	미수금	3,546,546	25,349	0.7%
	선급금	1,442,219	2,281	0.2%
	장기성매출채권	4,563	139	3.0%
	장기성미수금	35,683	153	0.4%
	장기성선급금	175,211	1,369	0.8%
	장기대여금	173,068	7,849	4.5%
	합 계	30,084,459	457,957	1.5%
제47기	매출채권	25,494,637	326,611	1.3%
	단기대여금	8,570	80	0.9%
	미수금	3,400,227	47,564	1.4%
	선급금	1,709,840	3,837	0.2%
	장기성매출채권	25,747	249	1.0%
	장기성미수금	185,667	1,726	0.9%
	장기성선급금	422,884	793	0.2%
	장기대여금	180,839	2,334	1.3%
	합 계	31,428,411	383,194	1.2%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준)

(2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제49기 3분기	제48기	제47기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	457,957	383,194	294,157
2. 순대손처리액(①-②±③)	△24,300	29,843	11,373
① 대손처리액(상각채권액) 등	11,522	31,334	14,149
② 상각채권회수액	1,482	1,491	2,776
③ 기타증감액	△34,340	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	208,631	104,606	100,410
4. 기말 대손충당금 잔액합계	690,888	457,957	383,194

※ 연결기준입니다. [△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

1) 대손충당금 설정방침

재무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정

2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거

- 대손경험률 : 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액 : 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정

[대손추산액 설정기준]

상황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

3) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	32,878,706	47,984	53,295	49,294	33,029,279
구성비율	99.5%	0.1%	0.2%	0.1%	100.0%

※ 매출채권잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준)

다. 재고자산 현황

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

부문	사업부문	계정과목	제49기 3분기말	제48기말	제47기말	비고
CE		제품 및 상품	2,894,535	2,045,068	1,679,255	
		반제품 및 재공품	217,894	109,934	73,060	
		원재료 및 저장품	3,340,687	1,826,473	1,671,254	
		미착품	1,717,612	1,957,076	1,607,908	
		소 계	8,170,728	5,938,551	5,031,477	
IM		제품 및 상품	2,583,964	2,032,004	1,924,116	
		반제품 및 재공품	749,977	531,628	347,780	
		원재료 및 저장품	4,962,135	2,851,438	2,471,314	
		미착품	764,296	594,955	492,149	
		소 계	9,060,372	6,010,025	5,235,359	
DS	반도체	제품 및 상품	758,735	871,428	1,598,617	
		반제품 및 재공품	4,364,006	3,796,746	4,740,937	
		원재료 및 저장품	767,171	541,573	505,226	
		미착품	35,184	62,078	109,333	
		소 계	5,925,096	5,271,825	6,954,113	
	DP	제품 및 상품	514,417	299,208	398,342	
		반제품 및 재공품	1,262,550	444,831	483,084	
		원재료 및 저장품	914,994	375,611	265,206	
		미착품	157,067	69,782	49,957	
		소 계	2,849,028	1,189,432	1,196,589	
	DS 계	제품 및 상품	1,312,304	1,203,332	2,014,630	
		반제품 및 재공품	5,980,898	4,412,185	5,353,650	
		원재료 및 저장품	1,889,492	977,020	804,420	
		미착품	96,716	135,230	162,897	
		소 계	9,279,410	6,727,767	8,335,597	
Harman		제품 및 상품	445,790	-	-	
		반제품 및 재공품	91,586	-	-	
		원재료 및 저장품	395,826	-	-	
		미착품	121,120	-	-	
		소 계	1,054,322	-	-	

부문	사업부문	계정과목	제49기 3분기말	제48기말	제47기말	비고
총 계		제품 및 상품	8,139,522	5,905,339	5,769,460	
		반제품 및 재공품	6,970,199	5,017,384	5,779,303	
		원재료 및 저장품	10,705,676	6,494,166	5,859,262	
		미착품	1,217,104	936,614	1,403,769	
		소 계	27,032,501	18,353,503	18,811,794	
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]			9.1%	7.0%	7.8%	
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]			5.5회	6.5회	6.8회	

※ CE부문은 프린팅솔루션 사업부를 제외하여 재작성하였습니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점인 11월말과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함.

2) 실사방법

- 사내보관재고 : 폐창식 전수조사 실시

  ※ 반도체 및 DP 라인재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- 사외보관재고

  제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치확인서 징구 및 표본조사 병행
- 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인함.

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2017년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비 고
제품 및 상품	9,377,377	9,377,377	(1,237,855)	8,139,522	
반제품 및 재공품	7,289,992	7,289,992	(319,793)	6,970,199	
원재료 및 저장품	11,718,995	11,718,995	(1,013,319)	10,705,676	
미착품	1,217,104	1,217,104	-	1,217,104	
합 계	29,603,468	29,603,468	(2,570,967)	27,032,501	

※ 연결기준입니다.

라. 공정가치평가 방법 및 내역

(1) 평가방법

[금융자산]

- 분류

당사는 금융자산을 그 취득목적과 성격에 따라 당기손익인식금융자산과 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 경영진은 최초 인식시점에서 이러한 금융상품의 분류를 결정하고 있습니다.

1) 당기손익인식금융자산
당기손익인식금융자산은 단기매매목적의 금융상품입니다. 당사는 주로 단기간 내에 매각할 목적으로 취득한 금융상품을 당기손익인식금융자산으로 분류합니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매목적으로 분류합니다. 당기손익인식금융자산은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

2) 대여금 및 수취채권
대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 결정가능하며 활성시장에서 거래되지 않는 비파생금융자산입니다. 보고기간 종료일 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다

3) 매도가능금융자산
매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정하거나, 다른 범주에 포함되지 않은 비파생금융상품입니다. 매도가능금융자산은 보고기간 종료일 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하거나 경영진이 처분할 의도가 있는 경우가 아니면 비유동자산으로 분류됩니다.

- 인식과 측정

금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다. 금융자산은 최초 인식시점에 공정가치로 측정하며, 거래원가는 당기손익인식금융자산을 제외한 금융자산은 공정가치에 가산하고 당기손익인식금융자산의 경우에는 당기비용으로 처리됩니다. 최초 인식 이후 매도가능금융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정되고, 대여금 및 수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정됩니다.

당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되고, 매도가능금융자산의 공정가치변동은 기타포괄손익에 계상되어 이를 처분하거나 손상을 인식하는 때 자본에서 당기손익으로 재분류됩니다.

유효이자율법을 적용하여 계산한 매도가능금융자산 및 만기보유금융자산의 이자는 금융수익으로 손익계산서에 인식되며 매도가능금융자산의 배당금은 당사의 배당금 수취 권리가 확정되는 시점에 기타수익으로 인식하고 있습니다.

- 금융상품의 상계

금융자산과 금융부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계 권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있는 경우 상계되고 재무상태표에 순액으로 표시됩니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

- 금융상품의 제거

당사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 "차입금"으로 분류됩니다.

- 금융자산의 손상

당사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간 종료일에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.

대여금 및 수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은 장부금액에서 직접 차감됩니다. 당사는 금융자산을 더 이상 회수하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다.
금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거에는 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움, 이자지급이나 원금상환의 연체, 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 등이 포함됩니다. 또한, 매도가능지분상품의 공정가치가 원가로부터 유의적 또는 지속적으로 하락하는 경우는 손상의 객관적인 증거에 해당됩니다.

[금융부채]

- 분류 및 측정

당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.

당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 "매입채무", "차입금" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다.

- 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

- 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	-	30,788,226	-	-	30,788,226
단기금융상품	-	41,280,668	-	-	41,280,668
단기매도가능금융자산	-	-	3,964,250	-	3,964,250
매출채권	-	30,351,245	-	-	30,351,245
장기매도가능금융자산	-	-	8,066,146	-	8,066,146
기타	56,799	6,130,370	-	56,932	6,244,101
계	56,799	108,550,509	12,030,396	56,932	120,694,636

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	-	11,367,405	-	11,367,405
단기차입금	-	1,711,656	13,617,682	15,329,338
미지급금	335,640	11,698,655	-	12,034,295
유동성장기부채	-	17,659	-	17,659
사채	-	1,015,061	-	1,015,061
장기차입금	-	2,199,998	-	2,199,998
장기미지급금	-	1,683,082	-	1,683,082
기타	97,080	9,713,414	41,137	9,851,631
계	432,720	39,406,930	13,658,819	53,498,469

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

- 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	계
현금및현금성자산	-	32,111,442	-	32,111,442
단기금융상품	-	52,432,411	-	52,432,411
단기매도가능금융자산	-	-	3,638,460	3,638,460
매출채권	-	24,279,211	-	24,279,211
장기매도가능금융자산	-	-	6,804,276	6,804,276
기타	63,208	3,396,655	-	3,459,863
계	63,208	112,219,719	10,442,736	122,725,663

(단위 : 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	-	6,485,039	-	6,485,039
단기차입금	-	1,817,021	10,929,768	12,746,789
미지급금	-	10,225,271	-	10,225,271
유동성장기부채	-	1,232,817	-	1,232,817
사채	-	58,542	-	58,542
장기차입금	-	1,244,238	-	1,244,238
장기미지급금	342,702	2,666,957	-	3,009,659
기타	74,697	11,867,772	-	11,942,469
계	417,399	35,597,657	10,929,768	46,944,824

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 등을 포함하고 있습니다.

(3) 공정가치 측정

- 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	30,788,226	(*1)	32,111,442	(*1)
단기금융상품	41,280,668	(*1)	52,432,411	(*1)
단기매도가능금융자산	3,964,250	3,964,250	3,638,460	3,638,460
매출채권	30,351,245	(*1)	24,279,211	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	8,066,146	6,885,713	6,804,276	5,826,507
기타(*4)	6,244,101	1,273,750	3,459,863	919,071
소 계	120,694,636		122,725,663	
금융부채				
매입채무	11,367,405	(*1)	6,485,039	(*1)
단기차입금	15,329,338	(*1)	12,746,789	(*1)
미지급금(*3)	12,034,295	335,640	10,225,271	(*1)
유동성장기부채	17,659	(*1)	1,232,817	(*1)
사채	1,015,061	1,029,997	58,542	76,129
장기차입금	2,199,998	2,209,618	1,244,238	1,225,455
장기미지급금	1,683,082	1,663,015	3,009,659	3,022,821
기타(*4)	9,851,631	138,216	11,942,469	74,697
소 계	53,498,469		46,944,824	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 1,180,433백만원(전기: 977,769백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 11,698,655백만원(전기: 10,225,271백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*4) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 금융자산 4,929,761백만원(전기 : 2,452,118백만원) 및 금융부채 9,713,415백만원(전기: 11,867,772백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

- 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,964,250	-	3,964,250
장기매도가능금융자산	3,115,711	-	3,770,002	6,885,713
기타	-	1,273,750	-	1,273,750
(2) 부 채				
미지급금	-	-	335,640	335,640
사채	-	1,029,997	-	1,029,997
장기차입금	-	2,209,618	-	2,209,618
장기미지급금	-	1,663,015	-	1,663,015
기타	-	102,157	36,059	138,216

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,638,460	-	3,638,460
장기매도가능금융자산	2,362,235	-	3,464,272	5,826,507
기타	-	919,071	-	919,071
(2) 부 채				
사채	-	76,129	-	76,129
장기차입금	-	1,225,455	-	1,225,455
장기미지급금	-	2,680,119	342,702	3,022,821
기타	-	74,697	-	74,697

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

・Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격

・Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)

・Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

당사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

- 가치평가기법 및 투입변수

1) 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
장기매도가능금융자산				
말타니	16,270	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.45%~9.45%(8.45%)
삼성벤처투자	7,515	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	21.31%~23.31%(22.31%)
Corning Incorporated 전환우선주	3,746,217	삼항모형	위험 할인율	5.27%~7.27%(6.27%)
			가격 변동성	26.9%~32.9%(29.9%)
미지급금				
조건부금융부채	335,640	현금흐름할인모형	할인율	3.81%~4.65%(4.23%)
기타				
조건부금융부채	29,484	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	10.50%
			무위험할인율	0.97%
			자산변동성	34.54%
			신용스프레드	2.12%
조건부금융부채	5,332	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	17.57%
			무위험할인율	0.86%
			영업레버리지율	60.00%
			매출총이익할인율	6.68%
조건부금융부채	1,243	확률가중모형	가중평균자본비용	8.60%
			신용위험	2.12%

- Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초잔액	3,464,272	3,488,344
매입	-	91,584
매도 등	-	(85,169)
당기손익으로 인식된 손익	-	(6,528)
기타포괄손익으로 인식된 손익	305,730	478,104
기타	-	1,534
분기말	3,770,002	3,967,869

(단위 : 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	342,702	312,738
결제 등	(2,669)	-
당기손익으로 인식된 손익	(7,062)	(5,118)
사업결합으로 인한 취득	39,083	-
기타	(355)	-
분기말	371,699	307,620

- Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
장기매도가능금융자산(*1)	-	175,464	-	(162,648)
미지급금(*2)	824	824	(826)	(826)
계	824	176,288	(826)	(163,474)

(*1) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.
(*2) 미지급금은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

- 해당사항 없음

마. 채무증권 발행실적 등

채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자	회사채	공모	1997년 10월 02일	114,670	7.7	AA-(S&P), A1(Moody's)	2027년 10월 01일	일부상환	골드만삭스 외
SEA	회사채	공모	2012년 04월 10일	1,134,600	1.8	A+(S&P), A1(Moody's)	2017년 04월 10일	상환	골드만삭스 외
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015년 05월 06일	458,680	4.2	Baa2 (Moody's), BBB+ (S&P)	2025년 05월 15일	미상환	J.P.모건 외
Harman Finance International SCA	회사채	공모	2015년 05월 20일	472,805	2.0	Baa2 (Moody's), BBB+ (S&P)	2022년 05월 27일	미상환	HSBC 외
합 계	-	-	-	2,180,755	-	-	-	-	-

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.(SEA는 만기일 환율 적용)
※ SEA 회사채는 2017년 4월 상환 완료하였습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2017.09.30) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	114,670	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2017.09.30)

재무비율 유지현황	계약내용	해당 없음
	이행현황	해당 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 中(해당자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 中('17년 3분기중 처분 자산은 전체의 0.2%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당 없음

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.
※ 기준일 환율을 적용하였습니다.
※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	5,734	5,734	5,734	5,734	478,539	487,348	-	988,820
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	5,734	5,734	5,734	5,734	478,539	487,348	-	988,820

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(삼성전자)

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	28,668	-	57,335
	합계	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	28,668	-	57,335

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(Harman)

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	472,805	458,680	-	931,485
	합계	-	-	-	-	472,805	458,680	-	931,485

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : -) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : -) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

삼일회계법인은 당사의 제47기, 제48기 감사 및 제49기 3분기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제47기, 제48기 감사의견은 모두 적정이며 제 49기 3분기 검토 결과, 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속회사는 제49기 3분기말 현재 278개이며, 당분기 중에 Samsung Electronics Iberia(SESA)는 E&Y, Samsung India Electronics(SIEL)는 KPMG, 미래로시스템은 외부감사인을 PwC로 변경하였습니다. 당분기 중 지분인수된 종속기업 Harman International Industries, Inc.과 신규 설립된 종속기업 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)는 PwC를 외부감사인으로 선임하였습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제49기 3분기	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음
제48기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음
제47기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 분・반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

<제49기 3분기 검토일정>

구 분		일정
1분기	사전검토	2017.03.06 ~ 2017.03.24
	본검토	2017.04.07 ~ 2017.05.12
반기	사전검토	2017.06.05 ~ 2017.06.23
	본검토	2017.07.07 ~ 2017.08.11
3분기	사전검토	2017.09.06 ~ 2017.09.22
	본검토	2017.10.11 ~ 2017.11.13

※ 상기 일정은 별도・연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

[감사용역 체결 현황] (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간
제49기 3분기	삼일회계법인	별도 및 연결 분·반기 재무제표 검토	1,971	22,660
제48기 (전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	3,690	43,999
제47기 (전전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	3,690	43,928

당사의 감사인인 삼일회계법인은 회계감사 용역 외에 하기 내용의 비감사용역을 수행하였으며, 당사는 용역의 대가로 제49기 3분기에 689백만원을 지급하였습니다.

[비감사용역 계약체결 현황] (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고
제49기 3분기	2017년 1월	세무자문업무	2017.01~2017.09	153	
	2016년 12월	관세 등 관련 자문업무	2017.01~2017.09	536	
	소계			689	
제48기 (전기)	2016년 12월	세무자문업무	2016.12~2016.12	220	
	2016년 2월	관세 등 관련 자문업무	2016.01~2016.12	1,133	
	소계			1,353	
제47기 (전전기)	2014년 6월	법인설립 및 인수, 분할 관련 자문업무	2015.01~2015.12	503	
	2014년 5월	세무자문업무	2015.01~2015.12	47	
	소계			550	

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2017년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(권오현, 윤부근, 신종균, 이재용)과 사외이사 5인(이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 박재완), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.
이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사				
				이인호	김한중	송광수	이병기	박재완
1차	'17.01.24	① 2016년(제48기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 자기주식 취득 및 소각의 건 ③ 삼성디스플레이(주)와 패널 개발계약 체결의 건 ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
2차	'17.02.24	① 제48기 정기주주총회 소집결정의 건 ② 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 - 제1호 : 제48기(2016.1.1~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 ③ 대외 후원금 운영기준(案) ④ 생산물 배상책임보험 가입의 건 ※ 보고사항 ① 주주가치 제고 방안 진행현황 공유의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
3차	'17.03.24	① 이사 보수 책정의 건 ② 2017년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건 ③ 국제기능올림픽 후원의 건 ※ 보고사항 ① 거버넌스위원회 설치·운영(안) 보고의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참
		① 2017년(제49기) 1/4분기 재무제표, 분기보고서 및 3월 분기배당 승인의 건 ② 자기주식 취득 및 소각의 건 ③ 보유 자기주식 소각의 건 ④ CSR위원회 규정 개정의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사				
				이인호	김한중	송광수	이병기	박재완
4차	'17.04.27	⑤ 사회공헌 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		⑥ 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결 및 폐기보상의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		⑦ 삼성디스플레이(주)와 개발 프로젝트 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		※ 보고사항 ① 지주회사 전환 검토 결과						
5차	'17.06.12	① 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		② 삼성디스플레이(주)와 검사설비 공급 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6차	'17.07.27	① 2017년(제49기) 상반기 재무제표, 반기보고서 및 6월 분기배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		② 자기주식 취득 및 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		③ 손해보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		④ 삼성디스플레이(주)와 패널 개발계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고
경영위원회	사내이사 3명	권오현, 윤부근, 신종균	하단 기재내용 참조	
내부거래위원회	사외이사 3명	이인호, 김한중, 송광수	하단 기재내용 참조	
보상위원회	사외이사 3명	송광수, 이인호, 이병기	하단 기재내용 참조	
거버넌스위원회	사외이사 5명	이병기, 이인호, 김한중, 송광수, 박재완	하단 기재내용 참조	

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2017년 3분기말 기준입니다.
※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

- 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다. 경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항

경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항
1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
2) 주요 경영전략
3) 사업계획·사업구조 조정 추진
4) 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각
(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
7) 기타 주요 경영현황
8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
9) 지배인의 선임 또는 해임
10) 최근사업년도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약

13) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
14) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
15) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는
공급계약 체결 또는 해지
16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항
1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는
신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
- 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.
- 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.
4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
5) 내부거래의 승인
내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을
상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의
자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산,
무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이
갱신하는 경우는 제외함)
6) 사채발행
7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로
인한 경우에 한함
8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중
이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과
다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회

- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
  - o 내부거래 보고 청취권
    계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
    ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
  - o 내부거래 직권조사 명령권
  - o 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회

- 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
  - o 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  - o 등기이사에 대한 보상체계
  - o 기타 이사회에서 위임한 사항

□ 거버넌스위원회

- 설치목적 : 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
  - o 회사의 사회적 책임과 관련된 사항
  - o 주주가치 제고와 관련한 사항
    · 주주환원 정책 사전심의
    · 주주권익 개선을 위한 각종 활동 검토
    · 기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토
  - o 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
  - o 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명 출석률 및 찬반여부
경영 위원회	'17.01.24	① 메모리 투자의 건 ② S.LSI 투자의 건	가결 가결	해당사항 없음 (전원 사내이사로 구성)
	'17.02.24	① 메모리 투자의 건 ② 해외법인 청산의 건	가결 가결	
	'17.03.08	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	
	'17.04.24	① S.LSI 투자의 건 ② 평택단지 투자의 건 ③ 해외법인 증자의 건 ④ 임대차 계약 체결의 건	가결 가결 가결 가결	
	'17.06.12	① 메모리 투자의 건 ② TP센터 투자의 건 ③ 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 ④ 해외법인 청산 철회의 건	가결 가결 가결 가결	
	'17.07.27	① 메모리 투자의 건 ② 화성캠퍼스 주차빌딩 신축의 건 ③ 해외법인 설립의 건 ④ 해외법인 설립의 건	가결 가결 가결 가결	
	'17.08.28	① 해외법인 출자의 건 ② 매출채권 담보대출 한도 증액의 건	가결 가결	
	'17.09.12	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)
				찬 반 여 부		
내부거래 위원회	'17.01.23	- '16년 4/4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-
	'17.02.22	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 생산물 배상책임 보험 가입의 건	-	-	-	-
	'17.04.26	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 사회공헌 기부금 출연의 건 2) 삼성디스플레이(주) 임대차계약 체결 및 폐기보상의 건 - '17년 1/4분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	- -	- -
	'17.06.12	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건	-	-	-	-
	'17.07.26	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 손해보험 가입의 건 - '17년 2/4분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	- -	- -

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				송광수 (출석률:100%)	이인호 (출석률:100%)	이병기 (출석률:100%)
				찬 반 여 부		
보상 위원회	'17.02.22	① 위원장 선임의 건 ② 2017년 이사보수한도 심의의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

□ 거버넌스위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명				
				이병기 (출석률:100%)	이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)	박재완 (출석률:100%)
				찬 반 여 부				
거버넌스 위원회	'17.02.24	※ 보고사항 ① 2017년 1분기 CSR리스크관리협의회 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-
	'17.04.27	※ 보고사항 ① IR동향 보고의 건 ② 2017년 2분기 CSR리스크관리협의회 결과 보고의 건	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	'17.06.12	① 기업지배구조헌장 제정 검토의 건 ② 거버넌스위원회 운영 검토의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
	'17.07.27	※ 보고사항 ① IR동향 보고의 건 ② 2017년 3분기 CSR리스크관리협의회 결과 보고의 건	- -	- -	- -	- -	- -	- -

※ 이사회 결의('17. 4. 27)에 따라, CSR위원회가 거버넌스위원회로 개편되었습니다.

라. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는
이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여
주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우,
이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	권오현	이사회	이사회 의장 DS부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사 (대표이사)	윤부근	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사 (대표이사)	신종균	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사	이재용	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사외이사	이인호	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	김한중	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	송광수	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	이병기	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	박재완	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2017년 3분기말 기준입니다.

② 사외이사후보 추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3인(김한중, 이병기, 박재완)과 사내이사 1인(권오현)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

- 지원조직 : 경영지원실 인사팀
- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원
- 담당 직원의 현황 : 5명

(2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실적

1) 국내 경영현장 점검

- 시기 : 매년 5월 정기적으로 실시
- 주체 : 인사팀 및 해당 국내사업장 경영진
- 내용 : 경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰

2) 해외 경영현장 점검

- 시기 : 매년 8월 정기적으로 실시
- 주체 : 인사팀 및 해당 해외사업장 경영진
- 내용 : 경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2017년 3분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주요경력	비 고
이인호 (위원장)	- 신한은행 고문 (2009~2011) - 신한금융지주회사 대표이사 사장 (2005~2009) - 신한은행 은행장 (1999~2003)	사외이사
김한중	- 연세대학교 의과대학 명예교수 (2012~현재) - 연세대학교 총장 (2008~2012) - 연세대학교 의과대학 교수 (1982~2012)	사외이사
송광수	- 김&장 법률사무소 고문 (2007~현재) - 제33대 대검찰청 검찰총장 (2003~2005) - 대구고등검찰청 검사장 (2002~2003)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한・책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계・재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이인호 1인)	상법 제542조의11 제 2항, 당사 감사위원회 규정 제3조
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족	
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

2017년 3분기말 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명		
				이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)
				찬 반 여 부		
감사 위원회	'17.01.23	- 제48기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-
		- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
		- 2016년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-	-	-
		- 2016년 감사팀 감사실적 보고	-	-	-	-
		- 외부감사인 선임계획 보고	-	-	-	-
	'17.02.22	- 외부감사인 선임 승인	가결	찬성	찬성	찬성
	'17.02.24	- 제48기 정기주주총회 목적사항 심의	-	-	-	-
		- '16년 내부감시장치 가동현황 보고	-	-	-	-
	'17.04.26	- 제49기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고	-	-	-	-
		- 2017년 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-	-	-
		- 2017년 1/4분기 대외 후원금 현황 보고	-	-	-	-
	'17.07.26	- 제49기 상반기 재무제표 및 분기보고서 보고	-	-	-	-
		- 2017년 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-	-	-
		- 2017년 2/4분기 대외 후원금 현황 보고	-	-	-	-
		- 2017년 상반기 감사실적 보고	-	-	-	-

라. 준법지원인에 관한 사항

1.준법지원인	성명	이상주
	나이	만47세
	최종학력	법학박사(고려대 법대) / 행정학 석사(하버드 행정대학원)
	현직	삼성전자 법무실 Compliance팀장 (2015년 12월~)
	주요경력	'12.12 : 삼성전자 해외법무팀 팀장 전무대우 '15.12 : 삼성전자 Compliance팀 팀장 전무대우 '16.02 : 삼성전자 개인정보보호사무국장(겸) 전무대우
2. 이사회 결의일		2016.01.28.
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

다음은 기초 및 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
이건희	본인	보통주	4,985,464	3.54	4,985,464	3.84	-
이건희	본인	우선주	12,398	0.06	12,398	0.07	-
삼성물산	특수관계인	보통주	5,976,362	4.25	5,976,362	4.61	-
삼성복지재단	특수관계인	보통주	89,683	0.06	89,683	0.07	-
삼성문화재단	특수관계인	보통주	37,615	0.03	37,615	0.03	-
홍라희	특수관계인	보통주	1,083,072	0.77	1,083,072	0.83	-
이재용	특수관계인	보통주	840,403	0.60	840,403	0.65	-
삼성생명	특수관계인	보통주	10,622,814	7.55	10,622,814	8.19	-
삼성생명	특수관계인	우선주	879	0.00	879	0.00	-
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	보통주	467,320	0.33	458,497	0.35	장내매매
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	우선주	51,614	0.25	23,788	0.13	장내매매
삼성화재	특수관계인	보통주	1,856,370	1.32	1,856,370	1.43	-
권오현	특수관계인	보통주	1,300	0.00	1,300	0.00	-
계		보통주	25,960,403	18.45	25,951,580	20.00	-
		우선주	64,891	0.32	37,065	0.20	-

※ 장내매매 外 지분율 변동은 자기주식 소각에 따른 것입니다.

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 : 이건희

○ 경력(최근 5년간) : 삼성전자 회장 (2010.3 ~)

국제올림픽위원회 명예위원 (2017 ~)

국제올림픽위원회 위원 (1996 ~ 2017)

- 최대주주 변동현황

당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식의 분포현황

최근 주주명부폐쇄일인 2017년 9월 30일 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 주, %)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	국민연금공단	12,604,178	9.71	-
	삼성생명	11,081,311	8.54	-
우리사주조합		-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 9월 30일자 기준입니다.

※ 삼성생명 소유주식수 및 지분율은 특별계정 포함 기준입니다.

3. 소액주주현황

[2017년 9월 30일 현재] (단위 : 명, 주, %)

구 분	주 주		보유주식		비 고
	주주수	비 율	주식수	비 율	
소액주주	104,829	99.91	77,342,384	59.60	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주
전 체	104,921	100.00	129,768,494	100.00	

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 9월 30일자 기준입니다.

※ 보통주 기준입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 이 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이를 처리한다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞(주) 제8조 6항 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. ☞(주) 제11조의 3 (일반공모증자) 1. 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다. 2. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. ☞(주) 제11조의 4 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 임·직원(상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 상법이 허용하는 한도내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 임·직원(이 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로하되 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임·직원은 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의

	산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다. 4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다. 5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다. 6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관련 법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다. 7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 임・직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 임・직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내	
주주명부폐쇄기간			1월 1일부터 1개월 間	
주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)			
명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23			
주주의 특전	없음		공고게재신문	중앙일보

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류			'17.4월	5월	6월	7월	8월	9월
보통주	주가	최 고	2,231,000	2,351,000	2,415,000	2,560,000	2,450,000	2,681,000
		최 저	2,014,000	2,232,000	2,234,000	2,350,000	2,231,000	2,302,000
		평 균	2,097,950	2,277,526	2,328,714	2,469,667	2,342,909	2,512,667
	거래량	최고(일)	460,645	468,219	348,069	523,366	508,146	341,144
		최저(일)	104,495	148,489	151,988	136,111	102,069	158,870
		월 간	4,765	5,161	4,626	4,444	5,361	4,679
우선주	주가	최 고	1,753,000	1,806,000	1,921,000	2,056,000	1,959,000	2,152,000
		최 저	1,559,000	1,727,000	1,749,000	1,849,000	1,800,000	1,876,000
		평 균	1,616,950	1,770,789	1,856,905	1,956,381	1,898,273	2,033,619
	거래량	최고(일)	105,630	151,918	56,600	84,712	72,665	78,594
		최저(일)	7,485	22,612	21,078	15,456	11,999	14,011
		월 간	647	1,083	722	766	689	735

※ 월간 거래량은 천주 단위입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)] (단위 : $, 원, DR)

종 류			'17.4월	5월	6월	7월	8월	9월
보통주	주가	최 고	981.00	1,035.00	1,053.00	1,141.00	1,101.00	1,194.00
		(₩환산)	1,108,628	1,171,724	1,195,366	1,279,974	1,230,918	1,356,742
		최 저	882.50	990.00	997.50	1,016.00	983.00	1,022.00
		(₩환산)	1,005,874	1,119,393	1,119,993	1,163,320	1,121,701	1,147,399
		평 균	925.25	1,009.88	1,026.82	1,088.14	1,038.64	1,110.81
	거래량	최고(일)	55,329	51,557	76,863	76,483	95,469	48,751
		최저(일)	8,228	10,592	8,361	9,348	15,333	10,698
		월 간	456	522	514	606	658	567

※ 월간 거래량은 천DR 단위입니다.
※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준이며, 원주 1주당 2DR입니다.

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)] (단위 : $, 원, DR)

종 류			'17.4월	5월	6월	7월	8월	9월
우선주	주가	최 고	766.00	804.00	841.00	911.00	871.00	945.00
		(₩환산)	865,657	898,872	954,703	1,024,784	985,014	1,073,804
		최 저	681.00	763.00	781.00	805.00	794.00	831.00
		(₩환산)	776,204	865,624	876,126	921,725	906,033	940,277
		평 균	712.56	784.24	817.14	863.67	839.36	895.38
	거래량	최고(일)	10,322	37,396	7,514	12,349	11,484	11,762
		최저(일)	580	262	330	503	608	531
		월 간	43	114	53	69	73	88

※ 월간 거래량은 천DR 단위입니다.
※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준이며, 원주 1주당 2DR입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
권오현	남	1952.10	대표이사	등기임원	상근	이사회 의장 DS부문 경영전반 총괄	삼성전자 DS부문장	1,300	-	67개월	2018.03.15
윤부근	남	1953.02	대표이사	등기임원	상근	CE부문 경영전반 총괄	삼성전자 CE부문장	-	-	55개월	2019.03.14
신종균	남	1956.01	대표이사	등기임원	상근	IM부문 경영전반 총괄	삼성전자 IM부문장	-	-	55개월	2019.03.14
이재용	남	1968.06	사내이사	등기임원	상근	경영전반 총괄	삼성전자 부회장	840,403	-	12개월	2019.10.27
이인호	남	1943.11	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 신한은행 은행장	-	-	91개월	2019.03.18
김한중	남	1948.11	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 연세대학교 총장	-	-	67개월	2018.03.15
송광수	남	1950.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	김·장 법률사무소 고문	-	-	55개월	2019.03.14
이병기	남	1951.05	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교 명예교수	-	-	67개월	2018.03.15
박재완	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	성균관대학교 행정학과 교수	-	-	19개월	2019.03.11

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자		겸 직 회 사	
성 명	직 위	회사명	직 위
송광수	사외이사	(주)두산	사외이사
박재완	사외이사	롯데쇼핑(주)	사외이사
권오현	사내이사, 대표이사	삼성디스플레이(주)	사내이사, 대표이사

※ 2017년 9월 30일 기준입니다.
※ 상기 겸직자는 겸직회사의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
※ 이재용 사내이사는 2017년 4월 5일 EXOR N.V 사외이사직에서 사임했습니다.

다. 미등기임원

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
이건희	회장	1942.01	남	회장	대표이사 회장	서울대(博士)		비상근
윤주화	사장	1953.02	남	삼성사회봉사단장	삼성에버랜드 패션부문 대표이사	성균관대		상근
장원기	사장	1955.02	남	중국전략협력실장	중국본사장	연세대(碩士)		상근
김기남	사장	1958.04	남	반도체총괄	삼성디스플레이 대표이사	Univ. of California, LA(博士)		상근
김상균	사장	1958.07	남	법무실장	준법경영실장	서울대		상근
이상훈	사장	1955.06	남	경영지원실장	북미총괄 경영지원팀장	경북대		상근
전동수	사장	1958.08	남	의료기기사업부장	SDS 대표이사	경북대(碩士)		상근
성인희	사장	1957.01	남	의료사업일류화추진단장	정밀화학 대표이사	경희대		상근
이인용	사장	1957.03	남	커뮤니케이션팀장	경영지원총괄 홍보팀장	서울대		상근
김영기	사장	1962.01	남	네트워크사업부장	네트워크 신규사업개발팀장	Univ. of Southern California(博士)		상근
김종호	사장	1957.06	남	글로벌품질혁신실장	삼성중공업 생산부문장	숭실대		상근
김현석	사장	1961.01	남	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 개발팀장	Portland State Univ.(碩士)		상근
고동진	사장	1961.03	남	무선사업부장	무선 개발실장	Univ. of Sussex(碩士)		상근
정칠희	사장	1957.01	남	종합기술원장	종합기술원 副원장	Michigan State Univ.(博士)		상근
강인엽	부사장	1963.07	남	System LSI사업부장	System LSI SOC개발실장	Univ. of California, LA(博士)		상근
안승호	부사장대우	1959.07	남	법무실 IP센터장	종합기술원 IP전략팀장	Santa Clara Univ.(博士)		상근
조준형	부사장대우	1960.08	남	법무실 법무팀장	CEO 보좌역	동아대		상근
김상우	부사장대우	1961.10	남	구주총괄 대외협력팀장	구주총괄 법무지원팀장	Columbia Univ.(碩士)		상근
박재순	부사장	1960.08	남	생활가전 전략마케팅팀장	중국총괄	성균관대		상근
지재완	부사장대우	1957.09	남	법무실 해외법무팀장	법무실 준법지원팀장	Illinois, Urbana-Champaign(博士)		상근
강경훈	부사장	1964.08	남	인사팀 담당임원	경영전략팀 담당임원	경찰대		상근
박종서	부사장	1957.05	남	무선 구매팀장	일본본사 담당임원	건국대		상근
서병삼	부사장	1957.06	남	생활가전사업부장	생활가전 Global CS팀장	아주대		상근
엄영훈	부사장	1960.03	남	북미 副총괄	구주총괄	한국과학기술원(碩士)		상근
이상철	부사장	1960.06	남	동남아총괄	무선 전략마케팅실장	인하대		상근
이영희	부사장	1964.11	여	무선 마케팅팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)		상근
지완구	부사장	1958.02	남	경영지원실 안식년	경영혁신센터장	국민대		상근
팀백스터	부사장	1961.04	남	북미총괄	SEA법인장	Roger Williams Univ.		상근
박길재	부사장	1966.04	남	무선 제품기술팀장	무선 개발2실 담당임원	연세대(碩士)		상근
박동수	부사장	1962.06	남	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 개발팀장	한국과학기술원(博士)		상근
박병대	부사장	1959.02	남	한국총괄	생활가전 전략마케팅팀장	한국외국어대		상근
박종환	부사장	1961.12	남	전장사업팀장	생활가전 C&M사업팀장	연세대(碩士)		상근
배영창	부사장	1961.09	남	Foundry 전략마케팅팀장	System LSI 전략마케팅팀장	명지대		상근
안중현	부사장	1963.03	남	기획팀 담당임원	전략T/F장	한국과학기술원(碩士)		상근
왕통	부사장	1962.06	남	SCIC 담당임원	SRC-Beijing연구소장	北京郵電大(북경우전대)		상근
이준영	부사장	1959.08	남	영상디스플레이 안식년	영상디스플레이 구매팀장	숭실대		상근
진교영	부사장	1962.08	남	메모리사업부장	DS부문 반도체총괄 메모리사업부 DRAM개발실장	서울대(博士)		상근
최성호	부사장	1960.12	남	지원팀장	삼성디스플레이 경영지원실장	성균관대		상근
최영준	부사장	1962.02	남	경영지원실 안식년	재경팀 담당임원	부산대		상근
최정혁	부사장	1962.03	남	Test&Package센터장	메모리 품질보증실장	인하대		상근
김문수	부사장	1963.01	남	구주총괄	영상전략마케팅팀장	고려대		상근
김용관	부사장	1963.12	남	경영지원실 안식년	지원팀 담당임원	Thunderbird(碩士)		상근
남궁범	부사장	1964.01	남	재경팀장	경영지원팀 담당임원	고려대		상근
데이빗스틸	부사장	1966.09	남	커뮤니케이션팀 담당임원	북미총괄 기획홍보팀장	MIT(博士)		비상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
윤두표	부사장	1961.07	남	무선 안식년	무선 Global CS팀장	경북대		상근
정은승	부사장	1960.08	남	Foundry사업부장	반도체연구소장	Univ. of Texas, Arlington(博士)		상근
정태경	부사장	1963.10	남	LED사업팀장	Test&Package센터장	한국과학기술원(博士)		상근
주은기	부사장	1962.01	남	상생협력센터장	상생협력센터 대외협력팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
최경식	부사장	1962.03	남	무선 전략마케팅실장	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(碩士)		상근
최윤호	부사장	1963.01	남	무선 지원팀장	구주총괄 경영지원팀장	성균관대		상근
최주선	부사장	1963.05	남	DS부문 미주총괄	메모리 전략마케팅팀장	한국과학기술원(博士)		상근
황득규	부사장	1959.06	남	기흥/화성단지장	기흥/화성단지총괄	Boston Univ.(碩士)		상근
계승교	부사장	1963.12	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	SDS SDSA법인장	The Johns Hopkins Univ.(碩士)	15	상근
권계현	부사장	1964.07	남	중국총괄	SCIC Mobile Div.장	Univ. of Edinburgh(碩士)		상근
김용회	부사장	1961.02	남	영상디스플레이 구매팀장	생활가전 구매팀장	광운대		상근
박용기	부사장	1963.04	남	인사팀장	무선 인사팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
소병세	부사장	1962.09	남	SSIC 담당임원	SSIC 기술전략팀장	Univ.of Wisconsin, Madison(博士)		상근
신명훈	부사장대우	1965.01	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)		상근
심원환	부사장	1960.02	남	베트남복합단지장	구미지원센터장	경북대(碩士)		상근
장시호	부사장	1961.07	남	글로벌기술센터장	무선 Global제조센터장	한양대		상근
천강욱	부사장	1966.01	남	영상디스플레이 상품전략팀장	영상디스플레이 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
최철	부사장	1962.05	남	DS부문 중국총괄	SSC 담당임원	청화대(碩士)		상근
김석기	부사장	1962.11	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Global운영센터장	한양대		상근
김정환	부사장	1958.01	남	중남미총괄	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	한국외국어대		상근
이정배	부사장	1967.02	남	메모리 품질보증실장	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)		상근
최시영	부사장	1964.01	남	Foundry제조센터장	S.LSI제조센터장	The Ohio State Univ.(博士)		상근
한재수	부사장	1962.06	남	메모리 전략마케팅팀장	DS부문 미주총괄	성균관대		상근
홍현칠	부사장	1961.01	남	서남아총괄	SELA법인장	한국외국어대		상근
심순선	전무	1961.10	남	Global CS센터장	CS환경센터장	성균관대(碩士)		상근
안덕호	전무대우	1968.07	남	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	서울대		상근
이태협	전무	1960.05	남	성균관대(파견)	커뮤니케이션팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)		상근
김병균	전무	1963.06	남	경영지원실 안식년	중국총괄 지원팀장	Stanford Univ.(碩士)		상근
김하수	전무대우	1957.11	남	무선 금형기술팀장	무선 제품기술팀 담당임원	창원전문대		상근
박경군	전무	1962.10	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	동아대		상근
서병훈	전무	1963.07	남	커뮤니케이션팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(博士)		상근
윤한길	전무	1962.09	남	무선 상품전략팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Florida(博士)		상근
이명진	전무	1958.08	남	IR그룹장	커뮤니케이션팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo		상근
이상주	전무대우	1970.09	남	법무실 Compliance팀장	법무실 준법지원팀 담당임원	Harvard Univ.(碩士)		상근
이종철	전무대우	1968.01	남	북미총괄 법무지원팀장	법무실 준법지원팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(碩士)	43	상근
이진곤	전무	1963.02	남	생활가전 Global제조팀장	SSEC법인장	한양대		상근
이충로	전무	1958.10	남	경영지원실 안식년	중동총괄	한국과학기술원(碩士)		상근
전준영	전무	1962.05	남	DS부문 구매팀장	System LSI 기획팀장	성균관대		상근
최영규	전무	1961.03	남	무선 PC사업팀장	무선 개발실 담당임원	서울대(碩士)		상근
강윤제	전무대우	1968.08	남	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인 담당임원	청주대		상근
김의탁	전무	1958.06	남	CIS총괄	영상전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대		상근
김재윤	전무	1963.03	남	기획팀장	삼성경제연구소 산업전략1실장	서울대(博士)	21	상근
백수현	전무	1963.01	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대	48	상근
윤철운	전무	1962.11	남	영상디스플레이 Global CS팀장	SAMEX법인장	한국과학기술원(碩士)		상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
이상수	전무	1960.07	남	영상디스플레이 안식년	SEHC법인장	성균관대		상근
이인정	전무대우	1961.10	남	법무실 IP센터 라이센싱팀장	IP센터 IP법무팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)		상근
임상모	전무	1963.06	남	경영지원실 안식년	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign (碩士)		상근
전용성	전무	1958.06	남	경영지원실 안식년	동남아총괄	건국대		상근
정수연	전무	1961.06	남	무선 Global제조센터 담당임원	SEV법인장	금오공대		상근
조용철	전무	1962.01	남	TSE-S법인장	커뮤니케이션팀 담당임원	서강대		상근
조호석	전무	1963.10	남	구미지원센터장	SEV 담당임원	영남대		상근
최구연	전무	1962.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	한양대		상근
최홍섭	전무	1962.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성물산 커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(碩士)	57	상근
강봉용	전무	1964.01	남	DS부문 지원팀장	메모리 지원팀장	고려대		상근
강창진	전무	1961.08	남	DS부문 기획팀장	DS부문 감사팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
김도형	전무	1958.09	남	SEHC법인장	SEPM법인장	아주대		상근
김언수	전무	1963.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	GMO 브랜드전략팀장	고려대		상근
김원경	전무	1967.08	남	북미총괄 대외협력팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(碩士)		상근
김유영	전무	1958.10	남	아프리카총괄	SEIN-S법인장	한국외국어대		상근
명성완	전무	1962.03	남	중동총괄	SEG법인장	한국외국어대		상근
박문호	전무	1965.01	남	인사팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대		상근
박윤상	전무	1963.06	남	무선 PSI팀 담당임원	무선 개발1실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)		상근
박정준	전무	1962.03	남	경영지원실 안식년	SCIC 담당임원	홍익대		상근
박찬훈	전무	1962.04	남	SAS법인장	SCS법인장	電氣通信大學(博士)		상근
박현호	전무	1962.05	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	계명대		상근
배주천	전무대우	1958.11	남	기흥/화성단지 전기제어기술팀장	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	숭실대(博士)		상근
서기용	전무	1960.11	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SECA법인장	연세대(碩士)		상근
신재경	전무	1963.01	남	Test&Package센터 담당임원	SESS법인장	서울대(碩士)		상근
안정태	전무	1964.02	남	영상디스플레이 지원팀장	북미총괄 지원팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign (碩士)		상근
양걸	전무	1962.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	서강대(碩士)		상근
오수열	전무	1960.07	남	네트워크 Global제조팀장	네트워크 Global운영팀장	아주대		상근
이봉주	전무	1963.03	남	DS부문 인사팀장	System LSI 인사팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
장호식	전무대우	1963.10	남	법무실 IP센터 IP전략팀장	IP센터 IP전략팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)		상근
정경진	전무	1961.04	남	감사팀장	영상디스플레이 지원팀장	충남대		상근
최진원	전무	1966.09	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대		상근
추종석	전무	1962.09	남	영상전략마케팅팀장	영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(碩士)		상근
강봉구	전무	1962.02	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	홍익대		상근
김경준	전무	1965.02	남	무선 Global CS팀장	무선 개발2실 담당임원	한양대(碩士)		상근
김정호	전무	1964.04	남	재경팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	Emory Univ.(碩士)		상근
백지호	전무	1964.09	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(碩士)		상근
송두헌	전무	1964.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
신동훈	전무	1963.02	남	생활가전 안식년	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Warwick(碩士)		상근
이왕익	전무	1963.07	남	재경팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
이윤	전무	1959.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	중남미총괄 마케팅팀장	Univ. of Washington, Seattle(碩士)		상근
이춘재	전무	1959.10	남	영상디스플레이 Global운영팀장	SEDA-P(M)공장장	경북대		상근
이평우	전무	1963.11	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	성균관대		상근
이흥모	전무대우	1962.10	남	DMC연구소 IP출원팀장	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)		상근
장성학	전무	1963.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	아주대(碩士)		상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
정진수	전무	1959.05	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 네트워크영업팀장	경북대		상근
최주호	전무	1963.03	남	무선 인사팀장	인사팀 담당임원	아주대(碩士)		상근
하혜승	전무	1967.11	여	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Wellesley Coll.		상근
황규철	전무	1964.09	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
고승환	전무	1962.09	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당임원	인하대		상근
김동욱	전무	1963.09	남	SEVT법인장	SEVT 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
김범동	전무	1963.02	남	Foundry 인사팀장	System LSI 인사팀장	고려대(碩士)		상근
김사필	전무	1965.04	남	상생협력센터 대외협력팀장	인사팀 담당임원	경찰대		상근
김성진	전무	1965.03	남	생활가전 지원팀장	지원팀 담당임원	고려대		상근
김진해	전무	1963.12	남	한국총괄 모바일영업팀장	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	광운대		상근
목장균	전무	1964.03	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대		상근
민장식	전무	1963.11	남	무선 안식년	무선 제품기술팀 담당임원	중앙대		상근
백홍주	전무	1961.12	남	메모리제조센터장	SCS법인장	인하대		상근
변성호	전무	1964.01	남	무선 안식년	무선 전략마케팅실 담당임원	경북대		상근
성일경	전무	1964.01	남	SEG법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	연세대		상근
신재호	전무	1964.11	남	메모리 지원팀장	SCS법인 담당임원	성균관대		상근
심상필	전무	1965.05	남	SAS 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
심의경	전무	1964.10	남	메모리 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
윤성희	전무	1964.12	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	영남대		상근
이강협	전무	1962.12	남	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대		상근
이민혁	전무대우	1972.02	남	무선 디자인팀장	무선 디자인팀 담당임원	경희대		상근
이상규	전무	1961.06	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경운대		상근
이성수	전무	1964.11	남	DS부문 감사팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경희대		상근
이승욱	전무	1967.02	남	기획팀 담당임원	삼성SDI 감사팀장	Akron(博士)	35	상근
전세원	전무	1964.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	SSI법인 담당부장	홍익대		상근
최방섭	전무	1963.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	지원팀 담당임원	서울대		상근
최승범	전무	1964.12	남	소프트웨어센터 S/W전략팀장	지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
최원진	전무	1964.01	남	한국총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대		상근
최정준	전무	1965.08	남	지원팀 담당임원	한국총괄 지원팀장	성균관대		상근
홍두희	전무	1964.02	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	Wake Forest Univ.(碩士)		상근
강석립	전무	1964.10	남	기흥/화성단지 시스템기술팀장	메모리 제조센터 담당임원	경북대		상근
김경진	전무	1963.11	남	SAMEX법인장	SESK법인장	숭실대		상근
김완수	전무	1961.08	남	SEM-P법인장	SIEL-P(N)공장장	삼성전자기술대학(碩士)		상근
김우준	전무	1968.05	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	차세대사업팀 담당임원	서울대(博士)		상근
나기홍	전무	1966.03	남	인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	고려대		상근
박봉주	전무	1963.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	서강대		상근
부성종	전무	1964.10	남	경영혁신센터 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대		상근
스틴지아노	전무	1966.02	남	SEA 담당임원	SEA CB Div. SVP	Rutgers Univ.	58	상근
이병철	전무	1965.10	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	청화대(淸華大)(碩士)		상근
이현식	전무	1964.12	남	한국총괄 B2B영업팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
임백균	전무	1963.02	남	SCS법인장	메모리제조센터 담당임원	삼성전자기술대학(碩士)		상근
채원철	전무	1966.05	남	무선 기술전략팀장	무선 기술관리팀장	광운대		상근
황동준	상무	1960.09	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	숭실대		상근
강승구	상무	1963.08	남	서남아총괄 SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한양대		상근
김재훈	상무대우	1972.08	남	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)		상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
고홍선	상무	1965.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	한양대(碩士)		상근
곽진환	상무	1968.01	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 기술분석팀 담당임원	Santa Clara Univ.(碩士)		상근
김교익	상무	1961.01	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	성균관대		상근
김기원	상무	1963.04	남	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(碩士)	47	상근
김병욱	상무	1963.08	남	기흥/화성단지 지원팀 담당임원	재경팀 담당임원	고려대		상근
김영수	상무대우	1968.07	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대	54	상근
김인철	상무	1962.09	남	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당임원	국민대(碩士)		상근
김정원	상무	1959.04	남	DS부문 안식년	기흥/화성단지총괄 건설팀 담당임원	중앙대(碩士)	21	상근
김진성	상무	1963.02	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	아주대		상근
김학태	상무	1964.08	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SECA법인장	경북대		상근
문양춘	상무	1963.12	남	생활가전 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 수석	조선대		상근
박재천	상무	1965.10	남	한국총괄 안식년	한국총괄 마케팅팀장	영남대		상근
박진호	상무	1961.07	남	의료기기 안식년	의료기기 전략마케팅팀장	서울대(碩士)		상근
송기찬	상무	1963.05	남	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	성균관대		상근
송원득	상무대우	1964.01	남	법무실 IP센터 담당임원	반도체 지적재산팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
안윤순	상무	1964.06	남	SEH-P법인장	SERK법인장	인하대		상근
유석영	상무	1963.04	남	SCS 담당임원	반도체연구소 인사팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor (碩士)		상근
윤성혁	상무	1962.09	남	SSA법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign (碩士)		상근
이광성	상무	1963.07	남	인재개발원副원장	영상디스플레이 인사팀장	Keio Univ.(碩士)		상근
이병국	상무	1965.11	남	무선 Global제조센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	부산대		상근
이재엽	상무	1966.08	남	SET법인장	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대		상근
장수철	상무	1961.09	남	DS부문 안식년	Test&Package센터 제조기술3팀장	아주대(碩士)		상근
허정호	상무	1962.06	남	중국총괄 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Long Island Univ.(碩士)		상근
황우찬	상무	1962.10	남	제도개선T/F 담당임원	신문화T/F 담당임원	한양대(碩士)		상근
김남용	상무	1965.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	연세대		상근
김대현	상무	1964.08	남	SETK법인장	SEI법인장	한국과학기술원(碩士)		상근
김명욱	상무	1961.01	남	SSEC법인장	SIEL-P(N)공장장	인하대		상근
김상규	상무	1968.01	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당임원	서울대(碩士)		상근
김선식	상무	1964.06	남	Test&Package센터 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	성균관대(碩士)		상근
김영도	상무	1962.12	남	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 구매전략팀 담당부장	경북대		상근
김이태	상무	1966.02	남	기획팀 담당임원	IR그룹 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(博士)	17	상근
김종신	상무	1963.10	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(碩士)		상근
김창한	상무	1963.01	남	DS부문 기획팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	성균관대		상근
김현도	상무	1966.04	남	영상디스플레이 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
김현주	상무	1965.06	남	SEJ법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	광운대		상근
남정현	상무대우	1964.04	남	글로벌기술센터 제조혁신팀장	삼성중공업 생산부문 담당임원	천안공고		상근
류문형	상무	1965.07	남	북미총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	서울대		상근
문성우	상무	1971.12	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	한국과학기술원(博士)		상근
문태경	상무	1962.03	남	한국총괄 B2C영업팀장	한국총괄 중부지사장	고려대		상근
박경철	상무	1964.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEDA-S 판매부문장	연세대		상근
박봉출	상무	1964.01	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	인사팀 담당부장	숭실대		상근
박영우	상무	1962.11	남	SESS법인장	메모리 Solution개발실 담당임원	인천대		상근
박진영	상무	1964.02	남	무선 안식년	무선 전략마케팅실 담당임원	Tsukuba Univ.(碩士)		상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
박찬호	상무	1964.07	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	서울대(碩士)		상근
서동면	상무	1963.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한양대		상근
서양석	상무	1966.10	남	서남아총괄 지원팀장	정보전략팀 담당임원	Thunderbird(碩士)		상근
송봉섭	상무	1965.04	남	인사팀 담당임원	생활가전 인사팀장	경북대		상근
송하석	상무	1963.07	남	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	성균관대		상근
신종민	상무	1962.10	남	SEV법인장	TSTC법인장	울산대		상근
양준호	상무대우	1971.02	남	무선 디자인팀 담당임원	디자인경영센터 차세대디자인팀 담당임원	세종대		상근
오세용	상무	1962.06	남	동남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	중앙대		상근
오창건	상무	1962.01	남	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(碩士)		상근
음두찬	상무	1965.12	남	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	SRA-SV연구소장	한국과학기술원(碩士)		상근
이계성	상무대우	1967.11	남	법무실 담당임원	법무실 준법지원팀 담당임원	St. Louis Univ.(碩士)		상근
이규열	상무	1966.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 수석	항공대		상근
이상욱	상무	1964.06	남	무선 기술전략팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	서울대(博士)	33	상근
임성택	상무	1966.06	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	연세대		상근
장성재	상무	1965.06	남	지원팀 담당임원	감사팀 담당임원	서강대		상근
전승준	상무	1962.06	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	한양대(碩士)		상근
정윤	상무	1967.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SETK법인장	서울대(博士)		상근
조덕현	상무	1966.02	남	중동총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	경북대		상근
진연탁	상무	1963.05	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	성균관대(碩士)		상근
최수영	상무	1965.11	남	생활가전 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	고려대		상근
최승식	상무	1966.01	남	SERC 담당임원	SEKZ법인장	고려대		상근
최윤범	상무	1963.02	남	SEVT 담당임원	Media Solution센터 지원팀장	경원대		상근
한승훈	상무	1965.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Iowa State Univ.(博士)		상근
한인국	상무	1964.11	남	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한양대		상근
홍성룡	상무	1963.11	남	무선 PC사업팀 담당임원	아프리카총괄	고려대(碩士)		상근
강동훈	상무대우	1970.12	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)		상근
강민호	상무	1964.05	남	네트워크 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	경북대		상근
권재훈	상무	1964.04	남	SEIN-S법인장	SEAU법인장	한국외국어대		상근
김기선	상무	1968.04	여	무선 상품전략팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	성균관대(碩士)		상근
김도현	상무대우	1975.03	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대		상근
김동욱	상무	1968.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대(碩士)		상근
김동진	상무	1963.06	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	연세대		상근
김동환	상무	1964.06	남	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	항공대		상근
김민섭	상무	1966.02	남	Test&Package센터 지원팀장	DS부문 지원팀 담당임원	성균관대		상근
김성환	상무	1964.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEM-S법인장	고려대(碩士)		상근
김영수	상무	1966.08	남	SESA법인장	SGE법인장	서강대		상근
김영윤	상무	1961.08	남	소프트웨어센터 안식년	소프트웨어센터 S/W전략팀 담당임원	연세대		상근
김영태	상무	1963.10	남	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	서울대		상근
김영호	상무	1964.12	남	감사팀 담당임원	재경팀 담당임원	Tulane Univ.(碩士)		상근
김유석	상무대우	1965.04	남	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 IP전략팀 담당임원	Washington Univ. in St. Louis (博士)		상근
김정렬	상무	1963.03	남	LED사업팀 담당임원	SSW 담당임원	경희대		상근
김종헌	상무	1966.08	남	생활가전 인사팀장	인사팀 담당임원	육사		상근
김태관	상무	1965.01	남	구주총괄 지원팀장	생활가전 지원팀 담당임원	고려대		상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
더못라이언	상무	1962.09	남	DS부문 구주총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical College		상근
바우만	상무	1966.05	남	SEUK법인장	SEPOL법인장	Univ. of Bath(碩士)		상근
박경호	상무	1965.06	남	종합기술원 기획팀장	종합기술원 CTO전략팀 담당임원	성균관대		상근
박성호	상무	1968.09	남	SEHZ법인장	SEV 담당임원	경북대(碩士)		상근
박윤희	상무	1965.09	남	SEMAG법인장	글로벌마케팅실 채널전략팀장	서울대		상근
배학범	상무	1963.08	남	SEDA-P(M) 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	경희대		상근
백수하	상무	1964.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한양대	48	상근
손기태	상무	1967.12	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	서울대		상근
신동호	상무	1963.10	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	S.LSI Global운영팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)		상근
안민용	상무	1963.06	남	Test&Package센터 품질팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경북대		상근
안용일	상무대우	1971.02	남	디자인경영센터 UX센터장	디자인경영센터 디자인전략팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
안정수	상무	1964.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 수석	고려대		상근
양경택	상무	1964.02	남	SEHC 담당임원	한국총괄 지원팀장	서강대		상근
양석환	상무	1962.05	남	SEA 담당임원	SALS법인장	Purdue Univ.(碩士)		상근
엄재훈	상무	1966.06	남	SCIC 담당임원	중국총괄 Retail Management팀장	서강대(碩士)		상근
이경태	상무	1966.12	남	무선 기획팀장	지원팀 담당임원	서울대(碩士)		상근
이동근	상무	1963.01	남	무선 인사팀 담당임원	정보보호센터 담당부장	고려대(博士)		상근
이상배	상무	1963.03	남	Foundry제조센터 담당임원	System LSI TD팀 담당임원	광운대(博士)		상근
이상우	상무대우	1972.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대	28	상근
이선영	상무	1965.04	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한양대		상근
이승백	상무	1964.02	남	DS부문 커뮤니케이션팀장	DS부문 인사팀 담당임원	중앙대		상근
이우섭	상무	1966.05	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	성균관대		상근
이창영	상무	1963.01	남	무선 안식년	무선 Global CS팀 담당임원	경북대		상근
이태관	상무대우	1971.12	남	법무실 담당임원	삼성물산 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(碩士)	57	상근
임성관	상무	1962.02	남	LED사업팀 품질팀장	System LSI 품질 담당임원	경북대		상근
임휘용	상무	1965.02	남	네트워크 인사팀장	수원지원센터 인사팀장	서강대		상근
장재혁	상무	1967.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	중앙대		상근
전경빈	상무	1966.12	남	Global CS센터 품질혁신팀장	CS환경센터 품질혁신팀장	한국과학기술원(博士)		상근
정광열	상무	1965.09	남	커뮤니케이션팀 담당임원	DMC부문 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
정기수	상무	1965.02	남	글로벌기술센터 담당임원	수원지원센터 인사팀장	연세대		상근
정상섭	상무	1966.11	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
정상인	상무대우	1969.06	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(碩士)		상근
정영락	상무	1962.10	남	SEI법인장(Co)	영상전략마케팅팀 담당임원	단국대		상근
정홍구	상무	1964.08	남	무선 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	고려대		상근
조상호	상무	1965.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEUK법인장	경희대		상근
최길현	상무	1966.10	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	한양대(碩士)		상근
최완우	상무	1965.02	남	DS부문 인사팀 담당임원	Test&Package센터 인사팀장	서강대		상근
최중열	상무대우	1967.06	남	생활가전 디자인팀장	생활가전 디자인 담당임원	서울대(碩士)		상근
허국	상무	1965.08	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	서강대		상근
허길영	상무	1965.08	남	DS부문 지원팀 담당임원	Test&Package센터 지원팀장	아주대(碩士)		상근
홍승오	상무	1968.10	남	기획팀 담당임원	경영지원실 사업전략 담당부장	London Business Sch. (LBS) (碩士)		상근
가네코	상무	1958.12	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 VP	Musashi Univ.	58	상근
강윤석	상무	1964.05	남	LED사업팀 담당임원	Test&Package센터 인사팀장	성균관대(碩士)	58	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
강인규	상무대우	1968.05	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대	22	상근
강현석	상무	1963.08	남	SIEL-S 담당임원	SEPOL 담당부장	서강대	58	상근
고희권	상무	1965.08	남	창조경제지원센터 담당임원	기획팀 담당임원	연세대(碩士)	58	상근
권태훈	상무	1968.02	남	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	North Carolina, Chapel Hill(碩士)	58	상근
김개연	상무	1969.10	남	무선 상품전략팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(碩士)	58	상근
김경훈	상무대우	1974.01	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인 담당임원	중앙대	58	상근
김도현	상무	1965.04	남	SECH법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	항공대	58	상근
김동관	상무	1969.10	남	인사팀 담당임원	SDS 보안선진화T/F장	한양대	58	상근
김방룡	상무	1964.04	남	경영지원실 안식년	지원팀 담당임원	성균관대	58	상근
김병주	상무	1966.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당부장	중앙대	58	상근
김요정	상무	1965.04	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI 제품기술팀장	포항공대(碩士)	58	상근
김윤수	상무	1967.12	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SECE법인장	Thunderbird(碩士)	58	상근
김은중	상무	1965.06	남	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	성균관대	58	상근
김정봉	상무	1965.07	남	경력컨설팅센터장	인사팀 담당임원	부산대	21	상근
김종근	상무	1967.06	남	SEDA-P(M) 담당임원	무선 Global제조센터 Global제조 지원팀장	경북대(碩士)	58	상근
김종두	상무	1964.09	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	부산대	58	상근
김종민	상무	1968.03	남	IRO	인력개발원 담당부장	Univ. of Pennsylvania(碩士)	58	상근
김형남	상무	1965.06	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	감사팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	58	상근
김호진	상무	1966.08	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당부장	성균관대	58	상근
까를로	상무	1971.01	남	SEI법인장(Co)	SEI 副법인장	UNIVERSITA STATALE DI MILANO (碩士)	58	상근
나운천	상무	1967.02	남	SEA 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)	58	상근
남길준	상무	1963.08	남	SECA법인장	SEA 담당임원	서강대	58	상근
노형훈	상무	1964.11	남	TSE-P법인장	SSEC 담당부장	고려대	58	상근
마틴	상무	1970.02	남	SEG 副법인장	SEG 담당임원	Staatl. Berufsakademie Mannheim	58	상근
맹경무	상무	1970.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(博士)	58	상근
박광채	상무	1964.04	남	의료기기 지원팀장	수원지원센터 지원팀장	서울대	58	상근
박동수	상무	1966.12	남	Global CS센터 Global서비스팀장	CS환경센터 Global서비스팀장	광주대	58	상근
박범주	상무	1966.04	남	인재개발원 담당임원	인재개발센터 담당부장	성균관대(博士)	58	상근
박석민	상무	1970.12	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	Univ. of Texas, Austin(博士)	58	상근
박찬우	상무	1973.05	남	무선 상품전략팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	58	상근
방현우	상무	1967.07	남	베트남복합단지 대외협력팀장	서남아총괄 대외협력팀장	고려대(碩士)	58	상근
서응교	상무	1964.11	남	지원팀 담당임원	서남아총괄 경영지원팀장	서울대	58	상근
손명식	상무	1966.10	남	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당임원	숭실대	58	상근
신성우	상무	1965.12	남	SAS 담당임원	SAS 담당부장	연세대	58	상근
신왕철	상무	1965.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 개발실 수석	서강대	58	상근
안병진	상무	1966.02	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(碩士)	58	상근
안준언	상무	1965.07	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	경운대	58	상근
안진	상무	1966.02	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SDC 감사팀 담당임원	인하대	33	상근
양동성	상무	1967.12	남	DS부문 구주총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	성균관대	58	상근
오시연	상무	1971.02	여	중국총괄 지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(碩士)	33	상근
오창민	상무	1965.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEJ 담당임원	서울대(碩士)	58	상근
오치오	상무	1967.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	종합기술원 인사팀 담당부장	건국대(碩士)	58	상근
유우석	상무	1963.08	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	성균관대	58	상근
윤여봉	상무	1964.10	남	Saudi Arabia지점장	SGE법인장	고려대	57	상근
윤태양	상무	1968.12	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대(碩士)	58	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
이기호	상무	1964.06	남	SEPCO법인장	SEA 담당임원	성균관대	58	상근
이람	상무	1962.07	남	SAMEX 담당임원	SAMEX 담당임원	Alliant International Univ.(碩士)	58	상근
이민규	상무	1963.10	남	종합기술원 지원팀장	아프리카총괄 지원팀장	연세대	58	상근
이상길	상무	1965.08	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 구주총괄 담당부장	서강대	58	상근
이상재	상무	1965.06	남	서남아총괄 대외협력팀장	글로벌기술센터 담당임원	중앙대	58	상근
이성민	상무	1964.09	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	성균관대	58	상근
이승구	상무	1969.08	남	인사팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대	58	상근
이영태	상무대우	1963.09	남	SEVT 담당임원	SEV 담당임원	삼성경영기술대학	58	상근
이정주	상무	1964.06	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당부장	고려대	58	상근
이철희	상무	1963.04	남	SEV 담당임원	무선 지원팀 담당임원	성균관대	58	상근
이헌	상무	1969.02	남	SEAU법인장	SEPCO법인장	Syracuse Univ.(碩士)	58	상근
이홍빈	상무	1964.04	남	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당임원	명지대	58	상근
장문석	상무	1969.03	남	무선 Global운영팀장	무선 Global운영팀 담당임원	항공대	58	상근
장성대	상무	1964.08	남	기흥/화성단지 건설팀장	기흥/화성단지총괄 Facility팀장	동국대	58	상근
전용병	상무	1966.08	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	북경대(碩士)	58	상근
정광명	상무	1964.04	남	생활가전 광주지원팀장	무선 인사팀 담당부장	전남대	58	상근
정사율	상무	1966.11	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	고려대	58	상근
정완영	상무	1965.05	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	고려대	58	상근
정재신	상무	1964.08	남	중남미총괄 물류혁신팀장	경영혁신팀 담당임원	서강대	33	상근
조성수	상무	1966.12	남	SSEC 담당임원	프린팅솔루션 지원팀 담당임원	서울대	58	상근
조용휘	상무	1968.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	58	상근
조인하	상무	1974.02	여	영상전략마케팅팀 담당임원	SEASA 담당부장	서강대(碩士)	58	상근
조재식	상무	1963.04	남	무선 안식년	무선 제품기술팀 담당임원	경북대	58	상근
주재훈	상무	1964.11	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 개발실 수석	한양대	58	상근
주창훈	상무	1970.10	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(碩士)	58	상근
지현기	상무	1968.01	남	메모리 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	58	상근
최경록	상무	1971.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	SRC-Tianjin연구소장	경북대(碩士)	58	상근
케빈리	상무	1962.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin	58	상근
폴브래넌	상무	1960.11	남	SECA 담당임원	SECA VP	Carleton Univ.	58	상근
홍유진	상무대우	1972.05	여	무선 UX혁신팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of California, LA(碩士)	58	상근
홍종서	상무	1966.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	고려대	58	상근
가르시아	상무	1972.08	남	SESA 담당임원	SESA VP	ESADE(碩士)	46	상근
고상범	상무대우	1965.10	남	무선 금형기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	부산대	46	상근
김광진	상무	1965.12	남	SCIC 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	고려대	46	상근
김기건	상무	1964.02	남	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당부장	광운대	46	상근
김기훈	상무	1968.05	남	SEI 담당임원	지원팀 담당임원	Univ. of Baltimore(碩士)	46	상근
김대원	상무	1965.11	남	SEF법인장	SEF 副법인장	성균관대(碩士)	46	상근
김병도	상무	1967.03	남	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅실 디지털전략팀장	서강대(碩士)	46	상근
김상용	상무	1970.11	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당임원	연세대	46	상근
김세호	상무	1967.10	남	SENA법인장	SEAD법인장	동국대	46	상근
김수진	상무	1969.08	여	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성물산 커뮤니케이션팀 담당임원	Pennsylvania(博士)	22	상근
김승민	상무	1967.03	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대	46	상근
김연성	상무	1966.05	남	중남미총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	MIT(碩士)	46	상근
김재묵	상무	1965.05	남	상생협력센터 구매전략팀 담당임원	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	국민대	46	상근
김재준	상무	1968.01	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)	46	상근
김정우	상무	1965.04	남	SEPOL법인장	SEROM법인장	고려대	46	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
김종균	상무	1966.08	남	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대	46	상근
김진수	상무대우	1971.10	남	디자인경영센터 차세대디자인팀 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대	46	상근
김철기	상무	1968.03	남	SAMNA-S법인장	SME 담당부장	경북대	46	상근
김태경	상무	1968.12	남	경영지원실 안식년	중국총괄 지원팀 담당임원	부산대	46	상근
김형준	상무	1966.11	남	무선 지원팀 담당임원	SAMEX 담당부장	Emory Univ.(碩士)	46	상근
김희선	상무	1969.10	여	무선 마케팅팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Duke Univ.(碩士)	46	상근
노상석	상무	1964.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대	46	상근
데니맥글린	상무	1966.11	남	SEA 담당임원	SEA SVP	Villanova Univ.(碩士)	46	상근
라스얀손	상무	1961.10	남	구주총괄 안식년	SENA 담당임원	RMI Berghs전문대	46	상근
메노	상무	1968.06	남	SEBN 담당임원	SEBN VP	Haarlem Business School	46	상근
문국열	상무	1969.01	남	SEV 담당임원	무선 Global제조센터 담당부장	구미1전문대	46	상근
박광준	상무	1964.11	남	기흥/화성단지 지원팀장	기흥/화성단지총괄 지원팀장	숭실대	46	상근
박순철	상무	1966.07	남	지원팀 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	연세대	46	상근
박정현	상무	1964.09	남	SCA법인장	SEEA법인장	서강대	46	상근
박태수	상무	1962.11	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	중앙대	46	상근
박효상	상무	1967.08	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한양대	46	상근
백종수	상무	1971.01	남	전장사업팀 담당임원	기획팀 담당임원	서울대(碩士)	46	상근
서경욱	상무	1966.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SAPL법인장	Michigan State Univ.(碩士)	46	상근
서기호	상무	1964.03	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	항공대	46	상근
서형석	상무	1968.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	연세대(碩士)	46	상근
석종욱	상무	1969.06	남	TSLED법인장	기흥/화성단지총괄 LED제조팀장	광운대	46	상근
손성원	상무	1969.02	남	지원팀 담당임원	SEG 담당임원	연세대(碩士)	46	상근
송명주	상무	1970.02	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	동남아총괄 마케팅팀 담당부장	서강대(碩士)	46	상근
송현주	상무대우	1969.03	여	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 디자인 수석	한국과학기술원(碩士)	46	상근
신용인	상무	1969.11	남	SEVT 담당임원	SEV 담당임원	서강대	46	상근
심재덕	상무	1973.07	남	중국전략협력실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	46	상근
안상호	상무	1965.03	남	Test&Package센터 Package 기술팀장	Test&Package센터 Package 기술팀장	한국과학기술원(碩士)	46	상근
안재우	상무	1969.12	남	중국총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	고려대	46	상근
안해원	상무대우	1963.05	남	무선 금형기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	금오공대(博士)	46	상근
양예목	상무	1965.03	남	생활가전 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임원	항공대	46	상근
여명구	상무	1970.10	남	DS부문 인사팀 담당임원	기흥/화성단지총괄 인사팀장	충북대	46	상근
연경희	상무	1971.08	여	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	SENZ법인장	경원대	46	상근
오병민	상무	1967.02	남	기흥/화성단지 보건관리팀장	기흥/화성단지총괄 환경안전팀 담당임원	광운대	46	상근
오종훈	상무	1969.10	남	Foundry 지원팀장	System LSI 지원팀장	Purdue Univ.(碩士)	46	상근
원종현	상무	1967.05	남	SAMEX 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	성균관대	46	상근
윤종상	상무	1965.12	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	연세대	46	상근
윤준오	상무	1967.06	남	기획팀 담당임원	기획팀 담당임원	건국대	46	상근
윤창훈	상무	1965.06	남	SEDA-S 담당임원	무선 광소재사업팀장	경희대	46	상근
이경우	상무	1965.10	남	SRJ 경영지원실장	IRO	도시샤대(博士)	46	상근
이규호	상무	1969.06	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	서강대	46	상근
이동우	상무	1967.06	남	System LSI 기획팀장	감사팀 담당임원	경북대	46	상근
이동준	상무	1970.12	남	DMC연구소 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	고려대	46	상근
이상훈	상무	1963.09	남	SME법인장	글로벌B2B센터 담당임원	항공대	46	상근
이성현	상무	1966.07	남	SELA법인장	SAMCOL법인장	홍익대	46	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
이영순	상무	1966.10	여	인사팀 담당임원	인재개발원 담당임원	한국과학기술원(碩士)	46	상근
이영호	상무	1967.07	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당임원	Univ. of Maryland, Coll. Park(碩士)	46	상근
이원준	상무	1970.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대	46	상근
이재용	상무	1969.04	남	무선 개발1실 담당임원	소프트웨어센터 Big Data센터 담당임원	London Sch. of Economics(博士)	46	상근
이철구	상무	1968.07	남	SEVT 담당임원	SEV 담당부장	강남대	46	상근
이청용	상무	1968.12	남	SGE법인장	글로벌마케팅센터 담당임원	MIT(碩士)	46	상근
이충순	상무	1967.09	남	SERC 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대	46	상근
이환구	상무	1964.03	남	DS부문 지원팀 담당임원	DS부문 구주총괄 담당임원	성균관대	46	상근
임성욱	상무	1964.02	남	SEDA-P(C) 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	영남대	46	상근
임종규	상무	1965.06	남	경영지원실 안식년	경영혁신팀 담당임원	연세대	46	상근
장다니엘	상무	1971.07	남	무선 안식년	무선 전략마케팅실 담당임원	REIMS Management School(碩士)	46	상근
장호영	상무	1968.01	남	SEV 담당임원	무선 Global운영실 구매 담당부장	경북대	46	상근
전필규	상무	1968.11	남	북미총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	HELSINKI SCH OF ECNOMICS (碩士)	46	상근
정훈	상무	1969.01	남	SEBN법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	홍익대	46	상근
조규일	상무	1968.09	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발2실 담당임원	포항공대(碩士)	46	상근
조기재	상무	1964.05	남	지원팀 담당임원	메모리 지원팀장	Babson Coll.(碩士)	46	상근
조성혁	상무	1970.05	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of California, Berkeley(碩士)	46	상근
조시정	상무	1969.11	남	인사팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대	46	상근
조언호	상무	1965.12	남	Test&Package센터 제조기술2팀장	Test&Package센터 TEST기술팀장	경북대	46	상근
조종욱	상무	1969.08	남	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	성균관대	46	상근
조홍상	상무	1966.06	남	SEM-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	46	상근
쥬이시앙	상무	1972.12	남	SAPL법인장	SME 담당임원	Naional Univ. of Singapore(碩士)	45	상근
진문구	상무	1965.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	46	상근
짐엘리엇	상무	1970.11	남	DS부문 미주총괄 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.	46	상근
채민영	상무	1966.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당부장	중앙대	46	상근
천경율	상무	1965.02	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당부장	서강대	46	상근
천문식	상무	1963.10	남	재경팀 담당임원	지원팀 담당임원	경북대	46	상근
최상진	상무	1967.03	남	메모리제조센터 담당임원	생산기술연구소 담당임원	포항공대(碩士)	46	상근
최승걸	상무	1968.12	남	기흥/화성단지 Facility팀장	SCS 담당임원	서울시립대	46	상근
최익수	상무	1967.05	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign (碩士)	46	상근
피재걸	상무	1964.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)	46	상근
하영욱	상무	1964.01	남	DS부문 미주총괄 담당임원	SSIC 담당임원	HELSINKI SCH OF ECNOMICS (碩士)	46	상근
한성우	상무	1964.09	남	경영지원실 안식년	SSA법인장	인하대	46	상근
한장수	상무	1970.02	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 책임변호사	State Univ. of New York, Buffalo (博士)	45	상근
허성회	상무	1969.01	남	SCS 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	46	상근
홍경헌	상무	1963.01	남	글로벌기술센터 제조기술팀장	글로벌기술센터 자동화기술팀 담당임원	영남대	46	상근
홍범석	상무	1968.06	남	Iran지점장	SELV법인장	중앙대	46	상근
홍성희	상무	1966.02	남	DS부문 구매팀 담당임원	Test&Package센터 구매팀장	서강대	46	상근
황하섭	상무	1964.03	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	인하대	46	상근
강명구	상무	1971.09	남	SSIC 담당임원	DS부문 기술전략팀 수석	서울대(博士)	34	상근
고대곤	상무	1965.03	남	SIEL-P(C)법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	아주대	34	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
곽연봉	상무대우	1967.03	남	기흥/화성단지 전기제어기술팀 담당임원	기흥/화성단지총괄 담당부장	광운대	34	상근
권오봉	상무	1969.08	남	SEDA-P(M) 담당임원	무선 Global제조센터 담당부장	금오공대(碩士)	34	상근
김기삼	상무	1965.11	남	SCS 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	아주대(碩士)	34	상근
김대주	상무	1969.10	남	아프리카총괄 지원팀장	프린팅솔루션 지원팀 담당임원	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	34	상근
김병성	상무	1969.12	남	SEHZ 담당임원	무선 지원팀 담당임원	인하대	34	상근
김보경	상무	1966.08	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	34	상근
김상효	상무	1967.10	남	IR그룹 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Duke Univ.(碩士)	34	상근
김성기	상무	1968.11	남	북미총괄 CS팀장	CIS총괄 CS팀장	연세대(碩士)	34	상근
김성욱	상무	1968.06	남	한국총괄 온라인영업팀장	인사팀 담당임원	고려대(碩士)	34	상근
김세녕	상무	1964.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	삼성전자기술대학(碩士)	34	상근
김연준	상무	1967.11	남	SESK 담당임원	SEH-P 담당임원	충남대(碩士)	34	상근
김용주	상무	1970.08	남	System LSI 지원팀장	System LSI 지원팀 담당임원	한국외국어대	34	상근
김우석	상무	1969.03	남	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅실 담당임원	New York Univ.(碩士)	34	상근
김윤영	상무	1966.01	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	아주대	34	상근
김의석	상무대우	1973.12	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대	34	상근
김재원	상무	1969.08	남	SEA 담당임원	STA 담당임원	Notre Dame(碩士)	34	상근
김정석	상무	1969.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	연세대(碩士)	34	상근
김정호	상무	1969.05	남	SEHK법인장	SCIC 담당임원	연세대	34	상근
김창업	상무	1969.08	남	SEM-S 담당임원	SEDA-S 담당임원	한양대	34	상근
김한석	상무	1968.07	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	인하대	34	상근
김현수	상무	1970.09	남	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당부장	성균관대(博士)	34	상근
데이브다스	상무	1975.06	남	SEA 담당임원	SEA VP	WHU-Kellogg(Germany-USA) (碩士)	34	상근
리차드	상무	1969.12	남	구주총괄 인사팀장	구주총괄 VP	INSEAD(碩士)	34	상근
명호석	상무	1967.04	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대	34	상근
박기원	상무	1966.06	남	글로벌마케팅센터 담당임원	Saudi Arabia지점장	서울대	34	상근
박상교	상무대우	1972.03	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대	34	상근
박성근	상무	1966.01	남	SEV 담당임원	중국전략협력실 담당임원	동국대	34	상근
박성민	상무	1965.04	남	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	인하대	34	상근
박정선	상무	1972.12	여	SRA 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Duke Univ.(碩士)	34	상근
박정호	상무대우	1971.09	남	법무실 담당임원	법무실 법무팀 수석변호사	Michigan State Univ.(碩士)	34	상근
박진영	상무	1971.11	여	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대	34	상근
박태호	상무	1969.03	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	Pittsburgh(碩士)	34	상근
박해진	상무	1965.10	남	DS부문 동남아총괄	메모리 전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대	34	상근
박현규	상무	1968.06	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	대구대	34	상근
백승엽	상무	1967.01	남	SELS법인장	SELS 副법인장	California State Univ., Hayward (碩士)	34	상근
백승협	상무	1966.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선사업부 개발실 수석	경희사이버대학	34	상근
부민혁	상무대우	1973.06	남	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전사업부 수석	제주대	34	상근
서한석	상무	1968.02	남	SEA 담당임원	STA 담당부장	George Washington Univ.(碩士)	34	상근
손영호	상무	1965.07	남	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	34	상근
송승엽	상무	1968.08	남	SCS 담당임원	Test&Package센터 제조기술3팀장	성균관대	34	상근
신동수	상무	1968.06	남	네트워크 지원팀 담당임원	기획팀 담당부장	서울대(碩士)	34	상근
신승철	상무	1973.04	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	연세대	34	상근
신현진	상무	1971.01	남	동남아총괄 인사팀장	동남아총괄 인사팀장	경북대	34	상근
안장혁	상무	1967.12	남	전장사업팀 담당임원	SEF 담당임원	육사	34	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
엄재원	상무	1968.04	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	연세대	34	상근
오창환	상무	1969.01	남	DS부문 인사팀 담당임원	삼성경제연구소 글로벌팀장	George Washington Univ.(碩士)	21	상근
우영돈	상무대우	1974.01	남	법무실 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대	34	상근
원성근	상무	1968.05	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	경북대	34	상근
위차이	상무	1966.04	남	TSE-S 담당임원	TSE-S VP	La Verne(碩士)	34	상근
유병길	상무	1970.09	남	감사팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Virginia(碩士)	34	상근
윤강혁	상무	1965.07	남	한국총괄 안식년	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서강대	34	상근
윤병관	상무	1970.11	남	SIEL-P(N)공장장	SIEL-P(N) 담당임원	구미1전문대	34	상근
윤수정	상무대우	1969.01	여	생활가전 안식년	생활가전 디자인팀 담당임원	Sch. of the Visual Arts(碩士)	34	상근
윤승호	상무	1967.07	남	경영지원실 안식년	SEEG-S법인장	인하대	34	상근
윤인수	상무대우	1974.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)	34	상근
이광렬	상무	1969.02	남	Global CS센터 담당임원	구주총괄 CS팀장	한양대	34	상근
이귀로	상무	1966.08	남	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	동국대	34	상근
이금찬	상무	1965.01	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SERC 담당임원	Pittsburgh(碩士)	34	상근
이민	상무	1971.07	남	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)	34	상근
이상윤	상무	1968.09	남	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	경희대	34	상근
이상재	상무	1965.12	남	Test&Package센터 TEST기술팀장	메모리 DRAM개발실 담당임원	홍익대	34	상근
이창섭	상무	1965.11	남	SELV법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대	34	상근
이학민	상무	1972.04	남	지원팀 담당임원	글로벌지원팀 담당부장	서울대(碩士)	34	상근
이호영	상무	1965.02	남	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	경희대	34	상근
이황균	상무	1965.05	남	SERK법인장	SEIN-P법인장	성균관대	34	상근
인석진	상무	1967.12	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	성균관대	34	상근
임병택	상무	1968.10	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	경북대	34	상근
장단단	상무	1964.06	여	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	HOSEI UNIV.	34	상근
장세연	상무	1967.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	광운대	34	상근
전병준	상무	1966.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SESG법인장	성균관대	34	상근
전우성	상무	1964.03	남	SEMA법인장	생활가전 Global제조센터 담당임원	조선대	34	상근
전은환	상무	1972.02	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Purdue Univ.(碩士)	34	상근
정순찬	상무	1965.02	남	기흥/화성단지 평택인프라기술팀장	메모리제조센터 담당임원	건국대	34	상근
정재웅	상무	1969.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	국민대(碩士)	34	상근
조명호	상무	1969.05	남	감사팀 담당임원	감사팀 담당임원	연세대(碩士)	34	상근
조필주	상무	1971.07	남	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당부장	서울대(博士)	34	상근
주재완	상무	1968.02	남	중국총괄 CS팀장	CS환경센터 Global서비스팀 담당임원	연세대(碩士)	34	상근
지우정	상무	1967.11	남	한국총괄 인사팀장	동남아총괄 인사팀장	고려대(碩士)	34	상근
최헌복	상무	1969.02	남	DS부문 지원팀 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	상해교통대(上海交通大)(碩士)	34	상근
트레비스	상무	1966.09	남	SEA 담당임원	SEA VP	Arizona State Univ.	34	상근
하영수	상무	1964.07	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	인하대	34	상근
한규한	연구위원	1966.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 기획팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)	34	상근
한상숙	상무	1966.07	여	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	Northwestern Univ.(碩士)	34	상근
허석	상무	1973.10	남	Foundry 기획팀장	System LSI 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)	34	상근
현경호	상무	1966.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	한양대	34	상근
현상훈	상무	1965.05	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)	34	상근
고재윤	상무	1973.01	남	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(碩士)	22	상근
고재필	상무	1970.03	남	영상디스플레이 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	Purdue Univ.(碩士)	22	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
구본영	상무	1967.05	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	서울대(碩士)	22	상근
권오수	상무	1968.04	남	TSTC 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대	22	상근
김강수	상무	1966.09	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	성균관대	22	상근
김경조	상무	1965.12	남	Test&Package센터 제조기술3팀장	Test&Package센터 GPO팀장	성균관대	22	상근
김군한	상무	1968.06	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	성균관대	22	상근
김민정	상무	1971.07	여	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	22	상근
김병우	상무	1968.03	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	경북대	22	상근
김성은	상무	1971.09	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	고려대(碩士)	22	상근
김수련	상무	1967.04	여	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	한국과학기술원(博士)	22	상근
김재훈	상무	1967.01	남	SEDA-S 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)	22	상근
김홍식	상무	1969.09	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	인하대	22	상근
마이클레이 포드	상무	1962.02	남	SAS 담당임원	SAS VP	Texas, Dallas(碩士)	22	상근
문종승	상무	1971.08	남	글로벌기술센터 제조전략팀장	글로벌기술센터 제조혁신팀장	Georgia Inst. of Tech.(博士)	22	상근
문희동	상무	1971.07	남	종합기술원 인사팀장	인사팀 담당부장	한양대	22	상근
박정미	상무	1968.07	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	한국과학기술원(碩士)	22	상근
박정진	상무	1968.07	남	SEG 담당임원	지원팀 담당부장	Minnesota, Twin Cities(碩士)	22	상근
박종범	상무	1969.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	연세대(碩士)	22	상근
박준호	상무	1972.05	남	무선 상품전략팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대	22	상근
박철범	상무	1966.03	남	상생협력센터 구매전략팀 담당임원	상생협력센터 시너지구매팀 담당임원	고려대	22	상근
배상우	상무	1970.10	남	Foundry 품질팀장	System LSI 품질팀 담당임원	Purdue Univ.(博士)	22	상근
복정수	상무	1970.06	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SESG법인장	고려대	22	상근
서보철	상무	1972.01	남	감사팀 담당임원	감사팀 담당임원	동국대	22	상근
송철섭	상무	1967.12	남	DS부문 중국총괄 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당부장	인하대	22	상근
신영주	상무	1969.09	남	SCS 담당임원	SCS 수석	Purdue Univ.(博士)	22	상근
안재용	상무	1968.08	남	DS부문 인사팀 담당임원	SDC 감사팀 담당임원	성균관대	15	상근
안종찬	상무	1968.10	남	무선 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	경북대	22	상근
유승호	상무	1968.06	남	지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	연세대	22	상근
윤종덕	상무	1969.04	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	고려대(碩士)	22	상근
이계원	상무	1968.05	남	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	서울대(碩士)	22	상근
이광헌	상무	1971.06	남	무선 인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	연세대	22	상근
이규영	상무	1968.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대(碩士)	22	상근
이상도	상무	1969.03	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	City Univ. of New York(CUNY)(碩士)	22	상근
이상원	상무	1971.07	남	SEF 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)	22	상근
이상직	상무	1970.06	남	SEASA법인장	Venezuela지점장	한국외국어대	22	상근
이재범	상무	1970.10	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	홍익대	22	상근
이재환	상무	1967.08	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEPAK법인장	성균관대	22	상근
이정길	상무	1971.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	게이오大(Keio Univ.)(碩士)	22	상근
이정삼	상무	1967.06	남	Test&Package센터 GPO팀장	Test&Package센터 Global제조혁신팀장	인하대	22	상근
이창수	상무	1971.07	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	경희대	22	상근
이창욱	상무	1965.05	남	아프리카총괄 담당임원	SEWA법인장	광운대	22	상근
저스틴데니슨	상무	1974.05	남	SEA 담당임원	SEA VP	Northwestern Univ.(碩士)	22	상근
정윤찬	상무	1968.09	남	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	감사팀 담당부장	성균관대	22	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
정지호	상무	1967.01	남	무선 인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당부장	아주대	22	상근
정진성	상무	1967.08	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	부산대	22	상근
정호진	상무	1971.05	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SECA 담당부장	Rutgers Univ.(碩士)	22	상근
제이디라우	상무	1966.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	Houston(碩士)	22	상근
조영준	상무	1971.05	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당임원	성균관대	22	상근
지송하	상무	1973.01	여	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅실 담당부장	이화여대	22	상근
지응준	상무	1968.01	남	종합기술원 기획팀 담당임원	종합기술원 기획팀 담당부장	연세대(博士)	22	상근
최광보	상무	1971.03	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	부산대	22	상근
케빈모어튼	상무	1963.03	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Loyola Marymount Univ.	22	상근
피터리	상무	1970.05	남	커뮤니케이션팀 담당임원	기획팀 담당부장	Chicago(碩士)	22	상근
한우섭	상무	1967.01	남	의료기기 IVD사업팀장	의료기기 Global CS팀장	한국과학기술원(博士)	22	상근
허태영	상무	1970.11	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of California, LA	22	상근
홍성범	상무	1967.03	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	Institue Teknologi Bandung(碩士)	22	상근
황대환	상무	1969.06	남	무선 Global제조센터 담당임원	무선 Global제조센터 담당부장	수도전기공고	22	상근
황보용	상무	1970.10	남	메모리 기획팀 담당임원	종합기술원 기획팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	22	상근
황완구	상무	1972.02	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	서울대(博士)	22	상근
황태환	상무	1968.04	남	SEAD법인장	SEB법인장	경희대	22	상근
강재원	상무	1967.07	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	인하대	5	상근
김동준	상무	1973.05	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	광주과학기술원(博士)	5	상근
김성은	상무	1968.11	남	무선 기술전략팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	항공대	5	상근
김성한	상무	1970.05	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)	5	상근
김세윤	상무	1973.06	남	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	고려대(碩士)	5	상근
김욱한	상무	1967.12	남	SESG법인장	SEG 담당부장	한국과학기술원(碩士)	5	상근
김이수	상무	1973.03	남	SEVT 담당임원	SEVT 담당부장	아주대	5	상근
김호균	상무	1968.12	남	DMC연구소 인사팀장	DMC연구소 인사팀장	연세대(碩士)	5	상근
박건태	상무	1969.09	남	무선 구매팀 담당임원	감사팀 담당부장	Colorado, Boulder(碩士)	5	상근
박현정	상무	1969.12	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	고려대	5	상근
박훈종	상무	1967.08	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당부장	인하대	5	상근
서영진	상무	1969.05	남	Global CS센터 제품환경팀장	Global CS센터 제품환경팀장	Insa De Lyon (博士)	5	상근
송두근	상무	1968.07	남	기흥/화성단지 환경안전팀장	기흥/화성단지 환경안전팀장	성균관대	5	상근
엄종국	상무	1968.03	남	생활가전 지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 담당부장	인하대	5	상근
오정석	상무	1970.03	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	청화대(淸華大)(碩士)	5	상근
윤주한	상무	1970.05	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	California, Berkeley(碩士)	5	상근
이관수	상무	1969.11	남	네트워크 지원팀 담당임원	네트워크 지원팀 담당부장	영남대	5	상근
이동헌	상무대우	1972.09	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	고려대	5	상근
이영직	상무	1967.08	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	아주대	5	상근
이재욱	상무	1968.07	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	성균관대(碩士)	5	상근
이재환	상무	1970.09	남	SEEG-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	중앙대(碩士)	5	상근
이종민	상무	1971.09	남	무선 개발1실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Illinois Inst. of Tech.(碩士)	5	상근
이치훈	상무	1969.08	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당임원	서울대(博士)	5	상근
이헌	상무	1971.01	남	SEROM법인장	SECZ법인장	Duke Univ.(碩士)	5	상근
임성윤	상무	1971.01	남	SEPR법인장	SEPR법인장	고려대	5	상근
정상태	상무	1972.01	남	SEA 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	중앙대	5	상근
정의옥	상무	1968.07	남	Foundry Global운영팀장	Foundry Global운영팀장	인하대	5	상근
존헤링턴	상무	1962.02	남	SEA 담당임원	SEA 담당임원	Wisconsin, Madison	5	상근
최병갑	상무	1969.08	남	Test&Package센터 설비혁신팀장	Test&Package센터 설비혁신팀장	서울대(博士)	5	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
홍성민	상무	1969.06	남	System LSI 인사팀장	System LSI 인사팀 담당부장	Texas, Austin(碩士)	5	상근
홍영기	상무	1970.03	남	Foundry제조센터 담당임원	Foundry제조센터 담당임원	Imperial College(博士)	5	상근
홍정호	상무	1969.02	남	SESA 담당임원	지원팀 담당부장	Washington, Seattle(碩士)	5	상근
김창용	연구위원	1959.12	남	DMC연구소장	종합기술원 Future IT연구소장	한국과학기술원(博士)		상근
조승환	연구위원	1962.10	남	소프트웨어센터 副센터장	무선 개발실 담당임원	한양대(碩士)		상근
김희덕	연구위원	1963.01	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	광운대(碩士)		상근
노태문	연구위원	1968.09	남	무선 개발2실장	무선 전략마케팅실 담당임원	포항공대(博士)		상근
송현명	연구위원	1960.10	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	서울대(碩士)		상근
김용식	연구위원	1957.01	남	생산기술연구소장	생산기술연구소 장비기술연구팀장	Purdue Univ.(博士)		상근
이효건	연구위원	1962.01	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	소프트웨어센터 S/W Platform팀장	한국과학기술원(博士)		상근
정민형	연구위원	1961.01	남	의료기기 안식년	의료기기 DR사업팀장	서울대		상근
한종희	연구위원	1962.03	남	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발실장	인하대		상근
김용제	연구위원	1962.04	남	SRA연구소장	프린팅솔루션 개발팀장	아주대(碩士)		상근
윤종식	연구위원	1961.09	남	Foundry 기술개발실장	System LSI Foundry사업팀장	Univ. of California, LA(博士)		상근
장덕현	연구위원	1964.02	남	System LSI LSI개발실장	메모리 Solution개발실장	Univ. of Florida(博士)		상근
전경훈	연구위원	1962.12	남	네트워크 개발1팀장	차세대사업팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)		상근
강호규	연구위원	1961.09	남	반도체연구소장	반도체연구소 담당임원	Stanford Univ.(博士)		상근
경계현	연구위원	1963.03	남	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
정재헌	연구위원	1962.09	남	메모리 Solution개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Southern Carolina(博士)		상근
이상훈	연구위원	1959.07	남	생활가전 메카솔루션팀장	생활가전 금형팀장	동아대		상근
이재승	연구위원	1960.07	남	생활가전 개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	고려대(碩士)		상근
장성진	연구위원	1965.07	남	메모리 DRAM개발실장	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
황성우	연구위원	1962.08	남	종합기술원 Device & System연구센터장	종합기술원 Device연구소 담당임원	Princeton Univ.(博士)		상근
황정욱	연구위원	1965.04	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	인하대		상근
권도현	연구위원	1962.11	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	호주 아들레이드대(博士)		상근
김옥현	연구위원	1960.04	남	무선 안식년	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Alabama, Hunstsville (博士)		상근
성학경	연구위원	1960.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀장	생산기술연구소 금형기술센터장	Tokyo Institute of Tech(博士)		상근
조재문	연구위원	1961.08	남	의료기기 선행개발팀장	의료기기 개발2팀장	한국과학기술원(博士)		상근
이원식	연구위원	1962.08	남	전장사업팀 담당임원	무선 UX혁신팀장	Texas A&M-College(碩士)		상근
장용성	연구위원	1963.09	남	SCIC 담당임원	무선 개발2실 담당임원	연세대(博士)		상근
박영수	연구위원	1964.12	남	DS부문 안식년	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
박재홍	연구위원	1965.01	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)		상근
이규필	연구위원	1961.05	남	반도체연구소 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Univ. of Florida(博士)		상근
이상윤	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(博士)		상근
장동훈	연구위원	1960.09	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
전재호	연구위원	1963.04	남	네트워크 Global Technology Service팀장	네트워크 Global Service팀장	한국과학기술원(博士)		상근
정순문	연구위원	1961.11	남	반도체연구소 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Univ. of Florida(博士)		상근
최승철	연구위원	1963.12	남	SRI-Noida연구소장	무선 개발실 담당임원	경희대		상근
김학상	연구위원	1966.09	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell (博士)		상근
문제명	연구위원	1960.02	남	생활가전 안식년	생활가전 개발팀 담당임원	홍익대		상근
손재철	연구위원	1965.11	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
신민철	연구위원	1966.02	남	네트워크 개발2팀 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대(碩士)		상근
이덕형	연구위원	1961.12	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
강원석	연구위원	1964.11	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양대		상근
김준태	연구위원	1963.01	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
남석우	연구위원	1966.03	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	연세대(博士)		상근
도영수	연구위원	1965.09	남	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대		상근
신유균	연구위원	1965.02	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
채주락	연구위원	1964.08	남	영상디스플레이 AV사업팀장	영상디스플레이 개발실 담당임원	경북대		상근
최형식	연구위원	1958.06	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	인하대		상근
김학래	연구위원	1962.02	남	글로벌기술센터 자동화기술팀장	생산기술연구소 수석	한양대		상근
윤정남	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(博士)		상근
이준현	연구위원	1965.05	남	DMC연구소 차세대모바일팀장	DMC연구소 융복합시스템팀장	Cincinnati(博士)		상근
조병학	연구위원	1967.03	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)		상근
강임수	연구위원	1963.07	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당부장	성균관대(碩士)		상근
김민구	연구위원	1964.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
김형섭	연구위원	1966.01	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	Texas, Austin(博士)		상근
송재혁	연구위원	1967.08	남	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS 담당임원	서울대(博士)		상근
장의영	연구위원	1962.08	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 냉기개발팀 담당임원	경희대		상근
정기태	연구위원	1965.09	남	반도체연구소 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
최진혁	연구위원	1967.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
한진만	연구위원	1966.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대		상근
박원주	연구위원	1962.09	남	반도체연구소 담당임원	DS부문 소프트웨어연구소장	인하대		상근
이성덕	연구위원	1965.08	남	의료기기 DR사업팀장	의료기기 선행개발팀 담당임원	광운대(碩士)		상근
곽동원	연구위원	1961.07	남	무선 개발1실 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	Univ. of Texas, Arlington(博士)		상근
김진기	연구위원	1961.05	남	기흥/화성단지 시스템기술팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	New Jersey Inst. of Technologies (碩士)		상근
두석광	연구위원	1963.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Emerging센터 수석	서울대(博士)		상근
전병환	연구위원	1965.05	남	System LSI LSI개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대		상근
황윤일	연구위원	1963.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	정밀화학 전지소재사업단장	Carnegie Mellon Univ.(博士)	24	상근
김정욱	연구위원	1966.07	남	DS부문 안식년	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	GEORGIA INST. OF TECH.(博士)		상근
김환	연구위원	1967.02	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	부산대		상근
디페쉬	연구위원	1969.06	남	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(碩士)		상근
박정대	연구위원	1963.06	남	무선 개발2실 담당임원	삼성SDI 소형전지사업부 담당임원	경북대	5	상근
오수열	연구위원	1967.02	남	네트워크 개발2팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
이창선	연구위원	1968.10	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	고려대(碩士)		상근
임경묵	연구위원	1966.05	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	S.LSI담당 SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
전영식	연구위원	1967.08	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양대(碩士)		상근
정도형	연구위원	1967.03	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
정현준	연구위원	1964.06	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	SEH-P법인장	한양대		상근
주창남	연구위원	1965.04	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	성균관대		상근
홍형선	연구위원	1963.08	남	반도체연구소 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	인하대(碩士)		상근
구자흠	연구위원	1968.01	남	Foundry제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당임원	North Carolina State Univ.(博士)		상근
권영준	연구위원	1965.06	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Texas A&M Univ.(博士)		상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
김성운	연구위원	1965.09	남	무선 안식년	무선 개발2실 담당임원	Illinois, Chicago(博士)		상근
김인수	연구위원	1963.06	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	부산대		상근
김주년	연구위원	1969.12	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양사이버대		상근
김치욱	연구위원	1967.08	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	고려대(碩士)		상근
김태연	연구위원	1965.04	남	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	네트워크 제품기술팀 담당임원	서강대(碩士)		상근
노남석	연구위원	1967.08	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	삼성디스플레이 LCD사업부 담당임원	한국과학기술원(博士)	11	상근
박광일	연구위원	1971.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
박두식	연구위원	1965.08	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	포항공대(碩士)		상근
박성선	연구위원	1965.08	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	충남대		상근
박호진	연구위원	1962.09	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	한양대		상근
서장석	연구위원	1967.08	남	무선 개발1실 담당임원	무선 UX혁신팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
서호수	연구위원	1966.07	남	SRC-Guangzhou연구소장	무선 개발실 담당임원	경북대(碩士)		상근
송효정	연구위원	1969.10	여	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
신재광	연구위원	1964.09	남	종합기술원 담당임원	종합기술원 Device연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
위평환	연구위원	1964.10	남	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	네트워크 Global Service팀 담당임원	부산대		상근
윤상현	연구위원	1966.03	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	삼성전자기술대학(碩士)		상근
윤장현	연구위원	1968.12	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)		상근
이석준	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
이준희	연구위원	1969.03	남	무선 개발1실 담당임원	DMC연구소 담당임원	MIT(博士)		상근
전충삼	연구위원	1965.08	남	반도체연구소 담당임원	메모리제조센터 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
조성희	연구위원	1964.09	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	연세대		상근
최명수	연구위원	1966.06	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	한양대(碩士)		상근
최윤준	연구위원	1967.09	남	LED사업팀 전략마케팅팀 담당임원	LED사업팀 개발팀장	MIT(博士)		상근
한인택	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	서울대(博士)		상근
권상덕	연구위원	1967.03	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)	58	상근
권재욱	연구위원	1966.07	남	LED기술센터장	LED사업팀 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)	58	상근
김동섭	연구위원	1968.03	남	무선 안식년	무선 개발2실 담당임원	한양대	58	상근
김석원	연구위원	1964.05	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Virginia Tech(博士)	58	상근
김정기	연구위원	1965.08	남	네트워크 개발2팀 담당임원	네트워크 개발1팀 담당임원	서울대	58	상근
김정식	연구위원	1970.08	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양대(碩士)	58	상근
김태진	연구위원	1964.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	연세대	58	상근
류제형	연구위원	1974.02	남	무선 개발2실 담당임원	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	58	상근
문승도	연구위원	1968.10	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	58	상근
박성용	연구위원	1969.02	남	네트워크 개발1팀 담당임원	차세대사업팀 담당임원	서울대(博士)	58	상근
박종애	연구위원	1965.08	여	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	이화여대(博士)	58	상근
백일섭	연구위원	1968.08	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	광운대	58	상근
선경일	연구위원	1968.01	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	한국과학기술원(碩士)	58	상근
신현석	연구위원	1969.05	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	서강대(碩士)	58	상근
유미영	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	포항공대(碩士)	58	상근
유준영	연구위원	1967.09	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	성균관대	58	상근
유현상	연구위원	1964.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	TSE-P 수석	인하대	58	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
유호선	연구위원	1967.08	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	서울대(博士)	58	상근
이기수	연구위원	1964.07	남	생활가전 개발팀 담당임원	TSE-P법인장	한양대(碩士)	58	상근
이동기	연구위원	1969.05	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of California, San Diego (博士)	58	상근
이시화	연구위원	1965.12	남	DMC연구소 차세대미디어팀장	DMC연구소 융복합미디어팀장	한국과학기술원(博士)	58	상근
이준화	연구위원	1972.03	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)	58	상근
임정규	연구위원	1963.01	남	무선 PC사업팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	항공대	58	상근
임준서	연구위원	1968.08	남	DS부문 중국총괄 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	58	상근
정선태	연구위원	1965.07	남	무선 개발1실 담당임원	DMC연구소 선행Device팀 담당임원	서울대(博士)	58	상근
조창현	연구위원	1965.12	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)	58	상근
최성호	연구위원	1970.04	남	DMC연구소 글로벌표준팀장	DMC연구소 STE팀장	한국과학기술원(博士)	58	상근
허창완	연구위원	1968.04	남	SEV 담당임원	무선 개발실 담당임원	광운대	58	상근
강대철	연구위원	1965.08	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	인하대	46	상근
강상기	연구위원	1968.04	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	서울대(博士)	46	상근
강상범	연구위원	1969.02	남	반도체연구소 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)	46	상근
김용성	연구위원	1964.11	남	영상디스플레이 안식년	영상디스플레이 개발팀 담당임원	경북대	46	상근
김우섭	연구위원	1964.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	고려대(博士)	46	상근
노원일	연구위원	1967.08	남	네트워크 개발1팀 담당임원	차세대사업팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)	46	상근
문창록	연구위원	1971.01	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	서울대(博士)	46	상근
박기철	연구위원	1971.05	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)	46	상근
박기태	연구위원	1971.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Tohoku Univ.(博士)	46	상근
박성준	연구위원	1971.01	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device연구소 전문연구원	Stanford Univ.(博士)	46	상근
박정훈	연구위원	1969.10	남	DMC연구소 차세대미디어팀 담당임원	DMC연구소 융복합미디어팀 담당임원	한양대(碩士)	46	상근
안수진	연구위원	1969.12	여	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	포항공대(博士)	46	상근
안원익	연구위원	1970.07	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	46	상근
안정착	연구위원	1970.12	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 개발실 수석	포항공대(博士)	46	상근
오현석	연구위원	1967.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(博士)	46	상근
이시영	연구위원	1972.04	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	경북대(碩士)	46	상근
이영민	연구위원	1964.03	남	SRPOL연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(博士)	46	상근
이은철	연구위원	1965.07	남	Foundry 제품기술팀장	System LSI 제품기술팀장	광운대	46	상근
이종열	연구위원	1970.02	남	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(博士)	46	상근
이주영	연구위원	1966.07	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Univ. of California, LA(博士)	46	상근
이진욱	연구위원	1970.02	남	소프트웨어센터 Applied Platform팀장	소프트웨어센터 S/W Platform팀 담당임원	Arizona State Univ.(博士)	46	상근
임채환	연구위원	1971.01	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	경북대(博士)	46	상근
장경훈	연구위원	1970.02	남	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원	SRK연구소장	고려대(博士)	46	상근
장세영	연구위원	1974.09	여	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	46	상근
전찬욱	연구위원	1966.05	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	연세대	46	상근
정성욱	연구위원	1965.10	남	생활가전 안식년	생활가전 개발팀 담당임원	성균관대	46	상근
조강용	연구위원	1964.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	삼성전자기술대학(碩士)	46	상근
조상연	연구위원	1971.12	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Minnesota, Twin Cities (博士)	46	상근
조장호	연구위원	1969.04	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한국과학기술원(碩士)	46	상근
지영배	연구위원	1962.10	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	경기공전	46	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
최경세	연구위원	1969.04	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	서울대(博士)	46	상근
최기환	연구위원	1970.01	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	46	상근
최병기	연구위원	1966.02	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Emerging소재센터 전문연구원	Tokyo Institute of Tech(博士)	46	상근
최승현	연구위원	1967.10	남	네트워크 개발2팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	중앙대(碩士)	46	상근
최용원	연구위원	1968.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	고려대(碩士)	46	상근
최용훈	연구위원	1969.07	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	고려대	46	상근
최윤희	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	포항공대(碩士)	46	상근
키스호킨스	연구위원	1958.05	남	SARC연구소장	SAS 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(碩士)	46	상근
허운행	연구위원	1969.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	46	상근
황기현	연구위원	1967.06	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	서울대(博士)	46	상근
김광연	연구위원	1965.07	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	연세대(碩士)	34	상근
김동욱	연구위원	1965.08	남	무선 안식년	무선 개발2실 담당임원	한양대(博士)	34	상근
김두일	연구위원	1971.07	남	소프트웨어센터 S/W Platform팀wkd	소프트웨어센터 S/W Platform팀 담당임원	경북대	34	상근
김명철	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)	34	상근
김영집	연구위원	1971.03	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	34	상근
김우중	연구위원	1965.02	남	TSEC 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	국민대	34	상근
김한석	연구위원	1967.12	남	네트워크 안식년	SRC-Shenzhen연구소장	Illinois, Urbana-Champaign(博士)	34	상근
류수정	연구위원	1971.10	여	System LSI SOC개발실 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	GEORGIA INST. OF TECH.(博士)	34	상근
문용운	연구위원	1969.08	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	서강대(碩士)	34	상근
문준	연구위원	1974.06	남	네트워크 개발2팀 담당임원	네트워크 개발1팀 담당임원	서울대(博士)	34	상근
민이규	연구위원	1966.10	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양대(博士)	34	상근
민종술	연구위원	1968.03	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	DMC연구소 차세대미디어팀 담당임원	고려대(碩士)	34	상근
박찬익	연구위원	1972.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(博士)	34	상근
변준호	연구위원	1972.07	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Southern Illinois Univ.(博士)	34	상근
송호건	연구위원	1966.01	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	Univ. of California, Berkeley(博士)	34	상근
신경섭	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	Univ. of California, Berkeley(博士)	34	상근
알록나스데	연구위원	1962.11	남	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore SVP	Mcgill Univ.(博士)	34	상근
이근호	연구위원	1970.02	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)	34	상근
이용구	연구위원	1967.06	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	서강대(博士)	34	상근
이제석	연구위원	1969.01	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	연세대(碩士)	34	상근
이종배	연구위원	1966.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(碩士)	34	상근
임종형	연구위원	1969.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대	34	상근
장우석	연구위원	1971.01	남	반도체연구소 담당임원	DS부문 소프트웨어연구소 담당임원	서울대(碩士)	34	상근
장재훈	연구위원	1969.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	34	상근
조재학	연구위원	1965.10	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	홍익대	34	상근
조혜정	연구위원	1967.11	여	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원	DMC연구소 융복합시스템팀 담당임원	포항공대(博士)	34	상근
최창규	연구위원	1970.03	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 수석	한국과학기술원(博士)	34	상근
탁승식	연구위원	1965.04	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	성균관대	34	상근
프라나브	연구위원	1981.05	남	SRA 담당임원	SRA-SV VP	Massachusetts Inst. of Tech.(MIT)(碩士)	34	상근
황상준	연구위원	1972.01	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(博士)	34	상근
고형종	연구위원	1970.11	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Florida(博士)	22	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
김강태	연구위원	1972.10	남	소프트웨어센터 SE팀장	소프트웨어센터 SE팀 담당임원	중앙대(博士)	22	상근
김경남	연구위원	1965.11	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI사업부 LSI개발실 수석	성균관대	22	상근
김기호	연구위원	1966.03	남	SRC-Nanjing연구소장	영상디스플레이 개발실 수석	George Washington Univ.(碩士)	22	상근
김도균	연구위원	1969.06	남	DMC연구소 차세대모바일팀 담당임원	DMC연구소 융복합시스템팀 담당임원	연세대(碩士)	22	상근
김태훈	연구위원	1969.04	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(博士)	22	상근
김현숙	연구위원	1971.04	여	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	인하대(碩士)	22	상근
김현우	연구위원	1970.02	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)	22	상근
김후성	연구위원	1972.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(碩士)	22	상근
박형원	연구위원	1966.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한양대(碩士)	22	상근
반효동	연구위원	1967.06	남	반도체연구소 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(碩士)	22	상근
배광진	연구위원	1968.02	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대	22	상근
배용철	연구위원	1970.05	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(碩士)	22	상근
서행룡	연구위원	1967.09	남	기흥/화성단지 시스템기술팀 담당임원	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 수석	부산대	22	상근
손동현	연구위원	1969.09	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	고려대(碩士)	22	상근
손호성	연구위원	1968.04	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대	22	상근
신동준	연구위원	1971.01	남	SSIC 담당임원	DS부문 소프트웨어연구소 수석	서울대(碩士)	22	상근
용석우	연구위원	1970.09	남	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(碩士)	22	상근
원순재	연구위원	1972.01	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(碩士)	22	상근
윤석호	연구위원	1972.07	남	LED기술센터 담당임원	LED사업팀 담당임원	서울대(博士)	22	상근
이무형	연구위원	1970.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	Purdue Univ.(博士)	22	상근
이영수	연구위원	1972.01	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	글로벌기술센터 요소기술팀 수석	서울대(博士)	22	상근
이종명	연구위원	1970.03	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	서울대(博士)	22	상근
이종호	연구위원	1968.01	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	연세대(碩士)	22	상근
이진엽	연구위원	1970.02	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서강대(碩士)	22	상근
이효순	연구위원	1970.08	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 수석	서울대(博士)	22	상근
정용준	연구위원	1969.10	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서강대(碩士)	22	상근
조기호	연구위원	1971.03	남	네트워크 개발1팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	22	상근
박준수	연구위원	1967.08	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	연세대(碩士)	5	상근
박진환	연구위원	1970.07	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 전문연구원	한국과학기술원(博士)	5	상근
박철홍	연구위원	1968.05	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	California, San Diego(博士)	5	상근
방원철	연구위원	1969.04	남	의료기기 선행개발팀 담당임원	의료기기 선행개발팀 수석	한국과학기술원(博士)	5	상근
손영수	연구위원	1974.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 미주총괄 수석	포항공대(博士)	5	상근
송기환	연구위원	1970.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash설계팀 수석	서울대(博士)	5	상근
오승훈	연구위원	1968.03	남	SRI-Bangalore 副연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Aachen Univ. of Tech.(博士)	5	상근
오화석	연구위원	1972.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Controller개발팀 수석	서강대(碩士)	5	상근
위훈	연구위원	1970.04	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(博士)	5	상근
이석원	연구위원	1970.07	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 TP기술팀장	서울대(博士)	5	상근
이애영	연구위원	1968.12	여	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 수석	포항공대(碩士)	5	상근
이혜정	연구위원	1970.10	여	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서강대(碩士)	5	상근
임용식	연구위원	1971.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash PA팀 수석	한국과학기술원(博士)	5	상근
정상일	연구위원	1967.09	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI 수석	중앙대	5	상근
정진민	연구위원	1972.12	남	소프트웨어센터 담당임원	소프트웨어센터 수석	한국과학기술원(博士)	5	상근
조성대	연구위원	1969.06	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 수석	RPI(博士)	5	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
조학주	연구위원	1969.03	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 수석	Texas, Austin(博士)	5	상근
최기화	연구위원	1969.03	남	네트워크 개발1팀 담당임원	네트워크 개발1팀 수석	Carnegie Mellon Univ.(博士)	5	상근
최성욱	연구위원	1969.02	남	글로벌기술센터 담당임원	글로벌기술센터 수석	삼성전자공과대	5	상근
최철민	연구위원	1973.09	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발2실 수석	서울대(博士)	5	상근
감도영	연구위원	1960.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	경북대(碩士)		상근
계종욱	연구위원	1966.10	남	Foundry 기술개발실 담당임원		서울대(碩士)	1	상근
권오상	연구위원	1967.04	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	33	상근
김기남	연구위원	1964.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)	30	상근
김대길	연구위원	1970.11	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원		Southern California(碩士)	3	상근
김대현	연구위원	1974.06	남	DMC연구소 차세대미디어팀 담당임원	DMC연구소 차세대미디어팀 담당임원	Cornell Univ.(博士)	4	상근
김민경	연구위원	1973.07	여	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	University of Michigan(博士)	15	상근
김석원	연구위원	1970.11	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	MIT(博士)	7	상근
김성덕	연구위원	1966.09	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Lehigh Univ.(博士)	4	상근
김성한	연구위원	1967.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)	60	상근
김용재	연구위원	1972.03	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	서강대(碩士)	29	상근
김이환	연구위원	1968.12	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)	36	상근
김준석	연구위원	1969.04	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	10	상근
김지희	연구위원	1965.08	여	소프트웨어센터 Artificial Intelligence팀 담당임원	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	36	상근
김창흥	연구위원	1960.08	남	네트워크 개발1팀 담당임원	네트워크 개발1팀장	Univ. of Rhode Island(博士)	60	상근
김태성	연구위원	1968.12	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	28	상근
김태식	연구위원	1958.10	남	네트워크 개발2팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
김태용	연구위원	1973.01	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	16	상근
김형석	연구위원	1968.08	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(碩士)	48	상근
김홍석	연구위원	1976.05	남	소프트웨어센터 담당임원	소프트웨어센터 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign (博士)	16	상근
박병하	연구위원	1960.04	남	DS부문 인사팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)		상근
박상봉	연구위원	1969.01	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)	28	상근
박성파	연구위원	1971.10	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대	17	상근
박용인	연구위원	1964.04	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 차세대제품개발팀장	연세대(碩士)	42	상근
박용종	연구위원	1958.09	남	생활가전 선행개발팀장	생활가전 선행개발팀 담당임원	Universitat Karlsruhe(博士)		상근
박한결	연구위원	1969.09	남	SRA 담당임원	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원	California Inst. of Tech.(博士)	16	상근
변영기	연구위원	1961.08	남	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 개발실 담당임원	항공대		상근
송병무	연구위원	1973.08	남	Foundry 기술개발실 담당임원		Cornell Univ.(博士)	3	상근
신승혁	연구위원	1968.01	남	무선 기술전략팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(博士)		상근
심은수	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	Columbia Univ.(博士)		상근
쓰칭루	연구위원	1964.12	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	청화대(博士)	28	상근
안길준	연구위원	1969.01	남	소프트웨어센터 Security팀장	소프트웨어센터 Security팀장	George Mason Univ.(博士)	5	상근
양장규	연구위원	1963.09	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)	60	상근
오경석	연구위원	1965.06	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign (博士)	13	상근
오병목	연구위원	1969.09	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	MIT(博士)	20	상근
오부근	연구위원	1967.12	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양대(博士)	16	상근
윤종문	연구위원	1971.06	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Boston Univ.(碩士)	6	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
이경운	연구위원	1964.12	남	소프트웨어센터 Convergence팀장	소프트웨어센터 S/W Platform팀 담당임원	서울대		상근
이근배	연구위원	1961.03	남	소프트웨어센터 Artificial Intelligence 팀장	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀장	Univ. of California, LA(博士)	24	상근
이기선	연구위원	1974.06	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Virginia Tech(博士)	59	상근
이병길	연구위원	1967.03	남	무선 개발2실 담당임원	DMC연구소 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	52	상근
이용진	연구위원	1964.11	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	32	상근
이원석	연구위원	1967.10	남	무선 개발1실 담당임원	소프트웨어센터 Cloud Platform팀장	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)	44	상근
이인종	연구위원	1965.01	남	무선 개발1실장	무선 개발실 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill (博士)		상근
이재준	연구위원	1969.08	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	MIT(碩士)		상근
이종현	연구위원	1966.12	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Cambridge Univ.(博士)	28	상근
이현철	연구위원	1977.01	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Toronto(博士)	4	상근
임경원	연구위원	1967.07	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	48	상근
임백준	연구위원	1968.07	남	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원		Indiana Univ., Bloomington (碩士)	1	상근
임희태	연구위원	1966.11	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	부산대(博士)	60	상근
장동섭	연구위원	1962.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	생산기술연구소 금형기술센터 수석	The Ohio State Univ.(博士)	58	상근
장수백	연구위원	1975.09	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Southern Connecticut State Univ. (碩士)	15	상근
잭안	연구위원	1966.02	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Stanford Univ.(碩士)	20	상근
전성모	연구위원	1971.09	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Liverpool(碩士)	7	상근
정서형	연구위원	1967.05	남	네트워크 개발2팀 담당임원	차세대사업팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison (碩士)	22	상근
정재연	연구위원	1974.09	여	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	MIT(碩士)	12	상근
최성훈	연구위원	1973.02	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대(碩士)	13	상근
최원준	연구위원	1970.09	남	무선 개발2실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	19	상근
최윤석	연구위원	1970.01	남	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원		Texas, Austin(博士)	3	상근
토모야스	연구위원	1961.01	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	Tokyo Univ.	42	상근
함익대	연구위원	1964.11	남	영상디스플레이 STB사업팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대		상근
홍성훈	연구위원	1967.12	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	서울대(博士)	16	상근
강데이빗	전문위원	1973.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor	28	상근
강옥래	전문위원	1961.09	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대	33	상근
구성기	전문위원	1973.11	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 스마트가전T/F장	George Washington Univ.(博士)	12	상근
구윤모	전문위원	1962.07	남	무선 개발1실 담당임원	무선 기술전략팀장	Texas A&M Univ.(碩士)	59	상근
김광덕	전문위원	1962.08	남	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당임원	전남과학전문대	45	상근
김도현	전문위원	1966.11	남	커뮤니케이션팀 담당임원	글로벌협력팀 담당임원	서울대(碩士)	40	상근
김만영	전문위원	1969.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.	19	상근
김성윤	전문위원	1966.10	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 IP법무팀 담당임원	Harvard Univ.(碩士)		상근
김욱기	전문위원	1961.10	남	SEPM법인장	SIEL-P(C) 담당임원	성균관대		상근
김윤식	전문위원	1967.05	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대	50	상근
김준영	전문위원	1966.05	남	영상디스플레이 AV사업팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	서울대		상근
김철구	전문위원	1966.09	남	SIEL-S 담당임원	네트워크 담당부장	한양대	21	상근
김행일	전문위원	1957.07	남	Global EHS센터장	환경안전센터장	광운대		상근
김현정	전문위원	1974.01	여	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당부장	Harvard Univ.(碩士)	18	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
김호진	전문위원	1969.10	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	Hawthorne high school	10	상근
데이비드윤	전문위원	1971.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern University, Evanston (碩士)	5	상근
데이빗은	전문위원	1967.01	남	Samsung NEXT장	Global Innovation센터장	Harvard Univ.(碩士)		상근
도성대	전문위원	1966.12	남	서남아총괄 CS팀장	서남아총괄 CS팀장	부산대	5	상근
마츠오카	전문위원	1957.02	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	多摩美術大		상근
민소영	전문위원	1967.07	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Cranfield Sch. of Management (碩士)	31	상근
민은주	전문위원	1968.08	여	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Connecticut(博士)	57	상근
박상훈	전문위원	1969.09	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	SYRACUSE UNIV.(碩士)	5	상근
박성모	전문위원	1961.02	남	글로벌 CS센터 품질혁신팀 담당임원	CS환경센터 품질혁신팀 담당임원	홍익대	57	상근
박수영	전문위원	1965.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Texas, Dallas(碩士)	20	상근
박은주	전문위원	1964.07	남	SEV 담당임원	기흥/화성단지총괄 환경안전팀장	서울과학기술대	40	상근
박정준	전문위원	1970.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	Cranfield Univ.(碩士)	16	상근
사이먼오초버	전문위원	1967.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	London(碩士)	12	상근
서정아	전문위원	1971.05	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	6	상근
서준호	전문위원	1967.11	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 경쟁력강화T/F장	Duke Univ.(碩士)	9	상근
송병인	전문위원	1961.06	남	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당임원	충주공전	45	상근
송인숙	전문위원	1974.01	여	의료기기 상품기획팀장	의료기기 전략마케팅팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(博士)	29	상근
신민재	전문위원	1972.09	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 IP법무팀 담당임원	Harvard Univ.(碩士)	45	상근
엘리김	전문위원	1970.03	여	무선 개발1실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	INSEAD(碩士)	19	상근
유경여	전문위원	1973.06	여	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	연세대	13	상근
유재설	전문위원	1963.09	남	SEUC법인장	SERC 담당임원	서강대		상근
윤구	전문위원	1970.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Iowa Univ.(博士)	23	상근
윤종밀	전문위원	1963.05	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대	33	상근
윤준호	전문위원	1963.04	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	숭실대	21	상근
윤태식	전문위원	1969.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	연세대(碩士)	53	상근
이경성	전문위원	1961.05	남	SEVT 담당임원	환경안전센터 Global환경안전팀장	Univ. of Sheffield(碩士)	31	상근
이기남	전문위원	1961.08	남	SESK 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	항공대	57	상근
이돈태	전문위원	1968.09	남	디자인경영센터 副센터장	디자인경영센터 디자인전략팀장	연세대(博士)	33	상근
이상현	전문위원	1966.05	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)	57	상근
이원기	전문위원	1965.07	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	연세대(碩士)	33	상근
이원진	전문위원	1967.08	남	영상디스플레이 Service Business 팀장	영상디스플레이 서비스전략팀장	Purdue Univ.(碩士)	41	상근
이은영	전문위원	1973.03	여	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook	11	상근
이재일	전문위원	1962.03	남	창의개발센터장	인재개발센터장	광운대		상근
이재형	전문위원	1957.08	남	TSEC법인장	영상디스플레이 PDP일류화T/F장	경북대		상근
이지수	전문위원	1976.02	남	무선 개발1실 담당임원	무선 UX혁신팀 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	28	상근
이현율	전문위원	1974.02	여	무선 UX혁신팀 담당임원	무선 UX혁신팀 담당임원	MIT(博士)	35	상근
이희만	전문위원	1970.05	남	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	13	상근
임영수	전문위원	1969.06	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원		영남대(學士)	2	상근

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직 기간 (개월)	상근 여부
장영인	전문위원	1961.10	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	삼성물산 기획실 담당임원	계명대		상근
장재수	전문위원	1962.07	남	종합기술원 미래기술육성센터장	DMC연구소 기술전략팀장	Syracuse Univ.(碩士)		상근
장호진	전문위원	1970.09	남	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 라이센싱팀 책임변호사	Duke Univ.(碩士)	45	상근
전찬훈	전문위원	1962.07	남	Global EHS센터 수원환경안전팀장	Global EHS센터 수원환경안전팀장	오산전문대	5	상근
정수진	전문위원	1971.08	여	무선 UX혁신팀장	무선 UX혁신팀 담당임원	Illinois Institute of Technolog(碩士)	19	상근
제이콥탄	전문위원	1958.09	남	LED사업팀 副사업팀장	LED사업팀 전략마케팅팀장	North Carolina State Univ.(博士)	34	상근
조지현	전문위원	1961.06	남	상생협력센터 상생협력팀장	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	아주대(博士)	57	상근
지성용	전문위원	1963.02	남	창조경제지원센터 담당임원	상생협력아카데미 담당임원	인하대		상근
지세근	전문위원	1962.10	남	빙상연맹(파견)	경력컨설팅센터장	서울디지털대		상근
진재형	전문위원	1970.01	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 담당임원	연세대(碩士)	33	상근
최봉석	전문위원	1967.03	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Georgetown Univ.(碩士)	33	상근
최수호	전문위원	1963.02	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	California State Univ., Sacramento (碩士)		상근
최승은	전문위원	1969.07	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대(碩士)	18	상근
최의경	전문위원	1971.05	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(碩士)	31	상근
탁정욱	전문위원	1964.03	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대	50	상근
토마스고	전문위원	1970.11	남	무선 개발1실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Virginia	29	상근
패트릭쇼메	전문위원	1964.05	남	무선 상품전략팀장	무선 PSI팀장	Institut d administration des entreprises(碩士)	11	상근
피오슝커	전문위원	1961.10	남	무선 마케팅팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	California State Univ., Northridge (碩士)	30	상근
한상범	전문위원	1965.02	남	무선 Global CS팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대	21	상근
한석제	전문위원	1960.04	남	무선 Global Mobile B2B팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)	26	상근
한승희	전문위원	1969.11	여	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	서강대(碩士)	21	상근

※ 상기 미등기임원 현황은 2017년 3분기말 재직 기준입니다.
※ 미등기 임원 보유 주식수 : 보통주(의결권 있는 주식) 5,023,578주 / 우선주(의결권 없는 주식) 13,534주
(이건희 회장 보통주 4,985,464주, 우선주 12,398주 등)
※ 미등기 임원 보유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 9월 30일 기준이며,
이후 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략하였습니다.

라. 미등기임원의 변동

보고기간종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위	성명	출생년월	성별	담당업무	사유
신규선임	사장	정현호	1960.03	남	사업지원T/F장	재입사
	사장	노희찬	1961.10	남	경영지원실장	경력입사
	전문위원	이지선	1971.08	여	무선 전략마케팅실 담당임원	경력입사
	연구위원	김대우	1970.03	남	반도체연구소 담당임원	경력입사
퇴임	사장	윤주화	1953.02	남	삼성사회봉사단장	의원면직
	사장	김종호	1957.06	남	글로벌품질혁신실장	의원면직
	사장	이인용	1957.03	남	커뮤니케이션팀장	의원면직
	사장	장원기	1955.02	남	중국전략협력실장	의원면직
	사장	정칠희	1957.01	남	종합기술원장	의원면직

마. 직원의 현황

(기준일 : 2017.09.30) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계				
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
CE	남	11,159	-	92	-	11,251	13.4	-	-	-
CE	여	2,378	81	25	2	2,403	8.6	-	-	-
IM	남	19,840	-	204	-	20,044	11.6	-	-	-
IM	여	7,688	80	35	-	7,723	9.4	-	-	-
DS	남	34,042	-	170	3	34,212	10.3	-	-	-
DS	여	14,431	196	17	1	14,448	10.0	-	-	-
기타	남	7,546	-	141	1	7,687	13.5	-	-	-
기타	여	2,032	91	36	-	2,068	9.2	-	-	-
성별합계	남	72,587	-	607	4	73,194	11.4	4,934,431	70	-
성별합계	여	26,529	448	113	3	26,642	9.6	1,124,419	47	-
합 계		99,116	448	720	7	99,836	11.0	6,058,850	64	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.

※ 상기 직원의 수는 본사기준이며 사내이사(4명) 제외 기준입니다.
직원의 수는 사업보고서 작성 기준 변경에 따라 휴직자를 포함하여 기재하였습니다.

※ 1인 평균급여액은 3분기 평균 재직자 수 94,753명(남: 70,900명, 여: 23,853명) 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사・감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	4	-	-
사외이사	2	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	9	55,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로,
당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액

2-1. 이사・감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
9	27,463	3,051	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에
따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사・사외이사・감사위원회 위원이
등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.
※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	27,152	6,788	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	118	59	-
감사위원회 위원	3	193	65	-
감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사・사외이사・감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.
※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

<이사・감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

나. 주식선택권의 부여 및 행사현황

1. 이사・감사에게 부여한 주식매수선택권

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	4	-	-
사외이사	2	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	9	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2. 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

2017년 3분기말 현재 누적기준 미행사 주식매수선택권은 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

- 기업집단의 명칭 : 삼성

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2017년 3분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 4개 회사(삼성액티브자산운용, 삼성헤지자산운용, 하만인터내셔널코리아, 레드벤드소프트웨어코리아)가 증가하여 62개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(2017.09.30. 현재)

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
상장사	16	삼성물산㈜	1101110015762
		삼성전자㈜	1301110006246
		삼성에스디아이㈜	1101110394174
		삼성전기㈜	1301110001626
		삼성화재해상보험㈜	1101110005078
		삼성중공업㈜	1101110168595
		삼성생명보험㈜	1101110005953
		㈜멀티캠퍼스	1101111960792
		삼성증권㈜	1101110335649
		삼성에스디에스㈜	1101110398556
		삼성카드㈜	1101110346901
		삼성엔지니어링㈜	1101110240509
		㈜에스원	1101110221939
		㈜제일기획	1101110139017
		㈜호텔신라	1101110145519
		삼성바이오로직스㈜	1201110566317
		㈜서울레이크사이드	1101110504070
		㈜삼우종합건축사사무소	1101115494151
		㈜씨브이네트	1101111931686
		삼성바이오에피스㈜	1201110601501

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
비상장사	46	삼성디스플레이㈜	1345110187812
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140000991
		에스유머티리얼스㈜	1648110061337
		스테코㈜	1647110003490
		세메스㈜	1615110011795
		삼성전자서비스㈜	1301110049139
		삼성전자판매㈜	1801110210300
		삼성전자로지텍㈜	1301110046797
		수원삼성축구단㈜	1358110160126
		삼성메디슨㈜	1346110001036
		삼성화재애니카손해사정㈜	1101111595680
		삼성화재서비스손해사정㈜	1101111237703
		㈜삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		대정해상풍력발전(주)	2201110095315
		삼성선물㈜	1101110894520
		삼성자산운용㈜	1701110139833
		㈜생보부동산신탁	1101111617434
		삼성생명서비스손해사정㈜	1101111855414
		삼성에스알에이자산운용㈜	1101115004322
		㈜삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
		에스디플렉스㈜	1760110039005
		제일패션리테일㈜	1101114736934
		네추럴나인(주)	1101114940171
		삼성웰스토리㈜	1101115282077
		에스프린팅솔루션㈜	1358110303346
		㈜시큐아이	1101111912503
		에스티엠㈜	2301110176840
		에스코어㈜	1101113681031
		오픈핸즈㈜	1311110266146
		㈜미라콤아이앤씨	1101111617533
		삼성카드고객서비스㈜	1101115291656
		㈜휴먼티에스에스	1101114272706
		에스원씨알엠㈜	1358110190199
		신라스테이㈜	1101115433927
		에이치디씨신라면세점㈜	1101115722916
		㈜삼성경제연구소	1101110766670

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
		㈜삼성라이온즈	1701110015786
		삼성벤처투자㈜	1101111785538
		삼성액티브자산운용㈜	1101116277382
		삼성헤지자산운용㈜	1101116277390
		㈜하만인터내셔널코리아	1101113145673
		레드벤드소프트웨어코리아 ㈜	1101113613315
計	62		

2. 관계기업 및 자회사의 지분현황

피출자회사 출자회사	삼성 물산	삼성 전자	삼성 SDI	삼성 전기	삼 성 중공업	호텔 신라	삼성 엔지니어링	제일 기획	에스원	삼성 SDS	삼성 라이온즈	삼성 경제 연구소	스테코
삼성물산		4.6			0.1		7.0			17.1		1.0	
삼성전자			19.6	23.7	16.9	5.1		25.2		22.6		29.8	70.0
삼성SDI	2.1				0.4	0.1	11.7		11.0			29.6	
삼성전기	2.6				2.3							23.8	
삼성중공업												1.0	
제일기획					0.1						67.5		
호텔신라													
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS													
삼성생명보험	0.1	8.5	0.2	0.3	3.3	7.7	0.0	0.1	5.4	0.1		14.8	
삼성화재해상보험	1.4	1.4					0.2		1.0				
삼성증권						3.1			1.3				
삼성카드						1.3		3.0	1.9				
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨													
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
計	6.3	14.6	19.8	24.0	23.1	17.2	18.9	28.4	20.6	39.8	67.5	100.0	70.0

※ 단위는 %, 기준일은 2017년 3분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	세메스	삼성 전자 서비스	삼성 전자 판매	수원 삼성 축구단	삼성 전자 로지텍	삼성 디스플 레이	삼성 메디슨	삼성 바이오 로직스	삼성 바이오 에피스	삼성코닝 어드밴스 드글라스	에스유머 티리얼스	씨브이 네트	서울 레이크 사이드
삼성물산								43.4				40.1	100.0
삼성전자	91.5	99.3	100.0		100.0	84.8	68.5	31.5					
삼성SDI						15.2							
삼성전기													
삼성중공업													
제일기획				100.0									
호텔신라													
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS												9.4	
삼성생명보험								0.1					
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이										50.0	50.0		
삼성바이오로직스									94.6				
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨													
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
計	91.5	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	68.5	75.0	94.6	50.0	50.0	49.5	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2017년 3분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	삼우 종합건축 사무소	에스디 플렉스	제일패션 리테일	네추럴 나인	삼성 웰스토리	대정해상 풍력발전	시큐 아이	휴먼티에 스에스	에스원씨 알엠	에스 티엠	멀티 캠퍼스	에스 코어	오픈 핸즈
삼성물산	100.0		100.0	51.0	100.0		8.7						
삼성전자													
삼성SDI		50.0								100.0			
삼성전기													
삼성중공업						50.1							
제일기획												5.2	
호텔신라													
에스원								100.0	100.0			0.6	
삼성경제연구소											15.2		
삼성SDS							56.5				47.2	81.8	100.0
삼성생명보험											0.0		
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨												0.5	
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
計	100.0	50.0	100.0	51.0	100.0	50.1	65.2	100.0	100.0	100.0	62.4	88.1	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2017년 3분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	미라콤 아이앤씨	신라 스테이	HDC 신 라 면세점	삼성 생명 보험	생보 부동산 신탁	삼성생명 서비스 손해사정	삼성 에스알에이 자산운용	삼성생명 금융서비스 보험대리점	삼성화재 해상보험	삼성화재 애니카 손해사정	삼성화재 서비스 손해사정	삼성화재 금융서비스 보험대리점	삼성 증권
삼성물산				19.3									
삼성전자													
삼성SDI													
삼성전기													
삼성중공업													
제일기획	5.4												
호텔신라		100.0	50.0										
에스원	0.6												
삼성경제연구소													
삼성SDS	83.6												
삼성생명보험					50.0	99.8	100.0	100.0	15.0				29.4
삼성화재해상보험										100.0	100.0	100.0	
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨													
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
計	89.6	100.0	50.0	19.3	50.0	99.8	100.0	100.0	15.0	100.0	100.0	100.0	29.4

※ 단위는 %, 기준일은 2017년 3분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	삼성 카드	에스프린 팅솔루션	삼성카드 고객서비스	삼성 자산운용	삼성 선물	삼성벤처 투자	삼성액티브자 산운용	삼성헤지자산 운용	하만 인터내셔널 코리아	레드벤드 소프트웨어 코리아
삼성물산						16.7				
삼성전자		100.0				16.3				
삼성SDI						16.3				
삼성전기						17.0				
삼성중공업						17.0				
제일기획										
호텔신라										
에스원										
삼성경제연구소										
삼성SDS										
삼성생명보험	71.9			100.0						
삼성화재해상보험										
삼성증권					100.0	16.7				
삼성카드			100.0							
삼성디스플레이										
삼성바이오로직스										
삼성자산운용							100.0	100.0		
미라콤아이앤씨										
Harman International Industries, Inc.									100.0	
Red Bend Software Ltd.										100.0
計	71.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2017년 3분기말이며 보통주 기준입니다.

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율
㈜삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
Samsung C&T America Inc.	Meadowland Distribution	100.0
Samsung C&T America Inc.	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	10.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	S-print Inc	24.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SOUTHGATE SOLAR LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	WINDSOR SOLAR LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Arrnow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Arrnow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Arrnow LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 LP H.LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE DEVELOPMENT GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE DEVELOPMENT LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
Samsung Green repower, LLC	SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC	50.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL E&P LLC	90.0
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
PLL Holdings LLC	Parallel Petroleum LLC	61.0
SRE GRW LP Holdings LP	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
SRE SKW LP Holdings LP	South Kent Wind LP Inc.	50.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SOUTHGATE SOLAR GP INC.	SOUTHGATE SOLAR LP	0.0
WINDSOR SOLAR GP INC.	WINDSOR SOLAR LP	0.0
SRE Belle River LP Holdings LP	SP Belle River Wind LP	42.5
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Armow LP Holdings LP	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
SRE North Kent 1 LP H.LP	North Kent Wind 1 LP	35.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE Armow LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE North Kent 2 LP Holdings LP	North Kent Wind 2 LP	50.0
North Kent Wind 2 GP Inc	North Kent Wind 2 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Windsor Holdings GP Inc.	WINDSOR SOLAR GP INC.	50.0
SRE Southgate Holdings GP Inc.	SOUTHGATE SOLAR GP INC.	50.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE DEVELOPMENT GP INC.	SRE DEVELOPMENT LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	SRE North Kent 1 LP H.LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	North Kent Wind 2 GP Inc	50.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SRE Belle River LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0
Samsung Solar Energy 1 LLC	CS SOLAR LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SCNT Investment Atlantic SPRL	0.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, s.r.o	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Slovenia 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	94.3
Samsung C&T U.K. Ltd.	Samsung Nigeria Co., Ltd.	0.1
Solluce Romania 1 B.V.	LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L.	78.0
Solluce Slovenia 1 B.V.	ZE Solar 1 D.O.O.	70.0
Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	PT. Cahaya Borneo Sukses Agrosindo	49.0
Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	PT. Cassava Borneo Sukses Plantation	49.0
Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Samsung Development (Thailand) Co., Ltd.	67.0
Cheil Holding Inc.	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	75.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S-print Inc	16.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	12.7
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	10.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	13.2
Samsung C&T Hongkong Ltd.	천진국제무역공사	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Corporation (Guangzhou) Limited.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자㈜	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Canada Inc.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자㈜	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Hungarian RT.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Portuguesa S.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자㈜	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성전자㈜	Samsung Electronics Display (M) SDN.Bhd.	75.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics(M) SDN.BHD.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Asia Private Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자㈜	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자㈜	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자㈜	Samsung Malaysia Electronics(SME) Sdn.Bhd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자㈜	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	87.1
삼성전자㈜	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	89.6
삼성전자㈜	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자㈜	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자㈜	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자㈜	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	95.0
삼성전자㈜	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung SemiConductor Xian	100.0
삼성전자㈜	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자㈜	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자㈜	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	0.1
삼성전자㈜	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	82.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스	Samsung Bioepis TR Pharmaceutical Distributor LLC	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이㈜	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Slovakia s.r.o.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Suzhou Module Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	60.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이㈜	Novaled GmbH	9.9
세메스㈜	SEMES America, Inc.	100.0
세메스㈜	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
㈜삼성 메디슨	Samsung Medison India Private Ltd.	100.0
Studer Japan, Ltd.	Harman International Japan Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NexusDX, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Dacor Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung HVAC America, LLC(舊Quietside LLC)	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Joyent Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SamsungPay, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Prismview, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries Inc	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Dacor	100.0
Dacor Holdings, Inc.	EverythingDacor.com, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Distinctive Appliances of California, Inc.	100.0
Dacor	Dacor Canada Co.	100.0
Samsung Oak Holdings, Inc.	Stellus Technologies, Inc.	100.0
Joyent Inc	Joyent Ltd	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada Inc.	PrinterOn Corporation	100.0
Samsung Electronics Canada Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Electronics Canada Inc.	NewNet Communication Technologies (Canada), Inc.	100.0
PrinterOn Corporation	PrinterOn America Corporation	100.0
PrinterOn Corporation	PrinterOn Europe Limited	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
Samsung Research America, Inc	VivLabs	100.0
Samsung Research America, Inc	Kngine, Inc.	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Harman International Industries Inc	Studer Japan, Ltd.	100.0
Harman International Industries Inc	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries Inc	Red Bend Software Inc.	100.0
Harman International Industries Inc	S1NN USA, Inc.	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Connected Services Holding Corp.	100.0
Harman International Industries Inc	AMX Holding Corporation	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Financial Group, LLC	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Belgium SA	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Harman International Industries Inc	Harman Consumer Division Nordic A/S	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Consumer Finland OY	100.0
Harman International Industries Inc	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries Inc	Harman International SNC	0.0
Harman International Industries Inc	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries Inc	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Finance International SCA	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Finance International GP S.a.r.l	100.0
Harman International Industries Limited	ARCAM Ltd	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	100.0
Harman International Industries Inc	Harman International Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman International Industries Inc	Harman Industries Holdings Mauritius, Ltd	100.0
Harman International Industries Inc	Harman International Mexico S de RL de CV	100.0
AMX LLC	AMX UK Limited	100.0
AMX LLC	Knight Image Limited	100.0
AMX LLC	Inspiration Matters Limited	100.0
AMX LLC	Endeleo Limited	100.0
AMX LLC	Harman Professional Singapore Pte. Ltd	100.0
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Investment Group, LLC	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	5.0
Harman Investment Group, LLC	Harman Do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Professional, Inc.	AMX LLC	35.5
Harman Professional, Inc.	Southern Vision Systems, Inc.	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman Do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	0.0
Red Bend Software Inc.	Red Bend Software SAS France	100.0
Harman Connected Services Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services Inc.	Triple Play Integration LLC	100.0
Harman Connected Services Inc.	Harman Connected Services South America S.R.L.	100.0
Harman Connected Services Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Harman Connected Services Holding Corp.	Harman Connected Services Inc.	100.0
Harman Connected Services Holding Corp.	Harman Connected Services AB.	100.0
AMX Holding Corporation	AMX LLC	64.5
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian RT.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4
Samsung Electronics Hungarian RT.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (Propr	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkey	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Studer Professional Audio Gmbh	100.0
Harman Professional Denmark ApS	R&D International BVBA	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Harman Professional France SAS	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Harman Professional Germany GmbH	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Manufacturing UK Ltd.	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Pte. Ltd.	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Trading Zhuhai Ltd.	100.0
Harman France SNC	Harman International SNC	100.0
Harman Becker Automotive Systems Gmbh	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Becker Automotive Systems Gmbh	Ionroad Technologies, Ltd.	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman Becker Automotive Systems Gmbh	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman Deutschland Gmbh	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	95.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Duran Audio B.V.	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman RUS CIS, LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. Kg	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management Gmbh	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International s.r.o	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Professional Kft	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International Romania SRL	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Red Bend Ltd.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	TowerSec Ltd.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Finance International GP S.a.r.l	Harman Finance International SCA	0.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics Gmbh	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0
Duran Audio B.V.	Harman Investment Group, LLC	100.0
Duran Audio B.V.	Duran Audio Iberia Espana S.L.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Japan Co. Ltd.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Finland OY	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Limited	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services (Beijing) Solutions Co. Ltd.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services (Chengdu) Solutions Co. Ltd.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Taiwan Inc.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services OOO	100.0
AMX UK Limited	AMX Gmbh	100.0
Harman Automotive UK Limited	Harman De Mexico S De Rl De C.V.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman Automotive UK Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY. Ltd.	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
ARCAM Ltd	A&R Cambridge Ltd	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.A.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Innoetics E.P.E.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung France Research Center SARL	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novaled GmbH	40.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Display (M) SDN.Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd,.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.4
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	LAOS Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Harman Professional Singapore Pte. Ltd	AMX Products And Solutions Private Limited	100.0
Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	Aditi Technologies Europe GmbH	100.0
Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	INSP India Software Development Private Limited	100.0
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	100.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China - Tianjin	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Network R&D Center China-Shenzhen	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	12.9
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	10.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	43.1
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China - Nanjing	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	8.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd	Harman Automotive Infotech (Dalian) Co., Ltd	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd	Harman (Suzhou) Audio And Infotainment Systems Co., Ltd	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd	Harman (China) Technologies Co. Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman International (China) Holdings Co., Ltd	100.0
Harman Holding Limited	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd	100.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Maghreb Arab	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Harman Industries Holdings Mauritius, Ltd	Harman International (India) Private Limited	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	100.0
Ionroad Technologies, Ltd.	iOnRoad Limited	100.0
Red Bend Ltd.	Red Bend Software KK	100.0
Red Bend Ltd.	Red Bend Software Ltd.	100.0
Red Bend Ltd.	Broadsense Ltd.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Panama. S.A	100.0
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	Simpress Comercio, Locacao e Servicos S.A.	100.0
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Harman Do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes	100.0
Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd	0.0
삼성SDI㈜	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	89.2
삼성SDI㈜	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성SDI㈜	Samsung SDI Hungary Rt.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.	68.6
삼성SDI㈜	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성SDI㈜	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Lt	65.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	45.0
삼성SDI㈜	Novaled GmbH	50.1
삼성SDI㈜	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성SDI㈜	Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V.	100.0
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Brasil Ltda.	40.4
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI Brasil Ltda.	14.5
삼성전기㈜	Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Japan Advanced Technology Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기㈜	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS GMBH	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	75.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기㈜	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기㈜	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	Samsung Electro-Mechanics do Brasil Intermediacoes de Negocios Ltda.	100.0
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
삼성화재해상보험㈜	SAMSUNG FIRE & MARINE MANAGEMENT CORPORATION	100.0
삼성화재해상보험㈜	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE	100.0
삼성화재해상보험㈜	P.T. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험㈜	Samsung Vina Insurance Co., Ltd	75.0
삼성화재해상보험㈜	SAMSUNG REINSURANCE PTE. LTD	100.0
삼성화재해상보험㈜	삼성재산보험(중국)유한공사	100.0
삼성화재해상보험㈜	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East	100.0
삼성화재해상보험㈜	SAMSUNG FIRE & MARINE CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA.	100.0
삼성중공업㈜	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업㈜	Offshore 1 consulting Corporation	51.0
삼성중공업㈜	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업㈜	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업㈜	삼성중공업(영파)유한공사	100.0
삼성중공업㈜	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업㈜	영성가야선업유한공사	100.0
삼성중공업㈜	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
삼성중공업㈜	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES BRASIL ASSESSORIA EM PROJETOS EMPRESARIAIS LTDA.	100.0
삼성중공업㈜	SHI BRAZIL CONSTRUCTION	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험㈜	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험㈜	30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED	100.0
삼성생명보험㈜	THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD.	35.8
삼성생명보험㈜	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	90.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED	30 GRESHAM STREET (SINGAPORE) LIMITED	100.0
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	100.0
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L	100.0
Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	MYODO METAL CO., LTD.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Finance Corporation.	80.0
삼성물산㈜	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산㈜	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	90.0
삼성물산㈜	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산㈜	SCNT Power Norte S. De R.L. de C.V.	100.0
삼성물산㈜	QSSC, S.A. de C.V.	60.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Canada Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산㈜	Whessoe engineering Limited	100.0
삼성물산㈜	SCNT Investment Atlantic SPRL	100.0
삼성물산㈜	POSS-SLPC, s.r.o	50.0
삼성물산㈜	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산㈜	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산㈜	Solluce Slovenia 1 B.V.	80.0
삼성물산㈜	Ecosolar OOD	100.0
삼성물산㈜	Ecoenergy Solar OOD	100.0
삼성물산㈜	Agrilplam EOOD	100.0
삼성물산㈜	Fishtrade EOOD	100.0
삼성물산㈜	Manageproject EOOD	100.0
삼성물산㈜	Solar Park EOOD	100.0
삼성물산㈜	Veselinovo Energy OOD	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Construction Hungary Kft.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T (KL) Sdh.,Bhd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산㈜	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산㈜	S-print Inc	40.0
삼성물산㈜	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	29.7
삼성물산㈜	Samsung Development (Thailand) Co., Ltd.	33.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	43.9
삼성물산㈜	Cheil Holding Inc.	40.0
삼성물산㈜	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	25.0
삼성물산㈜	Samsung Design Philippines Inc	100.0
삼성물산㈜	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	90.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성물산㈜	Samsung C&T India Pte., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산㈜	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산㈜	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	40.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Nigeria Co., Ltd.	99.9
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산㈜	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산㈜	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산㈜	JSC BALKHASH THERMAL POWER PLANT	50.0
삼성물산㈜	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산㈜	Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.	6.4
삼성물산㈜	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	0.0
삼성물산㈜	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	10.0
삼성물산㈜	Cheil Industries Corp., USA	100.0
삼성물산㈜	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산㈜	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	100.0
삼성물산㈜	CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성물산㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	19.3
삼성웰스토리㈜	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	90.0
삼성웰스토리㈜	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	85.0
삼성웰스토리㈜	Shanghai Welstory Food Company Limited	70.0
㈜멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC	82.4
Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd.	Eight Seconds (Shanghai) Trading Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai China Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai e-Commerce Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai Marketing Service Co., Ltd.	100.0
PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	MEDIALYTICS Inc.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권㈜	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권㈜	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권㈜	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL America, Inc.	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GSCL CANADA., LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Europe Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Hungary Kft.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL UK Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung GSCL Portugal, Sociedade Unipessoal Lda	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Austria GmbH	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Czech s.r.o.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Switzerland GmbH	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS VIETNAM CO., LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS India Private Limited	100.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL ASIA PACIFIC PTE. LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS GSCL Vietnam Co Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	100.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL AUSTRALIA PTY., LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	SDS-ACUTECH CO., LTD	50.0
삼성에스디에스㈜	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS China, Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt Co. Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Transport and Logistics Joint Stock Company	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda	99.7
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD	99.7
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	100.0
(주)미라콤아이앤씨	MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda	0.3
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S. A.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C.	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD	0.3
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	0.0
Samsung SDS China, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd	100.0
Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd.	Samsung SDS Global Development Center Xi'an	100.0
MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	MIRACOM INC CHINA LTD	100.0
삼성엔지니어링㈜	Offshore 1 consulting Corporation	49.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering America Inc.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering Hungary Ltd.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	100.0
삼성엔지니어링㈜	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering India Private Ltd.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering Vietnam	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Lt	100.0
삼성엔지니어링㈜	SAMSUNG ENGINEERING CONSTRUCTION XIAN CO., LTD.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Saudi Arabia Company Limited.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	64.8
삼성엔지니어링㈜	Muharraq STP Company B.S.C.	4.6
삼성엔지니어링㈜	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	45.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링㈜	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering Bolivia S.A	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering Kazakhstan LLP	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	100.0
Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Engineering India Private Ltd.	Samsung Saudi Arabia Company Limited.	0.0
Samsung Saudi Arabia Company Limited.	Samsung EPC Company Ltd.	75.0
Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Muharraq STP Company B.S.C.	89.9
㈜에스원	SOCM LLC	100.0
㈜에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
㈜에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
㈜제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
㈜제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
㈜제일기획	IRIS Worldwide Holdings Limited	85.2
㈜제일기획	Cheil Europe Ltd.	100.0
㈜제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
㈜제일기획	Cheil France SAS	100.0
㈜제일기획	Cheil Nordic AB	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
㈜제일기획	Cheil India Pvt. Ltd.	100.0
㈜제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
㈜제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
㈜제일기획	Cheil Vietnam Co. Ltd.	90.0
㈜제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
㈜제일기획	Cheil Malaysia SDN BHD	100.0
㈜제일기획	Cheil China	100.0
㈜제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
㈜제일기획	Bravo Asia Limited	100.0
㈜제일기획	Bravo Asia-Shanghai	100.0
㈜제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
㈜제일기획	Cheil South Africa Pty., Ltd.	100.0
㈜제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
㈜제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
㈜제일기획	Cheil Jordan LLC	100.0
㈜제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
㈜제일기획	Cheil Brazil Communications Ltda.	100.0
㈜제일기획	Cheil Mexico Inc. SA de CV	98.0
㈜제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
㈜제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
㈜제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
㈜제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
㈜호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
㈜호텔신라	SAMSUNG HOSPITALITY U.K. Limited	100.0
㈜호텔신라	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
㈜호텔신라	Shilla Travel Retail Pte.Ltd	100.0
㈜호텔신라	SAMSUNG HOSPITALITY VIETNAM CO.,LTD	99.0
㈜호텔신라	SHILLA HOSPITALITY PHILIPPINES INC.	100.0
㈜호텔신라	SAMSUNG HOSPITALITY INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
㈜호텔신라	SHILLA LIMITED Macao	100.0
㈜호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
㈜호텔신라	SHILLA LIMITED Hong Kong	100.0
㈜호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris USA, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Experience, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Latin America, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Worldwide San Diego, Inc.	100.0
Iris Latin America, Inc.	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	0.0
Iris Latin America, Inc.	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	0.0
Iris Canada Holdings Ltd	Pricing Solutions Ltd	75.1
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Pvt. Ltd.	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico Inc. SA de CV	2.0
Samsung Hospitality America Inc.	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
IRIS Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
IRIS Worldwide Holdings Limited	Josh & James Limited	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Canada Holdings Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	76.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Products (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Korea Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris PR Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Concise Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Amsterdam B.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Datalytics Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Culture Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Concise Consultants Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions (UK) Limited	75.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Pvt Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Sydney PTY Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris (Beijing) Advertising Company Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Hong Kong Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0
Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded Partners, Inc.	100.0
Iris Ventures (Worldwide) Limited	THE ELEPHANT ROOM LIMITED	49.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper Technologies Pte Limited	100.0
Cheil Europe Ltd.	BEATTIE MCGUINNESS BUNGAY LIMITED	100.0
Cheil Europe Ltd.	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL SPAIN S.L	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL BENELUX B.V.	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	95.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Cheil Hong Kong Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	3.1
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Samsung Hospitality China Co.,Ltd	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	0.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ LLC	One RX India PVT. LTD	100.0

출자회사명	피출자회사명	지분율
One Agency FZ LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Interior Design LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Printing LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency South Africa Pty., Ltd.	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Russia LLC	99.9
One RX Interior Design LLC	One RX India PVT. LTD	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0
Cheil Rus LLC	One RX Russia LLC	0.1

※ 단위는 %, 기준일은 2017년 3분기말, 보통주 기준입니다.

3. 관련법령상의 규제내용 등

○ “ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 上 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기 : 2017년 5월 1일

② 규제내용 요약

- 상호출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융·보험사의 계열사 의결권 제한
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(2017.09.30 현재)

성명	계열사 겸직현황		
	회사명	직위	상근여부
권오현	삼성디스플레이	대표이사	상근
전동수	삼성메디슨	대표이사	상근
김용식	세메스	대표이사	상근
신재호	세메스	감사	비상근
최정준	로지텍	감사	비상근
	전자판매	감사	비상근
	서비스	감사	비상근
	삼성디스플레이	감사	비상근
박순철	삼성메디슨	감사	비상근
	에스프린팅	감사	비상근
	삼성벤처투자	감사	비상근
박광채	삼성메디슨	사내이사	상근
이원준	삼성경제연구소	감사	비상근
허석	스테코	기타 비상무이사	비상근
오종훈	스테코	감사	비상근
윤태양	세메스	기타 비상무이사	비상근
장세연	세메스	기타 비상무이사	비상근
서기호	세메스	기타 비상무이사	비상근

5. 타법인출자 현황

2017년 3분기말 현재 당사의 타법인 출자금액은 장부가 기준 57조 387억원이며,
사업관련 등으로 출자하였습니다.

[2017.09.30 현재] (단위 : 천주, 백만원, %)

계정과목		법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
						수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분 율	장부가액	총자산	당기 순손익	
									수량	금액							
매도가능증권 등	상장	삼성전기㈜	1977.01	사업관련	250	17,693	23.69	445,244				17,693	23.69	445,244	7,662,629	22,914	
	비상장	스테코㈜	1995.06	경영참가 등	24,000	2,590	70	35,861				2,590	70	35,861	112,968	334	
	비상장	세메스㈜	1992.12	경영참가 등	1,000	2,173	91.54	71,906				2,173	91.54	71,906	889,089	55,962	
	비상장	삼성경제연구소㈜	1991.05	사업관련	320	3,576	29.8	24,942				3,576	29.8	24,942	110,400	33	
	상장	삼성에스디에스㈜	1992.07	사업관련	6,160	17,472	22.58	560,827				17,472	22.58	560,827	6,842,004	514,328	
	비상장	삼성전자서비스㈜	1998.01	경영참가 등	30,000	6,000	99.33	48,121				6,000	99.33	48,121	296,820	-4,578	
	비상장	삼성전자판매㈜	2000.12	경영참가 등	3,100	1,767	100	247,523				1,767	100	247,523	597,695	1,730	
	비상장	삼성전자로지텍㈜	1999.04	경영참가 등	76	1,011	100	46,669				1,011	100	46,669	143,800	11,562	
	비상장	삼성디스플레이㈜	2012.04	경영참가 등	16,009,547	221,969	84.78	18,509,307				221,969	84.78	18,509,307	43,305,405	1,498,628	
	비상장	SVIC 21호 투자조합	2011.11	경영참가 등	19,800	1	99	97,570	0	-11,484		1	99	86,086	99,815	6,525	회수
	비상장	SVIC 22호 투자조합	2011.11	경영참가 등	19,800	1	99	147,282	0	-7,920		1	99	139,362	143,315	-14,804	회수
	비상장	SVIC 26호 투자조합	2014.11	경영참가 등	19,800	2	99	183,744	0	-11,613		2	99	172,131	169,961	-6,288	회수/출자
	비상장	SVIC 27호 투자조합	2014.09	경영참가 등	5,940	0	99	15,642	0	3,366		0	99	19,008	15,131	-1,430	출자
	비상장	SVIC 28호 투자조합	2015.02	경영참가 등	7,425	2	99	159,984	0	-1,990		2	99	157,994	175,205	-1,228	회수/출자
	비상장	SVIC 32호 투자조합	2016.08	경영참가 등	19,800	0	99	40,194	0	29,373		0	99	69,567	39,936	-1,924	출자
	비상장	SVIC 33호 투자조합	2016.11	경영참가 등	4,950	0	99	4,950	0	58,455		0	99	63,405	5,008	-692	출자
	비상장	삼성메디슨	2011.02	경영참가 등	286,384	87,350	68.45	477,648				87,350	68.45	477,648	303,561	-24,455	
	비상장	에스프린팅솔루션㈜	2016.11	사업관련	218,370	10,000	100	218,370				10,000	100	218,370	568,549	-1,029	
	상장	삼성바이오로직스㈜	2011.04	사업관련	30,000	20,837	31.49	443,193				20,837	31.49	443,193	7,533,016	-176,823	
	비상장	인텔렉추얼디스커버리	2011.05	사업관련	5,000	1,784	15.71	5,241				1,784	15.71	5,241	42,653	-4,067	
	상장	삼성중공업㈜	1977.09	사업관련	125	65,931	16.91	609,862			128,565	65,931	16.91	738,427	17,217,463	-138,777	평가
	상장	호텔신라㈜	1979.12	사업관련	252	2,005	5.11	96,527			20,148	2,005	5.11	116,675	2,040,955	27,830	평가
	상장	제일기획㈜	1988.09	사업관련	185	29,038	25.24	491,599				29,038	25.24	491,599	2,151,432	90,648	

계정과목		법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
						수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분 율	장부가액	총자산	당기 순손익	
									수량	금액							
	상장	에이테크솔루션	2009.11	사업관련	26,348	1,592	15.92	16,636			-3,200	1,592	15.92	13,436	159,802	1,285	평가
	상장	㈜아이마켓코리아	2000.12	사업관련	1,900	647	1.8	6,732			-511	647	1.8	6,221	1,334,065	35,590	평가
	상장	㈜케이티스카이라이프	2001.12	사업관련	3,344	240	0.5	4,152			-696	240	0.5	3,456	777,948	68,863	평가
	상장	삼성SDI㈜	1977.01	사업관련	304	13,463	19.58	1,242,605				13,463	19.58	1,242,605	14,900,311	211,111	
	상장	원익아이피에스	2016.04	사업관련	16,214	1,851	4.48	48,495			14,622	1,851	4.48	63,117	280,654	22,519	평가
	상장	원익홀딩스(舊원익IPS)	2013.12	사업관련	15,411	1,759	2.28	11,857			1,442	1,759	2.28	13,299	862,636	198,964	평가
	비상장	에스에스엘엠	2012.04	사업관련	52,296	220	0.39	0	-220	0		0	0	0	176,271	-32,484	매각
	비상장	기협기술금융㈜	1995.01	사업관련	5,000	1,000	17.24	5,000				1,000	17.24	5,000	97,792	1,117	
	비상장	한국경제신문㈜	1987.05	사업관련	150	72	0.39	365				72	0.39	365	265,249	22,122	
	비상장	삼성벤처투자㈜	1999.11	사업관련	4,900	980	16.33	7,515				980	16.33	7,515	93,335	7,076	
	비상장	㈜싸이버뱅크	2000.12	사업관련	8,000	1,083	7.46	0				1,083	7.46	0	0	0	
	비상장	화인칩스	2001.12	사업관련	10	2	3.81	10				2	3.81	10	4,476	686	
	비상장	에스케이텔링크㈜	2010.11	사업관련	4,357	15	1.13	4,357				15	1.13	4,357	445,376	59,598	
	비상장	인켈	2006.11	사업관련	130	0	0	0				0	0	0	113,368	-22,459	
	상장	㈜용평리조트	2007.05	사업관련	1,869	400	0.83	3,432			1,008	400	0.83	4,440	928,946	14,321	평가
	비상장	삼보컴퓨터	2012.09	채권회수	0	0	0.01	0				0	0.01	0	37,789	2,315	
	비상장	아이큐브투자조합1호	2009.12	사업관련	4,000	0	16.23	4,000		-2,386		0	16.23	1,614	8,650	-4,350	회수
	비상장	케이티와이브로인프라	2010.07	사업관련	60,000	600	24.2	48,500	-600	-48,500		0	0	0	274,821	4,692	청산
	비상장	신성건설	2010.07	채권회수	1	0	0.01	0				0	0.01	0	50,934	-1,211	
	비상장	우방	2010.07	채권회수	0	1	0	0				1	0	0	334,186	37,017	
	비상장	희훈디앤지	2010.07	채권회수	0	2	0.02	0	-2	0		0	0	0	0	0	청산
	비상장	대우산업개발	2012.12	채권회수	0	0	0.02	0				0	0.02	0	164,940	7,845	
	비상장	대우송도개발	2012.12	채권회수	0	9	0.02	0				9	0.02	0	21,715	-1,162	
	비상장	자일자동차판매	2012.12	채권회수	0	1	0	0				1	0	0	279,358	5,590	
	비상장	우정건설㈜	2014.04	채권회수	0	5	0.35	0	-5	0		0	0	0	0	0	청산
	비상장	㈜현진	2014.04	채권회수	0	23	0.25	0				23	0.25	0	21,785	-5,511	
	비상장	성원건설㈜	2014.04	채권회수	0	1	0.03	0				1	0.03	0	27,744	-627	
	비상장	㈜인희	2014.04	채권회수	0	2	0.17	0				2	0.17	0	10,092	38	

계정과목	법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분 율	장부가액	총자산	당기 순손익	
								수량	금액							
비상장	삼성솔루션㈜	2014.04	채권회수	0	4	6.7	0				4	6.7	0	8,607	387	
비상장	STX건설㈜	2014.04	채권회수	0	0	0.01	0	0	0		0	0	0	76,758	-10,907	무상 소각
비상장	풍림산업	2014.05	채권회수	0	52	0.37	0				52	0.37	0	263,815	-60,461	
비상장	반도체성장펀드	2017.03	사업관련	500	0	0	0	34,500,000	34,500		34,500,000	66.67	34,500	0	0	출자
비상장	JNT(반도체펀드)	2011.02	사업관련	1,800	0	24	2,496	0	-384		0	24	2,112	9,937	-915	회수
비상장	SV(반도체펀드)	2011.02	사업관련	1,850	0	14.85	2,292		-2,292		0	14.85	0	19,502	-940	회수
비상장	서울투자파트너스	2011.10	사업관련	1,550	0	19.38	2,689		-221		0	19.38	2,468	11,627	-186	회수
비상장	대신아주IB (반도체펀드)	2011.08	사업관련	258	0	3	726				0	3	726	24,396	-8,781	
비상장	TS(반도체펀드)	2011.11	사업관련	1,700	0	20.48	1,204		-528		0	20.48	676	12,718	20	회수
비상장	IMM (반도체펀드)	2011.11	사업관련	760	0	7.6	708		-238		0	7.6	470	4,885	-4,145	회수
비상장	L&S (반도체펀드)	2012.07	사업관련	848	0	7.46	1,756				0	7.46	1,756	23,455	4,759	
비상장	말타니(舊태원전기산업)	2012.04	사업관련	16,544	45	15	16,270				45	15	16,270	73,361	1,318	
비상장	팬택자산관리	2013.06	사업관련	53,000	53,000	10.03	0				53,000	10.03	0	60,155	-399	
비상장	KTCNP-GC (반도체펀드)	2013.12	사업관련	960	0	3.56	5,255		-649		0	3.56	4,606	137,299	-7,731	회수
비상장	포스텍기술투자	2013.12	사업관련	600	0	10	600				0	10	600	5,762	-45	
비상장	지능정보기술연구원	2016.07	사업관련	3,000	600	14.29	3,000				600	14.29	3,000	19,927	1,149	
비상장	SECA	1992.08	해외거점 확보	3,823	0	100	90,922				0	100	90,922	728,783	48,727	
비상장	SEA	1978.07	해외거점 확보	59,362	492	100	10,063,081		6,990,726		492	100	17,053,807	21,810,492	246,141	증자
비상장	SELA	1989.04	해외거점 확보	319	40	100	86,962				40	100	86,962	371,630	41,466	
비상장	SEM	1995.07	해외거점 확보	3,032	3,837	63.58	165,638				3,837	63.58	165,638	1,136,282	95,024	
비상장	SEASA	1996.06	해외거점 확보	4,696	21,854	98	6,779				21,854	98	6,779	60,558	582	
비상장	SEDA	1994.01	해외거점 확보	13,224	77,205,709	87.04	647,620				77,205,709	87.04	647,620	5,200,799	966,821	
비상장	SECH	2002.12	해외거점 확보	597	0	4.1	597				0	4.1	597	438,074	17,303	
비상장	SESA	1989.01	해외거점 확보	3,276	8,021	100	142,091				8,021	100	142,091	794,238	34,156	
비상장	SENA	1992.03	해외거점 확보	392	1,000	100	69,372				1,000	100	69,372	961,566	24,867	
비상장	SEH	1991.05	해외거점 확보	1,954	753	100	650,157				753	100	650,157	1,743,979	89,712	
비상장	SEP	1982.09	해외거점 확보	204	1,751	100	37,616				1,751	100	37,616	157,324	6,821	
비상장	SEF	1991.08	해외거점 확보	230	2,700	100	234,115				2,700	100	234,115	1,207,985	56,790	

계정과목	법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분 율	장부가액	총자산	당기 순손익	
								수량	금액							
비상장	SEUK	1995.07	해외거점 확보	33,908	109,546	100	433,202				109,546	100	433,202	1,526,879	107,243	
비상장	SEHG	1982.02	해외거점 확보	28,042	0	100	354,846				0	100	354,846	532,697	96,966	
비상장	SEAG	2002.01	해외거점 확보	40	0	100	32,162				0	100	32,162	303,737	14,268	
비상장	SEI	1993.05	해외거점 확보	862	677	100	143,181				677	100	143,181	901,906	53,567	
비상장	SEBN	1995.07	해외거점 확보	236	539,138	100	914,751				539,138	100	914,751	1,319,479	27,363	
비상장	SELS	1991.05	해외거점 확보	18,314	1,306	100	24,288				1,306	100	24,288	2,887,230	36,768	
비상장	SEPOL	1996.04	해외거점 확보	5,462	106	100	78,267				106	100	78,267	526,135	39,215	
비상장	SSA	1998.12	해외거점 확보	263	2,000	100	32,622				2,000	100	32,622	491,077	18,583	
비상장	SESK	2002.06	해외거점 확보	8,976	0	55.68	263,767				0	55.68	263,767	2,053,467	115,387	
비상장	SEEH	2008.01	해외거점 확보	4,214	0	100	1,369,992				0	100	1,369,992	8,643,308	350,974	
비상장	SEO	1997.01	해외거점 확보	120	0	100	-10,043				0	100	-10,043	126,485	-941	
비상장	SERC	2006.01	해외거점 확보	24,877	0	100	188,290				0	100	188,290	981,971	59,986	
비상장	SERK	2007.07	해외거점 확보	4,600	0	100	204,555				0	100	204,555	902,533	112,741	
비상장	SEAU	1987.11	해외거점 확보	392	53,200	100	111,964				53,200	100	111,964	431,774	1,274	
비상장	SEMA	1989.09	해외거점 확보	4,378	16,247	100	153,602				16,247	100	153,602	136,334	14,555	
비상장	SGE	1995.05	해외거점 확보	827	0	100	32,836				0	100	32,836	873,034	-62,828	
비상장	SEEG	2012.07	해외거점 확보	23	0	0.05	39				0	0.05	39	610,030	48,512	
비상장	SEIN	1991.08	해외거점 확보	7,463	46	99.99	118,909				46	99.99	118,909	1,204,467	84,705	
비상장	SDMA	1995.03	해외거점 확보	21,876	71,400	75	244,382		-225,642		71,400	75	18,741	212,535	9,595	배당/ 감액
비상장	SIEL	1995.08	해외거점 확보	5,414	216,787	100	75,263				216,787	100	75,263	4,563,407	753,164	
비상장	SRI-B	2005.05	해외거점 확보	7,358	17	100	31,787				17	100	31,787	190,083	45,529	
비상장	SAVINA	1995.01	해외거점 확보	5,839	0	100	28,365				0	100	28,365	217,496	50,399	
비상장	TSE	1988.01	해외거점 확보	1,390	11,020	91.83	279,163				11,020	91.83	279,163	2,079,865	198,980	
비상장	STE	1996.01	해외거점 확보	4,206	2,499	49	0				2,499	49	0	6,772	0	
비상장	SME	2003.05	해외거점 확보	4,796	17,100	100	7,644				17,100	100	7,644	313,299	19,309	
비상장	SAPL	2006.07	해외거점 확보	793	877,133	100	981,483				877,133	100	981,483	5,528,472	1,056,956	
비상장	SEHK	1988.09	해외거점 확보	349	274,250	100	79,033				274,250	100	79,033	1,256,625	20,902	
비상장	SET	1994.11	해외거점 확보	456	27,270	100	112,949				27,270	100	112,949	1,857,017	-36,178	

계정과목	법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분 율	장부가액	총자산	당기 순손익	
								수량	금액							
비상장	SESS	1994.12	해외거점 확보	18,875	0	100	504,313				0	100	504,313	866,173	79,963	
비상장	SCIC	1996.03	해외거점 확보	23,253	0	100	640,452				0	100	640,452	13,632,938	298,373	
비상장	SEHZ	1992.12	해외거점 확보	792	0	89.56	255,535				0	89.56	255,535	6,174,579	764,426	
비상장	SSEC	1995.04	해외거점 확보	32,128	0	69.06	130,551				0	69.06	130,551	604,198	55,944	
비상장	TSEC	1993.04	해외거점 확보	15,064	0	48.2	138,101				0	48.2	138,101	831,374	125,192	
비상장	SSDP	1993.08	해외거점 확보	4,446	0	87.1	65,319				0	87.1	65,319	917,909	56,095	
비상장	TSTC	2001.03	해외거점 확보	10,813	0	90	490,041				0	90	490,041	1,354,396	225,537	
비상장	SSET	2002.02	해외거점 확보	6,009	0	95	121,624				0	95	121,624	147,439	11,604	
비상장	SESC	2002.09	해외거점 확보	5,471	0	73.7	34,028				0	73.7	34,028	923,116	41,963	
비상장	SSS	2001.01	해외거점 확보	1,200	0	100	19,189				0	100	19,189	5,862,409	181,041	
비상장	SSCR	2006.09	해외거점 확보	3,405	0	100	9,332				0	100	9,332	26,219	2,455	
비상장	TSOE	2010.04	해외거점 확보	33,837	0	82	73,893				0	82	73,893	87,314	-31,551	
비상장	TSLED	2012.04	해외거점 확보	119,519	0	100	119,519				0	100	119,519	391,711	49,608	
비상장	SCS	2012.09	해외거점 확보	111,770	0	100	3,888,196		137,204		0	100	4,025,400	9,749,448	1,113,218	증자
비상장	SSCX	2016.04	해외거점 확보	1,141	0	100	1,141				0	100	1,141	318,010	11,537	
비상장	SJC	1975.12	해외거점 확보	273	1,560	100	370,647				1,560	100	370,647	661,483	4,886	
비상장	SRJ	1992.08	해외거점 확보	3,120	122	100	117,257				122	100	117,257	156,447	3,543	
비상장	TSST Japan	2004.03	사업관련	1,639	30	49.03	0				30	49.03	0	850	-41	
비상장	SDIB	1996.09	사업관련	3,110	586	0.08	0				586	0.08	0	27,730	1,472	
비상장	Semiconductor Portal	2002.12	사업관련	38	0	1.21	10				0	1.21	10	1,682	57	
비상장	Nanosys, Inc	2010.08	사업관련	4,774	1,747	1.43	2,387				1,747	1.35	2,387	23,824	-13,454	
비상장	ONE BLUE LLC	2011.07	사업관련	1,766	0	16.67	1,766				0	16.67	1,766	37,111	1,263	
비상장	TidalScale	2013.08	사업관련	1,112	2,882	8.87	1,112				2,882	8.28	1,112	6,275	-6,077	
비상장	Sentiance	2012.12	사업관련	3,422	7	10.85	3,422				7	8.41	3,422	5,688	-2,661	
비상장	Mantis Vision	2014.01	사업관련	1,594	355	2.93	1,980				355	2.87	1,980	4,471	-7,191	
비상장	Argus Cyber Security	2015.09	사업관련	356	10	0.39	356	373			383	0.39	356	27,464	-5,640	주식 분할
비상장	INEDA	2014.04	사업관련	3,181	6,100	7.42	5,397				6,100	2.88	5,397	7,225	-15,654	
비상장	Leman	2014.08	사업관련	1,019	17	3.66	1,019				17	3.38	1,019	3,369	-3,240	

계정과목		법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
						수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분 율	장부가액	총자산	당기 순손익	
									수량	금액							
	비상장	Alces	2014.09	사업관련	4,832	421	18.5	4,832				421	18.5	4,832	2,878	-3,397	
	비상장	Keyssa	2016.01	사업관련	3,332	1,235	2.58	3,332				1,235	2.12	3,332	34,786	-23,422	
	비상장	Zyomed	2016.01	사업관련	2,044	1,464	2.88	2,044				1,464	2.88	2,044	17,136	-2,908	
	비상장	SensiFree	2016.01	사업관련	2,111	490	17.88	2,111				490	17.88	2,111	2,411	-2,642	
	비상장	Bot Home Automation	2016.03	사업관련	2,307	540	0.89	2,307				540	0.89	2,307	209,182	-57,704	
	비상장	Unispectral	2016.02	사업관련	1,112	115	8.83	1,112	2,193	1,018		2,308	13.07	2,130	2,220	-2,336	취득
	비상장	Quobyte	2016.04	사업관련	2,865	729	11.83	2,865				729	11.83	2,865	3,995	-1,773	
	비상장	Afero	2016.05	사업관련	5,685	723	5.6	5,685				723	5.72	5,685	7,480	-12,184	
	비상장	Graphcore	2016.06	사업관련	3,494	3,000	7.73	3,494				3,000	5.08	3,494	27,974	-10,171	
	비상장	Soundhound	2016.12	사업관련	7,059	306	1.24	7,059				306	1.2	7,059	48,723	-23,483	
합 계					17,734,439			49,936,537	34,501,739	6,940,795	161,378			57,038,710			

※ 별도기준으로 작성되었습니다.
※ 지분율은 보통주 기준입니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등

가. 채무보증 내역

- 국내채무보증 : 해당사항 없음

- 해외채무보증

(단위 : 천US$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역 (잔액)				채무보증한도	이자율 (%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	SMBC 外	2018-06-13	1,000,000	0	1,000,000	0	1,423,000		2016-11-09
SEM (멕시코생판법인)	계열회사	Santander 外	2018-08-19	0	0	0	0	546,000		2016-11-09
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	83,585	0	25,475	58,110	156,000	7.89%	2016-12-17
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	HSBC 外	2018-06-13	0	0	0	0	769,000		2016-10-08
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	0	9,436	0	9,436	178,000	2.40%	2016-11-09
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 外	2018-06-13	68,739	0	18,353	50,386	180,000	2.80%	2016-11-09
SSA (남아공판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	34,327	0	30,813	3,514	335,000	8.25%	2016-11-09
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 外	2017-12-16	0	1,513	0	1,513	110,000	5.00%	2016-11-09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BTMU 外	2018-06-13	187,867	22,795	0	210,662	590,000	12.12%	2016-11-09
SECE (카자흐판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-07-19	0	0	0	0	93,739		2016-12-17
SEEG (이집트생산법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	50,000		2017-06-14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 外	2018-06-13	0	0	0	0	186,000		2016-11-09
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 外	2018-05-31	0	32,434	0	32,434	886,603	0.27%	2016-11-09
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 外	2018-06-13	0	0	0	0	175,000		2016-11-09
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	101,326	0	101,326	0	391,000		2016-11-09
SECA (캐나다판매법인)	계열회사	Nova Scotia	2017-10-10	0	0	0	0	12,062		2016-10-11
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	30,000		2016-12-17
SEEH										

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역 (잔액)				채무보증한도	이자율 (%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
(네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 外	2018-09-05	0	0	0	0	727,000		2016-11-01
SERK (러시아생산법인)	계열회사	BNP 外	2018-06-28	0	0	0	0	345,000		2016-11-09
SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	10,000		2016-12-17
SAPL (싱가폴법인)	계열회사	BOA 外	2018-06-13	0	0	0	0	411,000		2016-11-09
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	15,000		2016-11-09
SAVINA (베트남생산법인)	계열회사	SCB 外	2018-06-13	0	0	0	0	71,000		2016-11-09
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	30,000		2016-11-09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 外	2018-06-13	0	0	0	0	350,000		2016-11-09
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	110,000		2016-11-09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	5,000		2016-12-17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	1,000		2016-12-17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	10,282	0	10,282	0	30,000		2016-11-09
Simpress (브라질판매법인)	계열회사	BNP	2017-11-08	44,529	722	0	45,250	60,000	10.65%	2016-11-09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	2,000		2017-06-14
SEPM (폴란드판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	86,870	15,749	0	102,619	125,000	1.85%	2017-06-14
Adgear (캐나다판매법인)	계열회사	BOA	2017-11-08	0	0	0	0	2,000		2016-11-09
Harman Finance International SCA	계열회사	JP Morgan 外	2022-05-27	367,115	45,203	0	412,318	412,318	2.00%	2015-05-27
합 계				1,984,640	127,852	1,186,249	926,242	8,817,722		

※ 채무보증 내역 중 기초잔액 및 기말잔액이 없는 법인은 未포함
※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관 계	변동금액					잔액	비고
		유가증권의 종류	매수	매도	합계	매매손익		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SAS	계열회사	자산매각/매입	2017.09.25	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	71,874	58,136
SCS	계열회사	자산매각/매입	2017.09.06	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	51,092	5,100
SESS	계열회사	자산매각/매입	2017.08.11	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	11,283	1,958
Kngine	계열회사	자산매입	2017.08.24	매입일자	기타의무형자산	소프트웨어 개발 등	4,821	-
SSEC	계열회사	자산매입	2017.03.16	매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	2,527	-
SEV	계열회사	자산매각/매입	2017.09.18	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	2,472	177
SSEC(E)	계열회사	자산매입	2017.09.12	매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	2,027	-
TSE	계열회사	자산매각	2017.03.01	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	842	19
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2017.09.22	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	800	△40
SESK	계열회사	자산매각/매입	2017.08.21	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	504	13
SEHC	계열회사	자산매각	2017.09.01	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	472	85
SEUK	계열회사	자산매입	2017.02.28	매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	433	-
SEHZ	계열회사	자산매각/매입	2017.09.12	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	280	2
TSTC	계열회사	자산매입	2017.09.08	매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	215	-
SEDA	계열회사	자산매각	2017.03.14	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	203	125
TSLED	계열회사	자산매입	2017.09.26	매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	186	-
SEIN	계열회사	자산매각/매입	2017.08.01	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	132	44
SII	계열회사	자산매각	2017.08.30	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	128	19

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었습니다. [△는 부(-)의 값임]
※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상은 아닙니다.
※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

당사는 2017년 3분기중 법인 Capa 증설 등의 목적으로 자산을 SAS(Samsung Austin Semiconductor LLC.) 등 계열회사에 매각하였으며, 국내생산 효율화를 위해 설비 등 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SEA	계열회사	매출입 등	2017.01~2017.09	HHP 및 가전제품 매출입 등	19,946,516
SSI	계열회사	매출입 등	2017.01~2017.09	반도체 매출입 등	17,507,654
SEVT	계열회사	매출입 등	2017.01~2017.09	HHP 매출입 등	14,826,391
SSS	계열회사	매출입 등	2017.01~2017.09	반도체 매출 등	12,379,597
SEV	계열회사	매출입 등	2017.01~2017.09	HHP 및 가전제품 매출입 등	9,856,026
SEHZ	계열회사	매출입 등	2017.01~2017.09	HHP 및 TV 매출입 등	9,370,021

※ 2017년 중 계열회사인 SEA(Samsung Electronics America, Inc.) 법인 등과 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2017년 3분기말 현재 제품경쟁력 제고 및 상생경영을 위한 협력회사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,359억의 대여금이 있습니다.
또한, 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 2017년 3분기말 현재 77억을 한도로 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	대여금 내역					비 고
		계정과목	거래내역				
			기초잔액	증가	감소	기말잔액	
세스트 외	협력업체	단기대여금	31,271	2,592	1,862	32,001	
범진아이앤디 외	협력업체 및 종업원	장기대여금	84,382	128,667	109,174	103,876	
합 계			115,653	131,259	111,036	135,877	

※ 상기 내역은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금 차감전 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
2016.09.12	프린팅솔루션 사업부문 양도	본건 거래는 기본양수도계약 상의 선행조건 충족을 전제로 계약체결일로부터 1년 내 종결 예정이나, 종결 일정은 추후 변동 가능합니다.	거래 종결

※ 거래 종결에 따라 관련 예정일정 등 공시사항을 정정합니다. 한국, 미국, EU, 중국 등 본건 거래와 관련된 국가에서의 기업결합 승인 등 기본양수도계약 상의 선행조건들이 충족되어 2017.11.01 본건 거래가 종결되었습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

2017.09.30일 기준

주총일자	안 건	결의내용
제48기 정기주주총회 ('17.3.24)	1. 제48기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결
제48기 임시주주총회 ('16.10.27)	1. 프린팅솔루션 사업부 분할계획서 승인의 건 2. 사내이사 이재용 선임의 건	가결 가결
제47기 정기주주총회 ('16.3.11)	1. 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 선임의 건 2-1-1호 : 사외이사 이인호 선임의 건 2-1-2호 : 사외이사 송광수 선임의 건 2-1-3호 : 사외이사 박재완 선임의 건 2-2호 : 사내이사 선임의 건 2-2-1호 : 사내이사 윤부근 선임의 건 2-2-2호 : 사내이사 신종균 선임의 건 2-2-3호 : 사내이사 이상훈 선임의 건 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-3-1호 : 감사위원회 위원 이인호 선임의 건 2-3-2호 : 감사위원회 위원 송광수 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 정관 일부 변경의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
제46기 정기주주총회 ('15.3.13)	1. 제46기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 선임의 건 2-1-1호 : 사외이사 김한중 선임의 건 2-1-2호 : 사외이사 이병기 선임의 건 2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이사 권오현) 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이사 김한중) 3. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결

3. 중요한 소송사건

(1) Apple사

① 1차 소송

구 분	내 용
소제기일	2011년 4월 15일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 트레이드 드레스, 실용 특허, 디자인 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
진행현황	2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 당사 제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 평결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 당사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 당사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 당사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 당사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 당사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 당사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 당사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다. 2016년 12월 6일 대법원은 당사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월 7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다.
향후 소송일정	디자인 관련 재재판(2018년 5월)
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

② 2차 소송

구 분	내 용
소제기일	2012년 2월 8일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
	2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두 번째 소송과 관련해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 평결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 당사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 1

진행현황	8일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 번복하여 Apple사의 기술특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 번복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 당사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 당사 상고에 반대하는 법정조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 당사 상고를 기각하였습니다.
향후 소송일정	향후분 로열티 관련 대응(2018년 1월, 1심 법원 심리)
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향은 향후분 로열티 관련 법원 판단이 남아 있으므로 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

(2) TFT-LCD 판매 관련

① Iiyama社 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2014년 12월 19일
소송 당사자	원고 : Mouse Computer社, 유럽內 Iiyama 5개社 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	원고 신청에 의한 항소 진행 중
향후 일정 및 전망	2017년 12월 항소 구두변론 진행 예정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

② 영국 정부기관 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2015년 11월 4일
소송 당사자	원고 : 영국 42개 정부기관 피고 : 삼성전자 및 해외 판매 자회사
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대한 영국 정부기관 클레임
진행상황	소장 송달 완료
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

③ 이스라엘LCD 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2013년 11월 26일
소송 당사자	원고 : Hatzlacha 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중

구 분	내 용
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

(3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 채무보증내역

- 국내채무보증

2017년 3분기말 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대한 채무보증 약정한도는 51,383백만원이며, 잔액은 33,302백만원입니다.
이외 메디캐피탈에 대하여 다임기업투자 등에 한도 2,264백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

- 해외채무보증

(단위 : 천US$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거래내역(잔액)				채무보증한도	이자율(%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	SMBC 外	2018-06-13	1,000,000	0	1,000,000	0	1,423,000		2016-11-09
SEM (멕시코생판법인)	계열회사	Santander 外	2018-08-19	0	0	0	0	546,000		2016-11-09
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	83,585	0	25,475	58,110	156,000	7.89%	2016-12-17
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	HSBC 外	2018-06-13	0	0	0	0	769,000		2016-10-08
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	0	9,436	0	9,436	178,000	2.40%	2016-11-09
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 外	2018-06-13	68,739	0	18,353	50,386	180,000	2.80%	2016-11-09
SSA (남아공판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	34,327	0	30,813	3,514	335,000	8.25%	2016-11-09
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 外	2017-12-16	0	1,513	0	1,513	110,000	5.00%	2016-11-09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BTMU 外	2018-06-13	187,867	22,795	0	210,662	590,000	12.12%	2016-11-09
SECE (카자흐판매법인)	계열회사	Citibank 外	2018-07-19	0	0	0	0	93,739		2016-12-17
SEEG (이집트생산법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	50,000		2017-06-14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 外	2018-06-13	0	0	0	0	186,000		2016-11-09
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 外	2018-05-31	0	32,434	0	32,434	886,603	0.27%	2016-11-09
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 外	2018-06-13	0	0	0	0	175,000		2016-11-09
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 外	2018-06-13	101,326	0	101,326	0	391,000		2016-11-09
SECA (캐나다판매법인)	계열회사	Nova Scotia	2017-10-10	0	0	0	0	12,062		2016-10-11
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	30,000		2016-12-17
SEEH	계열회사	HSBC 外	2018-09-05	0	0	0	0	727,000		2016-11-01

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역 (잔액)				채무보증한도	이자율 (%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
(네덜란드지주사)										
SERK (러시아생산법인)	계열회사	BNP 外	2018-06-28	0	0	0	0	345,000		2016-11-09
SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	10,000		2016-12-17
SAPL (싱가폴법인)	계열회사	BOA 外	2018-06-13	0	0	0	0	411,000		2016-11-09
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	15,000		2016-11-09
SAMNA (베트남생산법인)	계열회사	SCB 外	2018-06-13	0	0	0	0	71,000		2016-11-09
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	30,000		2016-11-09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 外	2018-06-13	0	0	0	0	350,000		2016-11-09
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	0	0	0	0	110,000		2016-11-09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	5,000		2016-12-17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	2017-12-16	0	0	0	0	1,000		2016-12-17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	2017-11-08	10,282	0	10,282	0	30,000		2016-11-09
Simpress (브라질판매법인)	계열회사	BNP	2017-11-08	44,529	722	0	45,250	60,000	10.65%	2016-11-09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	2,000		2017-06-14
SEPM (폴란드판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	86,870	15,749	0	102,619	125,000	1.85%	2017-06-14
Adgear (캐나다판매법인)	계열회사	BOA	2017-11-08	0	0	0	0	2,000		2016-11-09
Harman Finance International SCA	계열회사	JP Morgan 外	2022-05-27	367,115	45,203	0	412,318	412,318	2.00%	2015-05-27
합 계				1,984,640	127,852	1,186,249	926,242	8,817,722		

※ 채무보증 내역 중 기초잔액 및 기말잔액이 없는 법인은 未포함
※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반으로 2012년 7월 10일 시정명령 및 과징금(14,126백만원) 부과 처분을 받아 소송을 제기하여 현재 법원에 소송 계속 중에 있습니다. 당사는 공정거래 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대해 불공정거래 예방교육을 시행하고 있습니다.

그리고 당사는 공정거래위원회로부터 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제4조(중요정보의 고시 및 통합공고) 위반으로 2014년 1월 13일 과태료(26백만원) 부과 처분을 받아 과태료를 납부하였습니다. 당사는 표시·광고의 공정화에 관한 법률 준수를 위해 임직원에 대해 교육을 시행하고 있습니다.

당사는 2013년 1월 28일 불산누출 사고 및 노동부 등 특별감독 결과와 관련하여 2013년 3월 7일에 산업안전보건기준에 관한 규칙 266조(차단밸브의 설치 금지) 등 위반으로 과태료 267백만원을, 2013년 4월 1일에 유해화학물질관리법 제46조(화학물질관리대장 미작성) 등 위반으로 개선명령 및 과태료 2.2백만원을 부과 처분 받아 이행보고 및 과태료를 납부하였습니다. 이와 관련하여, 2014년 10월 31일 1심 판결(수원지방법원)에서 당사 임직원 3명(화학물질 공급관리자(Career Level 4):근속년수 20년, 유해화학물질 관리자(퇴직,CL3):근속년수 8년, 화학물질 공급실무자(CL2):근속년수 11년)에게 총 15백만원의 벌금이 선고되었으며, 현재 상고심재판 진행 중입니다. 당사는 안전 관리 담당자의 능력 향상을 위하여 관련 교육을 시행하고 있으며, 아울러 위험설비 유지·관리업무에 대한 관리감독을 강화하고 있습니다.

2013년 5월 2일 불산누출 사고와 관련하여서는, 2014년 2월 27일에 산업안전보건법 및 유해화학물질관리법 제24조 유독물의 관리기준(안전보호구 착용) 등 위반으로 벌금 4.5백만원을 부과 처분 받아 납부하였습니다. 당사는 Leak 예방 조직 신설 등 안전보건관리시스템을 전면 재구축하여 재발하지 않도록 노력하고 있습니다.

당사는 2013년 8월 환경부 및 경기도 합동 점검시 수입 화학물질 미신고로 유해화학물질관리법 제9조(수입화학물질 확인) 위반으로 과태료(166.7백만원) 부과 처분 받아 납부하였습니다. 당사는 수입 화학물질 신고 프로세스개선 등을 통해 사전 신고 여부를 확인하고 있습니다.

당사는 2014년 6월 16일부터 6월 20일까지 진행된 검찰・고용노동부 합동점검 결과와 관련하여 2015년 7월 29일 산업안전보건법 24조(보건상의 조치) 등 안전조치 의무 위반으로 당사 임원(안전보건관리총괄책임자(고문):근속년수 32년)과 회사 각 2백만원의 벌금을 부과처분(수원지방법원) 받아 납부 완료하였습니다. 당사는 재발방지를 위하여 환경안전 사전평가시스템을 개발하여 정기진단을 실시하고 있습니다.

당사는 2015년 12월 14일부터 12월 16일까지 진행된 고용노동부 정기감독 등과 관련하여 2015년 12월 31일 산업안전보건법 49조의2 7항(공정안전보고서 제출) 등 위반으로 2,345만원의 과태료를 부과받아 기한 내 20% 감경된 금액으로 1,876만원 자진 납부 완료하였습니다. 이와 관련하여 당사는 유해위험기계기구 안전검사 시스템을 개발하여 준법 경영을 강화하고 있습니다.

2016년 12월 5일부터 12월 9일까지 진행된 고용노동부 PSM 이행상태점검 등과 관련하여 2016년 12월 14일 산업안전보건법 49조의2 7항(공정안전보고서 제출) 등 위반으로 352만원의 과태료를 부과받아 자진 납부완료하였습니다. 당사는 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.
상기 기술된 임직원 근속년수는 제재일 기준입니다.

'박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사'는 2017년 2월 28일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등의 혐의로 당사 임원 5명(이재용 부회장, 최지성 前 부회장, 장충기 前 사장, 박상진 前 사장, 황성수 前 전무)을 기소하였고, 서울중앙지방법원은 2017년 8월 25일 위 혐의를 일부 인정하여 이재용 부회장 징역 5년, 최지성 前 부회장 징역 4년, 장충기 前 사장 징역 4년, 박상진 前 사장 징역 3년 및 집행유예 5년, 황성수 前 전무 징역 2년 6개월 및 집행유예 4년을 선고하였습니다. 이 사건은 현재 항소심 재판이 진행 중으로, 당사는 향후 진행 상황을 확인할 예정입니다.

당사(삼성디스플레이 포함)는 삼성디스플레이 주식회사의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

당사(삼성디스플레이 포함)는 2013년 10월 23일 Corning Incorporated 등과 포괄적 사업협력에 대한 기본계약을 체결하였습니다. 동 계약은 상호 간의 손실보전 조건을 포함하고 있어 향후 자원의 유입 또는 유출이 있을 수 있으며, 보고기간종료일 현재 지급이 예상되는 금액을 부채로 계상하였습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 연결재무제표 및 재무제표의 우발부채와 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다.

6. 단기매매차익 미환수 현황

당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

7. 대외후원 현황

현 황	금 액	내 용	비 고
2017년사회공헌기금 운영 계획	125.9억원	- 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2017년 회사매칭기금으로 125.9억원 운영 계획 - 동 기금은 국내외 봉사활동 지원 및 지역 사회공헌 활동 등에 사용 예정	'17.3.24 이사회 의결
국제기능올림픽 후원	135만 유로 (약16.3억원)	- 제 44회 UAE 아부다비 국제기능올림픽대회 최상위 스폰서 후원 및 2017~2018년 국제기능올림픽위원회 (WorldSkills International) 후원	
호암재단 기부금 출연	40억원	- '호암상' 시상 등 재단사업 지원을 위한 출연	'17.4.27 이사회 의결
언론재단 기부금 출연	17억원	- '삼성언론상' 운영 등 언론 발전 사업을 지원하기 위한 출연	
삼성복지재단 기부금 출연	240억원	- 저소득층 중학생 학습지원	
삼성생명공익재단 기부금 출연	377억원	- 삼성의료원 운영 지원 등	
성균관대학 기부금 출연	150억원	- 삼성장학금 지원 등	

8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 작성기준일 이후 2017년 10월 31일자 이사회 결의에 의거 자기주식 취득 및 소각을 결정하였습니다. 취득 예정 주식수는 총 89만주(보통주 71.2만주, 우선주 17.8만주)이며, 취득 종료 예상일은 2018년 1월 31일입니다. 동 이사회 결의에 의거 취득한 자기주식은 소각할 예정입니다.

당사는 작성기준일 이후 2017년 10월 31일자 이사회 결의에 의거 2017년 9월 30일을 배당기준일로 하여 분기배당을 결정하였습니다. 배당금액은 보통주와 우선주 모두 1주당 7,000원으로 총 959,051백만원이며 2017년 11월 20일에 지급 예정입니다.

당사는 작성기준일 이후 2017년 11월 1일 프린팅솔루션 사업부문 양도 거래를 종결하였습니다.

9. 합병 등의 사후 정보

(1) 분할 내역

[프린팅솔루션 사업부문 분할]
・회사명 : 에스프린팅솔루션 주식회사
・소재지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
・대표이사 : 김기호
・분할방법 : 물적분할(분할후 에스프린팅솔루션 주식회사 신설)
・분할목적 : 프린팅솔루션 사업의 경쟁력 강화
・분할승인 : 2016년 10월 27일(임시주주총회 결의)
・분할기일 : 2016년 11월 1일

(단위 : 억원)

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도('17.3Q)	1차연도		2차연도('17.3Q)		
				실적	괴리율	실적	괴리율	
에스프린팅솔루션 주식회사	매출액	2,094	12,203	2,186	4.40%	12,195	△0.07%	
	영업이익	△29	561	△61	111.48%	577	2.85%	
	당기순이익	△67	554	△10	△84.72%	588	6.14%	

[△는 부(-)의 값임]

에스프린팅솔루션 주식회사 지분을 포함한 프린팅솔루션 사업부문 양도 거래가 2017년 11월 1일 종결되었습니다.

상기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

합병 등의 사후정보는 별도기준으로 작성되었습니다.

그 밖의 주요한 사업결합 및 사업매각 등의 내용은 연결재무제표 및 재무제표의 사업결합 주석과 매각예정분류(처분자산집단) 주석을 참조하시기 바랍니다.

10. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술 인증' 취득을 확대하고 있습니다.

(녹색기술 인증)

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제32조 제2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하는 기업활동을 목표로 하는 플래닛퍼스트(PlanetFirst) 전략으로 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과로서 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2017년 3분기말 현재 총 20건의 유효 녹색기술 인증을 확보하고 있습니다. 또한 인증을 받은 녹색기술이 적용된 상용화제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증에 대해 총 76건(621모델)을 취득하였습니다.

2017년 3분기말 현재 인증취득 녹색기술은 아래 표와 같습니다.

부분	사업부문	녹색기술 명칭	건수	비고
CE		Digital TV용 저전력 SoC설계 기술 등	15	
IM		주변 조도에 순응하는 펜타일 디스플레이 절전 기술 등	5	
합 계			20	

※ 본사기준으로 작성되었습니다.

온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 II. 사업의 내용의 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항(나. 환경관련 규제사항)을 참조하십시오.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계